

목 차

분기 보고서	1
【대표이사 등의 확인】	2
I. 회사의 개요	3
1. 회사의 개요	3
2. 회사의 연혁	3
3. 자본금 변동사항	3
4. 주식의 총수 등	3
5. 정관에 관한 사항	3
II. 사업의 내용	4
1. 사업의 개요	4
2. 주요 제품 및 서비스	6
3. 원재료 및 생산설비	7
4. 매출 및 수주상황	15
5. 위험관리 및 파생거래	20
6. 주요계약 및 연구개발활동	26
7. 기타 참고사항	31
III. 재무에 관한 사항	50
1. 요약재무정보	50
2. 연결재무제표	52
2-1. 연결 재무상태표	52
2-2. 연결 손익계산서	53
2-3. 연결 포괄손익계산서	54
2-4. 연결 자본변동표	54
2-5. 연결 현금흐름표	55
3. 연결재무제표 주식	56
1. 일반적 사항 (연결)	56
2. 중요한 회계처리방침 (연결)	64
3. 범주별 금융상품 (연결)	66
4. 공정가치금융자산 (연결)	67
5. 채고자산 (연결)	69
6. 관계기업 및 공동기업 투자 (연결)	69
7. 유형자산 (연결)	74
8. 무형자산 (연결)	75
9. 차입금 (연결)	76
10. 사채 (연결)	78
11. 순확정급여부채(자산) (연결)	79
12. 충당부채 (연결)	80
13. 우발부채와 약정사항 (연결)	82
14. 계약부채 (연결)	82
15. 자본금 (연결)	83
16. 연결이익잉여금 (연결)	84
17. 기타자본항목 (연결)	85
18. 비용의 성격별 분류 (연결)	86
19. 판매비와관리비 (연결)	87
20. 기타수익 및 기타비용 (연결)	88

21. 금융수익 및 금융비용 (연결).....	89
22. 법인세비용 (연결).....	90
23. 주당이익 (연결).....	90
24. 현금흐름표 (연결).....	91
25. 재무위험관리 (연결).....	93
26. 부문별 보고 (연결).....	104
27. 특수관계자와의 거래 (연결).....	105
28. 매각예정분류(처분자산집단) (연결).....	111
4. 재무제표.....	112
4-1. 재무상태표.....	112
4-2. 손익계산서.....	114
4-3. 포괄손익계산서.....	114
4-4. 자본변동표.....	115
4-5. 현금흐름표.....	115
5. 재무제표 주석.....	116
1. 일반적 사항.....	116
2. 중요한 회계처리방침.....	116
3. 범주별 금융상품.....	118
4. 공정가치금융자산.....	119
5. 재고자산.....	121
6. 관계기업 및 공동기업 투자.....	122
7. 유형자산.....	122
8. 무형자산.....	124
9. 차입금.....	125
10. 사채.....	126
11. 순확정급여부채(자산).....	127
12. 충당부채.....	128
13. 우발부채와 약정사항.....	130
14. 계약부채.....	131
15. 자본금.....	131
16. 이익잉여금.....	132
17. 기타자본항목.....	133
18. 비용의 성격별 분류.....	134
19. 판매비와관리비.....	135
20. 기타수익 및 기타비용.....	136
21. 금융수익 및 금융비용.....	137
22. 법인세비용.....	138
23. 주당이익.....	138
24. 현금흐름표.....	139
25. 재무위험관리.....	141
26. 부문별 보고.....	149
27. 특수관계자와의 거래.....	150
6. 배당에 관한 사항.....	174
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항.....	178
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적.....	178
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적.....	181
8. 기타 재무에 관한 사항.....	182

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견	206
V. 회계감사인의 감사의견 등	207
1. 외부감사에 관한 사항	207
2. 내부통제에 관한 사항	215
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	216
1. 이사회에 관한 사항	216
2. 감사제도에 관한 사항	216
3. 주주총회 등에 관한 사항	216
VII. 주주에 관한 사항.....	217
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	223
1. 임원 및 직원 등의 현황.....	223
2. 임원의 보수 등	273
IX. 계열회사 등에 관한 사항.....	274
X. 대주주 등과의 거래내용	275
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	279
1. 공시내용 진행 및 변경사항	279
2. 우발부채 등에 관한 사항	279
3. 제재 등과 관련된 사항	282
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항	283
XII. 상세표	284
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)	284
2. 계열회사 현황(상세)	284
3. 타법인출자 현황(상세).....	284
4. 연구개발실적(상세)	285
【 전문가의 확인 】	310
1. 전문가의 확인.....	310
2. 전문가와의 이해관계	310

분기보고서

(제 56 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 09월 30일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2024년 11월 14일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

삼성전자주식회사

대 표 이 사 :

한 종 희

본 점 소 재 지 :

경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)

(전 화) 031-200-1114

(홈페이지) <http://www.samsung.com/sec>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재경팀장 (성 명) 김 동 욱

(전 화) 031-277-7218

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서
2024년 3분기 보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여
직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의
누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된
기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이
기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조의 규정에
따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2024. 11. 14

삼성전자 주식회사

대표이사: 한 중 회



신고업무 담당임원: 박 학 규



I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

2. 회사의 연혁

회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(사업보고서 등에 기재 예정)

3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(사업보고서 등에 기재 예정)

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

5. 정관에 관한 사항

정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄 및 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인, SDC 및 Harman 산하 종속기업 등 229개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업별로 보면, Set 사업은 DX(Device eXperience) 부문이 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, PC 등을 생산·판매하며, 부품 사업은 DS(Device Solutions) 부문에서 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산·판매하고, SDC가 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산·판매하고 있습니다. 또한, Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 카오디오 등 전장제품과 포터블/사운드바 스피커 등 소비자오디오 제품 등을 생산·판매하고 있습니다.

☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '다. 사업부문별 현황'과 '라. 사업부문별 요약 재무 현황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

지역별로 보면, 국내에서는 DX 부문 및 DS 부문 등을 총괄하는 본사와 32개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다. 본사는 수원, 구미, 광주, 기흥, 화성, 평택사업장 등으로 구성되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이(주)와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매(주), 제품 수리 서비스를 담당하는 삼성전자서비스(주), 제품 운송을 담당하는 삼성전자로지텍(주) 등 비상장 종속기업들로 구성되어 있습니다.

해외(미주, 유럽·CIS, 중동·아프리카, 아시아 등지)에서는 생산, 판매, 연구활동 등을 담당하는 197개의 비상장 중속기업이 운영되고 있습니다.

미주에는 TV, 스마트폰 등 Set 제품의 미국 판매를 담당하는 SEA(New Jersey, USA), TV 생산을 담당하는 SII(California, USA), 반도체·디스플레이 패널 판매를 담당하는 SSI(California, USA), 반도체 생산을 담당하는 SAS(Texas, USA), Set 제품 복합 생산법인 SEDA(Brazil), 전장부품사업 등을 담당하는 Harman(Connecticut, USA) 등을 포함하여 총 47개의 판매·생산 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽·CIS에는 SEUK(UK), SEG(Germany), SEF(France), SEI(Italy) 등 Set 제품 판매법인과 SEH(Hungary) 등 TV 생산법인, 가전제품 생산법인 SEPM(Poland) 등을 포함하여 총 68개의 법인이 운영되고 있습니다.

중동·아프리카에는 SGE(UAE), SSA(South Africa) 등 Set 제품 판매법인과 SEEG(Egypt), SSAP(South Africa) 등 TV 생산법인을 포함한 총 21개 법인이 운영되고 있습니다.

아시아(중국 제외)에는 SESP(Singapore), SEAU(Australia), SEPCO(Philippines), SME(Malaysia) 등 판매법인과 스마트폰 등 생산법인 SEV·SEVT(Vietnam), TV 등 생산법인 SEHC(Vietnam), 디스플레이 패널 생산법인 SDV(Vietnam), 복합 생산법인 SIEL(India) 등을 포함한 총 32개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국에는 SCIC(Beijing), SEHK(Hong Kong) 등 Set 제품 판매법인과 SSS(Shanghai), SSCX(Xian) 등 반도체·디스플레이 패널 판매법인, SSEC(Suzhou) 등 Set 제품 생산법인, SCS(Xian) 등 반도체 생산법인을 포함하여 총 29개의 법인이 운영되고 있습니다.

2024년 3분기 당사의 매출은 225조 826억원으로 전년 동기 대비 17.7% 증가하였으며, 주요 매출처로는 Apple, Deutsche Telekom, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics, Verizon 등(알파벳순)이 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰 등 완제품과 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 반도체 부품 및 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산·판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등을 생산·판매하고 있습니다.

2024년 3분기 매출은 DX 부문이 134조 3,575억원(59.7%), DS 부문이 80조 9,652억원(36.0%)이며, SDC가 21조 317억원(9.3%), Harman은 10조 3,489억원(4.6%)입니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	주요 제품	매출액	비중
DX 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, PC 등	1,343,575	59.7%
DS 부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	809,652	36.0%
SDC	스마트폰용 OLED패널 등	210,317	9.3%
Harman	디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등	103,489	4.6%
기타	부문간 내부거래 제거 등	△216,207	△9.6%
총 계		2,250,826	100.0%

※ 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

2024년 3분기 TV의 평균 판매가격은 전년 연간 평균 대비 약 2% 하락하였으며, 스마트폰은 전년 연간 평균 대비 약 3% 상승하였습니다. 그리고 메모리 평균 판매가격은 전년 연간 평균 대비 약 55% 상승하였으며, 스마트폰용 OLED 패널은 약 29% 하락하였습니다. 한편 디지털 콕핏의 평균 판매가격은 전년 연간 평균 대비 약 1% 상승하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 현황

당사의 주요 원재료로 DX 부문은 모바일AP 솔루션, Camera Module 등을 Qualcomm, 삼성전기(주) 등에서 공급받고 있으며, TV·모니터용 디스플레이 패널 등을 CSOT 등으로부터 공급받고 있습니다. DS 부문은 Chemical, Wafer 등을 솔브레인(주), SK실트론(주) 등으로부터, SDC는 FPCA, Cover Glass 등을 (주)비에이치, Apple 등으로부터 공급받고 있습니다. Harman은 MCU(Micro Controller Unit)를 포함한 SOC(System-On-Chip), 통신 모듈 등을 NVIDIA, WNC 등에서 공급받고 있습니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	품 목	구체적 용도	매입액	비중	주요 매입처
DX 부문	모바일AP 솔루션	CPU	87,051	16.6%	Qualcomm, MediaTek
	디스플레이 패널	TV·모니터용 화면표시장치	59,019	11.2%	CSOT, SDP 등
	Camera Module	스마트폰 카메라	42,741	8.1%	삼성전기(주), 파트론 등
	기타	-	336,932	64.1%	
	소 계			525,743	100.0%
DS 부문	Chemical	원판 가공	20,179	16.4%	솔브레인(주), 동우화인켐(주) 등
	Wafer	반도체 원판	16,186	13.1%	SK실트론(주), SILTRONIC 등
	기타	-	86,945	70.5%	
	소 계			123,310	100.0%
SDC	FPCA	구동회로	18,631	20.0%	(주)비에이치, 씨유테크 등
	Cover Glass	강화유리	12,131	13.0%	Apple, LENS 등
	기타	-	62,364	67.0%	
	소 계			93,126	100.0%
Harman	SOC(System-On-Chip)	CPU	5,628	10.0%	NVIDIA, Intel 등
	통신 모듈	차량 통신	3,330	5.9%	WNC(Wistron NeWeb Corp.) 등
	기타	-	47,503	84.1%	
	소 계			56,461	100.0%
기타	-	-	297	-	
총 계			798,937	-	

※ 매입액은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있지 않습니다.

※ 비중은 각 부문의 원재료 총매입액 대비 각 품목의 매입액 비중입니다.

※ 주요 매입처 중 삼성전기(주)는 계열회사입니다.

나. 주요 원재료 가격 변동 추이

DX 부문의 주요 원재료인 모바일AP 솔루션 가격은 전년 연간 평균 대비 약 6% 상승하였고, Camera Module은 약 4% 상승, TV·모니터용 디스플레이 패널은 약 11% 상승하였습니다. DS 부문의 주요 원재료 중 반도체 Wafer 가격은 전년 대비 약 3% 하락하였으며, SDC의 FPCA 가격은 약 23% 하락, 강화유리용 Cover Glass 가격은 약 26% 하락하였습니다. Harman의 원재료 중 SOC(System-On-Chip) 가격은 약 5% 하락하였으며, 통신 모듈은 약 9% 하락하였습니다.

※ 원재료 가격은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있습니다.

다. 생산능력, 생산실적, 가동률

(생산능력)

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제56기 3분기	제55기	제54기
DX 부문	TV, 모니터 등	38,533	53,552	55,747
	스마트폰 등	199,650	284,700	332,170
DS 부문	메모리	1,693,103,022	1,926,651,546	1,905,731,836
SDC	디스플레이 패널	1,688	2,320	2,700
Harman	디지털 콕핏	6,681	10,912	11,257

※ 생산능력은 주요 제품의 연결 기준입니다.

DX 부문의 주요 품목별 생산능력은 '평균 라인 수'×'시간당 평균 생산실적'×'일 평균 가동시간'×'표준 가동일수'로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1Gb환산 기준으로 환산 생산실적(패키지OUT 기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있습니다. SDC의 경우 라인별 생산 가능한 제품의 총 면적을 8세대 Glass(2,200×2,500mm)로 환산하고 있으며, Harman의 디지털 콕핏 생산능력은 '각 거래처·제품별 생산셀(조립, 테스트) 수'×'각 생산셀별 시간당 생산능력'×'1일 표준 생산시간'×'표준생산일수'로 산출하였습니다.

(생산실적)

2024년(제56기) 3분기 DX 부문의 TV, 모니터 등 생산실적은 31,052천대이며 멕시코, 베트남, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있습니다. 스마트폰 등 생산실적은 147,714천대이며 한국(구미), 베트남, 인도, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS 부문의 메모리 생산실적은 1,693,103백만개(1Gb 환산 기준)이며 한국(화성, 평택 등), 중국에서 생산하고 있습니다. SDC의 디스플레이 패널 생산실적은 1,291천개(8세대 Glass 환산 기준)이며 한국(천안, 아산) 등에서 생산 중입니다. Harman의 디지털 콕핏 생산실적은 4,673천개이며, 주로 멕시코, 헝가리, 중국 등에서 생산되고 있습니다.

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제56기 3분기	제55기	제54기
DX 부문	TV, 모니터 등	31,052	40,085	41,802
	스마트폰 등	147,714	189,991	229,180
DS 부문	메모리	1,693,103,022	1,926,651,546	1,905,731,836
SDC	디스플레이 패널	1,291	1,407	2,008
Harman	디지털 콕핏	4,673	7,658	8,334

※ 생산실적은 주요 제품의 연결 기준입니다.

(가동률)

당사 DX 부문의 2024년(제56기) 3분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, TV, 모니터 등은 80.6%, 스마트폰 등은 74.0%입니다.

(단위 : 천대)

부 문	품 목	제56기 3분기		
		생산능력 대수	실제 생산 대수	가동률
DX 부문	TV, 모니터 등	38,533	31,052	80.6%
	스마트폰 등	199,650	147,714	74.0%

DS 부문의 메모리 사업과 SDC의 디스플레이 패널 사업은 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 2024년(제56기) 3분기 가동일은 휴일을 포함하여 총 274일입니다. 가동률은 생산라인별 가동 가능시간 (가동일 × 생산라인 수 × 24시간) 대비 실제 가동 시간으로 산출하였습니다.

(단위 : 시간)

부 문	품 목	제56기 3분기		
		가동 가능 시간	실제 가동 시간	가동률
DS 부문	메모리	65,760	65,760	100.0%
SDC	디스플레이 패널	32,880	32,880	100.0%

Harman의 2024년(제56기) 3분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며 69.9%입니다.

(단위 : 천개)

부 문	품 목	제56기 3분기		
		생산능력 개수	실제 생산 개수	가동률
Harman	디지털 콕핏	6,681	4,673	69.9%

라. 생산설비 및 투자 현황 등

(생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등)

당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 광주, 화성, 평택, 아산 등 국내사업장 및 북미, 구주(유럽), 중국 등 해외 DX 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄, SDC 및 Harman 산하 중속기업 등에서 주요 제품의 생산, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업 활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지
국내 (DX 부문, DS 부문, SDC 산하 12개 사업장)	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)
	우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33(우면동)
	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)
	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1(반월동)
	평택사업장	경기도 평택시 삼성로 114(고덕동)
	천안사업장	충청남도 천안시 서북구 변영로 465 (성성동)
	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158 (북수리)
	아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181 (명암리)
	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244(공단동)
	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302(임수동)
	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107(오선동)
해외 (DX 부문 산하 9개 지역총괄)	북미 총괄	85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA
	구주 총괄	2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK
	중국 총괄	No.31, Jinghui Street, Chaoyang, Beijing, China
	동남아 총괄	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore
	서남아 총괄	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India
	CIS 총괄	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia
	중동 총괄	7421 King Fahd Road Al Olaya Dist, Riyadh 12212, KSA
	아프리카 총괄	2929 William Nicol Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa
해외 (DS 부문 산하 5개 지역총괄)	미주 총괄	3655 N. 1st St. San Jose, California, USA
	구주 총괄	Einsteinstrasse 174, 81677, Munich, Germany
	중국 총괄	3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China
	동남아 총괄	3 Church Street, #26-01 Samsung Hub, Singapore
	일본 총괄	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo, Japan
Harman	미국 HQ	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	30001 Cabot Drive, Novi, Michigan, USA
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany

Harman Consumer Nederland B.V.	16 Danzigerkade, 1013 AP, Amsterdam, Netherlands
-----------------------------------	--------------------------------------------------

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2024년 3분기말 현재 장부금액은 195조 288억원으로 전년말 대비 7조 7,725억원 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

구분	토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	계	
기초	기초장부금액	99,994	432,381	833,092	467,203	39,893	1,872,563
	- 취득원가	101,580	736,899	3,285,615	467,203	140,587	4,731,884
	- 감가상각누계액 (손상 포함)	△1,586	△304,518	△2,452,523	-	△100,694	△2,859,321
증감	일반취득 및 자본적지출	1,382	64,265	340,670	△53,033	15,219	368,503
	감가상각	△376	△31,587	△245,538	-	△11,655	△289,156
	처분·폐기·손상	△145	△4,571	△1,101	△494	△237	△6,548
	기타	98	3,532	3,833	△2,005	△532	4,926
기말	기말장부금액	100,953	464,020	930,956	411,671	42,688	1,950,288
	- 취득원가	102,626	799,461	3,630,425	411,671	148,376	5,092,559
	- 감가상각누계액 (손상 포함)	△1,673	△335,441	△2,699,469	-	△105,688	△3,142,271

※ 토지의 감가상각은 기업회계기준서 제1116호 '리스'에 따른 사용권자산의 감가상각비입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.

(시설투자 현황)

2024년 3분기 DS 부문 및 SDC 등의 첨단공정 증설·전환과 인프라 투자를 중심으로 35.8조원의 시설투자가 이루어졌습니다. 당사는 DRAM 차세대 기술 경쟁력 강화 및 중장기 수요 대비를 위한 투자를 지속 추진하였고, 시스템 반도체는 Advanced 노드 Capa 확보를 위한 투자도 진행 중입니다. 내실을 다지는 활동을 통해 투자 효율성 제고에도 집중할 계획입니다.

(단위 : 억원)

구분	내 용	투자기간	대상자산	투자액
DS 부문	신·증설, 보완 등	2024.01~2024.09	건물·설비 등	303,111
SDC	신·증설, 보완 등	2024.01~2024.09	건물·설비 등	38,654
기 타	신·증설, 보완 등	2024.01~2024.09	건물·설비 등	16,644
합 계				358,409

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

2024년 3분기 매출은 225조 826억원으로 전년 동기 대비 17.7% 증가하였습니다. 부문별로 보면 전년 동기 대비 DX 부문이 3.0%, DS 부문이 80.3% 증가하였고, SDC는 1.3%, Harman은 1.1% 감소하였습니다.

(단위 : 억원)

부 문	매출유형	품 목	제56기 3분기	제55기	제54기
DX 부문	제·상품, 용역 및 기타매출	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, PC 등	1,343,575	1,699,923	1,824,897
DS 부문	제·상품, 용역 및 기타매출	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	809,652	665,945	984,553
SDC	제·상품, 용역 및 기타매출	스마트폰용 OLED 패널 등	210,317	309,754	343,826
Harman	제·상품, 용역 및 기타매출	디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등	103,489	143,885	132,137
기 타	부문간 내부거래 제거 등		△216,207	△230,152	△263,099
합 계			2,250,826	2,589,355	3,022,314

※ 각 부문별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

[△는 부(-)의 값임]

(1) 주요 제품별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제56기 3분기	제55기	제54기
TV, 모니터 등	223,594	303,752	332,795
스마트폰 등	894,130	1,086,325	1,154,254
메모리	615,054	441,254	685,349
디스플레이 패널	210,317	309,754	343,826

※ 각 제품별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

(2) 매출유형별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제56기 3분기	제55기	제54기
제·상품	2,167,263	2,461,380	2,903,461
용역 및 기타매출	83,563	127,975	118,853
계	2,250,826	2,589,355	3,022,314

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 주요 지역별 매출 현황

(단위 : 억원)

구 분		제56기 3분기	제55기	제54기
내수	국내	165,934	205,196	221,799
	수출			
	미주	461,333	510,934	659,617
	유럽	226,537	239,342	265,147
	아시아·아프리카	259,949	326,262	425,114
	중국	494,274	422,007	546,998
계		1,608,027	1,703,741	2,118,675

※ 별도 기준의 내수·수출 매출 현황입니다.

나. 판매경로 등

(1) 국내

판매자	판매 경로	소비자
생산 및 매입	전속 대리점	소비자
	유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등)	
	통신사업자(SK텔레콤(주), (주)케이티, (주)LG유플러스)	
	직접판매(B2B 및 온라인)	

(2) 해외

판매자	판매 경로			소비자		
생산법인	판매법인	Retailer			소비자	
		Dealer		Retailer		
		Distributor	Dealer	Retailer		
		통신사업자, Automotive OEM				
		직접판매(B2B 및 온라인)				
	물류법인	판매법인	Retailer			
			Dealer			Retailer
			Distributor	Dealer		Retailer

(3) 판매경로별 매출액 비중

경로	도매	소매	특직판	기타
비중	16%	25%	50%	9%

다. 판매방법 및 조건

(1) 국내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
전속	대리점	약정여신조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
유통업체	양판점, 할인점, 백화점, 홍쇼핑, 온라인 등	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
통신사업자	SK텔레콤(주), (주)케이티, (주)LG유플러스	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담 (공동마케팅)
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없음

(2) 해외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
Retailer	소매점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Dealer	양판점, 할인점, 백화점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Distributor	현지 거래처 직판 영업	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없음

라. 판매전략

- 프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화
- 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
- 고객 · 시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

마. 주요 매출처

2024년 3분기 당사의 주요 매출처로는 Apple, Deutsche Telekom, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics, Verizon 등(알파벳순)입니다. 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 15% 수준입니다.

바. 수주상황

2024년 3분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리정책

당사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다.

재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다.

당사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

나. 주요 재무위험관리

(1) 시장위험

(환율변동위험)

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.

당사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 당사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한, 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

(이자율변동위험)

이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인해 투자 및 재무 활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 내부자금 공유를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.

(주가변동위험)

당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

2024년 3분기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 69,740백만원(전분기: 65,826백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 1,060백만원(전분기: 3,519백만원)입니다.

(2) 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험이 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.

당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.

(3) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 당사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

당사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다.

또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.

(4) 자본위험

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제56기 3분기말	제55기말
부 채	105,025,954	92,228,115
자 본	386,281,363	363,677,865
부채비율	27.2%	25.4%

다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 환율변동 위험관리 목적상 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도 (Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다. 통화선도 상품은 매매목적 및 위험회피목적으로 은행을 통하여 매수 또는 매도하고 있습니다.

2024년 3분기말 현재 당사는 USD, EUR 등 총 32개 통화에 대하여 4,876건의 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 자산·부채 장부금액 및 관련손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	자산	부채	이익	손실
통화선도	60,497	94,661	665,199	528,177

그리고 당사는 레인보우로보틱스(주) 및 그 최대주주 등과 체결한 주주간 계약에 따라, 일정 기간 동안 최대주주 등에게 최대주주 등이 보유하는 주식의 전부 또는 일부를 당사 또는 당사가 지정한 제3자에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 또한 레인보우로보틱스(주)의 최대주주 등은 일정한 사유가 발생할 경우, 당사가 보유한 레인보우로보틱스(주) 지분의 전부 또는 일부를 최대주주 등에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 2024년 3분기말 현재 해당 콜옵션의 공정가치는 안진회계법인이 평가하였습니다.

또한, 종속회사인 삼성디스플레이(주)는 Corning Incorporated와 2021년 4월 8일 실행된 주식매매계약에 따라, 보유 중인 Corning 지분증권 일부를 Corning에게 매각할수 있는 풋옵션을 보유하고 있으며, TCL Technology Group Corporation (TCL) 및 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)와 2021년 4월 1일 실행된 주주간 계약에 따라 CSOT가 상장기한 내 비상장 시, 삼성디스플레이(주)가 보유 중인 CSOT 지분증권 전부 또는 일부를 TCL에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다. 2024년 3분기말 현재 상기 풋옵션들 공정가치는 한영회계법인이 평가하였습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등

계약 상대방	항 목	내 용
Google	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2014.01.25
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	영구 라이선스 계약 (향후 10년간 출원될 특허까지 포함)
GlobalFoundries	계약 유형	공정 기술 라이선스 계약
	체결시기	2014.02.28
	목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대
Google	계약 유형	EMADA
	체결시기 및 기간	2019.02.27~2024.12.31(연장)
	목적 및 내용	유럽 32개국(EEA) 대상으로 Play Store, YouTube 등 구글 앱 사용에 대한 라이선스 계약
Ericsson	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2021.05.07
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
Qualcomm	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2022.07.06
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 · 부제소를 통한 사업 자유도 확보
Huawei	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2022.07.13
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
Nokia	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2023.01.19
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보

※ 기타 영업기밀에 해당하는 사항은 기재하지 않았습니다.

나. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품, 미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다. 또한, 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도 기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

2024년(제56기) 3분기 당사의 연구개발비용은 24조 7,465억원이며, 이 중 정부보조금으로 차감되거나 자산화된 연구개발비를 제외하고 24조 7,361억원을 당기비용으로 회계처리하였습니다.

[연구개발비용]

(단위 : 백만원, %)

과 목		제56기 3분기	제55기	제54기
연구개발비용 총계		24,746,494	28,352,769	24,929,171
(정부보조금)		△10,371	△13,045	△9,973
연구개발비용 계		24,736,123	28,339,724	24,919,198
회계 처리	개발비 자산화(무형자산)	-	-	-
	연구개발비(비용)	24,736,123	28,339,724	24,919,198
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계 ÷ 당기매출액 × 100]		11.0%	10.9%	8.2%

※ 연결 누계기준입니다.

※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.

[△는 부(-)의 값임]

다. 연구개발 조직 및 운영

(국내)

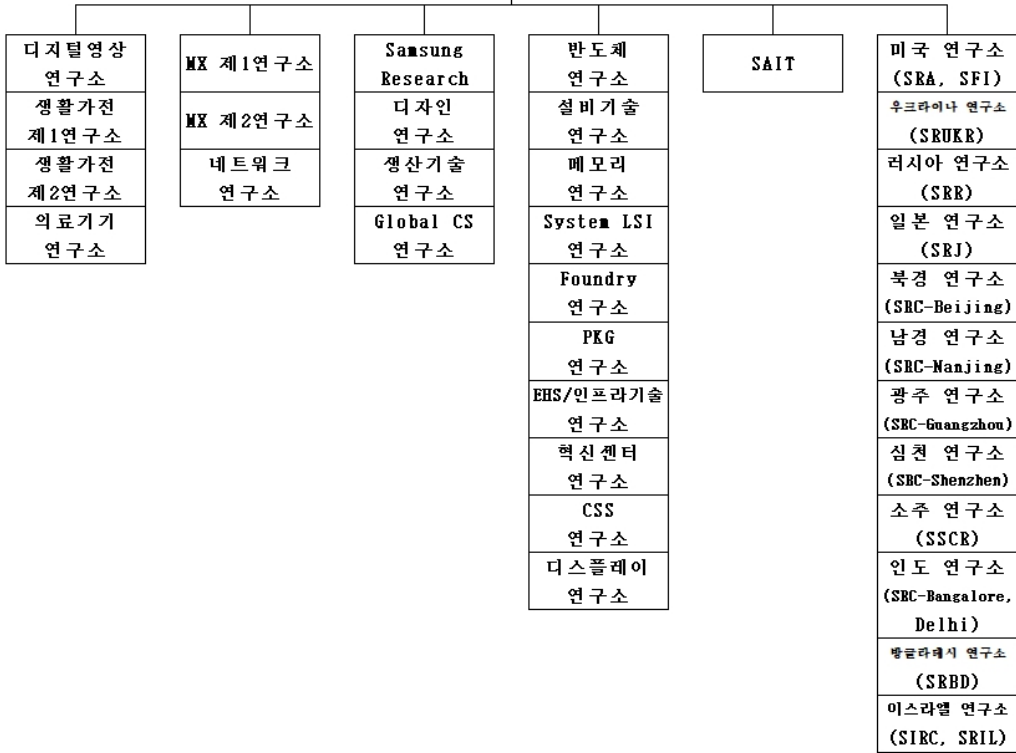
당사는 연구개발 조직을 기술 상용화 시기에 따라 3단계로 체계화하여 운영하고 있습니다.

향후 1~2년 내 시장에 선보일 상품화 기술은 각 부문 산하 사업부 개발팀에서 개발하고 있으며, 3~5년 내 중장기 미래 유망 기술은 Samsung Research, 반도체연구소 등의 각 부문 연구소에서 개발하고 있습니다. 또한, 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술은 당사의 종합 연구소인 SAIT에서 선행 개발하고 있습니다. SAIT는 전사 차원에서 유망 성장 분야에 대한 연구개발 방향 제시와 주력 사업의 기술 경쟁력 강화, 창의적 R&D 체제를 구축하기 위한 연구개발 활동을 수행하고 있습니다.

(해외)

미국(SRA, SFI), 우크라이나(SRUKR), 러시아(SRR), 일본(SRJ), 중국(SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Guangzhou, SRC-Shenzhen, SSCR), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 방글라데시(SRBD), 이스라엘(SIRC, SRIL) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품 개발 및 기초 기술 연구 등을 진행하고 있습니다.

代表理事



라. 연구개발실적

2024년 3분기 중 당사의 각 부문별 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

부문	연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	Galaxy 폴더블	<ul style="list-style-type: none"> Galaxy Z Fold6 출시 Galaxy Z Flip6 출시
	Galaxy S24	Galaxy S24 · S24+ · S24 Ultra 출시
	Galaxy A	<ul style="list-style-type: none"> Galaxy A55 5G 출시 Galaxy A35 5G 출시 Galaxy A25 5G 출시 Galaxy A15 LTE · 5G 출시
	Galaxy북	<ul style="list-style-type: none"> Galaxy Book4 Ultra 출시 Galaxy Book4 Pro 360 출시 Galaxy Book4 Pro 출시 Galaxy Book4 Edge 출시
	Neo QLED 8K	Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV 출시
	Neo QLED 4K	Mini LED 기반 4개 시리즈, 7개 사이즈 출시
	냉장고	<ul style="list-style-type: none"> Peltier 적용 에너지효율 초절전 BESPOKE AI 하이브리드 냉장고 출시 오토 오픈 도어 'BESPOKE AI 감치플러스' 출시
	세탁기	세탁건조기 BESPOKE AI 콤보 출시
	청소기	한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 출시
	RAN S/W Package	업계 최초 vRAN 기반 5G RedCap Energy-saving 기술 기능시험 완료
	기지국	고출력/고효율 신규 MMU(다중 안테나를 활용한 대용량 데이터 전송이 가능한 기지국) 개발
DS 부문	모바일 DRAM	업계 최고 속도 LPDDR5X 동작 검증 성공
	HBM	업계 최초 36GB HBM3E 12H D램 개발
	NAND	업계 최초 '9세대 V낸드' 양산
	Automotive	업계 최초 8세대 V낸드 기반 차량용 SSD 개발
	이미지센서	업계 최초 망원용 2억화소 모바일 이미지 센서 'HP9' 공개
	엑시노스	최신 기술 적용 웨어러블 SOC '엑시노스 W1000' 공개
SDC	OLED	<ul style="list-style-type: none"> Galaxy S24 AMOLED 개발 BMW Mini 13.4" Round OLED Display 적용 Surface Pro 10 출시 Galaxy Z Fold6 용 폴더블 OLED 개발 Google Pixel 9 Pro XL 용 OLED 개발
	QD-Display	31.5"UHD, 27"QHD, QD-OLED 개발

※ 상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련

당사는 R&D 활동의 지적재산화에도 집중하여 1984년 최초로 미국에 특허를 등록한 이래 현재 세계적으로 총 260,602건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

[국가별 등록 건수(2024년 3분기말 현재, 연결 기준)]

(단위 : 건)

구분	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가	계
등록건수	60,782	97,662	46,969	27,471	8,883	18,835	260,602

2024년 3분기 중 총 24.7조원의 R&D투자를 통해 국내 특허 5,478건, 미국 특허 6,981건을 등록하였습니다.

[주요 국가 연도별 특허등록 건수]

(단위 : 건)

구분	2024년 3분기	2023년	2022년
한국	5,478	8,908	9,136
미국	6,981	8,958	8,500

이 지적재산권은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로서 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 유사 기술·특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 확보를 통하여 향후 신규 사업 진출 시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 Google(2014.01.체결), Ericsson(2021.05.), Qualcomm(2022.07.), Huawei(2022.07.), Nokia(2023.01.) 등과의 특허 라이선스 체결을 통하여, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.

당사는 상기 특허뿐만 아니라 스마트폰, 스마트 TV 등에 적용된 당사 고유 디자인을보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여, 2024년 3분기 중 미국에서 372건의 디자인특허(Design Patent)를 취득하였습니다.

나. 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저히 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전 과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향을 최소화하기 위한 활동을 하고있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 협력회사 에코파트너 인증 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원 사용 절감, 에너지 절약, 유해 물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 에코디자인 평가 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 폐제품 회수·재활용시스템을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기·전자 제품 관련 국내외 환경 법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 폐제품 회수·재활용법 (예: EU WEEE Directive)
2. 유해물질 사용 제한 (예: EU RoHS Directive, REACH Regulation)
3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생하는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기오염방지시설, 수질 오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증(ISO 14001, ISO 45001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

주요한 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 환경오염물질 배출 규제: 「물환경보전법」 「대기환경보전법」 「폐기물관리법」 「소음·진동관리법」 「환경영향평가법」 등
2. 온실가스 배출 관리: 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 「기후위기대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법」 등
3. 기타 사업장환경관리법: 「화학물질관리법」 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 「악취방지법」 「토양환경보전법」 등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 국내에서 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법」 제27조(관리업체의 온실가스 목표관리)에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제27조 3항 및 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제24조(배출량의 보고 및 검증)에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사의 국내 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO₂-eq, TJ)

구 분	2023년	2022년	2021년
온실가스(tCO ₂ -eq)	17,337,196	19,285,537	19,267,217
에너지(TJ)	301,616	290,024	274,297

- ※ 정부에 신고된 본사 및 자회사 포함 기준입니다.
- ※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.
- ※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.
- ※ 배출량 및 에너지사용량은 정부의 적합성 평가 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다.

다. 사업부문별 현황

[DX 부문]

(산업의 특성 등)

1) TV산업

TV 산업은 1926년 흑백 TV, 1954년 컬러 TV 등장 이후 지금까지, 평면 TV(LCD),스마트 TV, 초대형 TV(OLED/QLED/Neo QLED/8K), 마이크로 LED 등으로 발전하면서 최고 화질을 제공하기 위한 혁신활동들이 지속적으로 일어나는 분야입니다.

TV에는 칩 설계, 회로개발, 화질/신호처리, AI 화질 기술 뿐만 아니라, 플랫폼과 어플리케이션이 잘 작동되도록 하는 운영체제(Operating System)와 각종 S/W 기술들이 적용됩니다. 최근들어 IoT 기술 발전으로 TV를 통해 제어할 수 있는 가정 내 전자기기들이 증가하고 있어서 스크린 허브 기능이 더욱 부각되고 있습니다.

TV업계는 마이크로 LED, Neo QLED, OLED 기술을 적용하여 최고 화질을 구현하는 제품 경쟁을 치열하게 하고 있습니다. 과거 55~65인치대가 주력이던 TV 시장은 이제 75인치 이상 98인치까지 초대형 제품들이 성장을 주도합니다. 4K 화질을 넘어서 8K 화질을 갖춘 제품이 새로운 시장을 열어가고 있으며, HD, FHD급 기존 화질을 고화질로 자동 업스케일하는 기술도 제품에 적용되고 있습니다.

TV업계는 AI 기술도 대거 채택하여 미래형 TV의 모습을 만들어 나가고 있습니다. 업체들마다 AI 관련 기술을 제품에 접목하기 위해 AI 반도체(System on Chip)는 물론 화질과 음질을 최적화하고, AI 기술을 활용하여 저화질 콘텐츠를 고화질로 업스케일링하는 기능도 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 기술력을 통해 TV는 집안내 가전 제품들을 연결하고 실시간으로 모니터링할 뿐만 아니라, 전력사용 최적화나 긴급상황 발생시 알람 서비스 등 새로운 서비스들을 제공하게 됩니다.

한편 TV 사용자들의 인식도 지난 수년간의 팬더믹 시기를 거치면서 크게 변화하고 있습니다. . 사용자들은 TV를 통해 영화를 보고 뉴스를 시청하는 것 뿐만 아니라, 전세계 미술관의 예술작품들을 다운로드받아서 감상한다거나, 게임과 헬스케어, 화상회의와 온라인 교육과 같은 새로운 서비스를 체험하는데 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 자기만의 개성을 추구하는 구매자들을 위해 디자인과 이동설치성, 주변기기들과의 연동성을 강조한 라이프스타일 제품 군도 매년 새롭게 출시되면서 틈새 시장이 빠르게 확대되고 있습니다.

2) 모바일 산업

모바일 산업은 1980년대 초 음성통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동 통신으로 발전하였습니다. 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 전 세계로 확산되었으며, 2019년 초 5세대 이동통신 5G 서비스가 한국과 미국을 시작으로 글로벌 상용화되었습니다. 5G 스마트폰은 2020년 2.7억대에서 2024년에는 8.7억대로 판매가 확대될 전망입니다. 이러한 5G의 확산은 AI·XR·자율주행 등 5G 융합 서비스 및 기반 산업의 생태계 조성을 가속화하고 있습니다(출처: TechInsights 2024.09).

스마트폰 시장은 2007년 이후 큰 폭으로 성장하여 2024년 전체 휴대폰 판매량 중 스마트폰의 비중은 86% 수준, 피쳐폰의 비중은 일부 신흥 시장에서의 수요로 인해 14% 수준으로 전망됩니다(출처: TechInsights 2024.09). 또한 스마트폰 보급률은 2023년 52.5%에서 2024년 53.1%로 소폭 증가할 것으로 전망됩니다(출처: TechInsights 2024.06).

스마트폰 시장이 성숙함에 따라 고성능 AP, 고화질 Display, 폴더블 폼팩터, 멀티카메라, 센서, 방수·방진, 생체 인식 등과 같은 하드웨어뿐만 아니라 플랫폼기반의 Application, UX, Game, Media, Digital Wallet, AI, 보안 등 전반적인 소프트웨어 기반 경험 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

1) TV산업

TV 시장 수요는 글로벌 경기 불확실성에 따른 소비심리 악화 영향으로 2022년 2억 328만대에서 2023년 2억 139만대 수준으로 소폭 감소하였습니다. 2024년은 파리올림픽 등 스포츠 이벤트에 따른 수요 확대 기대감으로 전년비 1.2% 성장한 2억 380만대를 기록할 것으로 전망됩니다. (출처: Omdia 2024.09)

< TV 시장점유율 추이 >

제 품	2024년 3분기	2023년	2022년
TV	28.9%	30.1%	29.7%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.
(2024년 3분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.)

2) 모바일 산업

스마트폰 시장은 경기 회복 기대에 따른 소비심리 상승과 AI 제품·서비스 확대 등으로 인해 2023년 11.5억대에서 2024년 12억대 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다(출처: TechInsights 2024.09). 태블릿 시장은 코로나19(COVID-19)의 영향에 따른 비대면 수요 증가로 2021년 1.8억대로 성장한 후, 교체 수요 감소 등으로 2023년 1.4억대 수준으로 역성장 하였으나 2024년에는 교체 주기 도래에 따라 수요가 1.5억대 수준으로 회복될 전망입니다(출처: TechInsights 2024.08).

< 스마트폰 시장점유율 추이 >

제 품	2024년 3분기	2023년	2022년
스마트폰	19.2%	19.7%	21.7%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 TechInsights의 세계시장점유율 자료(수량 기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

1) TV산업

당사는 2006년 이후 2023년까지 18년 연속으로 TV 판매 1위를 달성하고 있습니다. 이 기간 동안 전세계 TV 시장을 살펴보면, 249백만대를 기록한 2011년까지는 지속성장했으나, 2012년(233백만대)부터 2023년(201백만대) 까지 지속적으로 감소 추세입니다. 반면, 당사는 신제품의 적기 출시 및 마케팅 경쟁력 강화를 통해 전세계 시장점유율을 2006년 14.2%에서 2023년 30.1%로 확대했습니다.

올해 TV 시장은 75인치 이상 초대형 TV와 1,500불 이상 프리미엄 TV군이 성장을 주도하고 있습니다. 특히 북미와 유럽, 한국, 동남아, 중국 등지에서 강세를 보이고 있는데, 업체들 간 경쟁이 점점 더 치열해 지고 있고, 패널가격 상승세도 지속 중이어서 수익성 확보에 어려움이 가중되고 있습니다.

당사는 이러한 위기를 기회요인으로 판단하고, 8K해상도의 98인치 초대형 TV를 선두로 해서, Neo QLED, OLED, QLED 주력제품과 라이프스타일 TV, 사운드바 등 사업군에 AI 신기술을 대거 적용, 경쟁사와의 기술격차를 크게 벌려 나가고 있습니다.

24년형 Neo QLED 8K TV에 탑재된 '8K AI 업스케일링 프로(8K Upscaling Pro)'는 삼성 반도체와 AI기술을 사용하여 SD/HD/Full HD 등과 같은 저해상도 영상을 8K급으로 향상시킵니다. 음질 부분에서도 AI 기술을 적극 도입하여, 영화내 대화를 인식해 소음과 분리한 후 화자의 목소리를 또렷하게 조정하거나, 물체의 움직임에 따라 입체적 사운드를 구현하는 기능들이 가능하게 되었습니다.

또한, AI TV는 휴대폰, 사운드바를 비롯한 집안의 다양한 가전기기들과 손쉽게 연결되어 TV만의 서비스가 아니라 새로운 가치와 경험들도 선사합니다. TV와 연결된전자기기들의 에너지 사용량을 제어하여 최적화할 수도 있고, 부착된 카메라와 센서 등을 통해 집안의 상황을 파악하여, 외부에 있는 주인에게 알려줄 수도 있습니다. 이런 상황에서 모든 개인정보와 기기보안은 당사 보안 솔루션인 녹스(Knox)를 통해 철저히 보호됩니다.

당사는 AI 핵심 기술채용과 함께, 초대형 TV 시장 확대에 필요한 제품 라인업도 더욱 탄탄하게 구축하고 있습니다. 90인치 대 이상 성장 시장 주도를 위해, 98인치 라인업을 Neo QLED 8K/4K, QLED에 이어 UHD급으로 확대하는 한편, 85인치 Neo QLED, 83인치 및 77인치 OLED 라인업도 글로벌로 강화했습니다.

미래 기술인 차세대 마이크로 LED 제품도 89인치, 101인치에 이어 114인치로 확대하고 있으며, AI와 광학 문자인식 기술을 활용하여 자막을 실시간으로 음성 변환시키는 '들리는 자막' 기술을 실용화하고, 화면 윤곽선과 색상을 저시력자 맞춤형으로 재조정해 주는 '릴루미노 모드(Relumino Mode)'기능도 향상시켜 '모두를 위한 TV' 공급에도 최선의 노력을 하고 있습니다.

2) 모바일 산업

당사는 주력 사업인 스마트폰 시장에서 2011년 이후 13년 연속 글로벌 출하량 1위를 유지하고 있습니다(출처: TechInsights 2024.11). 또한, 스마트폰 뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블(스마트워치, 무선이어폰 등), 액세서리 등의 제품과 함께 Digital Health, Digital Wallet 등 콘텐츠와 서비스 부문에서도 사업 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

당사는 프리미엄에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업을 활용하여 지역별 시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 특히 프리미엄 스마트폰은 생성형 AI를 적용한 검색·실시간 통번역·자동 내용 요약·사진 편집, Dynamic AMOLED 2X(120Hz) 지원, UWB(Ultra Wideband)를 활용한 디지털키 및 콘텐츠 공유, 초음파 방식의 온스크린 지문 인식, 야간 촬영·8K 동영상 특화 카메라 기능 등 고객이 필요로 하는 차별화된 기능을 지속해서 선보이고 있습니다.

2019년에는 세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이를 탑재한 Galaxy Z 폴드로 신규 시장을 개척한 데 이어, 2020년에는 상하로 접히는 Galaxy Z 플립을 출시하였습니다. Galaxy Z 플립 시리즈는 아이코닉한 디자인과 높은 휴대성으로, 여성과 젊은 세대의 Galaxy 선호도를 높이는 데 기여하고 있습니다. 이후 당사만의 기술 리더십과 소비자 가치 중심의 사용성을 기반으로 폴더블 특화 경험을 지속 강화한 5세대, 6세대 Galaxy Z 시리즈를 출시하며 폴더블 시장을 주도해 왔습니다.

2024년 1월 출시한 Galaxy S24 시리즈는 당사 최초로 Galaxy AI를 탑재하였습니다. Galaxy AI는 사용자가 세상을 경험하는 방식을 바꾸고 무한한 잠재력을 발휘할 수 있도록 완전히 새로워진 검색, 창의적인 사진 편집, 실시간 번역, 편리한 텍스트 요약 등의 경험을 제공하고 있습니다. 또한 보다 강력한 보안성을 바탕으로 초연결 사회에서 소비자에게 안전한 AI 및 멀티 디바이스 사용 환경을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

2024년 7월 출시된 Galaxy Z 폴드6 및 Galaxy Z 플립6는 대화면과 폴더블 폼팩터에 최적화된 Galaxy AI 기능 탑재로 한 차원 높아진 폴더블 생산성을 제공하였습니다. 뿐만 아니라 역대 Galaxy Z시리즈 중 가장 얇고 가벼운 무게로 뛰어난 휴대성을 제공하면서도 성능과 내구성을 더욱 강화하여 제품 완성도를 한층 높였습니다.

스마트폰 외에도 대화면 디스플레이와 S Pen으로 노트 필기와 영상회의, 멀티태스킹등 생산적인 경험을 제공하는 태블릿, 생체 센서 기술을 적용하여 더욱 고도화된 피트니스 및 웰니스 기능을 제공하는 스마트 워치와 편안한 착용감으로 맞춤형 건강정보를 제공하는 스마트 링, 풍부하고 뛰어난 사운드 경험을 제공하는 무선 이어폰 등 다양한 Galaxy Ecosystem 제품군을 통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

당사는 제품과 더불어 그동안 Samsung Wallet(舊 Samsung Pay), Samsung Health 등의 실용적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔습니다. Samsung Wallet은 결제 외에도 신분증, 티켓 등의 다양한 기능을 제공하여 실물 지갑을 대체할 수 있는 서비스로 발전해 나가고 있으며, Samsung Health는 새로운 폼팩터와 AI 기능 적용을 통해 통합 건강관리 플랫폼으로서의 위상을 더욱 강화해 나가고자 합니다

뿐만 아니라 제품에 재활용 소재 적용을 확대하는 등, 친환경 기술 혁신도 지속하고 있습니다. 대표적으로 플라스틱 폐기물 중 하나인 폐어망을 재활용해 만든 소재를 Galaxy S22 시리즈 이후 많은 과제에 적용하고 있습니다. Galaxy S24 시리즈에는 재활용 코발트와 희토류를 적용하였고, Galaxy Z 폴드6 및 Galaxy Z 플립6에는 재활용금과 구리를 추가로 적용하였습니다.

추가로, 당사는 2023년 5월 자가 수리 프로그램을 도입하고 대상 모델과 국가를 확대해 가는 등, e-waste를 최소화하여 환경에도 도움이 되고자 하였습니다.

당사는 앞으로도 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 지속적인 기술 혁신 및 철저한 미래 준비를 통해 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공할 것입니다.

[DS 부문]

(산업의 특성 등)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다.

메모리 반도체는 읽고 쓸 수 있는 램(RAM, Random Access Memory) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM, Read Only Memory) 제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주기억 장치, 응용프로그램의 일시적 로딩>Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. 롬(ROM)은 전원이 꺼져도 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로, 대표적으로 입출력 시스템이나 IC카드 등에 사용됩니다.

System LSI 제품은 응용처에 따라 종류가 다양하며, 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit), 그래픽 처리 장치인 GPU(Graphics Processing Unit), ISP(Image Signal Processor), Modem(Modulator-Demodulator) 등을 내장한 모바일 기기용 SOC(System-On-Chip)가 가장 대표적인 제품입니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 AP 제품과 이미지 센서 등을 공급하고 있습니다.

Foundry 사업은 팹리스(Fabless) 업체가 설계한 반도체를 위탁 생산해서 공급해 주는 사업으로, 일반 제조업의 OEM 공급과 비슷한 개념의 '수탁 반도체 제조 사업'입니다. 반도체 공정 기술의 고도화와 투자 부담의 증가로 많은 IDM(Integrated Device Manufacturer)업체가 생산 시설을 보유하지 않은 팹리스(Fabless) 업체로 전환하였습니다. 이에 따라 대규모 Capa를 보유 중인 5개 내외의 소수업체가 전체 파운드리 시장의 대부분을 영위하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

'24.3분기 메모리 시장은, 주요 데이터센터 및 빅테크 기업들의 투자가 이어지며 AI 및 Conventional향 서버 수요는 지속 강세를 보였으나, 모바일 세그먼트의 경우 일부 고객사들의 재고 조정 및 중국 시장 내 Legacy 제품 공급 증가로 수급에 일부 영향이 있었습니다. 응용/제품별 시장 디커플링 속, 당사는 추가적인 보유 재고 건전화를 위해 주로 Legacy 제품으로 이루어진 부진재고 판매에 집중하는 한편, 선단 제품의 경우 AI 및 서버향 고수익 제품 수요에 적극 대응하였습니다.

'24.4분기 메모리 시장은 3분기와 유사하게 서버는 AI에 기인한 수요 강세가 이어지는 반면, 모바일은 일부 고객사의 재고 조정이 지속될 것으로 전망됩니다. 이러한 상황 속, 당사는 수익성 위주로 사업 포트폴리오를 지속 개선할 계획입니다. 또한, Legacy 라인의 선단공정 전환 가속화를 추진하고, 전분기에 이어 재고 건전화를 연내 마무리하여 사업 체질을 강화해 나가겠습니다.

Foundry 시장은 Advanced 노드를 사용하는 고성능 컴퓨터 (HPC) 및 인공지능 (AI) 분야를 중심으로 수요가 확대 되었으나, 글로벌 세트 시장 회복 지연에 따라 모바일(스마트폰 등)/PC 응용과 Mature 노드 사용 시장은 상대적으로 수요 약세가 지속되고 있습니다. 다만, 중장기적으로는 Advanced 노드 중심의 HPC/AI향 응용의 지속적인 성장과 모바일/PC/전장향 등 세트 시장의 수요 회복이 기대되는 바 지속적인 성장세가 전망됩니다.

< DRAM 시장점유율 추이 >

제 품	2024년 3분기	2023년	2022년
DRAM	42.2%	42.2%	43.1%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.
(2024년 3분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.)

(영업의 개황 등)

메모리의 서버 시장은 AI에 기인한 수요 강세가 이어지는 반면, 일부 모바일 고객사의 재고 조정은 계속 이어질 것으로 전망됩니다. 단, 지정학적 이슈, 주요 국가 금리 및 경기부양 정책 등 환경적 수요 영향성에 대한 지속적인 모니터링이 필요하겠습니다. 당사는 수익성 위주의 포트폴리오 개선 전략에 맞춰 전분기에 이은 재고 건전화를 연내 마무리 추진하여 사업 체질을 강화하는 한편, 고수익 제품 판매 기반 확대와 함께 선단공정 전환을 가속화하여 사업 경쟁력을 제고할 계획입니다.

DRAM은 HBM Capa 증가에 맞추어 판매 확대하는 한편 서버향 DDR5의 1b나노 전환을 가속화하며 32Gb 기반 고용량 모듈 판매 비중을 적극 확대할 계획입니다. 이외에도 업계 최초 개발한 10.7Gbps LPDDR5x와 GDDR7의 양산 공급을 통해 고부가가치 제품 리더십을 확보 예정입니다. NAND는 서버 SSD 시장 수요 강세 속에 시장의 메인이 되는 TLC SSD 수요에 적극 대응할 예정이며 V8(8세대 V낸드) 기반의 PCIe Gen5 판매를 더욱 확대할 계획입니다. 특히, 성장 잠재력이 높은 QLC SSD의 경우 4분기 64TB 제품 양산 및 128TB 제품 샘플링 예정이고, 내년 상반기에는 128TB까지 QLC SSD 라인업을 확대해서 양산을 전개할 계획입니다.

System LSI는 스마트폰이 프리미엄 및 신형 시장에서 판매 호조를 보이고 있지만 채널 재고 누적에 따른 하반기 조정을 감안하여 전년대비 소폭 성장할 것으로 전망하고 있으며, 고수익 제품 수주 확대 및 원가 경쟁력 강화를 적극 추진하고 있습니다.

SOC 사업은 Galaxy S24FE 모델의 글로벌 전지역향 진입과 볼륨향 A 시리즈(A55/A35) 제품의 판매 호조로 매출 확대 중이며, On-device AI 기반 고사양 제품 공급 확대와 응용처 및 고객 다변화 등을 통해 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이미지센서 사업은 당사 선도의 2억화소 센서가 기존 광각 카메라 중심에서 줌기능 개선 소구점을 기반으로 망원 카메라까지 응용처 다변화되며 수요가 증가 중이고, 차량용 센서 시장에서도 글로벌 주요 완성차 업체들로부터 센싱용 고화소 신제품 수주가 확대되고 있습니다. LSI 사업 중 스마트폰향 OLED mDDI는 선단 공정 경쟁력 및 기술 차별화 제품을 바탕으로 글로벌 Top-tier 고객들에 공급을 확대하고, pDDI는 기존 LCD 중심에서 OLED향 pDDI와 TCON(타이밍컨트롤러)을 바탕으로 사업 성장을 추진하고 있습니다. Power는 고객 다변화 기반 모바일향 매출 확대 및 메모리향 제품 Portfolio를 확대 중이며, Security는 스마트폰 및 컨슈머향의 보안 니즈 증가에 맞춘 고사양 제품 출시 등으로 매출 확대를 추진하고 있습니다.

Foundry는 시장변화에 맞춰 노드 및 응용별 전략을 구체화 함과 동시에, 기술개발, 제조, 비즈니스 역량에 대한 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. Advanced 노드는 GAA를 적용한 3나노 공정을 '22년부터 양산하였으며, 축적된 경험과 노하우를 후속 세대에 반영하여 개발하고 있습니다. 4나노는 3세대 제품 양산 중이며, 안정적인 수율을 기반으로 시장에서 경쟁력을 확대해 나가고 있습니다. 한편, Advanced 노드의 지속적인 기술경쟁력 확보를 위해, 2나노 공정 적기 개발을 추진함과 동시에 고객 확대에 집중할 계획입니다. Mature 노드는 고객 수요에 대응하기 위하여 Specialty 공정에 대한 꾸준한 투자 및 개발로 수익성 개선과 노드 장기 활용이 동시에 이뤄질 수 있는 전략을 마련하고 있습니다. 또한, 개발부터 양산까지의 사업화를 고려한 최적 라인 운영 및 공급 능력 확대도 지속 준비하고 있습니다. 지속적인 고객 협력 및 개발/수주/생산/공급 등 전방위 경쟁력을 강화함으로써 변화하는 시장에 맞춰 사업 기회를 확대해 나가겠습니다.

[SDC]

(산업의 특성 등)

디스플레이(Display)는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시 소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 QD-OLED(Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode), TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display) 등이 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색 일치율이 높고 색 재현 범위가 넓으며 응답 속도가 빠르다는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 OLED 디스플레이는 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 채용이 빠르게 증가하고 있습니다. 과거에는 OLED로 고해상도의 장수명 패널을 구현하는 것에 대해 시장의 큰 우려가 있었으나, 당사는 기술적 한계를 극복하여 시장을 발전시켜 왔습니다. OLED는 LCD의 단점을 극복할 뿐만 아니라, 앞으로 폴더블, IT(태블릿/노트북), Auto 등 다양한 응용처로 확대 적용이 가능하며 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. QD-OLED는 수 나노 미터의 반도체 결정인 퀀텀닷(Quantum Dot)을 패널에 내재화해 색 재현력과 시야각을 극대화한 자발광 디스플레이로, 향후 프리미엄급 TV 및 모니터 시장을 주도할 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

스마트폰용 디스플레이 패널 시장은 2023년 14.4억대에서 2024년 15.1억대로 성장할 것으로 전망됩니다. 스마트폰용 OLED 디스플레이의 경우 2023년 6.1억대에서 2024년 8.1억대로 증가할 전망이며, 전체 스마트폰 디스플레이 패널 시장에서 OLED가 차지하는 비중은 2023년 42.7%에서 2024년 53.3%로 증가할 것으로 전망됩니다. (출처: Omdia 2024.10)

또한, 대형 디스플레이 패널 시장은 2023년 8.1억대에서 2024년 8.8억대로 시장이 성장할 것으로 전망됩니다(출처: Omdia 2024.09).

< 스마트폰 패널 시장점유율 추이 >

제 품	2024년 3분기	2023년	2022년
스마트폰 패널	42.4%	50.1%	56.7%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.
(2024년 3분기 시장점유율은 외부조사기관의 예측치입니다.)

(영업의 개황 등)

당사는 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다. 또한 스마트폰 외에도 폴더블, 태블릿, 워치, 노트북, AUTO 등으로 제품군을 다각화하여 명실상부한 OLED 디스플레이의 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

당사는 Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 제품까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하여 소비자의 고도화되는 요구에 적극 대응하고 있습니다. 또한 차별화된 기능과 디자인의 폴더블·IT(태블릿/노트북) 제품을 지속적으로 출시하여 시장으로부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

스마트폰 디스플레이 시장은 패널 업체간 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 당사는 고화질과 저소비전력 등 차별화 기술을 지속 개발하여 하이엔드의 주도권을 유지하고 판매 확대를 추진하겠습니다.

또한, 8.6G IT OLED라인을 건설하는 등 스마트폰에 편중된 중소형 패널 사업을 다각화하여 IT, AUTO, Gaming 제품 등으로 제품 포트폴리오를 확대하고 사업 리더십을 더욱 견고히 할 계획입니다.

대형 디스플레이 사업은 프리미엄 TV 및 모니터 제품 중심으로 역량을 집중하고 수율 향상, Loss절감 등 내실을 다져서 사업 경쟁력을 강화할 계획입니다.

[Harman]

(산업의 특성 등)

Harman은 전장부품(Automotive)과 라이프스타일 오디오(Lifestyle Audio) 산업에서 경쟁하고 있습니다. 이 중 전장부문이 Harman 사업의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 디지털 콕핏, 카 오디오, 텔레매틱스 등 분야에 진출해 있습니다.

요즘 소비자들은 차량을 선택할 때 단순 이동수단 기능보다 이동시에 즐길 수 있는 차량내 경험(In-Cabin Experience)을 중요시하는 추세입니다. 이러한 소비자 니즈를 충족시키기 위해 자동차 제조사들은 Harman의 전장부품(디지털 콕핏, 카 오디오 등)을 활용하여 보다 편리하고 개인화된 맞춤형 경험을 제공하여 차별화하는데 주력하고 있습니다.

특히, 차량의 IT 기기화에 따른 SDV(Software Defined Vehicle)로의 변화로 인해, 자동차 제조사들은 중앙집중형 아키텍처의 도입을 시도하고 SW 기능을 강화하는 등 많은 변화를 추진 중입니다. 이에 따라, 전장 부품업체들의 공급제품에도 빠른 기술적 변화가 진행되고 있어, 기술 변화에 따른 업체간 경쟁은 치열할 것으로 예상됩니다.

라이프스타일 오디오 산업은 소비자 오디오와 프로페셔널 오디오 솔루션으로 구분됩니다. 소비자 오디오 제품(True Wireless Stereo, Portable Speaker, Headphone 등)은 과거 음원 재생 기기에 국한되었으나, 최근 무선 연결기술 적용 및 AI 탑재가 확산되어 기술 중심의 IT 기기로 진화하는 추세입니다. 이러한 기술 변화에 의해, IT 업체들이 소비자 오디오 시장에 참여하여 음향 설계 기술을 보유한 전통 오디오 업체들과 경쟁 중입니다.

소비자 오디오 시장은 TWS 헤드폰과 Home 오디오 및 게이밍 헤드폰 분야에서 고성장이 예상되고, 소비자들은 프리미엄 오디오를 경험(고음질/무손실 음원 등)하고자 하는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이에 Harman은 고성장 분야에 사업역량과 경쟁력을 강화하고 신제품을 지속 출시하여 시장에 대응하고 있으며, 프리미엄 오디오 경험을 추구하는 소비자의 Needs에 부합하기 위해 고음질/무손실 음원 재생기술을 보유한 미국업체 Roon Labs LLC를 2023년 4분기에 인수하여 고품질의 오디오 경험을 소비자들에게 제공하고 있습니다. 향후 타 부문 제품에도 Roon 기술을 적용하여 제품을 차별화하고 시장 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.

(국내외 시장여건 등)

최근 유럽과 중동의 지정학적 이슈로 인한 원자재 가격 상승 및 미/중 무역 갈등 심화 등 경기 불안 요소는 여전히 존재하나, 세계 자동차 공급망 불안요소는 많이 해소되었고, 고금리와 인플레이션이 점진적으로 정상화될 것으로 예상됩니다. 이러한 상황을 고려할 때 2025년 전 세계 자동차 생산량은 전년 대비 1.8% 성장할 것으로 전망됩니다. (출처: S&P Global Light Vehicle Production Forecast 2024.10)

< 디지털 콕핏 시장점유율 추이 >

제 품	2024년 3분기	2023년	2022년
디지털 콕핏	13.3%	16.5%	17.9%

- ※ 디지털 콕핏은 인포테인먼트 시스템 등을 통해 안전한 운전 환경을 제공하는 디지털 전장부품입니다.
- ※ 시장점유율은 외부조사기관인 Techinsights의 자료(금액기준)를 활용하였습니다.
(2024년 3분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.)

(영업의 개황 등)

Harman은 전장부품 시장에서 차량내 경험의 중심이 되는 디지털 콕핏, 카 오디오 분야에서 선도적 시장 입지를 유지하고 있습니다. 당사는 Harman의 선두 위상을 강화하기 위해 Harman의 전장사업에 당사의 무선통신, 디스플레이 등 IT 기술을 지속 접목시켜 차량의 IT기기화에 적극 대응해 나갈 계획입니다.

Harman은 차량의 SDV(Software Defined Vehicle)화 변화에 대응하기 위해 차별화된 기술 개발을 통해 끊임없는 혁신을 추구함으로써 소비자들의 차량내 경험이 한층 업그레이드되도록 노력해 나갈 것입니다.

Harman은 독자 보유한 음향 설계능력과 다양한 소비자층을 겨냥한 멀티 브랜드 전략을 구사하여 일반 소비자와 음악 애호가들 사이에서 오디오 전문 업체로서 브랜드 인지도 및 영향력을 확대해 왔습니다. 향후 타 부문과의 협력을 강화하고 새로운 제품을 출시하여 오디오 산업내에서의 위상과 입지를 더욱 강화해 나갈 예정입니다.

라. 사업부문별 요약 재무 현황

2024년(제56기) 3분기 매출은 DX 부문이 134조 3,575억원(59.7%), DS 부문이 80조 9,652억원(36.0%)이며, SDC가 21조 317억원(9.3%), Harman은 10조 3,489억원(4.6%)입니다.

2024년(제56기) 3분기 영업이익은 DX 부문이 10조 1,700억원, DS 부문이 12조 2,292억원, SDC가 2조 8,643억원, 그리고 Harman은 9,163억원입니다.

(단위 : 억원, %)

부문	구 분	제56기 3분기		제55기		제54기	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
DX 부문	매출액	1,343,575	59.7%	1,699,923	65.7%	1,824,897	60.4%
	영업이익	101,700	38.8%	143,847	219.0%	127,461	29.4%
	총자산	2,477,397	36.2%	2,342,534	37.2%	2,279,669	38.6%
DS 부문	매출액	809,652	36.0%	665,945	25.7%	984,553	32.6%
	영업이익	122,292	46.6%	△148,795	△226.6%	238,158	54.9%
	총자산	3,272,169	47.9%	2,871,411	45.6%	2,620,558	44.3%
SDC	매출액	210,317	9.3%	309,754	12.0%	343,826	11.4%
	영업이익	28,643	10.9%	55,665	84.8%	59,530	13.7%
	총자산	783,134	11.5%	792,752	12.6%	737,798	12.5%
Harman	매출액	103,489	4.6%	143,885	5.6%	132,137	4.4%
	영업이익	9,163	3.5%	11,737	17.9%	8,805	2.0%
	총자산	192,884	2.8%	179,566	2.9%	171,023	2.9%

※ 각 사업부문별 요약 재무 현황은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

(공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용)

- 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품·모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품·모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부 기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
- 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당 부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제56기 3분기	제55기	제54기
	2024년 9월말	2023년 12월말	2022년 12월말
[유동자산]	219,235,111	195,936,557	218,470,581
· 현금및현금성자산	43,131,359	69,080,893	49,680,710
· 단기금융상품	60,616,598	22,690,924	65,102,886
· 기타유동금융자산	28,571	635,393	443,690
· 매출채권	44,692,044	36,647,393	35,721,563
· 재고자산	53,356,759	51,625,874	52,187,866
· 기타	17,409,780	15,256,080	15,333,866
[비유동자산]	272,072,206	259,969,423	229,953,926
· 기타비유동금융자산	10,826,180	8,912,691	12,802,480
· 관계기업 및 공동기업 투자	12,235,974	11,767,444	10,893,869
· 유형자산	195,028,773	187,256,262	168,045,388
· 무형자산	23,077,457	22,741,862	20,217,754
· 기타	30,903,822	29,291,164	17,994,435
자산총계	491,307,317	455,905,980	448,424,507
[유동부채]	87,031,889	75,719,452	78,344,852
[비유동부채]	17,994,065	16,508,663	15,330,051
부채총계	105,025,954	92,228,115	93,674,903
[지배기업 소유주지분]	376,152,198	353,233,775	345,186,142
· 자본금	897,514	897,514	897,514
· 주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
· 이익잉여금	365,359,495	346,652,238	337,946,407
· 기타	5,491,296	1,280,130	1,938,328
[비지배지분]	10,129,165	10,444,090	9,563,462
자본총계	386,281,363	363,677,865	354,749,604
	2024년 1월~9월	2023년 1월~12월	2022년 1월~12월
매출액	225,082,634	258,935,494	302,231,360
영업이익	26,233,258	6,566,976	43,376,630
연결총당순이익	26,696,957	15,487,100	55,654,077
· 지배기업 소유주지분	26,045,230	14,473,401	54,730,018
· 비지배지분	651,727	1,013,699	924,059
기본주당순이익(단위 : 원)	3,834	2,131	8,057
희석주당순이익(단위 : 원)	3,834	2,131	8,057
연결에 포함된 회사수	230개	233개	233개

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제54기~제55기 연결감사보고서 및 제56기 분기 연결검토보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다.

나. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제56기 3분기	제55기	제54기
	2024년 9월말	2023년 12월말	2022년 12월말
[유동자산]	88,773,816	68,548,442	59,062,658
· 현금및현금성자산	5,582,718	6,061,451	3,921,593
· 단기금융상품	11,063,471	50,071	137
· 매출채권	35,176,097	27,363,016	20,503,223
· 재고자산	30,958,795	29,338,151	27,990,007
· 기타	5,992,735	5,735,753	6,647,698
[비유동자산]	234,608,995	228,308,847	201,021,092
· 기타비유동금융자산	2,100,328	1,854,504	1,364,608
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	57,436,120	57,392,438	57,397,249
· 유형자산	145,113,639	140,579,161	123,266,986
· 무형자산	10,522,995	10,440,211	8,561,424
· 기타	19,435,913	18,042,533	10,430,825
자산총계	323,382,811	296,857,289	260,083,750
[유동부채]	74,771,238	41,775,101	46,086,047
[비유동부채]	8,539,578	30,294,414	4,581,512
부채총계	83,310,816	72,069,515	50,667,559
[자본금]	897,514	897,514	897,514
[주식발행초과금]	4,403,893	4,403,893	4,403,893
[이익잉여금]	235,134,369	219,963,351	204,388,016
[기타]	△363,781	△476,984	△273,232
자본총계	240,071,995	224,787,774	209,416,191
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	2024년 1월~9월	2023년 1월~12월	2022년 1월~12월
매출액	160,802,657	170,374,090	211,867,483
영업이익(손실)	13,734,791	△11,526,297	25,319,329
당기순이익	22,530,464	25,397,099	25,418,778
기본주당순이익(단위 : 원)	3,317	3,739	3,742
희석주당순이익(단위 : 원)	3,317	3,739	3,742

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제54기~제55기 감사보고서 및 제56기 분기 검토보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다.

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 56 기 3분기말 2024.09.30 현재

제 55 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 56 기 3분기말	제 55 기말
자산		
유동자산	219,235,111	195,936,557
현금및현금성자산 (주3,25)	43,131,359	69,080,893
단기금융상품 (주3,25)	60,616,598	22,690,924
단기상각후원가금융자산 (주3,25)	0	608,281
단기당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,25)	28,571	27,112
매출채권 (주3,25)	44,692,044	36,647,393
미수금 (주3,25)	7,721,652	6,633,248
선급비용	3,491,001	3,366,130
재고자산 (주5)	53,356,759	51,625,874
기타유동자산 (주3,25)	6,197,127	5,038,838
매각예정분류자산 (주28)	0	217,864
비유동자산	272,072,206	259,969,423
기타포괄손익-공정가치금융자산 (주3,4,25)	9,640,598	7,481,297
당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,25)	1,185,582	1,431,394
관계기업 및 공동기업 투자 (주6)	12,235,974	11,767,444
유형자산 (주7)	195,028,773	187,256,262
무형자산 (주8)	23,077,457	22,741,862
순확정급여자산 (주11)	4,028,515	4,905,219
이연법인세자산	13,002,200	10,211,797
기타비유동자산 (주3,25)	13,873,107	14,174,148
자산총계	491,307,317	455,905,980
부채		
유동부채	87,031,889	75,719,452
매입채무 (주3,25)	12,861,787	11,319,824
단기차입금 (주3,9,25)	11,035,119	7,114,601
미지급금 (주3,25)	15,533,843	15,324,119
선수금 (주14)	1,733,635	1,492,602
예수금 (주3,25)	861,723	892,441
미지급비용 (주3,14,25)	28,951,863	26,013,273
당기법인세부채	4,882,420	3,358,715
유동성장기부채 (주3,9,10,25)	2,111,782	1,308,875
충당부채 (주12)	7,158,071	6,524,876
기타 유동부채 (주3,14,25)	1,901,646	2,308,472
매각예정분류부채 (주28)	0	61,654
비유동부채	17,994,065	16,508,663

사채 (주3,10,25)	19,537	537,618
장기차입금 (주3,9,25)	3,765,437	3,724,850
장기미지급금 (주3,25)	5,326,842	5,488,283
순확정급여부채 (주11)	487,239	456,557
이연법인세부채	539,914	620,549
장기충당부채 (주12)	3,357,773	2,878,450
기타 비유동 부채 (주3,14,25)	4,497,323	2,802,356
부채총계	105,025,954	92,228,115
자본		
지배기업 소유주지분	376,152,198	353,233,775
자본금 (주15)	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금 (주16)	365,359,495	346,652,238
기타자본항목 (주17)	5,491,296	1,280,130
비지배지분	10,129,165	10,444,090
자본총계	386,281,363	363,677,865
부채와자본총계	491,307,317	455,905,980

2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서

제 56 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 56 기 3분기		제 55 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액 (주26)	79,098,731	225,082,634	67,404,652	191,155,556
매출원가 (주18)	49,095,083	139,293,441	46,618,726	134,273,009
매출총이익	30,003,648	85,789,193	20,785,926	56,882,547
판매비와관리비 (주18,19)	20,820,277	59,555,935	18,352,392	53,140,288
영업이익 (주26)	9,183,371	26,233,258	2,433,534	3,742,259
기타수익 (주20)	712,914	1,476,696	244,352	949,823
기타비용 (주20)	553,052	1,179,941	206,403	579,442
지분법이익 (주6)	183,411	596,758	262,677	676,459
금융수익 (주21)	3,617,510	10,688,757	4,112,158	12,797,135
금융비용 (주21)	2,823,742	8,193,049	2,903,717	10,104,258
법인세비용차감전순이익	10,320,412	29,622,479	3,942,601	7,481,976
법인세비용(수익) (주22)	219,508	2,925,522	(1,901,570)	(1,660,366)
분기순이익	10,100,904	26,696,957	5,844,171	9,142,342
분기순이익의 귀속				
지배기업 소유주지분	9,781,547	26,045,230	5,501,304	8,449,574

비지배지분	319,357	651,727	342,867	692,768
주당이익 (주23)				
기본주당이익 (단위 : 원)	1,440	3,834	810	1,244
희석주당이익 (단위 : 원)	1,440	3,834	810	1,244

2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 56 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 56 기 3분기		제 55 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
분기순이익	10,100,904	26,696,957	5,844,171	9,142,342
기타포괄손익	(4,845,160)	4,439,174	1,572,861	7,468,617
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	320,456	1,467,592	(362,602)	781,034
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	301,501	1,579,654	(326,750)	1,144,740
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주17)	(2,227)	(22,543)	3,617	26,314
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	21,182	(89,519)	(39,469)	(390,020)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(5,165,616)	2,971,582	1,935,463	6,687,583
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주17)	(69,879)	62,295	34,057	119,485
해외사업장환산외환차이 (주17)	(5,077,267)	2,954,177	1,914,792	6,568,676
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주17)	(18,470)	(44,890)	(13,386)	(578)
분기총포괄손익	5,255,744	31,136,131	7,417,032	16,610,959
포괄손익의 귀속				
지배기업 소유주지분	4,934,790	30,275,707	7,089,926	15,851,327
비지배지분	320,954	860,424	327,106	759,632

2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 56 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	자본						
	지배기업 소유주지분					비지배지분	자본 합계
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계		
2023.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	337,946,407	1,938,328	345,186,142	9,563,462	354,749,604
분기순이익	0	0	8,449,574	0	8,449,574	692,768	9,142,342
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	3,086,721	(1,952,180)	1,134,541	10,199	1,144,740
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주17)	0	0	0	143,912	143,912	1,887	145,799
해외사업장환산외환차이 (주17)	0	0	0	6,513,750	6,513,750	54,926	6,568,676
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(389,872)	(389,872)	(148)	(390,020)

현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주17)	0	0	0	(578)	(578)	0	(578)
배당	0	0	(7,357,283)	0	(7,357,283)	(101,939)	(7,459,222)
연결실체내 자본거래 등	0	0	0	0	0	(9,439)	(9,439)
연결실체의 변동	0	0	0	0	0	250	250
기타	0	0	0	0	0	491	491
2023.09.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	342,125,419	6,253,360	353,680,186	10,212,457	363,892,643
2024.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	346,652,238	1,280,130	353,233,775	10,444,090	363,677,865
분기순이익	0	0	26,045,230	0	26,045,230	651,727	26,696,957
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	19,311	1,371,323	1,390,634	189,020	1,579,654
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주17)	0	0	0	45,689	45,689	(5,937)	39,752
해외사업장환산외환차이 (주17)	0	0	0	2,929,088	2,929,088	25,089	2,954,177
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(90,044)	(90,044)	525	(89,519)
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주17)	0	0	0	(44,890)	(44,890)	0	(44,890)
배당	0	0	(7,357,284)	0	(7,357,284)	(1,093,231)	(8,450,515)
연결실체내 자본거래 등	0	0	0	0	0	(12,245)	(12,245)
연결실체의 변동	0	0	0	0	0	(69,873)	(69,873)
기타							
2024.09.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	365,359,495	5,491,296	376,152,198	10,129,165	386,281,363

2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 56 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 56 기 3분기	제 55 기 3분기
영업활동현금흐름	50,960,350	24,192,198
영업에서 창출된 현금흐름	53,447,628	26,320,066
분기순이익	26,696,957	9,142,342
조정 (주24)	30,074,094	30,111,057
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주24)	(3,323,423)	(12,933,333)
이자의 수취	2,868,496	3,771,363
이자의 지급	(497,008)	(686,134)
배당금 수입	230,260	61,552
법인세 납부액	(5,089,026)	(5,274,649)
투자활동현금흐름	(73,513,780)	7,599,286
단기금융상품의 순감소(증가)	(37,039,380)	43,136,356
단기상각후원가금융자산의 순감소(증가)	620,858	416,095
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	(1,429)	(1,509)
장기금융상품의 처분	4,100,008	4,564,561
장기금융상품의 취득	(3,485,364)	(534)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	189,411	5,105,980
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(151,906)	(106,890)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	269,724	44,404
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(40,512)	(101,842)
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	28,878	24,517

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(10,999)	(71,875)
유형자산의 처분	79,578	68,377
유형자산의 취득	(36,320,811)	(42,398,379)
무형자산의 처분	15,869	11,253
무형자산의 취득	(1,677,059)	(2,248,152)
사업결합으로 인한 현금유출액	(142,156)	0
매각예정자산의 처분으로 인한 현금유입액	101,563	0
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(50,053)	(843,076)
재무활동현금흐름	(5,016,158)	(8,718,437)
단기차입금의 순증가(감소)	4,023,575	(702,893)
장기차입금의 차입	404,900	234,455
사채 및 장기차입금의 상환	(1,004,724)	(871,679)
배당금의 지급	(8,427,664)	(7,369,130)
비지배지분의 증감	(12,245)	(9,190)
외화환산으로 인한 현금의 변동	1,620,054	2,390,527
현금및현금성자산의 증가(감소)	(25,949,534)	25,463,574
기초현금및현금성자산	69,080,893	49,680,710
기말현금및현금성자산	43,131,359	75,144,284

3. 연결재무제표 주석

1. 일반적 사항 (연결)

가. 연결회사의 개요

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 스마트폰, 네트워크시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. SDC는 디스플레이 패널 사업을 영위하며, Harman은 전장부품사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이(주) 및 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 229개의 종속기업을 연결대상으로 하고, 삼성전기(주) 등 35개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

나. 종속기업 현황

당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0

	SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung Lennox HVAC North America, LLC	에어컨공조 판매	50.1
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Federal, Inc. (SFI)	R&D	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)	해외자회사 관리	100.0
	eMagin Corporation	디스플레이 패널 개발 및 생산	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
	AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0
	Sonio Corporation	소프트웨어 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Roon Labs, LLC.	오디오제품 판매	100.0
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4	
China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율
----	-----	----	-----

			(%)(*)
유럽 · CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV · 모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Oxford Semantic Technologies Limited (OST)	R&D	100.0
	Sonio SAS	소프트웨어 판매, R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0	
Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0	
Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0	
Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0	
Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0	
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0	
Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	마케팅	100.0	
지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽 · CIS	AKG Acoustics GmbH	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0

	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding GmbH & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman Management GmbH	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%) (*)
중동 · 아프리카	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkiye (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co., Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Middle east and North Africa (SEMENA)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV · 모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아 (중국 제외)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THANGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	디스플레이 패널 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman International (Thailand) Co., Ltd.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중국	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0

Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100.0
Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100.0
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	디스플레이 패널 생산	100.0
Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	디스플레이 패널 생산	95.0
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체 · FPD 장비 서비스	100.0
Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%) (*)
국내	삼성디스플레이㈜	디스플레이 패널 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스㈜	디스플레이 패널 부품 생산	50.0
	스테크㈜	반도체 부품 생산	70.0
	세메스㈜	반도체 · FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스㈜	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스㈜	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매㈜	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍㈜	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨㈜	의료기기 생산 및 판매	68.5
	㈜희망별숲	식품 제조 가공	100.0
	㈜미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	㈜하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0	

	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 57호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 62호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
	시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	62.5
	반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

다. 당분기 및 전기의 주요 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	당분기말		당분기			
	자산	부채	3개월		누적	
			매출액	분기순이익	매출액	분기순이익
삼성디스플레이㈜	64,435,972	6,945,024	7,210,694	1,574,730	18,286,880	4,810,511
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	44,062,285	16,215,351	10,614,272	221,799	30,674,582	555,774
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	27,625,323	265,991	-	335,101	-	4,950,820
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	23,415,564	13,562,762	1,204,206	476,266	3,378,359	732,721
Harman과 그 종속기업(*2)	19,288,358	6,349,252	3,526,058	319,585	10,324,797	723,077
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	17,266,856	788,489	2,588,077	238,418	8,609,499	882,856
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	16,801,434	9,877,915	12,717,008	56,683	30,443,783	257,885
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	14,687,239	14,118,807	661,677	35,767	2,101,375	47,383
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	11,918,023	3,287,829	7,922,490	492,134	26,411,478	2,010,454
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	9,110,491	3,492,215	4,630,555	451,767	13,533,065	1,211,772
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	8,416,388	3,011,274	-	39,279	-	160,555
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	7,073,742	2,050,853	6,099,276	379,408	17,049,546	1,306,961
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	7,060,626	2,078,678	5,938,972	252,940	15,048,714	632,663
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	6,833,077	6,155,939	7,712,379	130,195	23,590,340	362,423
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	4,914,859	1,618,006	1,941,237	32,740	6,122,245	245,822
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	4,276,215	775,613	1,843,288	116,637	5,311,618	230,777
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	2,950,376	1,928,270	1,540,621	13,453	4,595,930	28,912
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	2,605,733	1,887,926	3,580,674	(236,880)	12,133,190	501,382
Samsung International, Inc. (SII)	2,533,374	639,832	2,196,876	36,584	5,836,412	397,426
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	2,492,132	1,776,421	1,627,959	1,476	4,521,464	61,324

(SET)						
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	2,489,754	600,594	1,159,388	(1,026)	3,513,176	30,903
세메스㈜	2,264,972	621,216	569,591	38,985	1,814,825	116,029
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	2,120,419	1,068,700	1,036,889	45,131	3,221,591	71,307
Samsung Japan Corporation (SJC)	1,893,266	1,608,931	1,080,751	(1,262)	2,607,115	918
Samsung Electronics GmbH (SEG)	1,860,074	1,823,986	1,412,462	27,011	4,724,019	(31,852)

(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	전기말		전분기			
	자산	부채	3개월		누적	
			매출액	분기순이익	매출액	분기순이익
삼성디스플레이㈜	65,328,568	7,266,213	7,427,496	4,090,757	18,462,908	6,495,536
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	41,926,899	15,322,780	10,216,410	(273,767)	30,193,962	21,005
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	22,234,942	282,614	-	4,109,008	-	11,075,857
Harman과 그 종속기업(*2)	17,956,557	6,009,675	3,791,817	320,808	10,443,291	606,707
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	16,714,945	7,791,914	1,080,710	8,389	3,172,155	260,833
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	15,808,283	870,453	1,890,492	205,634	6,901,659	736,368
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	12,796,440	6,276,293	6,241,452	99,630	16,318,423	282,091
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	12,554,481	3,593,527	8,761,281	1,180,774	24,108,238	2,347,215
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	10,222,557	8,797,991	922,821	(28,228)	2,497,085	149,741
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	9,660,481	4,585,806	-	32,306	-	64,391
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	7,738,259	3,373,730	4,460,246	399,072	11,773,610	967,435
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	7,383,485	1,570,459	6,689,888	514,812	16,903,470	1,085,346
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	7,301,860	2,215,062	6,016,323	711,676	16,050,234	1,621,889
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	5,542,627	1,587,911	1,864,916	58,195	5,519,363	222,840
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	5,262,086	4,552,030	3,470,620	57,582	10,059,823	172,515
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	4,043,677	843,736	1,642,747	67,493	4,738,599	419,734
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	3,039,379	640,512	1,100,817	36,409	3,503,091	222,348
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	2,902,722	1,976,067	1,480,770	(15,082)	4,331,645	57,282
세메스㈜	2,187,919	659,607	413,797	(42,157)	1,823,533	40,800
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	2,153,032	1,038,115	959,167	6,318	2,711,330	89,370
Samsung Electronics GmbH (SEG)	2,097,706	2,033,152	1,528,115	(84,348)	4,577,315	(29,366)
Samsung International, Inc. (SII)	1,879,442	383,763	2,060,157	102,369	5,728,487	871,140
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	1,797,627	1,139,056	1,054,741	8,202	2,934,200	9,655

(SET)						
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	1,794,552	639,120	655,903	(31,236)	2,117,941	101,437
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	1,639,004	1,443,005	3,884,218	150,578	11,929,548	377,341

(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

라. 연결대상범위의 변동

당분기 중 연결재무제표 작성대상범위의 변동 내용은 다음과 같습니다.

구분	지역	기업명	사유	
신규연결	미주	Sonio Corporation	지분취득	
	유럽·CIS	Oxford Semantic Technologies Limited	지분취득	
		Sonio SAS	지분취득	
	중동·아프리카	Samsung Electronics Middle east and North Africa (SEMENA)	설립	
아시아(중국제외)	Harman International (Thailand) Co., Ltd.	설립		
연결제외	미주	Harman Financial Group LLC	청산	
	유럽·CIS	Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii (SDSK)	청산	
		Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	청산	
	아시아(중국제외)	DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	매각	
	중국	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	청산	
	국내		㈜도우인시스	매각
			지에프㈜	매각
SVIC 48호 신기술투자조합			청산	

2. 중요한 회계처리방침 (연결)

2.1. 재무제표 작성기준

연결회사의 2024년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간종료일인 2024년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 연결회사가 채택한 제·개정 기준서

연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

보고기간종료일 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 부채가 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 중간연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정

기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리 되는 판매 후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정 리스료'를 산정하도록 요구합니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 중간 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품 공시' 개정

동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 중간연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

나. 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 연결회사가 조기 적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정

외환시장이 정상적으로 작동하지 않을 때 기능통화에 의한 외화거래 보고와 해외사업장의 기능통화를 지배기업의 표시통화로 환산하는 규정을 명확히 하기 위해 두 통화간 교환가능성을 평가하는 규정을 추가합니다. 또한, 두 통화간 교환이 가능한지를 평가하여 교환가능성이 결여되었다고 판단한 경우, 적용할 현물환율을 추정하는 규정을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기 적용할 수 있습니다.

2.2. 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 가중평균연간 법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품 (연결)

금융자산의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산, 범주	상각후평가 측정 금융자산						기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산						당기손익-공정가치 측정 금융자산						기타금융자산															
	금융자산, 분류						금융자산, 분류						금융자산, 분류						금융자산, 분류															
	현금및 금융상품 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	현금및 금융상품 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	현금및 금융상품 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	현금및 금융상품 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산					
금융자산	43.13	60.61	0	0	44.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.1	44.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.50	19.50
산	1,359	6,598			2,044											4,838																2	2	

당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산, 범주	상각후평가 측정 금융자산						기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산						당기손익-공정가치 측정 금융자산						기타금융자산															
	금융자산, 분류						금융자산, 분류						금융자산, 분류						금융자산, 분류															
	현금및 금융상품 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	현금및 금융상품 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	현금및 금융상품 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	현금및 금융상품 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	현금및 금융상품 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산	단기상 각후원 가치금융 자산
금융자산	69.08	22.69	608.2	0	36.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.3	21.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.77	70.77
산	0,899	0,924	81		7,393											4,254																	7	7

금융자산의 범주별 공시, 합계

당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	현금및현금성자산	단기금융상품	단기상각후원가금융 자산	단기당기손익-공정 가치금융자산	매출채권	기타포괄손익-공정 가치금융자산	당기손익-공정가치 금융자산	기타	금융자산, 분류 합 계
금융자산	43,131,359	60,616,598	0	28,571	44,692,044	9,640,598	1,185,582	13,101,124	172,395,876

당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	현금및현금성자산	단기금융상품	단기상각후원가금융 자산	단기당기손익-공정 가치금융자산	매출채권	기타포괄손익-공정 가치금융자산	당기손익-공정가치 금융자산	기타	금융자산, 분류 합 계
금융자산	69,080,893	22,690,924	608,281	27,112	36,647,393	7,481,297	1,431,394	14,840,275	152,807,569

당기 및 전기 기타금융자산에 대한 각주

기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

금융부채의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

금융부채, 범주

상각후원가 측정 금융부채										당기손익-공정가치측정금융부채										기타금융부채									
금융부채, 분류										금융부채, 분류										금융부채, 분류									
매입채무	단기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	분류 합계	계	매입채무	단기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	분류 합계	계	매입채무	단기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	분류 합계	계
12,861,787	271,753	14,107,615	1,060,156	19,537	6,829	4,728,755	13,197,743	46,254,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,873	50,873	0	10,763,309	0	1,051,626	0	3,758,608	0	0	43,788	15,617,330

반기말

(단위 : 백만원)

상각후원가 측정 금융부채										당기손익-공정가치측정금융부채										기타금융부채									
금융부채, 분류										금융부채, 분류										금융부채, 분류									
매입채무	단기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	분류 합계	계	매입채무	단기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	분류 합계	계	매입채무	단기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	분류 합계	계
11,319,824	504,552	13,996,395	310,436	537,618	0	4,907,875	11,330,545	42,907,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,904	49,904	0	6,610,049	0	998,439	0	3,724,850	0	0	33,559	11,366,897

금융부채의 범주별 공시, 합계

당분기말

(단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합계
금융부채	12,861,787	11,035,119	14,107,676	2,111,782	19,537	3,765,437	4,728,755	13,292,404	61,922,497

전기말

(단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합계
금융부채	11,319,824	7,114,601	13,996,395	1,308,875	537,618	3,724,850	4,907,875	11,414,008	54,324,046

당기 및 전기 기타금융부채에 대한 각주

기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산 (연결)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역

당분기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
기타포괄손익-공정가치금융자산	9,640,598

전기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
기타포괄손익-공정가치금융자산	7,481,297

당기손익-공정가치 측정금융자산의 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

		금융자산, 범주		금융자산, 범주 합계
		당기손익인식금융자산		
		채무상품	지분상품	
당기손익인식금융자산 합계				1,214,153
당기손익인식금융 자산 합계	유동 당기손익인식 금융자산	28,571		28,571
	비유동 당기손익인 식금융자산	591,475	594,107	1,185,582

전기말

(단위 : 백만원)

		금융자산, 범주		금융자산, 범주 합계
		당기손익인식금융자산		
		채무상품	지분상품	
당기손익인식금융자산 합계				1,458,506
당기손익인식금융 자산 합계	유동 당기손익인식 금융자산	27,112		27,112
	비유동 당기손익인 식금융자산	619,036	812,358	1,431,394

공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산, 분류																
공정가치로 측정하는 금융자산																
상장주식																
삼성중공업주		우호환신사		우이아이넷코리아		우원익홀딩스		우원익아이피엑스		Wacom Co., Ltd.		Corning Incorporated		기타		
측정 방법																
	취득원가	장부금액(시정가 치)	취득원가	장부금액(시정가 치)	취득원가	장부금액(시정가 치)	취득원가	장부금액(시정가 치)	취득원가	장부금액(시정가 치)	취득원가	장부금액(시정가 치)	취득원가	장부금액(시정가 치)	장부금액(시정가 치)	
금융자산	932,158	1,344,294	13,957	95,825	324	5,457	30,821	8,813	32,428	114,943	62,013	53,031	3,831,362	4,587,655	553,970	869,971
보유주식수		134,027,281		2,004,717		647,320		3,518,342		3,701,672		8,396,400		77,000,000		
지분율		0.152		0.051		0.019		0.046		0.075		0.058		0.090		
지분율에 대한 설명		총발행보통주식수 기준 지분율입니다		총발행보통주식수 기준 지분율입니다		총발행보통주식수 기준 지분율입니다		총발행보통주식수 기준 지분율입니다		총발행보통주식수 기준 지분율입니다		총발행보통주식수 기준 지분율입니다		총발행보통주식수 기준 지분율입니다		
영																

전기말

(단위 : 백만원)

금융자산, 분류															
공정가치로 측정하는 금융자산															
상장주식															
삼성중공업주		우호환신사		우이아이넷코리아		우원익홀딩스		우원익아이피엑스		Wacom Co., Ltd.		Corning Incorporated		기타	
측정 방법															
	취득원가	장부금액(시정가 치)	취득원가	장부금액(시정가 치)	취득원가	장부금액(시정가 치)	취득원가	장부금액(시정가 치)	취득원가	장부금액(시정가 치)	취득원가	장부금액(시정가 치)	취득원가	장부금액(시정가 치)	장부금액(시정가 치)
금융자산		1,038,711		131,108		5,560		11,857		125,679		50,358		3,140,978	1,093,963
보유주식수															
지분율															
지분율에 대한 설명															
영															

공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시_2

당분기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 분류	
	공정가치로 측정하는 금융자산	
	상장주식	
	측정 전체	
	취득원가	장부금액(시장가치)
금융자산	5,457,033	7,079,989

전기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 분류	
	공정가치로 측정하는 금융자산	
	상장주식	
	측정 전체	
	취득원가	장부금액(시장가치)
금융자산		5,598,214

5. 재고자산 (연결)

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 백만원)

	평가전금액	재고자산 평가총당금	장부금액 합계
제품 및 상품	14,805,469	(1,005,275)	13,800,194
반제품 및 재공품	24,928,549	(1,577,455)	23,351,094
원재료 및 저장품	16,055,985	(1,404,171)	14,651,814
미착품	1,553,657	0	1,553,657
재고자산 계	57,343,660	(3,986,901)	53,356,759

전기말

(단위 : 백만원)

	평가전금액	재고자산 평가총당금	장부금액 합계
제품 및 상품	16,120,367	(1,567,353)	14,553,014
반제품 및 재공품	26,501,664	(4,303,216)	22,198,448
원재료 및 저장품	15,222,937	(1,525,583)	13,697,354
미착품	1,177,058	0	1,177,058
재고자산 계	59,022,026	(7,396,152)	51,625,874

6. 관계기업 및 공동기업 투자 (연결)

가. 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초	11,767,444	10,893,869
취득	10,999	71,875
처분	(28,908)	(24,517)
이익 중 지분해당액	596,758	676,459
기타(*)	(110,319)	16,067
분기말	12,235,974	11,633,753

(*) 기타는 배당, 손상, 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기(주)	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스(주)	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합·관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스(주)	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성SDI(주)(*2)	2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
(주)제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

(2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	기타 산업용 유리제품 생산 및 공급	50.0	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

다. 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업 투자 내역은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

(단위 : 백만원)

기업명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액
삼성전기(주)	359,237	1,956,167	1,964,026	359,237	1,837,925	1,841,393
삼성에스디에스(주)	147,963	2,039,607	2,051,408	147,963	1,955,699	1,966,206
삼성바이오로직스(주)	1,424,358	3,306,203	3,310,763	1,424,358	3,068,636	3,073,595
삼성SDI(주)	1,242,605	3,919,498	2,935,455	1,242,605	3,726,675	2,912,564
(주)제일기획	506,162	391,782	692,286	506,162	368,875	669,363
기타	678,311	844,623	1,069,479	690,481	844,645	1,093,799

계	4,358,636	12,457,880	12,023,417	4,370,806	11,802,455	11,556,920
---	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(2) 공동기업 투자

(단위 : 백만원)

기업명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액 (*)	장부금액	취득원가	순자산가액 (*)	장부금액
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	215,000	138,870	138,868	215,000	138,939	138,938
기타	259,994	74,075	73,689	259,994	72,215	71,586
계	474,994	212,945	212,557	474,994	211,154	210,524

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

라. 당분기 및 전분기 중 지분법평가 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

기업명	기초	지분법평가 내역			분기말
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기(주)	1,841,393	114,638	28,341	(20,346)	1,964,026
삼성에스디에스(주)	1,966,206	129,414	2,963	(47,175)	2,051,408
삼성바이오로직스(주)	3,073,595	238,363	(1,195)	-	3,310,763
삼성SDI(주)	2,912,564	43,281	(6,927)	(13,463)	2,935,455
㈜제일기획	669,363	48,454	6,701	(32,232)	692,286
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	138,938	(70)	-	-	138,868
기타	1,165,385	22,678	9,869	(54,764)	1,143,168
계	11,767,444	596,758	39,752	(167,980)	12,235,974

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전분기

(단위 : 백만원)

기업명	기초	지분법평가 내역			분기말
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기(주)	1,764,249	93,372	26,161	(37,156)	1,846,626
삼성에스디에스(주)	1,870,338	124,751	21,276	(55,910)	1,960,455
삼성바이오로직스(주)	2,808,673	177,431	(1,709)	-	2,984,395
삼성SDI(주)	2,691,223	179,930	55,152	(13,867)	2,912,438
㈜제일기획	649,161	48,624	5,916	(33,394)	670,307
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	137,745	(1,904)	-	-	135,841
기타	972,480	54,255	39,003	57,953	1,123,691

계	10,893,869	676,459	145,799	(82,374)	11,633,753
---	------------	---------	---------	----------	------------

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당 등으로 구성되어 있습니다.

마. 주요 관계기업 및 공동기업 투자의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다.

(1) 주요 관계기업

(단위 : 백만원)

구 분	당분기				
	삼성전기(주)	삼성에스디에스(주)	삼성바이오로직스(주)	삼성SDI(주)	주제일기획
I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표:					
유동자산	6,122,408	8,575,897	4,808,895	10,130,073	2,305,760
비유동자산	6,481,510	4,226,797	11,217,445	28,014,804	503,717
유동부채	3,267,728	2,404,111	3,563,760	10,706,160	1,211,679
비유동부채	772,236	1,005,515	1,871,031	6,303,506	219,464
비지배지분	211,368	363,591	-	1,666,032	11,918
요약 포괄손익계산서:					
매출	7,801,822	10,185,908	3,290,883	12,837,791	3,179,995
계속영업손익(*)	479,587	567,197	761,822	780,092	168,959
세후중단영업손익(*)	(8,846)	-	-	45,745	-
기타포괄손익(*)	121,155	35,297	(765)	198,912	23,318
총포괄손익(*)	591,896	602,494	761,057	1,024,749	192,277
II. 배당					
배당	20,347	47,175	-	13,463	32,232

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	전기				
	삼성전기(주)	삼성에스디에스(주)	삼성바이오로직스(주)	삼성SDI(주)	주제일기획
I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표(전기말):					
유동자산	5,208,418	8,160,300	5,521,988	9,187,029	2,372,420
비유동자산	6,449,453	4,160,724	10,524,209	24,851,831	517,085
유동부채	2,900,460	2,391,861	4,157,861	8,518,933	1,375,034
비유동부채	727,087	953,592	2,057,844	5,612,677	216,707
비지배지분	182,613	317,562	-	1,395,877	11,206
요약 포괄손익계산서(전분기):					
매출	6,592,508	9,899,748	2,621,080	16,163,308	2,991,311
계속영업손익(*)	400,245	551,507	567,008	1,438,967	169,611
세후중단영업손익(*)	(20,717)	-	-	74,022	-
기타포괄손익(*)	123,264	94,190	(5,462)	340,753	24,651
총포괄손익(*)	502,792	645,697	561,546	1,853,742	194,262
II. 배당(전분기)					
배당	37,155	55,911	-	13,867	33,394

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(2) 주요 공동기업

(단위 : 백만원)

구 분	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	
	당분기	전기
I. 요약 재무정보		
요약 재무상태표:		
유동자산	109,181	116,372
비유동자산	198,268	185,100
유동부채	28,677	22,684
비유동부채	1,033	911
요약 포괄손익계산서(*):		
매출	114,093	80,203
계속영업손익	(2,475)	(3,808)
세후중단영업손익	-	-
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	(2,475)	(3,808)
II. 배당		
배당	-	-

(*) 분기 9개월 기준 금액입니다.

(3) 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	관계기업	공동기업	관계기업	공동기업
분기순손익	20,643	2,035	52,375	1,880
기타포괄손익	9,563	306	39,244	(241)
총포괄손익	30,206	2,341	91,619	1,639

바. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 주요 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

기 업 명	당분기말		전기말
	주식수	시장가치	시장가치
삼성전기주	17,693,084	2,344,334	2,710,580
삼성에스디에스주	17,472,110	2,702,935	2,970,259
삼성바이오로직스주	22,217,309	21,706,311	16,885,155
삼성SDI주	13,462,673	5,095,622	6,354,382
㈜제일기획	29,038,075	534,010	552,595

사. 기타사항

증권선물위원회는 연결회사의 관계기업인 삼성바이오로직스(주)가 Biogen Therapeutics Inc.와 합작 투자한 삼성바이오에피스(주) 지분에 대한 회계처리와 관련하여, 합작계약 약정사항의 재무제표 주석 미기재를 이유로 담당임원 해임권고, 검찰 고발, 감사인 지정 등의 조치(이하 "1차 처분")를 2018년 7월 12일에 의결하였으며, 연결대상 범위 회계처리 오류 등 회계기준 위반을 이유로 과징금 80억원 부과, 대표이사 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰 고발 등의 조치(이하 "2차 처분")를 2018년 11월 14일 의결하였습니다.

이에 대하여 삼성바이오로직스(주)는 회계처리의 정당성을 입증하기 위하여 위 처분의취소를 구하는 소송(이하 "본안 소송")을 서울행정법원에 제기하였고, 현재 소송을 진행 중입니다. 1차 처분의 취소를 구하는 소송과 관련하여, 서울행정법원은 2020년 9월 24일 증권선물위원회가 부과한 행정 처분을 취소한다고 판결하고, 항소심 판결 선고 시까지 위 처분의 효력을 정지하는 결정을 하였으나, 증권선물위원회는 2020년 10월 16일 항소하여 현재 서울고등법원에서 소송을 진행 중입니다. 2차 처분의 취소를 구하는 소송과 관련하여, 서울행정법원은 2024년 8월 14일 증권선물위원회가 부과한 행정처분을 취소한다고 판결하였으나, 증권선물위원회는 2024년 8월 28일 항소하여 현재 서울고등법원에서 소송이 진행 중입니다.

또한, 삼성바이오로직스(주)는 위 처분에 대한 효력정지신청서를 서울행정법원에 제출하였으며, 법원은 2019년 1월 22일(2차 처분)과 2019년 2월 19일(1차 처분)에 본안 소송의 판결 시까지 처분의 효력을 정지하는 결정을 선고하였습니다. 이에 증권선물위원회는 위 집행정지 결정에 대하여 즉시항고하였으며, 서울고등법원은 2019년 5월 13일(2차 처분), 2019년 5월 24일(1차 처분) 항고를 기각하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2019년 5월 23일(2차 처분), 2019년 6월 10일(1차 처분) 재항고하였으며, 대법원은 2019년 9월 6일(2차 처분), 2019년 10월 11일(1차 처분) 재항고를 기각하여 효력정지 결정이 확정되었습니다.

향후 행정소송의 결과를 예측하기 어려우나 소송 결과에 따라 삼성바이오로직스(주)가 삼성바이오에피스(주) 지분에 관한 과거 회계처리를 수정하여 재무제표를 재작성하게 될 경우, 이로 인해 연결회사의 2015년부터 2022년까지 보고기간의 지분법평가손익, 관계기업투자주식, 이익잉여금과 2016년 일부 지분 처분이익 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 현재로서는 삼성바이오로직스(주)와 증권선물위원회 간의 행정소송에 대한 종결 시기와 그 결과를 예측할 수 없으므로, 연결회사의 당분기 재무제표에 이를 반영하기 어렵습니다.

7. 유형자산 (연결)

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초 장부금액	187,256,262
일반취득 및 자본적지출	36,850,301
감가상각비, 유형자산	(28,915,583)
처분·폐기·손상	(654,829)
기타	492,622
분기말 장부금액	195,028,773

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초 장부금액	168,045,388
일반취득 및 자본적지출	38,286,686
감가상각비, 유형자산	(26,469,065)
처분·폐기·손상	(265,236)
기타	1,208,190
분기말 장부금액	180,805,963

기타 변동에 대한 각주, 유형자산

기타는 환율변동에 의한 증감액, 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

감가상각비의 기능별 배분

당분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	25,632,347	3,283,236	28,915,583

전분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	23,577,699	2,891,366	26,469,065

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
사용권자산	5,473,932

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
사용권자산	5,449,032

사용권자산 변동에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
사용권자산의 추가	1,009,402
감가상각비, 사용권자산	906,841

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
사용권자산의 추가	1,586,885
감가상각비, 사용권자산	902,719

8. 무형자산 (연결)

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	22,741,862
개별취득	1,987,741
사업결합을 통한 취득	162,170
상각	(2,214,669)
처분·폐기·손상	(43,129)

기타	443,482
분기말장부금액	23,077,457

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	20,217,754
개별취득	4,695,885
사업결합을 통한 취득	0
상각	(2,363,112)
처분·폐기·손상	(37,095)
기타	623,568
분기말장부금액	23,137,000

기타 변동에 대한 각주, 무형자산

기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

무형자산상각비의 기능별 배분

당분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	1,500,766	713,903	2,214,669

전분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	1,661,406	701,706	2,363,112

9. 차입금 (연결)

단기차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 백만원)

	차입금명칭						차입금명칭 합계
	단기차입금						
	담보부차입금-우리은행 등			무담보차입금-씨티은행 등			
범위		범위 합계	범위		범위 합계		
하위범위	상위범위		하위범위	상위범위			
연이자율	0.004	0.115		0.000	0.485		
단기차입금			10,763,366			271,753	
차입금에 대한 기술			담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다				

전기말

(단위 : 백만원)

	차입금명칭						차입금명칭 합계
	단기차입금						
	담보부차입금-우리은행 등			무담보차입금-씨티은행 등			
범위		범위 합계	범위		범위 합계		
하위범위	상위범위		하위범위	상위범위			

연이자율							
단기차입금			6,610,049			504,552	7,114,601
차입금에 대한 기술			담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다				

유동성장기차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 백만원)

차입금명칭								차입금명칭 합계
유동성장기차입금								
은행차입금-BNP 등		리스부채-CSSD 등_1						
범위		범위 합계		범위		범위 합계		
하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		
연이자율	0.000		0.553			0.046		
유동성장기차입금			531,243				1,051,626	1,582,869

전기말

(단위 : 백만원)

차입금명칭								차입금명칭 합계
유동성장기차입금								
은행차입금-BNP 등		리스부채-CSSD 등_1						
범위		범위 합계		범위		범위 합계		
하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		
연이자율								
유동성장기차입금			304,082				998,439	1,302,521

장기차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 백만원)

차입금명칭								차입금명칭 합계
장기 차입금								
은행차입금-BNP 등		리스부채-CSSD 등_2						
범위		범위 합계		범위		범위 합계		
하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		
연이자율	0.000		0.074			0.046		
장기차입금			6,829				3,758,608	3,765,437

전기말

(단위 : 백만원)

차입금명칭								차입금명칭 합계
장기 차입금								
은행차입금-BNP 등		리스부채-CSSD 등_2						
범위		범위 합계		범위		범위 합계		
하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		
연이자율								
장기차입금			0				3,724,850	3,724,850

리스부채 이자비용에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
--	------

리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채의 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며 당분기 중 발생한 이자비용은 165,307백만원입니다.
리스부채에 대한 이자비용	165,307

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채의 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며 전분기 중 발생한 이자비용은 144,529백만원입니다.
리스부채에 대한 이자비용	144,529

10. 사채 (연결)

사채에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	US\$ denominated Straight Bonds	US\$ denominated Debenture Bonds	차입금명칭 합계
발행일	1997-10-02	2015-05-11	
만기일	2027-10-01	2025-05-15	
연이자율	0.077	0.042	
명목금액, 외화금액	US\$ 15,000천	US\$ 400,000천	
명목금액	19,794	527,840	547,634
사채할인발행차금			(257)
사채할증발행차금			1,073
사채			548,450
차감: 유동성사채			(528,913)
비유동성사채			19,537
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	

전기말

(단위 : 백만원)

	US\$ denominated Straight Bonds	US\$ denominated Debenture Bonds	차입금명칭 합계
발행일	1997-10-02	2015-05-11	
만기일	2027-10-01	2025-05-15	
연이자율	0.077	0.042	
명목금액, 외화금액	US\$ 20,000천	US\$ 400,000천	
명목금액	25,788	515,760	541,548

사채할인발행차금			(370)
사채할증발행차금			2,794
사채			543,972
차감: 유동성사채			(6,354)
비유동성사채			537,618
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.	

11. 순확정급여부채(자산) (연결)

확정급여제도에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	15,958,738	398,072	16,356,810
사외적립자산의 공정가치			(19,898,086)
순확정급여부채(자산)계			(3,541,276)

전기말

(단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	15,403,976	319,689	15,723,665
사외적립자산의 공정가치			(20,172,327)
순확정급여부채(자산)계			(4,448,662)

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여제도			1,047,737

순이자비용(수익), 확정 급여제도			(196,885)
과거근무원가, 확정급여 제도			(572)
기타 비용, 확정급여제 도			29,624
퇴직급여비용 합계, 확 정급여제도	353,571	526,333	879,904

전분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여 제도			961,884
순이자비용(수익), 확정 급여제도			(263,823)
과거근무원가, 확정급여 제도			(609)
기타 비용, 확정급여제 도			14,414
퇴직급여비용 합계, 확 정급여제도	281,444	430,422	711,866

12. 총당부채 (연결)

기타총당부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	판매보증	기술사용료	장기성과급	기타	기타총당부채 합계
기초	2,540,212	1,838,052	993,751	4,031,311	9,403,326
순전입(환입)	1,499,314	759,774	190,046	2,191,119	4,640,253
사용	(1,416,539)	(519,812)	(459,940)	(1,142,644)	(3,538,935)
기타	39,784	(50,294)	8,584	13,126	11,200
분기말	2,662,771	2,027,720	732,441	5,092,912	10,515,844

<p>총당부채의 성격에 대한 기술</p>	<p>연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험을 등을 기초로 추정하여 총당부채로 설정하고 있습니다.</p>	<p>연결회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.</p>	<p>연결회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 총당부채로 계상하고 있습니다.</p>	<p>연결회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다.</p> <p>연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다.</p>	
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

기타총당부채에 대한 기술

기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

무상할당배출권과 배출량 추정치에 대한 공시

	배출량
무상할당 배출권	1,796만톤(tCO ₂ -eq)
배출량 추정치	1,811만톤(tCO ₂ -eq)

배출권 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초	3,137
증가	0
사용	0
분기말	3,137

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초	19,567
증가	1,272
사용	(17,702)
분기말	3,137

배출부채 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초	137
순전입(환입)	(33)
사용	0
분기말	104

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초	32,838
순전입(환입)	(15,212)
사용	(17,491)
분기말	135

13. 우발부채와 약정사항 (연결)

법적소송우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	법적소송우발부채
유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채	당분기말 현재 연결회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	유·무형자산의 취득 약정
약정 금액	14,020,069
약정에 대한 설명	당분기말 현재 발생하지 않은 유·무형자산의 취득을 위한 약정액은 14,020,069백만원입니다.

14. 계약부채 (연결)

계약부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	13,174,413

전기말 (단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	13,327,724

계약부채에 대한 기술

계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

15. 자본금 (연결)

주식의 분류에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주	주식 합계
회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수(주)			25,000,000,000
주당 액면가액(원)			100
발행주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700	
유통주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700	
발행주식 액면 총액(백만원)	596,978	82,289	679,267
납입자본금(백만원)			897,514

자본에 대한 설명		<p>보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사에는 보통주 외 비누적적 우선주가 있습니다. 이 우선주는 의결권이 없고 액면금액을 기준으로 보통주의 배당보다 연 1%의 금전배당을 추가로 받을 수 있습니다. 보고기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 또한, 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하며, 당분기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면 총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.</p>
-----------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 연결이익잉여금 (연결)

이익잉여금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

		공시금액
이익잉여금		365,359,495
이익잉여금	임의적립금 등	208,888,506
	연결미처분이익잉여금	156,470,989

전기말

(단위 : 백만원)

		공시금액
이익잉여금		346,652,238

이익잉여금	임의적립금 등	208,198,003
	연결미처분이익잉여금	138,454,235

배당금에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	배당의 구분								
	1분기 배당			2분기 배당			3분기 배당		
	주식		주식 합계	주식		주식 합계	주식		주식 합계
보통주	우선주	보통주		우선주	보통주		우선주		
배당기준일			2024-03-31			2024-06-30			2024-09-30
배당받을 주식(주)	5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700	
보통주 주당 배당률 (액면가 기준)	3.61			3.61			3.61		
우선주 주당 배당률 (액면가 기준)		3.61			3.61			3.61	
배당금액	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154

전분기

(단위 : 백만원)

	배당의 구분								
	1분기 배당			2분기 배당			3분기 배당		
	주식		주식 합계	주식		주식 합계	주식		주식 합계
보통주	우선주	보통주		우선주	보통주		우선주		
배당기준일			2023-03-31			2023-06-30			2023-09-30
배당받을 주식(주)	5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700	
보통주 주당 배당률 (액면가 기준)	3.61			3.61			3.61		
우선주 주당 배당률 (액면가 기준)									
배당금액	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154

17. 기타자본항목 (연결)

기타자본구성요소

당분기말

(단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		5,491,296
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	1,565,742
	관계기업 및 공동기업의 기타포 괄손익누계액에 대한 지분	230,833
	해외사업장환산외환차이	6,580,200
	순확정급여부채(자산) 재측정요 소	(2,939,570)
	기타	54,091

전기말

(단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		1,280,130
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산	194,419

	평가손익	
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익누계액에 대한 지분	185,144
	해외사업장환산외환차이	3,651,112
	순확정급여부채(자산) 재측정요소	(2,849,526)
	기타	98,981

18. 비용의 성격별 분류 (연결)

비용의 성격별 분류 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
제품 및 재공품 등의 변동	597,733	(396,638)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	24,960,996	72,116,219
급여	8,647,579	24,876,278
퇴직급여	373,411	1,088,347
감가상각비	10,308,425	28,915,583
무형자산상각비	749,115	2,214,669
복리후생비	1,613,546	5,014,355
유틸리티비	2,195,661	6,189,017
외주용역비	2,012,305	5,779,356
광고선전비	1,444,625	4,203,296
판매촉진비	1,937,967	5,554,795
기타 비용	15,073,997	43,294,099
성격별 비용 합계	69,915,360	198,849,376

전분기

(단위 : 백만원)

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
제품 및 재공품 등의 변동	(630,592)	(3,783,006)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	26,445,655	74,832,914
급여	6,920,360	22,911,999
퇴직급여	276,350	827,860
감가상각비	8,900,426	26,469,065
무형자산상각비	786,661	2,363,112

복리후생비	1,538,580	4,820,029
유틸리티비	1,930,649	5,563,137
외주용역비	1,760,398	5,171,254
광고선전비	1,684,283	3,903,065
판매촉진비	1,831,205	5,072,992
기타 비용	13,527,143	39,260,876
성격별 비용 합계	64,971,118	187,413,297

성격별 비용에 대한 공시

연결손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비 (연결)

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
급여	2,176,493	6,537,999
퇴직급여	106,070	297,335
지급수수료	2,266,533	6,547,732
감가상각비	424,337	1,255,711
무형자산상각비	180,620	532,590
광고선전비	1,444,625	4,203,296
판매촉진비	1,937,967	5,554,795
운반비	786,621	2,148,165
서비스비	886,518	2,910,159
기타판매비와관리비	1,743,523	4,832,030
소계	11,953,307	34,819,812
경상연구개발비-연구개발 총지출액	8,866,970	24,736,123
계	20,820,277	59,555,935

전분기

(단위 : 백만원)

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
급여	2,041,225	6,215,701
퇴직급여	67,982	208,139
지급수수료	2,090,579	6,265,157
감가상각비	414,681	1,237,680

무형자산상각비	173,252	514,838
광고선전비	1,684,283	3,903,065
판매촉진비	1,831,205	5,072,992
운반비	397,097	1,231,700
서비스비	1,129,564	3,239,695
기타판매비와관리비	1,509,981	4,461,489
소계	11,339,849	32,350,456
경상연구개발비-연구개발 총지출액	7,012,543	20,789,832
계	18,352,392	53,140,288

20. 기타수익 및 기타비용 (연결)

기타수익 및 기타비용

당분기

(단위 : 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
기타수익		712,914	1,476,696
기타수익	배당금수익	28,901	101,417
	임대료수익	39,082	116,801
	유형자산처분이익	11,370	39,727
	기타	633,561	1,218,751
기타비용		553,052	1,179,941
기타비용	유형자산처분손실	75,763	107,000
	기부금	35,784	141,168
	기타	441,505	931,773

전분기

(단위 : 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
기타수익		244,352	949,823
기타수익	배당금수익	34,490	131,278
	임대료수익	37,383	112,288
	유형자산처분이익	28,003	83,050
	기타	144,476	623,207
기타비용		206,403	579,442
기타비용	유형자산처분손실	50,034	70,037
	기부금	76,808	179,601
	기타	79,561	329,804

21. 금융수익 및 금융비용 (연결)

금융수익 및 금융비용
당분기

(단위 : 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
이자수익(금융수익)		1,231,838	3,582,119
이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	1,231,772	3,581,969
	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 이 자수익	66	150
외환차이		2,151,676	6,470,989
파생상품관련이익		233,996	635,649
금융수익 합계		3,617,510	10,688,757
이자비용		244,966	682,486
이자비용	상각후원가 측정 금융부 채 이자비용	63,833	157,841
	기타 금융부채 이자비용	181,133	524,645
외환차이		2,322,090	6,874,638
파생상품관련손실		256,686	635,925
금융비용 합계		2,823,742	8,193,049

전분기

(단위 : 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
이자수익(금융수익)		1,145,777	3,358,496
이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	1,145,726	3,358,318
	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 이 자수익	51	178
외환차이		2,540,874	8,419,489
파생상품관련이익		425,507	1,019,150
금융수익 합계		4,112,158	12,797,135
이자비용		279,290	857,860
이자비용	상각후원가 측정 금융부 채 이자비용	159,815	487,721
	기타 금융부채 이자비용	119,475	370,139

외환차이	2,455,110	8,387,347
파생상품관련손실	169,317	859,051
금융비용 합계	2,903,717	10,104,258

금융수익 및 금융비용에 대한 기술

연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다

22. 법인세비용 (연결)

법인세에 대한 분기별 공시

	내용
법인세비용 인식에 대한 기술	법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 최선의 가중평균연간법인세율로 인식하였습니다.
2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 평균 연간법인세율	0.099

23. 주당이익 (연결)

주당이익

당분기

(단위 : 백만원)

	주식			
	보통주		우선주	
	3개월	누적	3개월	누적
지배기업 소유주지분	9,781,547	26,045,230	9,781,547	26,045,230
보통주에 귀속되는 분기순이익(손실)	8,596,578	22,890,024		
가중평균유통보통주식수(주)	5,969,782,550	5,969,782,550		
기본 보통주 주당 이익(원)	1,440	3,834		
지배기업의 우선주에 귀속되는 분기순이익(손실)			1,184,969	3,155,206
가중평균유통우선주식수(주)			822,886,700	822,886,700
기본 우선주 주당 이익(원)			1,440	3,834

	주식			
	보통주		우선주	
	3개월	누적	3개월	누적
지배기업 소유주지분	5,501,304	8,449,574	5,501,304	8,449,574
보통주에 귀속되는 분기순이익(손실)	4,834,858	7,425,965		
가중평균유통보통주식수(주)	5,969,782,550	5,969,782,550		
기본 보통주 주당 이익(원)	810	1,244		
지배기업의 우선주에 귀속되는 분기순이익(손실)			666,446	1,023,609
가중평균유통우선주식수(주)			822,886,700	822,886,700
기본 우선주 주당 이익(원)			810	1,244

희석주당이익에 대한 기술

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당분기 및 전분기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표 (연결)

현금흐름의 회계정책에 대한 기술

연결회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당분기 및 전분기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

영업활동현금흐름

당분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		30,074,094
조정내역 계	법인세비용	2,925,522
	금융수익	(5,128,916)
	금융비용	2,772,362
	퇴직급여	1,088,347
	감가상각비	28,915,583
	무형자산상각비	2,214,669
	대손충당금환입	(9,458)
	대손상각비	

	배당금수익	(101,417)
	지분법이익	(596,758)
	유형자산처분이익	(39,727)
	유형자산처분손실	107,000
	재고자산평가손실환입	(2,437,809)
	재고자산평가손실	
	기타	364,696
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(3,323,423)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	(7,829,780)
	미수금의 감소(증가)	355,257
	장단기선급비용의 감소(증가)	(409,024)
	재고자산의 감소(증가)	1,007,521
	매입채무의 증가(감소)	893,040
	장단기미지급금의 증가(감소)	839,263
	선수금의 증가(감소)	216,611
	예수금의 증가(감소)	(37,551)
	미지급비용의 증가(감소)	1,628,874
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,101,318
	퇴직금의 지급	(1,042,780)
	기타	(46,172)

전분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		30,111,057
조정내역 계	법인세비용	(1,660,366)
	금융수익	(5,173,514)
	금융비용	3,067,746
	퇴직급여	827,860
	감가상각비	26,469,065
	무형자산상각비	2,363,112
	대손충당금환입	
	대손상각비	91,444
	배당금수익	(131,278)
	지분법이익	(676,459)
	유형자산처분이익	(83,050)
	유형자산처분손실	70,037
	재고자산평가손실환입	
	재고자산평가손실	4,919,360
	기타	27,100
	영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	(5,734,362)
	미수금의 감소(증가)	990,596
	장단기선급비용의 감소(증가)	(377,419)
	재고자산의 감소(증가)	(6,286,040)
	매입채무의 증가(감소)	1,380,348
	장단기미지급금의 증가(감소)	637,296
	선수금의 증가(감소)	58,239
	예수금의 증가(감소)	(540,655)
	미지급비용의 증가(감소)	(4,137,776)
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,778,811
	퇴직금의 지급	(536,633)
	기타	(165,738)

리스 현금유출

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	885,181
리스부채에 대한 이자비용, 영업활동에서 생기는 현금유출	165,307

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	814,987
리스부채에 대한 이자비용, 영업활동에서 생기는 현금유출	144,529

25. 재무위험관리 (연결)

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	위험						위험 합계
	시장위험			신용위험	유동성위험	자본위험	
	환위험	이자율위험	지분가격위험				
위험에 대한 노출 정도에 대한 기술	연결회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 통화화외 다 른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위	이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인 해 투자 및 재무활동 으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현 금흐름이 변동될 위 험으로서, 주로 예금	당분기말 현재 지분 상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세 효과 반영 전)에 미치는 영향은 69,740백 만원(전분기:)	연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일 합니다.			

	<p>형에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.</p>	<p>및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다.</p>	<p>65,826백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 1,060백만원(전분기: 3,519백만원)입니다.</p>				
--	------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

<p>위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술</p>	<p>연결회사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 가능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 연결회사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한, 연결회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.</p>	<p>연결회사는 내부자금 공유를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.</p>	<p>연결회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융 자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 자본상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 적·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.</p>	<p>신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건의 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험극가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험이 관리되고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성 자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비용 제한 조항, 담보제공,</p>	<p>유동성위험이란 연결회사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결회사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 연결회사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다. 연결회사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별 회사의 유동성위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다. 또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대</p>	<p>연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표</p>	<p>연결회사는 영업활동에서 파생되는 시장 위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다. 재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다. 한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다. 연결회사의 재무위험 관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성 자산, 단기금융상품, 상각후원금금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.</p>
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.</p>	<p>비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 중속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.</p>		
지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익에 미치는 영향			69,740				
지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 당기손익에 미치는 영향			1,060				

전분기

(단위 : 백만원)

	위험						위험 합계
	시장위험			신용위험	유동성위험	자본위험	
	환위험	이자율위험	지분가격위험				
위험에 대한 노출 정도에 대한 기술							
위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술							
지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익에 미치는 영향			65,826				
지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 당기손익에 미치는 영향			3,519				

부채비율에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	총장부금액
부채	105,025,954
자본	386,281,363

부채비율	0.272
------	-------

전기말

(단위 : 백만원)

총장부금액	
부채	92,228,115
자본	363,677,865
부채비율	0.254

공정가치 측정, 금융자산

당분기말

(단위 : 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	단기상각후원가금융자산	단기당기손익-공정가치금융자산	매출채권	기타포괄손익-공정가치금융자산	당기손익-공정가치금융자산	기타	금융자산, 분류 합계
장부금액	43,131,359	60,616,598	0	28,571	44,692,044	9,640,598	1,185,582	13,101,124	172,395,876
공정가치			0	28,571		9,640,598	1,185,582	396,286	
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금융자산								12,704,838	
공정가치 공시 제외 사유에 대한 기술	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.			장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.			장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 12,704,838백만원은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

전기말

(단위 : 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	단기상각후원가금융자산	단기당기손익-공정가치금융자산	매출채권	기타포괄손익-공정가치금융자산	당기손익-공정가치금융자산	기타	금융자산, 분류 합계
장부금액	69,080,893	22,690,924	608,281	27,112	36,647,393	7,481,297	1,431,394	14,840,275	152,807,569
공정가치				27,112		7,481,297	1,431,394	546,021	
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금융자산								14,294,254	
공정가치 공시 제외 사유에 대한 기술	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.			장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 14,294,254백만원은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

공정가치 측정, 금융부채

당분기말

(단위 : 백만원)

매입채무	단기차입금	미지급금	유통성장기부채	유통성장기차입금	유통성사채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합계

장부금액	12,861,787	11,035,119	14,107,676	2,111,782	1,582,869	528,913	19,537	3,765,437	4,728,755	13,292,404	61,922,497
공정가치				525,007		525,007	21,479			94,661	
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금융부채										13,197,743	
공정가치 공시 제외 사유에 대한 기술	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융부채 13,197,743백만원은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

전기말

(단위 : 백만원)

매입채무	단기차입금	미지급금	유동성장기부채	유동성장기차입금	유동성사채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합계	
장부금액	11,319,824	7,114,601	13,996,395	1,308,875	1,302,521	6,354	537,618	3,724,850	4,907,875	11,414,008	54,324,046
공정가치				6,757		6,757	529,254			83,463	
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금융부채										11,330,545	
공정가치 공시 제외 사유에 대한 기술	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융부채 11,330,545백만원은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.		

금융상품의 공정가치 서명체계에 따른 수준별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

측정 단계	당기당기손익-공정가치금융자산			기타포괄손익-공정가치금융자산			당기손익-공정가치금융자산			기타포괄자산			유동성사채			사채			기타금융부채				
	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명체계의 모든 수준			
수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계	수준 1	수준 2	수준 3	의 모든 수준 합계
0	28,571	0	28,571	6,973,98	0	2,666,61	9,640,59	106,002	0	1,079,58	1,185,58	0	66,941	329,345	396,286								

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용됩니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에 포함된 상품은 파생상품, 사채 등이 있습니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

연결회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포 모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

연결회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

자신의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

(단위 : 백만원)

공정가치 서열체계의 모든 수준																													
공정가치 서열체계 수준 3																													
금융상품																													
기타포괄손익-공정가치금융자산										기타																			
삼성전자주					위미코세라믹스					TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. (CSOT)					China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)					지프 콜옵션					지프 북옵션				
관측할 수 없는 투입변수					관측할 수 없는 투입변수					관측할 수 없는 투입변수					관측할 수 없는 투입변수					관측할 수 없는 투입변수					관측할 수 없는 투입변수				
평가	가치	변동	변동	변동	평가	가치	변동	변동	변동	평가	가치	변동	변동	변동	평가	가치	변동	변동	변동	평가	가치	변동	변동	변동	평가	가치	변동	변동	변동
영구	평균	최대	최소	가치	영구	평균	최대	최소	가치	영구	평균	최대	최소	가치	영구	평균	최대	최소	가치	영구	평균	최대	최소	가치	영구	평균	최대	최소	가치
성장	기본	차별	차별	변동	성장	기본	차별	차별	변동	성장	기본	차별	차별	변동	성장	기본	차별	차별	변동	성장	기본	차별	차별	변동	성장	기본	차별	차별	변동
불투명	비율	1.측	2.측	측정	불투명	비율	1.측	2.측	측정	불투명	비율	1.측	2.측	측정	불투명	비율	1.측	2.측	측정	불투명	비율	1.측	2.측	측정	불투명	비율	1.측	2.측	측정
입변	측정	장부	장부	투입	입변	측정	장부	장부	투입	입변	측정	장부	장부	투입	입변	측정	장부	장부	투입	입변	측정	장부	장부	투입	입변	측정	장부	장부	투입
변수	투입	입변	입변	변수	변수	투입	입변	입변	변수	변수	투입	입변	입변	변수	변수	투입	입변	입변	변수	변수	투입	입변	입변	변수	변수	투입	입변	입변	변수
변수	투입	입변	입변	변수	변수	투입	입변	입변	변수	변수	투입	입변	입변	변수	변수	투입	입변	입변	변수	변수	투입	입변	입변	변수	변수	투입	입변	입변	변수

	수준 3
기초금융자산	3,730,134
매입	185,466
매도	(104,811)
당기손익으로 인식된 손익	(64,210)
기타포괄손익으로 인식된 손익	220,924
기타	108,033
분기말금융자산	4,075,536

전분기

(단위 : 백만원)

	수준 3
기초금융자산	3,303,227
매입	170,913
매도	(80,013)
당기손익으로 인식된 손익	367,233
기타포괄손익으로 인식된 손익	41,452
기타	22,416
분기말금융자산	3,825,228

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계 수준 3
기초금융부채	0
당기손익으로 인식된 손익	0
분기말금융부채	0

전분기

(단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계 수준 3
기초금융부채	7,404
당기손익으로 인식된 손익	(5,884)
분기말금융부채	1,520

관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정의 민감도분석 공시, 자산

(단위 : 백만원)

공정가치 서열체계의 모든 수준										자산 합계
공정가치 서열체계 수준 3										
기타포괄손익-공정가치금융자산					기타					
관측할 수 없는 투입변수					관측할 수 없는 투입변수					
영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용	기초 자산 가격, 즉	가격 변동성	관측할 수 없는 투입변수 합계	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용	기초 자산 가격, 즉	가격 변동성	관측할 수 없는 투입변수 합계	
수	측정 투입변수	정 투입변수			수	측정 투입변수	정 투입변수			
관측가능하지 않은	주요 관측불가능한	주요 관측불가능한			주요 관측불가능한	주요 관측불가능한			금융상품의 민감도	

투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정의 민감도에 대한 기술, 자산	투입변수인 영구성 장비를 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.	투입변수인 기준평가자본비용을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.						투입변수인 기초자산 가격(20%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.	투입변수인 가격 변동성(10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.		분석은 통계적 기법을 이용한 연속 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 여는 정도 있는 증가율, 자산	0.01	0.01						0.20	0.10		
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 여는 정도 있는 감소율, 자산	0.01	0.01						0.20	0.10		
당기손익(세전)으로 인식된, 가능성이 여는 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 변경하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산						0				86,470	
당기손익(세전)으로 인식된, 가능성이 여는 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 변경하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산						0				(80,151)	

기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정 가치 측정치의 증가, 자산					188,847						0	
기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정 가치 측정치의 감소, 자산					(123,174)						0	

26. 부문별 보고 (연결)

영업부문에 통합기준을 적용하면서 이루어진 경영진의 판단에 대한 설명

연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman 등으로 구성되어 있습니다.

당분기와 전분기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부거래조정액이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

영업부문에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	기업 전체 총계										기업 전체 총계 합계	
	영업부문								내부거래 조정 등			
	DX 부문		DS부문		SDC		Harman		3개월	누적	3개월	누적
매출액	44,993,923	134,357,477	29,271,373	80,965,214	7,999,109	21,031,687	3,529,579	10,348,923	(6,695,253)	(21,620,667)	79,098,731	225,082,634
감가상각비	645,059	1,927,417	8,922,648	24,769,254	606,882	1,815,166	81,078	254,625	0	0	10,308,425	28,915,583
무형자산상각비	405,108	1,213,969	173,843	499,189	59,290	173,765	47,837	156,329	0	0	749,115	2,214,669
영업이익	3,372,679	10,170,049	3,864,208	12,229,183	1,513,546	2,864,337	355,346	916,271	0	0	9,183,371	26,233,258
보고부문에 대한 기타											기타는 별도로 표 시하지 않았습니다	기타는 별도로 표 시하지 않았습니다

	기업 전체 총계										기업 전체 총계 합계	
	영업부문											
	DX 부문		DS부문		SDC		Harman		내부거래 조정 등		3개월	누적
매출액	44,015,400	130,444,087	16,438,381	44,902,120	8,218,580	21,315,797	3,802,481	10,464,123	(5,070,190)	(15,970,571)	67,404,652	191,155,556
광고상각비	630,205	1,886,122	7,348,081	21,759,591	789,196	2,426,796	84,909	247,977	0	0	8,900,426	26,469,065
무형자산상각비	434,536	1,285,032	186,394	585,578	55,773	166,420	52,523	152,204	0	0	786,661	2,363,112
영업이익	3,728,081	11,766,221	(3,753,932)	(12,697,630)	1,935,165	3,554,250	450,247	830,577	0	0	2,433,534	3,742,259
보고부문에 대한 기술											기타는 별도로 표 시하지 않았습니다	기타는 별도로 표 시하지 않았습니다

제품과 용역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	제품과 용역								제품과 용역 합계	
	TV, 모니터 등		스마트폰 등		메모리		디스플레이 패널			
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
매출액	7,581,896	22,359,402	29,980,552	89,412,970	22,273,248	61,505,350	7,999,109	21,031,687	79,098,731	225,082,634
주요 제품별 매출액에 대한 기술									기타는 별도로 표시하 지 않았습니다.	기타는 별도로 표시하 지 않았습니다.

전분기

(단위 : 백만원)

	제품과 용역								제품과 용역 합계	
	TV, 모니터 등		스마트폰 등		메모리		디스플레이 패널			
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
매출액	7,318,422	21,999,115	29,248,961	84,602,205	10,530,033	28,414,389	8,218,580	21,315,797	67,404,652	191,155,556
주요 제품별 매출액에 대한 기술									기타는 별도로 표시하 지 않았습니다.	기타는 별도로 표시하 지 않았습니다.

지역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	지역												지역 합계	
	연결상태 내 내부거래조정													
	국내		외국		미주		유럽		아시아 및 아프리카		중국			
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
순매출액	11,341,928	30,471,436	31,181,768	84,677,152	12,237,026	37,407,038	13,123,500	37,766,889	11,214,509	34,760,119	0	0	79,098,731	225,082,634
비유동자산	170,564,139	170,564,139	24,377,872	24,377,872	6,512,175	6,512,175	8,701,671	8,701,671	10,154,527	10,154,527	(2,204,154)	(2,204,154)	218,106,230	218,106,230
비유동자산에 대한 기술													금융상품, 이연법인세 자산, 관계기업 및 공 동기업 투자 등이 제 외된 금액입니다.	금융상품, 이연법인세 자산, 관계기업 및 공 동기업 투자 등이 제 외된 금액입니다.

전분기

(단위 : 백만원)

	지역												지역 합계	
	연결상태 내 내부거래조정													
	국내		외국		미주		유럽		아시아 및 아프리카		중국			
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
순매출액	12,422,555	33,992,795	24,194,051	88,278,483	11,730,385	35,377,983	11,797,052	34,344,380	7,260,609	19,161,955	0	0	67,404,652	191,155,556
비유동자산	158,137,128	158,137,128	17,953,693	17,953,693	6,136,716	6,136,716	9,276,504	9,276,504	13,306,785	13,306,785	(867,861)	(867,861)	203,942,963	203,942,963
비유동자산에 대한 기술													금융상품, 이연법인세 자산, 관계기업 및 공 동기업 투자 등이 제 외된 금액입니다.	금융상품, 이연법인세 자산, 관계기업 및 공 동기업 투자 등이 제 외된 금액입니다.

27. 특수관계자와의 거래 (연결)

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자										
	특수관계자					그 밖의 특수관계자			대규모기업집단		
	관계기업 및 공동기업										
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜재일기획	기타 관계기업 및 공동기업	삼성물산㈜	기타 그 밖의 특수관계자	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집단 소속회사	
매출 등, 특수관계자거래	81,802	37,780	86,152	34,683	843,164	19,565	586,364	1,953	6,813	183,757	
비유동자산 처분, 특수관계자거래	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0	
매입 등, 특수관계자거래	1,580,188	937,543	511,733	719,500	9,099,633	172,379	1,063,359	37,862	395,780	411,103	
비유동자산 매입, 특수관계자거래	199,395	0	18,401	13,760	163,439	4,920,921	3,213,117	2,637,963	19,313	559,202	
특수관계자거래에 대한 기술	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	
특수관계의 성격에 대한 기술								기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자										
	특수관계자					그 밖의 특수관계자			대규모기업집단		
	관계기업 및 공동기업										
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜재일기획	기타 관계기업 및 공동기업	삼성물산㈜	기타 그 밖의 특수관계자	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집단 소속회사	
매출 등, 특수관계자거래	120,809	61,381	90,332	37,183	697,346	41,776	378,253	1,055	7,493	167,119	
비유동자산 처분, 특수관계자거래	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	
매입 등, 특수관계자거래	1,481,041	860,130	555,308	638,490	9,302,277	196,312	1,324,651	23,919	391,091	887,932	
비유동자산 매입, 특수관계자거래	219,924	60	21,037	1,162	119,468	3,907,737	2,952,677	1,922,259	28,792	302,680	
특수관계자거래에 대한 기술	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	

								기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

특수관계자거래에 대한 공시, 합계

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
매출 등, 특수관계자거래	1,083,581	605,929	192,523
비유동자산 처분, 특수관계자거래	122	0	0
매입 등, 특수관계자거래	12,848,597	1,235,738	844,745
비유동자산 매입, 특수관계자거래	394,995	8,134,038	3,216,478
특수관계자거래에 대한 기술	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술			기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
매출 등, 특수관계자거래	1,007,051	420,029	175,667
비유동자산 처분, 특수관계자거래	0	70	0
매입 등, 특수관계자거래	12,837,246	1,521,163	1,302,942

비유동자산 매입, 특수관계자거래	361,651	6,860,414	2,253,731
특수관계자거래에 대한 기술	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술			기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자					그 밖의 특수관계자		대규모기업집단		
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜재일기획	기타 관계기업 및 공동기업	삼성물산㈜	기타 그 밖의 특수관계자	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집단 소속회사
채권 등, 특수관계자거래	8,760	315	123,744	55	229,461	207,266	21,497	1,558	983	57,567
채무 등, 특수관계자거래	614,294	160,847	80,769	329,371	1,184,690	1,102,293	244,223	1,296,518	41,192	264,930
특수관계자거래의 채권, 채무의 조건에 대한 설명	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스 부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스 부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스 부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스 부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스 부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스 부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스 부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스 부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스 부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스 부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술								기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전기말

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자					그 밖의 특수관계자		대규모기업집단		
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜재일기획	기타 관계기업 및 공동기업	삼성물산㈜	기타 그 밖의 특수관계자	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집단 소속회사
채권 등, 특수관계자거래	84,747	1,894	117,690	137	310,708	213,538	23,155	305	1,289	16,096
채무 등, 특수관계자거래	458,723	138,405	92,854	440,414	1,268,131	1,955,976	318,355	807,098	49,955	390,073

연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술								기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	

특수관계자에 대한 채권 채무에 대한 공시, 합계
당분기말

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
채권 등, 특수관계자거래	362,355	228,763	60,108
채무 등, 특수관계자거래	2,369,971	1,346,516	1,602,640
특수관계자거래의 채권, 채무의 조건에 대한 설명	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술			기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

전기말

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
채권 등, 특수관계자거래	515,176	236,693	17,690

채무 등, 특수관계자거래	2,398,527	2,274,331	1,247,126
특수관계자거래의 채권, 채무의 조건에 대한 설명	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술			기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

특수관계자 자금거래에 관한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자	
	특수관계자	
	관계기업 및 공동기업	대규모기업집단
현금출자, 출자금 납입	10,999	
현금출자, 출자금 회수	28,878	
지급결의한 배당금, 특수관계자 거래		96,174

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자	
	특수관계자	
	관계기업 및 공동기업	대규모기업집단
현금출자, 출자금 납입	71,875	
현금출자, 출자금 회수	24,517	
지급결의한 배당금, 특수관계자 거래		96,174

특수관계자 자금거래에 관한 공시_2

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자
지급결의한 배당금, 특수관계자거래	1,212,155

미지급 배당금, 특수관계자거래	0
리스 이용 계약, 특수관계자거래	28,726
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래	20,636

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자
지급결의한 배당금, 특수관계자거래	1,238,585
미지급 배당금, 특수관계자거래	0
리스 이용 계약, 특수관계자거래	1,812
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래	18,860

주요 경영진(등기임원)에 대한 보상에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
단기급여	7,186
퇴직급여	468
기타 장기급여	6,251

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
단기급여	7,737
퇴직급여	418
기타 장기급여	5,876

28. 매각예정분류(처분자산집단) (연결)

처분자산집단에 대한 공시

전기말

(단위 : 백만원)

	매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단
--	---------------------------

처분 또는 재분류된 매각예정으로 분류된 비유동 자산이나 처분자산집단에 대한 기술	전기 중 연결회사의 경영진은 (주)도우인시스 지분 56.8%를 (주)뉴파워프라즈마 등 3개사에게 매각하기로 결정하였습니다. 2023년 12월 7일 계약이 체결되었으며, 2024년 1월 31일 매각이 완료되었습니다.
매각지분율	0.568
매각계약체결일자	2023-12-07
매각완료일자	2024-01-31

매각예정으로 분류한 자산 및 부채에 대한 공시

전기말

(단위 : 백만원)

		매각예정으로 분류된 비유동 자산이나 처분자산집단
매각예정분류자산		217,864
매각예정분류자산	현금및현금성자산	14,153
	매출채권	1,316
	유동재고자산	4,697
	기타유동자산	13,134
	유형자산 및 무형자산	181,251
	기타비유동자산	3,313
매각예정분류부채		61,654
매각예정분류부채	유동부채	27,608
	비유동부채	34,046

매각예정으로 분류한 기타자본항목에 대한 공시

전기말

(단위 : 백만원)

		자본
		기타포괄손익누적액
		매각예정으로 분류된 비유동자산 또는 처분자산 집단과 관련하여 기타포괄손익으로 인식되어 자본에 누적된 금액
해외사업장환산외환차이		(217)

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 56 기 3분기말 2024.09.30 현재

제 55 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 56 기 3분기말	제 55 기말
자산		
유동자산	88,773,816	68,548,442
현금및현금성자산 (주3,25)	5,582,718	6,061,451
단기금융상품 (주3,25)	11,063,471	50,071
매출채권 (주3,25)	35,176,097	27,363,016
미수금 (주3,25)	1,455,772	1,910,054
선급비용	1,497,782	1,349,755
재고자산 (주5)	30,958,795	29,338,151
기타유동자산 (주3,25)	3,039,181	2,475,944
비유동자산	234,608,995	228,308,847
기타포괄손익-공정가치금융자산 (주3,4,25)	2,100,328	1,854,503
당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,25)	0	1
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 (주6)	57,436,120	57,392,438
유형자산 (주7)	145,113,639	140,579,161
무형자산 (주8)	10,522,995	10,440,211
순확정급여자산 (주11)	3,032,337	3,745,697
이연법인세자산	12,713,763	9,931,358
기타비유동자산 (주3,25)	3,689,813	4,365,478
자산총계	323,382,811	296,857,289
부채		
유동부채	74,771,238	41,775,101
매입채무 (주3,25)	11,239,430	7,943,834
단기차입금 (주3,9,25)	9,572,235	5,625,163
미지급금 (주3,25)	13,086,542	15,256,046
선수금 (주14)	307,649	302,589
예수금 (주3,25)	444,119	445,470
미지급비용 (주3,14,25)	9,789,336	6,931,991
당기법인세부채	2,446,656	0
유동성장기부채 (주3,9,10,25)	22,268,174	228,491
총당부채 (주12)	5,283,184	4,540,702
기타 유동부채 (주14)	333,913	500,815
비유동부채	8,539,578	30,294,414
사채 (주3,10,25)	19,537	19,064
장기차입금 (주3,9,25)	833,820	22,902,035
장기미지급금 (주3,25)	4,791,551	4,942,826
장기총당부채 (주12)	2,881,359	2,413,133
기타 비유동 부채	13,311	17,356
부채총계	83,310,816	72,069,515
자본		
자본금 (주15)	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893

이익잉여금 (주16)	235,134,369	219,963,351
기타자본항목 (주17)	(363,781)	(476,984)
자본총계	240,071,995	224,787,774
부채와자본총계	323,382,811	296,857,289

4-2. 손익계산서 손익계산서

제 56 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 56 기 3분기		제 55 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액 (주26)	55,828,922	160,802,657	45,866,224	127,763,991
매출원가 (주18)	40,110,052	115,064,366	38,570,371	109,492,430
매출총이익	15,718,870	45,738,291	7,295,853	18,271,561
판매비와관리비 (주18,19)	11,213,950	32,003,500	9,463,841	28,046,413
영업이익(손실) (주26)	4,504,920	13,734,791	(2,167,988)	(9,774,852)
기타수익 (주20)	248,312	9,846,280	7,368,532	29,471,874
기타비용 (주20)	102,321	458,707	118,180	249,611
금융수익 (주21)	1,377,577	4,448,859	2,080,064	6,062,738
금융비용 (주21)	1,707,108	4,810,113	2,060,513	6,537,513
법인세비용차감전순이익	4,321,380	22,761,110	5,101,915	18,972,636
법인세비용(수익) (주22)	(1,373,230)	230,646	(5,314,896)	(5,186,903)
분기순이익	5,694,610	22,530,464	10,416,811	24,159,539
주당이익 (주23)				
기본주당이익 (단위 : 원)	838	3,317	1,534	3,557
희석주당이익 (단위 : 원)	838	3,317	1,534	3,557

4-3. 포괄손익계산서 포괄손익계산서

제 56 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 56 기 3분기		제 55 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
분기순이익	5,694,610	22,530,464	10,416,811	24,159,539
기타포괄손익	(41,205)	111,041	54,585	(10,412)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(41,205)	111,041	54,585	(10,412)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	(63,024)	183,835	89,733	359,845
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	21,819	(72,794)	(35,148)	(370,257)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0	0

분기총포괄손익	5,653,405	22,641,505	10,471,396	24,149,127
---------	-----------	------------	------------	------------

4-4. 자본변동표

자본변동표

제 56 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	자본				
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계
2023.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	204,388,016	(273,232)	209,416,191
분기순이익	0	0	24,159,539	0	24,159,539
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	0	359,845	359,845
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(370,257)	(370,257)
배당	0	0	(7,357,284)	0	(7,357,284)
2023.09.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	221,190,271	(283,644)	226,208,034
2024.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	219,963,351	(476,984)	224,787,774
분기순이익	0	0	22,530,464	0	22,530,464
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	(2,162)	185,997	183,835
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(72,794)	(72,794)
배당	0	0	(7,357,284)	0	(7,357,284)
2024.09.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	235,134,369	(363,781)	240,071,995

4-5. 현금흐름표

현금흐름표

제 56 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 56 기 3분기	제 55 기 3분기
영업활동현금흐름	41,182,819	27,503,092
영업에서 창출된 현금흐름	32,609,879	817,658
분기순이익	22,530,464	24,159,539
조정 (주24)	13,079,638	(8,050,695)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주24)	(3,000,223)	(15,291,186)
이자의 수취	199,886	238,470
이자의 지급	(437,085)	(465,207)
배당금 수입	9,417,140	29,490,565
법인세 납부액	(607,001)	(2,578,394)
투자활동현금흐름	(38,170,218)	(35,415,842)
단기금융상품의 순감소(증가)	(10,218,839)	(1,131)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	2,942	22
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1	243
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	259,625	125,402

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(298,671)	(85,106)
유형자산의 처분	63,362	134,435
유형자산의 취득	(26,410,899)	(33,487,072)
무형자산의 처분	13,041	11,397
무형자산의 취득	(1,502,277)	(2,040,397)
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(78,503)	(73,635)
재무활동현금흐름	(3,490,138)	14,541,236
단기차입금의 순증가(감소)	4,031,665	45,578
장기차입금의 차입	0	21,990,000
사채 및 장기차입금의 상환	(165,069)	(136,145)
배당금의 지급	(7,356,734)	(7,358,197)
외화환산으로 인한 현금의 변동	(1,196)	(10,534)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(478,733)	6,617,952
기초현금및현금성자산	6,061,451	3,921,593
기말현금및현금성자산	5,582,718	10,539,545

5. 재무제표 주석

1. 일반적 사항

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사의 사업은 DX 부문, DS 부문으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 스마트폰, 네트워크시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.

2. 중요한 회계처리방침

2.1. 재무제표 작성기준

회사의 2024년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간종료일인 2024년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 회사가 채택한 제·개정 기준서

회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

보고기간종료일 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 부채가 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채

의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 중간재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정

기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리 되는 판매 후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정 리스료'를 산정하도록 요구합니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 중간재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품 공시' 개정

동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한, 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 중간재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 회사가 조기 적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정

외환시장이 정상적으로 작동하지 않을 때 기능통화에 의한 외화거래 보고를 명확히 하기 위해 두 통화간 교환가능성을 평가하는 규정을 추가합니다. 또한, 두 통화간 교환이 가능한지를 평가하여 교환가능성이 결여되었다고 판단한 경우, 적용할 현물환율을 추정하는 규정을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기 적용할 수 있습니다.

2.2. 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 가중평균연간 법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

분기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익

· 비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품

금융자산의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산, 범주																					
상각후평가 측정 금융자산							기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산							당기손익-공정가치 측정 금융자산							
금융자산, 분류							금융자산, 분류							금융자산, 분류							
현금및현금성 자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산	당기손익-공정가치금융자산	기타	합계	현금및현금성 자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산	당기손익-공정가치금융자산	기타	합계	현금및현금성 자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산	당기손익-공정가치금융자산	기타	합계	
금융자산	5,582,716	11,063,471	35,176,097	0	0	4,105,576	55,927,862	0	0	0	2,100,328	0	0	2,100,328	0	0	0	0	0	288,546	288,546

전기말

(단위 : 백만원)

금융자산, 범주																					
상각후평가 측정 금융자산							기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산							당기손익-공정가치 측정 금융자산							
금융자산, 분류							금융자산, 분류							금융자산, 분류							
현금및현금성 자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산	당기손익-공정가치금융자산	기타	합계	현금및현금성 자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산	당기손익-공정가치금융자산	기타	합계	현금및현금성 자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산	당기손익-공정가치금융자산	기타	합계	
금융자산	6,061,451	50,071	27,363,018	0	0	4,972,284	38,446,822	0	0	0	1,854,503	0	0	1,854,503	0	0	0	0	1	393,235	393,236

금융자산의 범주별 공시, 합계

당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	현금및현금성 자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융 자산	당기손익-공정가치금융 자산	기타	금융자산, 분류 합계
금융자산	5,582,718	11,063,471	35,176,097	2,100,328	0	4,394,122	58,316,736

전기말

(단위 : 백만원)

금융자산	현금및현금성 자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융 자산	당기손익-공정가치금융 자산	기타	금융자산, 분류 합계
금융자산	6,061,451	50,071	27,363,016	1,854,503	1	5,365,519	40,694,561

금융부채의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

금융부채, 범주																	
상각후평가 측정 금융부채							기타금융부채										
금융부채, 분류							금융부채, 분류										
매입채무	당기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	합계	매입채무	당기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	합계

금융부채	11,239,430	0	12,836,392	21,990,000	19,537	0	4,331,988	5,588,735	56,006,082	0	9,572,235	0	278,174	0	833,820	0	0	10,684,229
------	------------	---	------------	------------	--------	---	-----------	-----------	------------	---	-----------	---	---------	---	---------	---	---	------------

전기말

(단위 : 백만원)

금융부채, 범주										기타금융부채									
상각후원가 측정 금융부채																			
금융부채, 분류										금융부채, 분류									
매입채무	단기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	합계	매입채무	단기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	합계		
금융부채	7,943,834	0	15,015,578	6,354	19,064	21,990,000	4,486,390	3,652,969	53,114,189	0	5,625,163	0	222,137	0	912,035	0	0	6,759,335	

금융부채의 범주별 공시, 합계

당분기말

(단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합계
금융부채	11,239,430	9,572,235	12,836,392	22,268,174	19,537	833,820	4,331,988	5,588,735	66,690,311

전기말

(단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합계
금융부채	7,943,834	5,625,163	15,015,578	228,491	19,064	22,902,035	4,486,390	3,652,969	59,873,524

당기 및 전기 기타금융부채에 대한 각주

기타금융부채는 담보부차입금과 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산

기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역

당분기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
기타포괄손익-공정가치금융자산	2,100,328

전기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,854,503

당기손익-공정가치측정금융자산의 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	당기손익인식금융자산

	채무상품
당기손익-공정가치금융자산	0

전기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품
당기손익-공정가치금융자산	1

공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 표시

당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산, 범주		공정가치로 측정하는 금융자산																																		
상장주식		상장주식																																		
		삼성증권(주)	해운통신(주)	휴아이머켓코리	휴게이티스케이	모니용평(주)	휴에이테크솔부	휴엔릭홀딩스	휴엔릭에이피에	휴중진비이랩	솔브레인(주)	휴에스앤에스(주)	휴오이씨	휴케이씨텍	휴폴모티비랩	휴뉴피워프리즈	휴에프메스티	휴디엔에프	Marvell Technology, Inc.	SoundHound AI, Inc.																
측정 단계																																				
	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급		
	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가		
	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)		
금융자산	932,158	1,344,294	13,957	95,825	3,344	1,188	1,869	1,588		26,348	10,803	15,410	16,214	57,472	48,277	71,559	40,382	97,089	65,933	44,447	47,336	126,837	20,720	36,442	18,990	13,513	12,739	11,117	43,009	33,049	20,964	9,647	11,705	16,485	13,719	10,472
보유주식수	134,011	2,004	647,320	240,000	400,000	1,592,000	1,759,171	1,850,936	2,467,894	437,339	1,716,116	9,601,617	1,022,216	1,267,668	2,140,939	1,532,575	810,030	173,187	1,702,957																	
지분율	0.152	0.051	0.019	0.005	0.008	0.159	0.023	0.038	0.048	0.056	0.080	0.117	0.049	0.071	0.049	0.070	0.070	0.000	0.005																	
지분 설명	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타	종발 정보 종주 의수 기준 지분 평가 나타		

전기말

(단위 : 백만원)

금융자산, 범주		공정가치로 측정하는 금융자산																																
상장주식		상장주식																																
		삼성증권(주)	해운통신(주)	휴아이머켓코리	휴게이티스케이	모니용평(주)	휴에이테크솔부	휴엔릭홀딩스	휴엔릭에이피에	휴중진비이랩	솔브레인(주)	휴에스앤에스(주)	휴오이씨	휴케이씨텍	휴폴모티비랩	휴뉴피워프리즈	휴에프메스티	휴디엔에프	Marvell Technology, Inc.	SoundHound AI, Inc.														
측정 단계																																		
	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급	계급
	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가	평가
	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)	(시장 가치)
금융자산																																		
보유주식수																																		
지분율																																		
지분 설명																																		

공정	1,038	131.1						17.24		62.83	95.50	132.9	77.74	47.86	27.39	25.54	11.24	37.54	19.40	13.46	4.655
자산	.712	08	5,560	1,421	1,220		1		5,928	9	8	52	0	4	5	4	0	1	0	8	
보유																					
주식																					
수																					
지분																					
별																					
지분																					
별																					
대																					
별																					

공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시_2

당분기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 분류	
	공정가치로 측정하는 금융자산	
	상장주식	
	측정 전체	
	취득원가	장부금액(시장가치)
금융자산	1,353,398	1,991,657

전기말

(단위 : 백만원)

	금융자산, 분류	
	공정가치로 측정하는 금융자산	
	상장주식	
	측정 전체	
	취득원가	장부금액(시장가치)
금융자산		1,757,336

5. 재고자산

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 백만원)

	취득원가	재고자산 평가총당금	장부금액 합계
제품 및 상품	6,437,667	(619,510)	5,818,157
반제품 및 재공품	21,279,342	(1,170,819)	20,108,523
원재료 및 저장품	5,153,418	(732,647)	4,420,771
미착품	611,344	0	611,344
재고자산 계	33,481,771	(2,522,976)	30,958,795

전기말

(단위 : 백만원)

	취득원가	재고자산 평가총당금	장부금액 합계
제품 및 상품	7,914,117	(1,203,662)	6,710,455

반제품 및 재공품	21,866,523	(3,863,881)	18,002,642
원재료 및 저장품	4,910,170	(861,821)	4,048,349
미착품	576,705	0	576,705
재고자산 계	35,267,515	(5,929,364)	29,338,151

6. 관계기업 및 공동기업 투자

가. 당분기 및 전분기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	57,392,438	57,397,249
취득	298,671	85,106
처분	(254,989)	(125,428)
분기말장부금액	57,436,120	57,356,927

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 투자 현황은 다음과 같습니다.(종속기업 현황은 주석 27 참조)

기업명	관계의 성격	지분율 (%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기(주)	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스 (주)	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 · 관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로지 스(주)	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성SDI(주)(*2)	2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
(주)제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

다. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

구 분	당분기말			전기말	
	주식수	시장가치	장부금액	시장가치	장부금액
삼성전기(주)	17,693,084	2,344,334	445,244	2,710,580	445,244
삼성에스디에스 (주)	17,472,110	2,702,935	560,827	2,970,259	560,827
삼성바이오로지 스(주)	22,217,309	21,706,311	1,595,892	16,885,155	1,595,892
삼성SDI(주)	13,462,673	5,095,622	1,242,605	6,354,382	1,242,605
(주)제일기획	29,038,075	534,010	491,599	552,595	491,599

7. 유형자산

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초 장부금액	140,579,161
일반취득 및 자본적지출	26,610,733
감가상각비, 유형자산	(21,919,842)
처분·폐기·손상	(130,374)
기타	(26,039)
분기말 장부금액	145,113,639

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초 장부금액	123,266,986
일반취득 및 자본적지출	30,375,856
감가상각비, 유형자산	(18,935,711)
처분·폐기·손상	(116,364)
기타	(2,029)
분기말 장부금액	134,588,738

감가상각비의 기능별 배분

당분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	20,084,542	1,835,300	21,919,842

전분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	17,449,986	1,485,725	18,935,711

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
사용권자산	1,805,633

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
사용권자산	1,840,913

사용권자산 변동에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
사용권자산의 추가	197,937
감가상각비, 사용권자산	230,161

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
사용권자산의 추가	846,906
감가상각비, 사용권자산	177,516

8. 무형자산

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	10,440,211
개별취득	1,896,992
상각	(1,805,729)
처분·폐기·손상	(38,905)
기타	30,426
분기말장부금액	10,522,995

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	8,561,424
개별취득	4,275,619
상각	(1,974,390)
처분·폐기·손상	(36,598)
기타	17,835
분기말장부금액	10,843,890

무형자산상각비의 기능별 배분

당분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	1,364,458	441,271	1,805,729

전분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
--	------	-----------	-----------

무형자산상각비	1,525,100	449,290	1,974,390
---------	-----------	---------	-----------

9. 차입금

단기차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 백만원)

차입금명칭			
단기차입금			
담보부차입금-우리은행 등			
범위			범위 합계
하위범위	상위범위		
연이자율	0.004	0.115	
단기차입금			9,572,235
차입금에 대한 기술			담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

전기말

(단위 : 백만원)

차입금명칭			
단기차입금			
담보부차입금-우리은행 등			
범위			범위 합계
하위범위	상위범위		
연이자율			
단기차입금			5,625,163
차입금에 대한 기술			담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

유동성장기차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 백만원)

차입금명칭					
유동성장기차입금					
리스 부채		무담보차입금-삼성디스플레이(주)			차입금명칭 합계
범위	범위 합계	범위	범위 합계		
가중범위		가중범위			
만기일			2025-08-16		
연이자율	0.029		0.046		
유동성장기차입금		278,174	21,990,000		
			22,268,174		

전기말

(단위 : 백만원)

차입금명칭				
유동성장기차입금				
차입금명칭 합계				

	리스 부채		무담보차입금-삼성디스플레이주		
	범위	범위 합계	범위	범위 합계	
	가중범위		가중범위		
만기일					
연이자율					
유동성장기차입금		222,137		0	222,137

장기차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 백만원)

	차입금명칭				차입금명칭 합계	
	장기 차입금					
	리스 부채		무담보차입금			
	범위	범위 합계	범위	범위 합계		
	가중범위		가중범위			
연이자율	0.029					
장기차입금		833,820		0	833,820	

전기말

(단위 : 백만원)

	차입금명칭				차입금명칭 합계	
	장기 차입금					
	리스 부채		무담보차입금			
	범위	범위 합계	범위	범위 합계		
	가중범위		가중범위			
연이자율						
장기차입금		912,035		21,990,000	22,902,035	

리스부채 이자비용에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며, 당분기 중 발생한 이자비용은 24,745백만원입니다.
리스부채에 대한 이자비용	24,745

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며, 전분기 중 발생한 이자비용은 20,045백만원입니다.
리스부채에 대한 이자비용	20,045

10. 사채

사채에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	US\$ denominated Straight Bonds
발행일	1997-10-02
만기상환일	2027-10-01
연이자율	0.077
명목금액, 외화금액	US\$ 15,000천
명목금액	19,794
사채할인발행차금	(257)
사채	19,537
차감: 유동성사채	0
비유동성사채	19,537
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

전기말

(단위 : 백만원)

	US\$ denominated Straight Bonds
발행일	1997-10-02
만기상환일	2027-10-01
연이자율	0.077
명목금액, 외화금액	US\$ 20,000천
명목금액	25,788
사채할인발행차금	(370)
사채	25,418
차감: 유동성사채	(6,354)
비유동성사채	19,064
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

11. 순확정급여부채(자산)

확정급여제도에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	12,522,968	23,739	12,546,707
사외적립자산의 공정가치			(15,579,044)
순확정급여부채(자산)계			(3,032,337)

전기말

(단위 : 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급 여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적 립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	11,959,655	22,672	11,982,327
사외적립자산의 공정가 치			(15,728,024)
순확정급여부채(자산) 계			(3,745,697)

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여 제도			790,186
순이자비용(수익), 확정 급여제도			(161,733)
퇴직급여비용 합계, 확 정급여제도	250,687	377,766	628,453

전분기

(단위 : 백만원)

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여 제도			721,775
순이자비용(수익), 확정 급여제도			(206,435)
퇴직급여비용 합계, 확 정급여제도	202,355	312,985	515,340

12. 충당부채

기타충당부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	판매보증	기술사용료	장기성과급	기타	기타충당부채 합계
기초	673,951	1,815,938	713,719	3,750,227	6,953,835
순전입(환입)	638,348	781,888	152,131	2,128,922	3,701,289
사용	(542,741)	(519,812)	(262,023)	(1,127,486)	(2,452,062)
기타	0	(50,294)	0	11,775	(38,519)
분기말	769,558	2,027,720	603,827	4,763,438	8,164,543

총당부채의 성격에 대한 기술	회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험을 등을 기초로 추정하여 총당부채로 설정하고 있습니다.	회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.	회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 총당부채로 계상하고 있습니다.	회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다. 회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다.	
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

무상할당배출권과 배출량 추정치에 대한 공시

	배출량
무상할당 배출권	1,283만톤(tCO ₂ -eq)
배출량 추정치	1,378만톤(tCO ₂ -eq)

배출권 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초	3,137
증가	0
사용	0
분기말	3,137

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초	19,567
증가	1,265
사용	(17,695)
분기말	3,137

배출부채 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초	0
순전입(환입)	0
사용	0
분기말	0

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초	32,825
순전입(환입)	(15,348)
사용	(17,477)
분기말	0

13. 우발부채와 약정사항

채무보증 내역에 대한 공시

(단위 : 백만원)

우발부채				
보증 관련 우발부채				
전체 특수관계자				전체 특수관계자 합계
특수관계자				
종속기업				
SETK	SME	기타 해외 종속기업		
보증처	BNP 외	SCB	기타	
보증종료일	2025-06-13	2024-11-08		
보증종류	채무보증	채무보증	채무보증	
관련차입금	669,497	1,883	0	671,380
관련차입금, 외화				US\$ 508,793천
채무보증한도	1,249,661	145,156	9,329,217	10,724,034
채무보증한도, 외화				US\$ 8,126,731천

지급보증 내역에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	제공한 지급보증	제공받은 지급보증
특수관계 여부	해외종속기업	
지급보증한도	490,338	

지급보증에 대한 비고(설명)	당분기말 현재 회사가 해외중속 기업의 계약이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증 한도액은 490,338백만원입니다.	당분기말 현재 회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.
-----------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

법적소송우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	법적소송우발부채
유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채	당분기말 현재 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	분할 전 채무에 대한 연대채무	유·무형자산의 취득 약정
약정 금액		12,401,388
약정에 대한 설명	회사와 삼성디스플레이(주) 등은 분할된 삼성디스플레이(주) 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.	당분기말 현재 발생하지 않은 유·무형자산의 취득을 위한 약정액은 12,401,388백만원입니다.

14. 계약부채

계약부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	1,550,097

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
계약부채	1,491,085

계약부채에 대한 기술

계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

15. 자본금

주식의 분류에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	보통주	우선주	주식 합계
회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수(주)			25,000,000,000
주당 액면가액(원)			100
발행주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700	
유통주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700	
발행주식 액면 총액(백만원)	596,978	82,289	679,267
납입자본금(백만원)			897,514
자본에 대한 설명			<p>보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억 주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사에는 보통주 외 비누적적 우선주가 있습니다. 이 우선주는 의결권이 없고 액면금액을 기준으로 보통주의 배당보다 연 1%의 금전배당을 추가로 받을 수 있습니다. 보고기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 또한, 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하며, 당분기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면 총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.</p>

16. 이익잉여금

이익잉여금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

		공시금액
이익잉여금		235,134,369
이익잉여금	법정적립금	450,789
	임의적립금 등	234,683,580

전기말

(단위 : 백만원)

		공시금액
이익잉여금		219,963,351
이익잉여금	법정적립금	450,789
	임의적립금 등	219,512,562

배당금에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	배당의 구분								
	1분기 배당			2분기 배당			3분기 배당		
	주식		주식 합계	주식		주식 합계	주식		주식 합계
보통주	우선주	보통주		우선주	보통주		우선주		
배당기준일			2024-03-31			2024-06-30			2024-09-30
배당받을 주식(주)	5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700	
보통주 주당 배당률 (액면가 기준)	3.61			3.61			3.61		
우선주 주당 배당률 (액면가 기준)		3.61			3.61			3.61	
배당금액	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154

전분기

(단위 : 백만원)

	배당의 구분								
	1분기 배당			2분기 배당			3분기 배당		
	주식		주식 합계	주식		주식 합계	주식		주식 합계
보통주	우선주	보통주		우선주	보통주		우선주		
배당기준일			2023-03-31			2023-06-30			2023-09-30
배당받을 주식(주)	5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700	
보통주 주당 배당률 (액면가 기준)	3.61			3.61			3.61		
우선주 주당 배당률 (액면가 기준)		3.61			3.61			3.61	
배당금액	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154

17. 기타자본항목

기타자본구성요소

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
기타자본구성요소	(363,781)

기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	432,152
	순확정급여부채(자산) 재측정요 소	(2,556,341)
	기타	1,760,408

전기말

(단위 : 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		(476,984)
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	246,155
	순확정급여부채(자산) 재측정요 소	(2,483,547)
	기타	1,760,408

18. 비용의 성격별 분류

비용의 성격별 분류 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
제품 및 재공품 등의 변동	442,390	(1,213,583)
원재료 등의 사용액 및 상품 매 입액 등	23,005,765	69,035,177
급여	4,209,338	11,812,367
퇴직급여	210,778	632,526
감가상각비	7,973,786	21,919,842
무형자산상각비	608,344	1,805,729
복리후생비	791,072	2,467,043
유틸리티비	1,508,133	4,240,197
외주용역비	1,176,621	3,370,609
광고선전비	361,304	1,174,868
판매촉진비	328,654	1,026,958
기타 비용	10,707,817	30,796,133
성격별 비용 합계	51,324,002	147,067,866

전분기

(단위 : 백만원)

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
제품 및 재공품 등의 변동	327,935	(4,130,316)

원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	24,687,598	71,987,905
급여	2,716,624	10,772,706
퇴직급여	173,803	521,862
감가상각비	6,432,818	18,935,711
무형자산상각비	656,866	1,974,390
복리후생비	778,649	2,445,405
유틸리티비	1,305,906	3,717,654
외주용역비	936,144	2,795,393
광고선전비	643,777	1,299,175
판매촉진비	252,133	864,804
기타 비용	9,121,959	26,354,154
성격별 비용 합계	48,034,212	137,538,843

성격별 비용에 대한 공시

손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
급여	609,620	1,965,121
퇴직급여	36,872	110,687
지급수수료	807,374	2,368,248
감가상각비	118,933	357,176
무형자산상각비	98,366	294,905
광고선전비	361,304	1,174,868
판매촉진비	328,654	1,026,958
운반비	225,777	634,573
서비스비	288,787	1,103,666
기타판매비와관리비	677,003	1,784,498
소계	3,552,690	10,820,700
경상연구개발비-연구개발 총지출액	7,661,260	21,182,800
계	11,213,950	32,003,500

전분기

(단위 : 백만원)

	장부금액
	공시금액

	3개월	누적
급여	591,864	1,976,526
퇴직급여	31,500	94,104
지급수수료	756,087	2,471,999
감가상각비	119,777	348,326
무형자산상각비	98,775	292,024
광고선전비	643,777	1,299,175
판매촉진비	252,133	864,804
운반비	128,634	399,842
서비스비	427,007	1,078,175
기타판매비와관리비	571,123	1,650,370
소계	3,620,677	10,475,345
경상연구개발비-연구개발 총지출액	5,843,164	17,571,068
계	9,463,841	28,046,413

20. 기타수익 및 기타비용

기타수익 및 기타비용

당분기

(단위 : 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
기타수익		248,312	9,846,280
기타수익	배당금수익	50,211	9,419,973
	임대료수익	46,865	139,445
	유형자산처분이익	7,916	30,916
	기타	143,320	255,946
기타비용		102,321	458,707
기타비용	유형자산처분손실	71,578	94,587
	기부금	13,073	92,937
	기타	17,670	271,183

전분기

(단위 : 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
기타수익		7,368,532	29,471,874
기타수익	배당금수익	7,246,537	29,092,317
	임대료수익	46,261	136,660
	유형자산처분이익	16,261	85,536

	기타	59,473	157,361
기타비용		118,180	249,611
기타비용	유형자산처분손실	41,702	47,040
	기부금	58,689	136,328
	기타	17,789	66,243

21. 금융수익 및 금융비용

금융수익 및 금융비용

당분기

(단위 : 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
이자수익(금융수익)		114,172	262,245
이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	114,172	262,245
외환차이		1,263,405	4,186,614
파생상품관련이익		0	0
금융수익 합계		1,377,577	4,448,859
이자비용		231,397	560,154
이자비용	상각후원가 측정 금융부 채 이자비용	106,191	193,491
	기타 금융부채 이자비용	125,206	366,663
외환차이		1,419,283	4,145,270
파생상품관련손실		56,428	104,689
금융비용 합계		1,707,108	4,810,113

전분기

(단위 : 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
이자수익(금융수익)		129,961	280,542
이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	129,961	280,542
외환차이		1,743,306	5,339,646
파생상품관련이익		206,797	442,550
금융수익 합계		2,080,064	6,062,738
이자비용		368,665	846,643
이자비용	상각후원가 측정 금융부 채 이자비용	299,577	633,049
	기타 금융부채 이자비용	69,088	213,594

외환차이	1,691,848	5,597,291
파생상품관련손실	0	93,579
금융비용 합계	2,060,513	6,537,513

금융수익 및 금융비용에 대한 기술

회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

22. 법인세비용

법인세에 대한 분기별 공시

	내용
법인세비용 인식에 대한 기술	법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정된 최선의 가중평균연간법인세율로 인식하였습니다.
2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 평균 연간법인세율	0.01

23. 주당이익

주당이익

당분기

(단위 : 백만원)

		주식			
		보통주		우선주	
		3개월	누적	3개월	누적
분기순이익		5,694,610	22,530,464	5,694,610	22,530,464
보통주에 귀속되는 분기순이익(손실)		5,004,746	19,801,048		
보통주에 귀속되는 분기순이익(손실)	가중평균유통보통주 식수(주)	5,969,782,550	5,969,782,550		
기본 보통주 주당이익(원)		838	3,317		
우선주에 귀속되는 분기순이익(손실)				689,864	2,729,416
가중평균유통우선주식수(주)				822,886,700	822,886,700
기본 우선주 주당이익(원)				838	3,317

전분기

(단위 : 백만원)

		주식			
		보통주		우선주	
		3개월	누적	3개월	누적
분기순이익		10,416,811	24,159,539	10,416,811	24,159,539
보통주에 귀속되는 분기순이익(손실)		9,154,883	21,232,772		
보통주에 귀속되는 분기순이익(손실)	가중평균유통보통주 식수(주)	5,969,782,550	5,969,782,550		
기본 보통주 주당이익(원)		1,534	3,557		
우선주에 귀속되는 분기순이익(손실)				1,261,928	2,926,767

가중평균유통우선주식수(주)			822,886,700	822,886,700
기본 우선주 주당이익(원)			1,534	3,557

희석주당이익에 대한 기술

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당분기 및 전분기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표

현금흐름의 회계정책에 대한 기술

회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당분기 및 전분기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

영업활동현금흐름

당분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		13,079,638
조정내역 계	법인세비용(수익)	230,646
	금융수익	(699,700)
	금융비용	1,565,567
	퇴직급여	632,526
	감가상각비	21,919,842
	무형자산상각비	1,805,729
	대손충당금환입	(1,739)
	대손상각비	
	배당금수익	(9,419,973)
	유형자산처분이익	(30,916)
	유형자산처분손실	94,587
	재고자산평가손실환입	(3,055,369)
	재고자산평가손실	
	기타	38,438
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(3,000,223)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	(8,263,996)
	미수금의 감소(증가)	458,555
	장단기선급비용의 감소(증가)	(428,530)
	재고자산의 감소(증가)	1,466,935
	매입채무의 증가(감소)	3,447,423
	장단기미지급금의 증가(감소)	(1,815,074)
	선수금의 증가(감소)	5,060
	예수금의 증가(감소)	(1,351)
	미지급비용의 증가(감소)	1,793,005

	장단기충당부채의 증가(감소)	1,249,226
	퇴직금의 지급	(720,176)
	기타	(191,300)

전분기

(단위 : 백만원)

		공시금액
조정내역 계		(8,050,695)
조정내역 계	법인세비용(수익)	(5,186,903)
	금융수익	(1,082,050)
	금융비용	1,820,509
	퇴직급여	521,862
	감가상각비	18,935,711
	무형자산상각비	1,974,390
	대손충당금환입	
	대손상각비	21,150
	배당금수익	(29,092,317)
	유형자산처분이익	(85,536)
	유형자산처분손실	47,040
	재고자산평가손실환입	
	재고자산평가손실	4,052,533
	기타	22,916
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(15,291,186)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 감소(증가)	(5,895,993)
	미수금의 감소(증가)	836,995
	장단기선급비용의 감소(증가)	(255,602)
	재고자산의 감소(증가)	(7,678,307)
	매입채무의 증가(감소)	2,201,322
	장단기미지급금의 증가(감소)	(3,493,328)
	선수금의 증가(감소)	(77,280)
	예수금의 증가(감소)	(105,642)
	미지급비용의 증가(감소)	(1,741,372)
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,301,987
	퇴직금의 지급	(355,697)
	기타	(28,269)

리스 현금유출

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
--	------

리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	158,622
리스부채에 대한 이자비용, 영업활동에서 생기는 현금유출	24,745

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	129,808
리스부채에 대한 이자비용, 영업활동에서 생기는 현금유출	20,045

25. 재무위험관리

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	위험						위험 합계
	시장위험			신용위험	유동성위험	자본위험	
	환위험	이자율위험	지분가격위험				
위험에 대한 노출 정도에 대한 기술	회사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.	이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인해 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다.	당분기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세 효과 반영 전)에 미치는 영향은 19,917백만원(전분기: 17,370백만원)입니다.	회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대 노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.			

<p>위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술</p>	<p>회사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권 매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 회사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한, 회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.</p>	<p>회사는 내부자금 공유를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.</p>	<p>회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 적·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.</p>	<p>신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래 상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험이 관리되고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가를 거쳐 시행하고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수</p>	<p>유동성위험이란 회사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯하여, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 회사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다. 회사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성 위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성 위험을 최소화하고 자금운용부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다. 또한, 대규모 유동성이 필요한 경우에 대비하여 본사의 지급</p>	<p>회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.</p>	<p>회사는 영업활동에서 발생하는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다.</p> <p>재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 한해지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다.</p> <p>한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 한거래대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다.</p> <p>회사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.</p>
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.	보증을 통해 해외 중속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.		
지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익에 미치는 영향			19,917				

전분기

(단위 : 백만원)

	위험			신용위험	유동성위험	자본위험	위험 합계
	시장위험						
	환위험	이자율위험	지분가격위험				
위험에 대한 노출 정도에 대한 기술							
위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술							
지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익에 미치는 영향			17,370				

부채비율에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	총장부금액
부채	83,310,816
자본	240,071,995
부채비율	0.347

전기말

(단위 : 백만원)

	총장부금액
부채	72,069,515
자본	224,787,774
부채비율	0.321

공정가치 측정, 금융자산

당분기말

(단위 : 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가치금융자산	당기손익-공정가치금융자산	기타	금융자산, 분류 합계
장부금액	5,582,718	11,063,471	35,176,097	2,100,328	0	4,394,122	58,316,736
공정가치				2,100,328	0	288,546	
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금융자산						4,105,576	
공정가치 공시 제외 사유에 대한 기술	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.			장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 금융자산 4,105,576백만원은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.	

전기말

(단위 : 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가치금융자산	당기손익-공정가치금융자산	기타	금융자산, 분류 합계
장부금액	6,061,451	50,071	27,363,016	1,854,503	1	5,365,519	40,694,561
공정가치				1,854,503	1	393,235	
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로서 공정가치 공시 제외된 금융자산						4,972,284	
공정가치 공시 제외 사유에 대한 기술	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.			장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 금융자산 4,972,284백만원은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.	

공정가치 측정, 금융부채

당분기말

(단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급금	유동성장기부채	유동성장기차입금	유동성사채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합계
장부금액	11,239,430	9,572,235	12,836,392	22,268,174	22,268,174	0	19,537	833,820	4,331,988	5,588,735	66,690,311
공정가치				0		0	21,479				

공정가치 공시 제외 사유에 대한 기술	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.
----------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------

전기말

(단위 : 백만원)

매입채무	단기차입금	미지급금	유동성장기부채	유동성장기차입금	유동성사채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합계	
장부금액	7,943,834	5,625,163	15,015,578	228,491	222,137	6,354	19,064	22,902,035	4,486,390	3,652,969	59,873,524
공정가치				6,757		6,757	21,695				
공정가치 공시 제외 사유에 대한 기술	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.	

금융상품의 공정가치 서명체계에 따른 수준별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명			공정가치 서명체계의 모든 수준			공정가치 서명			공정가치 서명체계의 모든 수준			공정가치 서명			공정가치 서명체계의 모든 수준			공정가치 서명				
	수준 1	수준 2	수준 3	수준 1	수준 2	수준 3	수준 1	수준 2	수준 3	수준 1	수준 2	수준 3	수준 1	수준 2	수준 3	수준 1	수준 2	수준 3	수준 1	수준 2	수준 3		
	수준 합계			수준 합계			수준 합계			수준 합계			수준 합계			수준 합계			수준 합계				
금융자산	1,991,657	0	108,671	2,100,328	0	0	0	0	0	0	0	288,546	288,546										
금융부채														0	0	0	0	0	0	0	21,479	0	21,479

전기말

(단위 : 백만원)

공정가치 서명체계의 모든 수준	공정가치 서명			공정가치 서명체계의 모든 수준			공정가치 서명			공정가치 서명체계의 모든 수준			공정가치 서명			공정가치 서명체계의 모든 수준			공정가치 서명			
	수준 1	수준 2	수준 3	수준 1	수준 2	수준 3	수준 1	수준 2	수준 3	수준 1	수준 2	수준 3	수준 1	수준 2	수준 3	수준 1	수준 2	수준 3	수준 1	수준 2	수준 3	
	수준 합계			수준 합계			수준 합계			수준 합계			수준 합계			수준 합계			수준 합계			
금융자산	1,757,336	0	97,167	1,854,503	0	0	1	1	0	0	393,235	393,235										
금융부채													0	6,757	0	6,757	0	21,695	0	21,695	0	21,695

금융상품의 공정가치측정에 대한 공시

	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	동일한 자산에 대한 시장 공시가격	시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채	동일한 부채에 대한 시장 공시가격	시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

평가기법 및 투입변수에 대한 기술

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에 포함된 상품은 사채 등이 있습니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포 모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

공정가치 서열체계의 모든 수준														
공정가치 서열체계 수준 3														
금융상품														
기타포괄손익-공정가치금융자산											기타			
상장채투자주					비모수채권					지분 출원선				
관측할 수 없는 투입변수				관측할 수 없는 부	관측할 수 없는 투입변수				관측할 수 없는 부	관측할 수 없는 투입변수			관측할 수 없는 부	
영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	무위험 이자율, 측	가격 변동성, 측정	입변수 집계	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	무위험 이자율, 측	가격 변동성, 측정	입변수 집계	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	무위험 이자율, 측	가격 변동성, 측정	입변수 집계
가치평가방법				현금흐름할인법					현금흐름할인법 등					이형모형
유역적이지 않은 관측할 수 없는 투입변수, 자산	0.010	0.158			0.000	0.109						0.029	0.526	
금융자산, 공정가치				34,864					45,888					288,546

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	수준 3
기초금융자산	490,403
매입	0
매도	(2,942)
당기손익으로 인식된 손익	(104,689)
기타포괄손익으로 인식된 손익	14,445
분기말금융자산	397,217

전분기

(단위 : 백만원)

	수준 3
기초금융자산	116,726
매입	27,784
매도	(343)
당기손익으로 인식된 손익	347,859
기타포괄손익으로 인식된 손익	930
분기말금융자산	492,956

관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정의 민감도분석 공시, 자산

(단위 : 백만원)

공정가치 서열체계의 모든 수준														
공정가치 서열체계 수준 3														
자산														
기타포괄손익-공정가치금융자산											기타			
관측할 수 없는 투입변수				관측할 수 없는 투입	관측할 수 없는 투입변수				관측할 수 없는 투입	자산 합계				
영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	기초 자산 가격, 측	가격 변동성	변수 집계	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	기초 자산 가격, 측	가격 변동성	변수 집계	영구성장률, 투입변수	가중평균자본비용, 측정 투입변수	기초 자산 가격, 측	가격 변동성	변수 집계
관측가능하지 않은 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측	주요 관측불가능한 투입변수의 변동으로 인	주요 관측불가능한 투입변수의 변동으로 인								주요 관측불가능한 투입변수인 기초자	주요 관측불가능한 투입변수인 기초자	주요 관측불가능한 투입변수인 기초자	주요 관측불가능한 투입변수인 기초자	주요 관측불가능한 투입변수인 기초자
정률을 1% 증가 또는	관자본비용을 1% 증									산 가격(20%)을 증	산 가격(20%)을 증	산 가격(20%)을 증	산 가격(20%)을 증	산 가격(20%)을 증
										동성(10%)을 증가	동성(10%)을 증가	동성(10%)을 증가	동성(10%)을 증가	동성(10%)을 증가
														금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불

정치적 민감도에 대한 기술, 자산	는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.	가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.						가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.	또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.		동한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 증가율, 자산	0.01	0.01						0.20	0.10		
관측할 수 없는 투입변수의 가능성이 어느 정도 있는 감소율, 자산	0.01	0.01						0.20	0.10		
당기손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산										76.426	
당기손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산										(76.259)	

기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 증가, 자산					4,888					0	
기타포괄손익(세전)으로 인식된, 가능성이 어느 정도 있고 대체할 수 있는 가정을 반영하기 위한 하나 이상의 관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치 측정치의 감소, 자산					(3,639)					0	

26. 부문별 보고

영업부문에 통합기준을 적용하면서 이루어진 경영진의 판단에 대한 설명

회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고 부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문 등으로 구성되어 있습니다.

보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

영업부문에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	기업 전체 총계				기업 전체 총계 합계	
	영업부문					
	DX 부문		DS 부문		3개월	누적
3개월	누적	3개월	누적			
매출액	29,216,447	88,036,790	28,757,745	79,680,231	55,828,922	160,802,657
감가상각비	147,862	417,769	7,777,830	21,352,927	7,973,786	21,919,842
무형자산상각비	395,135	1,185,224	156,652	449,092	608,344	1,805,729
영업이익	1,361,823	3,968,453	3,144,210	9,765,496	4,504,920	13,734,791
보고부문에 대한 기술					기타는 별도로 표시하지 않았습니다.	기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전분기

(단위 : 백만원)

		기업 전체 총계				기업 전체 총계 합계	
		영업부문					
		DX 부문		DS 부문			
		3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
매출액		30,085,839	84,861,437	16,035,215	43,891,179	45,866,224	127,763,991
감가상각비		132,414	402,448	6,249,870	18,382,015	6,432,818	18,935,711
무형자산상각비		424,665	1,254,681	171,897	542,963	656,866	1,974,390
영업이익		2,056,695	4,313,707	(4,225,064)	(14,092,471)	(2,167,988)	(9,774,852)
보고부문에 대한 기술						기타는 별도로 표시하지 않았습니다.	기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

27. 특수관계자와의 거래

가. 당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%) (*)
미주	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung Lennox HVAC North America, LLC	에어컨공조 판매	50.1
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Federal, Inc. (SFI)	R&D	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)	해외자회사 관리	100.0
	eMagin Corporation	디스플레이 패널 개발 및 생산	100.0

	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
	AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0
	Sonio Corporation	소프트웨어 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)
미주	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de	오디오제품 판매	100.0

	C.V.		
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Roon Labs, LLC.	오디오제품 판매	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4
	China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%) (*)
유럽 · CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV · 모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0

	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Oxford Semantic Technologies Limited (OST)	R&D	100.0
	Sonio SAS	소프트웨어 판매, R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	마케팅	100.0
지역	기업명	업종	지분율 (%) (*)
유럽 · CIS	AKG Acoustics GmbH	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0

Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
Harman Holding GmbH & Co. KG	Management Company	100.0
Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
Harman International Estonia OU	R&D	100.0
Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman International Romania SRL	R&D	100.0
Harman Management GmbH	해외자회사 관리	100.0
Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%) (*)
중동 ·	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0

아프리카	Samsung Electronics Turkiye (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co., Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Middle east and North Africa (SEMENA)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotronics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV · 모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%) (*)
아시아 (중국 제외)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn.	전자제품 판매	100.0

Bhd. (SME)		
Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	디스플레이 패널 생산	100.0
PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0
Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	디스플레이 패널 생산	100.0
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0
Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0

	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman International (Thailand) Co., Ltd.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)
중국	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0

Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100.0
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	디스플레이 패널 생산	100.0
Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	디스플레이 패널 생산	95.0
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체 · FPD 장비 서비스	100.0
Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%) (*)
국내	삼성디스플레이(주)	디스플레이 패널 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스(주)	디스플레이 패널 부품 생산	50.0
	스테코(주)	반도체 부품 생산	70.0
	세메스(주)	반도체 · FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스(주)	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스(주)	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매(주)	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍(주)	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨(주)	의료기기 생산 및 판매	68.5
	(주)희망별숲	식품 제조 가공	100.0
	(주)미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	(주)하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업	99.0

	투자	
SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 57호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
SVIC 62호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자 신탁	반도체산업 투자	62.5
반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

간접 특수관계자
특수관계자

특수관계의 성격에 대한 기술				기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.
-----------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------

전분기

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자				
특수관계자				
	종속기업	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
매출 등, 특수관계자거래	123,851,954	667,456	312,832	144,608
비유동자산 처분, 특수관계자거래	44,926	0	70	0
매입 등, 특수관계자거래	65,595,894	3,524,614	646,002	602,151
비유동자산 매입, 특수관계자거래	15,980	240,228	3,711,478	2,132,491
특수관계자거래에 대한 기술	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술				기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.

특수관계자거래의 재관·재무 관역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자				
특수관계자				
종속기업	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단	
		계좌		

계	196.8	1,119.	303.2	667.4	208.7	201.9	2,324.	297.6	1,377.	367.0	40.11	54.69	87.71	267.8	917.7	2,021	4,448	6,266	2,607.	418.7	86.16	50.14	429.4	183.8	1,878.	149.5	766.3	39.22	265.7
수	86	907	03	10	89	66	691	28	493	07	8	4	8	59	07			878	87	6	9	35	13	745	85	29	3	21	
지																													

특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.
특수관계의 성격에 대한 기술				기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자			
	특수관계자			
	종속기업	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	대규모기업집단
채권 등, 특수관계자거래	24,463,048	364,610	204,278	5,209
채무 등, 특수관계자거래	11,087,063	1,168,350	2,026,330	1,071,273
특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

특수관계의 성격에 대한 기술				기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.
-----------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------

특수관계자 자금거래에 관한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	종속기업	관계기업 및 공동기업	대규모기업집단
대여거래, 대여	0		
차입거래, 차입	0	0	
현금출자, 출자금 납입	298,671	0	
현금출자, 출자금 회수	305,353	0	
지급결의한 배당금, 특수관계자거래			96,174

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	종속기업	관계기업 및 공동기업	대규모기업집단
대여거래, 대여	0		
차입거래, 차입	21,990,000	0	
현금출자, 출자금 납입	26,124	58,982	
현금출자, 출자금 회수	124,910	518	
지급결의한 배당금, 특수관계자거래			96,174

특수관계자 자금거래에 관한 공시_2

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	종속기업, 관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자

지급결의한 배당금, 특수관계자거래	1,212,155
미지급 배당금, 특수관계자거래	0
리스 이용 계약, 특수관계자거래	23,465
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래	45,128
채무보증에 대한 설명	회사는 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채무에 대하여 채무보증을 제공하고 있습니다(주석 13 참조).

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	종속기업, 관계기업 및 공동기업과 그 밖의 특수관계자
지급결의한 배당금, 특수관계자거래	1,238,585
미지급 배당금, 특수관계자거래	0
리스 이용 계약, 특수관계자거래	0
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래	13,582
채무보증에 대한 설명	

주요 경영진(등기임원)에 대한 보상에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
단기급여	7,186
퇴직급여	468
기타 장기급여	6,251

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
단기급여	7,737
퇴직급여	418
기타 장기급여	5,876

6. 배당에 관한 사항

당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 2021~2023년의 주주환원 정책에 따라 3년간 잉여 현금흐름(Free Cash Flow)의 50%를 재원으로 활용하여 정규 배당을 연간 총 9.8조원 수준으로 실시하였습니다. 한편, 당사는 2024년 1월에 2024~2026년의 주주환원 정책을 발표하였습니다. 이에 따라 당사는 2024년부터 2026년까지 3년간 발생하는 잉여현금흐름의 50%를 재원으로 활용하여 연간 9.8조원 수준의 정규배당을 유지하되, 정규배당 이후에도 잔여 재원이 발생하는 경우에 추가로 환원할 계획입니다. 또한, 당사는 2024년부터 2026년까지의 주주환원 정책 대상 기간 종료 이전이라도 M&A 추진, 현금규모 등을 감안하여 탄력적으로 새로운 주주환원 정책을 발표하고 시행할 수 있습니다.

[주요 배당지표]

(단위 : 원, 백만원, %, 주)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제56기 3분기	제55기	제54기
주당액면가액(원)		100	100	100
(연결)당기순이익(백만원)		26,045,230	14,473,401	54,730,018
(별도)당기순이익(백만원)		22,530,464	25,397,099	25,418,778
(연결)주당순이익(원)		3,834	2,131	8,057
현금배당금총액(백만원)		7,356,462	9,809,438	9,809,438
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		28.2	67.8	17.9
현금배당수익률(%)	보통주	1.7	1.9	2.5
	우선주	2.0	2.4	2.7
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	1,083	1,444	1,444
	우선주	1,083	1,445	1,445
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

* (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

* (연결)주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주식' 중 '주당이익' 항목을 참고하시기 바랍니다.

* 현금배당금총액의 자세한 내용은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주식' 중 '연결이익잉여금' 항목을 참고하시기 바랍니다. 분기 배당금은

제56기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)이며,

제55기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)이고,

제54기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)입니다.

[배당 이력]

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
42	43	2.1	2.5

* 연속 배당횟수는 당기 분기배당 및 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.

* 중간배당은 1999년(제31기)부터 연속 배당 시작하였고, 분기배당은 2017년(제49기)부터 연속 배당중이며, 결산배당은 1981년(제13기)부터 연속 배당 중입니다.

* 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다. 우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 2.4%, 최근 5년간 평균 배당수익률은 2.9%입니다.

* 최근 3년간은 2021년(제53기)부터 2023년(제55기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2019년(제51기)부터

2023년(제55기)까지 기간입니다.2024년(제56기) 3분기 배당수익률은 상기 '주요 배당지표'를
참고하시기 바랍니다(보통주 1.7%, 우선주 2.0%).

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등 특)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
삼성전자(주)	회사채	공모	1997.10.02	131,960	7.7%	Aa2 (Moody's), AA- (S&P)	2027.10.01	일부상환	Goldman Sachs 등
Harman International Industries, Inc	회사채	공모	2015.05.11	527,840	4.2%	A (S&P)	2025.05.15	미상환	J.P. Morgan 등
합 계	-	-	-	659,800	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2024년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 전자단기사채 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2024년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	527,840	6,598	6,598	6,598	-	-	-	547,634
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	527,840	6,598	6,598	6,598	-	-	-	547,634

- 삼성전자주

(기준일 : 2024년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	6,598	6,598	6,598	-	-	-	19,794
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	6,598	6,598	6,598	-	-	-	19,794

- Harman International Industries, Inc.와 그 종속기업

(기준일 : 2024년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	527,840	-	-	-	-	-	-	527,840
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	527,840	-	-	-	-	-	-	527,840

※ 미상환잔액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

마. 신종자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2024년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2024년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(삼성전자)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
US\$ 100,000,000 7.7% Debenture	1997.10.02	2027.10.01	131,960	1997.10.02	The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일)

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
담보권설정 제한현황	계약내용	순유형자산의 10% 미만
	이행현황	계약내용 이행 중 (해당 자산에 대해 담보권 설정 없음)
자산처분 제한현황	계약내용	(보증인이) 자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면 본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함
	이행현황	계약내용 이행 중 (2024년 3분기 중 처분 자산은 전체의 0.0%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당사항 없음

※ 발행액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

※ 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.는

Fiscal Agent의 지위에 있습니다.

※ 담보권설정 제한자산인 순유형자산은 생산설비 및 본사 보유주식입니다.

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된
가장 최근 재무제표의 작성기준일입니다.

※ 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시대상기간 중 공시대상인 자금조달 실적이 없습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성

해당사항 없습니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

(eMagin Corporation 지분인수)

종속기업 Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)는 Micro Display 기술 경쟁력을 확보를 위해 2023년 10월 18일자로 eMagin Corporation (대표자: Andrew Sculley, 소재지: New York, USA) 지분 100%를 인수하였습니다.

(주)도우인시스 지분매각)

종속기업 삼성디스플레이(주)는 OLED 산업 내 경쟁구도가 갈수록 심화되고 있는 상황에서 본 연의 사업과 R&D에 집중하기 위해 2024년 1월 31일자로 SVIC 29호 신기술투자조합 및 SVIC 48호 신기술투자조합이 보유한 (주)도우인시스 지분 56.8%를 (주)뉴파워프라즈마 등 3개 사에 매각하였습니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

(자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리)

해당사항 없습니다.

(중요한 소송사건)

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(채무보증 내역)

1) 국내채무보증

해당사항 없습니다.

2) 해외채무보증

(단위 : 천US\$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.08.19	715,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	210,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.09.30	329,000	329,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.12.17	2025.06.13	62,000	64,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2023.12.17	2025.06.13	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.12.16	96,000	96,000	8,065	△8,065	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	917,000	947,000	320,893	186,472	507,365	47.0%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.12.16	70,000	70,000	-	-	-	
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	114,000	114,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.05.31	835,508	832,731	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	125,000	125,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	537,000	537,000	-	-	-	
SECA	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	60,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2023.11.01	2025.09.05	888,400	856,400	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	15,600	15,600	-	-	-	
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	404,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2023.12.17	2025.06.13	270,000	270,000	-	-	-	
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	30,000	30,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	110,000	110,000	-	1,427	1,427	0.0%
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	20,000	20,000	-	-	-	
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	10,000	10,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증 시작일	보증 종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	2,000	2,000	-	-	-	-
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	100,000	100,000	-	-	-	-
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	25,000	25,000	-	-	-	-
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	-
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	15,000	15,000	-	-	-	-
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	-
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2021.11.22	2026.02.19	601,149	597,229	510,977	△3,332	507,645	8.1%
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022.04.26	채무소멸시	340,000	340,000	-	-	-	-
합 계							9,070,657	9,063,960	839,935	176,502	1,016,438	

- ※ 연결 기준입니다. SDN 건은 삼성디스플레이㈜, SAS 건은 SEA가 각각 채무보증인입니다. [△는 부(-)의 값임]
- ※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.
또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.
- ※ 당사는 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 산정된 채무보증 수수료를
수취하고 있습니다. 당사는 2023년 중 US\$2,141천의 수수료를 청구하였으며, 2024년 중 수취하였습니다.
한편, 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2023년 중 US\$3,066천의 수수료를 청구하였으며, 2024년 중 수취하였습니다.

☞ 우발채무 등에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

(감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항)

구 분	강조사항 등	핵심감사사항
제56기 3분기	해당사항 없음	해당사항 없음
제55기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성 (별도재무제표) 1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
제54기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감

나. 대손충당금(손실충당금) 설정 현황

(1) 계정과목별 대손충당금(손실충당금) 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금 (손실충당금)	대손충당 설정률
제56기 3분기말	매출채권	45,028,187	336,143	0.7%
	단기대여금	105,871	82,810	78.2%
	미수금	7,803,585	81,933	1.0%
	선급금	1,309,954	4,356	0.3%
	장기매출채권	25,496	-	0.0%
	장기미수금	905,310	177	0.0%
	장기선급금	5,456,774	7,453	0.1%
	장기대여금	144,863	1,136	0.8%
	합 계	60,780,040	514,008	0.8%
제55기말	매출채권	37,002,849	355,456	1.0%
	단기대여금	21,279	204	1.0%
	미수금	6,715,263	82,015	1.2%
	선급금	994,525	3,316	0.3%
	장기매출채권	23,889	-	0.0%
	장기미수금	759,704	209	0.0%
	장기선급금	4,964,481	9,255	0.2%
	장기대여금	239,149	77,608	32.5%
	합 계	50,721,139	528,063	1.0%
제54기말	매출채권	36,033,784	312,221	0.9%
	단기대여금	22,403	215	1.0%
	미수금	6,227,068	77,859	1.3%
	선급금	1,741,031	3,965	0.2%
	장기매출채권	204,248	-	0.0%
	장기미수금	824,468	242	0.0%
	장기선급금	2,382,711	10,969	0.5%
	장기대여금	225,983	1,206	0.5%
	합 계	47,661,696	406,677	0.9%

※ 연결 기준입니다.

※ 채권 금액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

(2) 대손충당금(손실충당금) 변동 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제56기 3분기	제55기	제54기
기초 대손충당금(손실충당금)	528,063	406,677	397,525
순대손처리액(① - ② + ③)	3,331	14,647	16,658
① 대손처리액(상각채권액) 등	6,126	19,179	9,711
② 상각채권회수액	-	4	-
③ 기타증감액	△2,795	△4,528	6,947
대손상각비 계상(환입)액	△7,421	136,033	25,810
기말 대손충당금(손실충당금)	514,007	528,063	406,677

※ 연결 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

(3) 매출채권 관련 대손충당금(손실충당금) 설정 방침

(설정방침)

- 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 고려하는 기대신용손실모형을 적용하여 대손충당금(손실충당금) 설정

(대손경험률 및 대손예상액 산정근거)

- 대손경험률: 과거 3개년 평균 채권잔액에 대한 신용손실 경험 등을 근거로 연령별 대손경험률을 산정하여 설정
- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등과 채무자의 신용정보 및 미래 전망을 고려하여 합리적인 대손예상액 설정

[대손 설정 기준]

상 황	설정률
분 쟁	25 %
수금의뢰	50 %
소 송	75 %
부 도	100 %

(대손 처리 기준)

매출채권 등에 대해 다음과 같은 사유 발생 시 실대손처리

- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우
- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
- 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우
- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	44,823,708	34,156	94,699	101,120	45,053,683
구성비율	99.5%	0.1%	0.2%	0.2%	100.0%

※ 연결 기준입니다.

※ 매출채권 잔액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

다. 재고자산 현황

(1) 사업부문별 재고자산의 보유 현황

(단위 : 백만원, %, 회)

부문	계정과목	제56기 3분기말	제55기말	제54기말
DX 부문	제품 및 상품	6,690,420	7,229,898	7,712,885
	반제품 및 재공품	818,255	967,513	1,013,606
	원재료 및 저장품	10,291,671	9,608,619	10,520,293
	미착품	1,266,972	1,014,420	943,322
	소 계	19,067,318	18,820,450	20,190,106
DS 부문	제품 및 상품	5,787,291	6,476,768	6,601,087
	반제품 및 재공품	22,148,765	20,961,730	18,756,104
	원재료 및 저장품	3,579,456	3,484,046	3,639,061
	미착품	80,794	76,226	61,352
	소 계	31,596,306	30,998,770	29,057,604
SDC	제품 및 상품	350,377	284,394	811,518
	반제품 및 재공품	416,414	296,788	542,473
	원재료 및 저장품	725,772	564,573	788,521
	미착품	20,236	6,509	23,626
	소 계	1,512,799	1,152,264	2,166,138
Harman	제품 및 상품	867,356	725,484	799,919
	반제품 및 재공품	107,472	104,514	119,890
	원재료 및 저장품	713,338	700,011	913,085
	미착품	684,955	319,785	269,715
	소 계	2,373,121	1,849,794	2,102,609
총 계	제품 및 상품	13,800,194	14,553,014	16,032,226
	반제품 및 재공품	23,351,094	22,198,448	20,077,519
	원재료 및 저장품	14,651,814	13,697,354	14,979,280
	미착품	1,553,657	1,177,058	1,098,841
	소 계	53,356,759	51,625,874	52,187,866
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]		10.9%	11.3%	11.6%
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		3.5회	3.5회	4.1회

※ 당사 연결 기준입니다.

(2) 재고자산의 실사내역 등

(실사내역)

- 5월말 및 11월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
- 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출고 내역을 확인하여 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인

(실사방법)

- 사내보관재고: 폐창식 전수조사 실시
 - ※ 반도체 및 디스플레이 패널 라인 재고 및 자동화창고보관 SVC자재는 표본조사
 - 사외보관재고: 제3자 보관재고, 운송 중인 재고는 전수로 물품보유확인서 또는 장치보관확인서 징구 및 표본조사 병행
 - 외부감사인은 당사의 기말 재고실사에 입회·확인하고 일부 항목은 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인
- ※ 당사는 2024년 5월 31일부터 6월 3일까지 상반기 재고실사를 실시하였으며, 종속기업들도 동일기준(5월말)으로 상반기 재고실사를 진행하였습니다.

(장기체화재고 등 내역)

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우 저가법 등을 사용하여 재고자산의 장부금액을 결정하고 있으며, 2024년 3분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가총당금	기말잔액
제품 및 상품	14,805,469	14,805,469	△1,005,275	13,800,194
반제품 및 재공품	24,928,549	24,928,549	△1,577,455	23,351,094
원재료 및 저장품	16,055,985	16,055,985	△1,404,171	14,651,814
미착품	1,553,657	1,553,657	-	1,553,657
합 계	57,343,660	57,343,660	△3,986,901	53,356,759

※ 당사 연결 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

라. 수주계약 현황

2024년 3분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

마. 공정가치평가 내역

(1) 금융상품의 공정가치평가 방법

[금융자산]

(분류)

당사는 금융자산을 공정가치 측정 금융자산(기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식), 상각후원가 측정 금융자산으로 분류합니다.

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(측정)

당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거합니다. 당사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

① 상각후원가 측정 금융자산

사업모형이 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

사업모형이 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 모두를 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

③ 당기손익-공정가치 측정 금융자산

상기 상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

2) 지분상품

당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로, 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않고 제거되는 시점에 자본에 누적된 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익을 이익잉여금으로 대체합니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 당사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

(손상)

당사는 미래전망정보에 근거하여, 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

(인식과 제거)

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금 흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 당사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 '차입금'으로 분류하고 있습니다.

(금융상품의 상계)

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

[금융부채]

(분류 및 측정)

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

- 1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채
과생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
- 2) 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 생기는 금융부채
이러한 금융부채는 상기 금융자산의 내용을 적용하여 측정합니다.
- 3) 금융보증계약
최초 인식 시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 4) 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정
최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 5) 기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가
이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.

(제거)

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다.

[파생상품]

당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

당사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 인식하고 있습니다.

(2) 범주별 금융상품 내역

1) 제56기 3분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산	당기손익- 공정가치 측정 금융자산	기타금융자산 (*)	계
현금및현금성자산	43,131,359	-	-	-	43,131,359
단기금융상품	60,616,598	-	-	-	60,616,598
단기상각후원가금융자산	-	-	-	-	-
단기당기손익-공정가치금융자 산	-	-	28,571	-	28,571
매출채권	44,692,044	-	-	-	44,692,044
기타포괄손익-공정가치금융자 산	-	9,640,598	-	-	9,640,598
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,185,582	-	1,185,582
기타	12,704,838	-	376,784	19,502	13,101,124
계	161,144,839	9,640,598	1,590,937	19,502	172,395,876

(*) 기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	12,861,787	-	-	12,861,787
단기차입금	271,753	-	10,763,366	11,035,119
미지급금	14,107,676	-	-	14,107,676
유동성장기부채	1,060,156	-	1,051,626	2,111,782
사채	19,537	-	-	19,537
장기차입금	6,829	-	3,758,608	3,765,437
장기미지급금	4,728,755	-	-	4,728,755
기타	13,197,743	50,873	43,788	13,292,404
계	46,254,236	50,873	15,617,388	61,922,497

(*) 기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주
로

분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

2) 제55기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산	당기손익- 공정가치 측정 금융자산	기타금융자산 (*)	계
현금및현금성자산	69,080,893	-	-	-	69,080,893
단기금융상품	22,690,924	-	-	-	22,690,924
단기상각후원가금융자산	608,281	-	-	-	608,281
단기당기손익-공정가치금융자 산	-	-	27,112	-	27,112
매출채권	36,647,393	-	-	-	36,647,393
기타포괄손익-공정가치금융자 산	-	7,481,297	-	-	7,481,297
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,431,394	-	1,431,394
기타	14,294,254	-	475,244	70,777	14,840,275
계	143,321,745	7,481,297	1,933,750	70,777	152,807,569

(*) 기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	12,861,787	-	-	12,861,787
단기차입금	271,753	-	10,763,366	11,035,119
미지급금	14,107,676	-	-	14,107,676
유동성장기부채	1,060,156	-	1,051,626	2,111,782
사채	19,537	-	-	19,537
장기차입금	6,829	-	3,758,608	3,765,437
장기미지급금	4,728,755	-	-	4,728,755
기타	13,197,743	50,873	43,788	13,292,404
계	46,254,236	50,873	15,617,388	61,922,497

(*) 기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주

로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

(3) 금융상품의 공정가치 측정내역

(금융상품의 장부금액과 공정가치)

(단위 : 백만원)

구 분	제56기 3분기말		제55기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	43,131,359	(*1)	69,080,893	(*1)
단기금융상품	60,616,598	(*1)	22,690,924	(*1)
단기상각후원가금융자산	-	-	608,281	(*1)
단기당기손익-공정가치금융자산	28,571	28,571	27,112	27,112
매출채권	44,692,044	(*1)	36,647,393	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	9,640,598	9,640,598	7,481,297	7,481,297
당기손익-공정가치금융자산	1,185,582	1,185,582	1,431,394	1,431,394
기타(*2)	13,101,124	396,286	14,840,275	546,021
계	172,395,876		152,807,569	
금융부채:				
매입채무	12,861,787	(*1)	11,319,824	(*1)
단기차입금	11,035,119	(*1)	7,114,601	(*1)
미지급금	14,107,676	(*1)	13,996,395	(*1)
유동성장기부채	2,111,782	525,007	1,308,875	6,757
- 유동성장기차입금	1,582,869	(*1)(*3)	1,302,521	(*1)(*3)
- 유동성사채	528,913	525,007	6,354	6,757
사채	19,537	21,479	537,618	529,254
장기차입금	3,765,437	(*1)(*3)	3,724,850	(*1)(*3)
장기미지급금	4,728,755	(*1)	4,907,875	(*1)
기타(*2)	13,292,404	94,661	11,414,008	83,463
계	61,922,497		54,324,046	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 12,704,838백만원(전기말: 14,294,254백만원) 및

금융부채 13,197,743백만원(전기말: 11,330,545백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*3) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계)

(단위 : 백만원)

구 분	제56기 3분기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	28,571	-	28,571
기타포괄손익-공정가치금융자산	6,973,987	-	2,666,611	9,640,598
당기손익-공정가치금융자산	106,002	-	1,079,580	1,185,582
기타	-	66,941	329,345	396,286
금융부채:				
유동성사채	-	525,007	-	525,007
사채	-	21,479	-	21,479
기타	-	94,661	-	94,661

(단위 : 백만원)

구 분	제55기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	27,112	-	27,112
기타포괄손익-공정가치금융자산	5,250,993	-	2,230,304	7,481,297
당기손익-공정가치금융자산	347,221	-	1,084,173	1,431,394
기타	-	130,364	415,657	546,021
금융부채:				
유동성사채	-	6,757	-	6,757
사채	-	529,254	-	529,254
기타	-	83,463	-	83,463

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용됩니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에 포함된 상품은 파생상품, 사채 등이 있습니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

당사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포 모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(가치평가기법 및 투입변수)

당사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2024년 3분기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자(주)	34,864	현금흐름할인법	영구성장률	1.0%
			가중평균자본비용	15.8%
(주)미코세라믹스	45,888	현금흐름할인법 등	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	10.9%
TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	1,445,161	현금흐름할인법	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	9.3%
China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	266,395	현금흐름할인법	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	9.3%
기타:				
지분 콜옵션	288,546	이항모형	무위험 이자율	2.9%
			가격 변동성	52.6%
지분 풋옵션	40,799	이항모형	무위험 이자율	3.5%~4.6%, 1.4%
			가격 변동성	25.7%, 35.5%

[△는 부(-)의 값임]

(수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동내역)

(단위 : 백만원)

금융자산	제56기 3분기	제55기 반기
기초	3,730,134	3,303,227
매입	185,466	120,995
매도	△104,811	△3,216,022
당기손익으로 인식된 손익	△64,210	248,191
기타포괄손익으로 인식된 손익	220,924	3,124,848
기타	108,033	△88,555
기말	4,075,536	3,492,684

[△는 부(-)의 값임]

(단위 : 백만원)

금융부채	제56기 3분기	제55기 반기
기초	-	7,404
당기손익으로 인식된 손익	-	-
기말	-	7,404

[△는 부(-)의 값임]

(‘수준 3’으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석)

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

2024년 3분기말 현재 ‘수준 3’으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익 효과(자본은 법인세효과 반영전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동 효과		불리한 변동 효과	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	188,847	-	△123,174
기타	86,470	-	△80,151	-

※ 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장을 및 가중평균자본비용을

1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 가격(20%) 및가격 변동성(10%)을

증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(4) 유형자산 재평가내역

당사는 공시대상기간 중 유형자산 재평가내역이 없습니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 등

삼정회계법인은 당사의 제55기 감사 및 제56기 3분기 검토를 수행하였고, 제55기 감사 결과 감사의견은 적정이며, 제56기 3분기 검토 결과 재무제표에 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

그리고 안진회계법인은 당사의 제54기 감사를 수행하였고 감사의견은 적정입니다. 한편, 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간 중 모두 적정의견을 받았습니다.

[회계감사인의 명칭 및 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제56기 3분기 (당분기)	삼정회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
제55기 (전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성 (별도재무제표) 1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
제54기 (전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감

※ 감사의견은 별도·연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

[감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제56기 3분기 (당분기)	삼정회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 별도 및 연결 내부회계관리제도 감사	7,800	78,000	4,991	49,913
제55기 (전기)	삼정회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 별도 및 연결 내부회계관리제도 감사	7,800	85,700	7,800	85,036
제54기 (전전기)	안진회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사	8,424	78,000	8,424	78,146

(제56기 3분기 일정)

구 분	일 정	
제56기 1분기	사전검토	2024.03.11 ~ 2024.03.29
	본검토	2024.04.08 ~ 2024.05.14
제56기 2분기	사전검토	2024.06.10 ~ 2024.06.27
	본검토	2024.07.08 ~ 2024.08.13
제56기 3분기	사전검토	2024.09.09 ~ 2024.09.27
	본검토	2024.10.08 ~ 2024.11.13

※ 별도·연결 재무제표 검토에 대한 일정입니다.

[비감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제56기 3분기 (당분기)	2017.02	세무자문업무(해외중속기업)	2024.01~2024.06	43	삼정회계법인
	2018.09	세무자문업무(해외중속기업)	2024.01~2024.05	-	
	2019.05	세무자문업무(해외중속기업)	2024.01~2024.06	73	
제55기 (전기)	2017.02	세무자문업무(해외중속기업)	2023.01~2023.12	202	삼정회계법인
	2018.09	세무자문업무(해외중속기업)	2023.01~2023.12	27	
	2019.05	세무자문업무(해외중속기업)	2023.01~2023.12	79	
	2023.05	ESG인증업무(국내중속기업)	2023.05~2023.07	25	
제54기 (전전기)	-	-	-	-	-

[내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과]

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2024.01.29	<ul style="list-style-type: none"> 감사위원회: 위원 3명 회사: 감사팀장 감사인: 업무수행이사 외 5명 	대면회의	<ul style="list-style-type: none"> 연간 회계감사 진행 상황 핵심 감사사항 등 중점 감사사항 내부회계관리제도 감사 진행 상황 기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항
2	2024.04.26	<ul style="list-style-type: none"> 감사위원회: 위원 3명 회사: 감사팀장 감사인: 업무수행이사 외 5명 	대면회의	<ul style="list-style-type: none"> 분기 검토 경과 보고 연간 회계감사 계획 기타 감사계획단계 필수 커뮤니케이션 사항
3	2024.07.29	<ul style="list-style-type: none"> 감사위원회: 위원 3명 회사: 감사팀장 감사인: 업무수행이사 외 5명 	대면회의	<ul style="list-style-type: none"> 연간 회계감사 진행 상황 핵심 감사사항 선정 계획 분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항
4	2024.10.25	<ul style="list-style-type: none"> 감사위원회: 위원 3명 회사: 감사팀장 감사인: 업무수행이사 외 5명 	대면회의	<ul style="list-style-type: none"> 연간 회계감사 진행 상황 핵심 감사사항 선정 계획 내부회계관리제도 감사 진행 상황 분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항

[조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보]

해당사항 없습니다.

나. 회계감사인의 변경

제56기 3분기말(당분기말) 현재 당사의 종속기업은 229개이며, 당분기 중 해외 종속기업 중 Harman International Industires, Inc. 외 16개 종속기업은 PwC에서 KPMG로 회계감사인을 변경하였으며, 국내 종속기업 중 (주)하만인터내셔널코리아는 삼일회계법인(PwC)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 회계감사인을 변경하였습니다. 또한, 전기 중 신규 인수한 eMagin Corporation은 삼정회계법인(KPMG)을 회계감사인으로 신규 선임하였고, 전기 중 설립된 종속기업 Samsung Federal Inc.는 KPMG를 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 종속기업의 회계감사인 변경 및 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

[제56기 종속기업의 회계감사인 변경 현황]

종속기업명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인
(주)하만인터내셔널코리아	삼일회계법인(PwC)	삼정회계법인(KPMG)
Harman International Industires, Inc.	PwC	KPMG
Harman (China) Technologies Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Holding Limited	PwC	KPMG
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Becker Automotive Systems GmbH	PwC	KPMG
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	PwC	KPMG
Harman Connected Services GmbH	PwC	KPMG
Harman Consumer Nederland B.V.	PwC	KPMG
Harman Deutschland GmbH	PwC	KPMG
Harman Holding GmbH & Co. KG	PwC	KPMG
Harman Hungary Financing Ltd.	PwC	KPMG
Harman Professional Kft	PwC	KPMG

당사는 제55기(전기)부터 회계감사인을 안진회계법인(Deloitte)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 변경하였습니다. 이는 지정감사인이었던 안진회계법인(Deloitte)과의 계약이 2022년말 기간 만료로 종료됨에 따라 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조 제1항 및 제3항, 제4항에 의거하여 감사위원회가 선정한 결과로, 삼정회계법인(KPMG)을 2023년부터 2025년까지 3개년의 회계감사인으로 신규 선임하였습니다.

제55기말(전기말) 현재 당사의 종속기업은 232개이며, 전기 중 국내 종속기업 가운데 삼성디스플레이(주) 등 8개는 안진회계법인(Deloitte)에서 삼정회계법인(KPMG)으로, 에스유머티리얼스(주)는 한영회계법인(E&Y)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 회계감사인을 변경하였습니다. 또한, 해외 종속기업 중 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 30개사는 Deloitte에서 KPMG로, Samsung Japan Corporation (SJC) 등 65개사는 PwC에서 KPMG로, Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA) 등 6개사는 E&Y에서 KPMG로, Laos Samsung Electronics Sole Co.,Ltd (LSE)는 KPP Co., Ltd에서 KPMG로 회계감사인을 변경하였습니다. 한편, 전기 중 설립된 종속기업 SVIC 62호 신기술투자조합은 삼정회계법인(KPMG)을 신규 선임하였고, 전전기 중 설립된 종속기업 (주)희망별숲은 삼정회계법인(KPMG)을, Samsung Electronics Uzbekistan FC LLC (SEUZ), DOWOINSYS VINA COMPANY LIMITED는 KPMG를 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 해당 종속기업들은 당사(지배회사)의 회계감사인 변경에 따라 연결감사 업무 효율화 등을 위해 회계감사인을 변경 및 신규 선임하였으며, 이는 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

[제55기 종속기업의 회계감사인 변경 현황]

종속기업명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인
삼성디스플레이(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자서비스(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자서비스씨에스(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자판매(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자로지텍(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
(주)도우인시스	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
지에프(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
(주)미래로시스템	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
에스유머티리얼스(주)	한영회계법인(E&Y)	삼정회계법인(KPMG)
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	Deloitte	KPMG
Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	Deloitte	KPMG
Samsung International, Inc. (SII)	Deloitte	KPMG
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics GmbH (SEG)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	Deloitte	KPMG
Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	Deloitte	KPMG

Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	Deloitte	KPMG
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Deloitte	KPMG
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	Deloitte	KPMG
Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Vietnam THANGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	Deloitte	KPMG
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	Deloitte	KPMG
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Deloitte	KPMG
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Turkiye (SETK)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	Deloitte	KPMG
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Deloitte	KPMG
Samsung Japan Corporation (SJC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	PwC	KPMG
Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	PwC	KPMG
Samsung Research America, Inc (SRA)	PwC	KPMG
SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	PwC	KPMG
SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	PwC	KPMG
SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	PwC	KPMG

Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	PwC	KPMG
Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	PwC	KPMG
Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	PwC	KPMG
Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	PwC	KPMG
Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	PwC	KPMG
PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	PwC	KPMG
PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	PwC	KPMG
Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	PwC	KPMG
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	PwC	KPMG
Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	PwC	KPMG
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	PwC	KPMG
Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	PwC	KPMG
Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	PwC	KPMG
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	PwC	KPMG
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	PwC	KPMG
Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	PwC	KPMG
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	PwC	KPMG
Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	PwC	KPMG
Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	PwC	KPMG
Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	PwC	KPMG
Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	PwC	KPMG
Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	PwC	KPMG

Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	E&Y	KPMG
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	KPP Co., Ltd	KPMG

또한, 제54기말(전전기) 현재 당사의 종속기업은 232개이며, 종속기업 Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)이 PwC를, SVIC 52호 신기술투자조합과 SVIC 55호 신기술투자조합, SVIC 56호 신기술투자조합, SVIC 57호 신기술투자조합은 삼정회계법인(KPMG)을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 종속기업의 회계감사인 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

2. 내부통제에 관한 사항

내부통제에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

이사회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

2. 감사제도에 관한 사항

감사제도에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

3. 주주총회 등에 관한 사항

주주총회 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일)

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
삼성생명보험(주)	최대주주 본인	보통주	508,157,148	8.51	508,157,148	8.51	-
삼성생명보험(주)	최대주주 본인	우선주	43,950	0.01	43,950	0.01	-
삼성생명보험(주) (특별계정)	최대주주 본인	보통주	8,097,938	0.14	5,771,050	0.10	장내 매매
삼성생명보험(주) (특별계정)	최대주주 본인	우선주	417,085	0.06	422,795	0.05	장내 매매
삼성물산(주)	계열회사	보통주	298,818,100	5.01	298,818,100	5.01	-
삼성화재해상보험(주)	계열회사	보통주	88,802,052	1.49	88,802,052	1.49	-
삼성복지재단	출연 재단	보통주	4,484,150	0.08	4,484,150	0.08	-
삼성문화재단	출연 재단	보통주	1,880,750	0.03	1,880,750	0.03	-
삼성생명공익재단	출연 재단	보통주	0	0.00	1,250	0.00	특수관계없는 일반인의 기부
홍라희	최대주주의 특수관계인	보통주	117,302,806	1.96	97,978,700	1.64	장외 매매
홍라희	최대주주의 특수관계인	우선주	206,633	0.03	206,633	0.03	-
이재용	최대주주의 특수관계인	보통주	97,414,196	1.63	97,414,196	1.63	-
이재용	최대주주의 특수관계인	우선주	137,757	0.02	137,757	0.02	-
이부진	계열회사 임원	보통주	55,394,044	0.93	47,745,681	0.80	장외 매매
이부진	계열회사 임원	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
이서현	계열회사 임원	보통주	55,394,044	0.93	47,290,190	0.79	장외 매매
이서현	계열회사 임원	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
한종희	계열회사 임원	보통주	15,000	0.00	25,000	0.00	장내 매매
경계현	계열회사 임원	보통주	21,050	0.00	0	0.00	이사 사임
노태문	계열회사 임원	보통주	13,000	0.00	23,000	0.00	장내 매매
박학규	계열회사 임원	보통주	22,500	0.00	34,000	0.00	장내 매매
이정배	계열회사 임원	보통주	15,000	0.00	21,800	0.00	장내 매매
김한조	계열회사 임원	보통주	3,655	0.00	3,655	0.00	-
조혜경	계열회사 임원	보통주	0	0.00	500	0.00	신규 선임
계		보통주	1,235,835,433	20.70	1,198,451,222	20.08	-
		우선주	1,080,935	0.13	1,086,645	0.13	-

※ 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다.

(단, 보통주 일부는 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한되어 있습니다. 자세한 현황은 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' 중 '3. 주주총회 등에 관한 사항'의 '라. 의결권 현황'을 참고하시기 바랍니다.)

※ 2024년 9월 30일 기준입니다. 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 '주식등의대량보유상황보고서(일반)' 등을 참고하시기 바랍니다.

2. 최대주주 관련 사항

가. 최대주주의 개요

(1) 최대주주(삼성생명보험주)의 기본정보

1) 법적·상업적 명칭: 삼성생명보험주 (Samsung Life Insurance Co., Ltd.)

2) 설립일자: 1957년 4월 24일

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)

전화번호: 1588-3114

홈페이지: www.samsunglife.com

4) 최대주주(삼성생명보험주)의 대표이사·업무집행자·최대주주

(단위 : 명, %)

명칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조함원)		업무집행자 (업무집행조함원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성생명보험주	67,928	홍원학	0.00	-	-	삼성물산주	19.34
		-	-	-	-	-	-

※ 2024년 9월 30일 보통주 기준입니다.

5) 최대주주(삼성생명보험주)의 대표이사·업무집행자·최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조함원)		업무집행자 (업무집행조함원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2024.03.21	홍원학	0.00	-	-	-	-

※ 2024년 3월 21일 전영목 대표이사가 사임하고, 홍원학 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

(2) 최대주주(삼성생명보험주)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성생명보험주
자산총계	312,665,253
부채총계	277,382,931
자본총계	35,282,322
매출액	22,759,623
영업이익	2,448,075
당기순이익	2,165,949

※ 재무현황은 2024년 9월 30일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주(삼성생명보험주)의 사업현황 등

삼성생명보험주는 인보험 및 그와 관련된 재보험계약 등을 주요 영업목적으로 하는 생명보험회사로, 보험업법 및 기타 법령 등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

또한, 주요 종속기업인 삼성카드주는 여신전문금융업(신용카드업·시설대여업·할부금융업 등)을 영위하는 여신전문금융회사로, 여신전문금융업법 및 기타 관계법령에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

☞ 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 삼성생명보험주의 사업(분·반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 최대주주의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 기본정보

1) 법적·상업적 명칭: 삼성물산주 (Samsung C&T Corporation)

2) 설립일자 및 존속기간

1963년 12월 23일에 동화부동산주식회사로 시작하여, 2014년 7월 제일모직주식회사로 사명을 변경하였습니다. 또한 1938년 3월 1일 설립된 삼성상회를 모태로 1951년 1월에 설립된 삼성물산주식회사와의 합병을 통하여 2015년 9월 2일(합병등기일) 삼성물산주식회사로 사명을 변경하였습니다.

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

전화번호: 02-2145-5114

홈페이지: www.samsungcnt.com

4) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 대표이사·업무집행자·최대주주

(단위 : 명, %)

명칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성물산주	110,810	오세철	0.00	-	-	이재용	19.06
		정해린	0.00	-	-	-	-
		이재언	0.00	-	-	-	-

※ 2024년 9월 30일, 보통주 기준입니다.

5) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 대표이사·업무집행자·최대주주의 변동내역

(단위 : %)

변동일	대표이사 (대표조함원)		업무집행자 (업무집행조함원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2023.03.17	한승환	-	-	-	-	-
2023.03.17	정해린	0.00	-	-	-	-
2023.04.21	-	-	-	-	이재용	18.26
2024.03.15	고정석	-	-	-	-	-
2024.03.15	이재연	0.00	-	-	-	-
2024.04.19	-	-	-	-	이재용	19.06

- ※ 2023년 3월 17일 한승환 대표이사가 사임하고, 정해린 대표이사가 선임되었습니다.
- ※ 2023년 4월 21일 자기주식 소각(보통주 1,295,411)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(18.13%→18.26%)되었습니다.
- ※ 2024년 3월 15일 고정석 대표이사가 사임하고, 이재연 대표이사가 선임되었습니다.
- ※ 2024년 4월 19일 자기주식 소각(보통주 7,807,563)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(18.26%→19.06%)되었습니다.

(2) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	삼성물산주
법인 또는 단체의 명칭	삼성물산주
자산총계	62,356,760
부채총계	23,942,808
자본총계	38,413,952
매출액	32,110,475
영업이익	2,348,833
당기순이익	2,116,205

※ 재무현황은 2024년 9월 30일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 사업현황 등

삼성물산주는 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고 있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 산업소재, 섬유 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류 수입 및 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는 리조트부문, 바이오의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어 있습니다.

☞ 최대주주의 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 삼성물산주의 사업(분·반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원

(기준일 : 2024년 09월 30일)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
한중희	남	1962.03	부회장	사내이사	상근	대표이사 (DX부문 경영전반 총괄)	· 인하대 전자공학 학사 · 삼성전자 DX부문장	25,000	-	계열회사 임원	55개월	2026.03.17
노태문	남	1968.09	사장	사내이사	상근	MX사업부장	· 포항공대 전자전기공학 박사 · 삼성전자 MX사업부장	23,000	-	계열회사 임원	31개월	2025.03.15
박학규	남	1964.11	사장	사내이사	상근	CFO	· KAIST 경영학 석사 · 삼성전자 경영지원실장	34,000	-	계열회사 임원	31개월	2025.03.15
이정배	남	1967.02	사장	사내이사	상근	메모리사업부장	· 서울대 전자공학 박사 · 삼성전자 메모리사업부장	21,800	-	계열회사 임원	31개월	2025.03.15
김한조	남	1956.07	이사	사외이사	비상근	이사회 의장 감사위원회 위원장 내부거래위원회 위원 보상위원회 위원 지속가능경영위원회 위원장	· 연세대 불어불문학 학사 · 하나금융지주 부회장	3,655	-	계열회사 임원	67개월	2025.03.19
김준성	남	1967.10	이사	사외이사	비상근	보상위원회 위원 지속가능경영위원회 위원	· Carnegie Mellon대 경제학/산업공학 학사 · 싱가포르 투자청 · 토탈리턴그룹 이사	-	-	계열회사 임원	31개월	2025.03.15
허은녕	남	1964.08	이사	사외이사	비상근	내부거래위원회 위원장 사외이사 후보추천위원회 위원 지속가능경영위원회 위원	· Pennsylvania State대 자원경제학 박사 · 서울대 공과대학 교수	-	-	계열회사 임원	23개월	2025.11.02
유명희	여	1967.06	이사	사외이사	비상근	감사위원회 위원 내부거래위원회 위원 사외이사 후보추천위원회 위원 지속가능경영위원회 위원	· Vanderbilt대 법학 박사 · 산업통상자원부 · 통상교섭본부 본부장	-	-	계열회사 임원	23개월	2025.11.02
신제운	남	1958.03	이사	사외이사	비상근	사외이사 후보추천위원회 위원장 보상위원회 위원 지속가능경영위원회 위원	· 서울대 경제학 학사 · 금융위원회 위원장	-	-	계열회사 임원	7개월	2027.03.28
조혜경	여	1964.07	이사	사외이사	비상근	감사위원회 위원 지속가능경영위원회 위원	· 서울대 로봇공학 박사 · 한성대 시응용학과 교수	500	-	계열회사 임원	7개월	2027.03.19

- ※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.
- ※ 등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 기준이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하시기 바랍니다.
- ※ 2024년 3월 20일 정기주주총회에서 신재윤 사외이사, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 이사가 신규 선임되었으며, 유명희 사외이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. 당일 개최된 이사회를 통해 허은녕 사외이사와 유명희 사외이사가 내부거래위원회 위원으로 선임되었고, 신재윤 이사는 사외이사 후보추천위원회 위원, 보상위원회 위원, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었으며, 조혜경 사외이사는 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.
- ※ 2024년 3월 20일 김선욱 사외이사가 퇴임하였습니다.
- ※ 2024년 3월 22일 김종훈 사외이사의 임기가 만료되었습니다.
- ※ 2024년 4월 26일 허은녕 사외이사가 내부거래위원회 위원장으로 선임되었습니다.
- ※ 2024년 5월 21일 경계현 사내이사가 사임하였습니다.
- ※ 2024년 7월 29일 신재윤 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.

나. 등기임원의 타회사 임원겸직 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일)

겸직자		겸직회사		
성명	직위	기업명	직위	재임기간
유명희	사외이사	HD현대건설기계	사외이사	2022년~현재
조혜경	사외이사	현대건설	사외이사	2021년~현재

다. 미등기임원 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일)

(단위 : 개월)

성명	성별	출생 연월	직위	상근 여부	담당업무	주요경력	학력	최대주주의와의 관계	재직 기간
이재용	남	1968.06	회장	상근	회장	COO	Harvard Univ.(박사수료)	최대주주의 특수관계인	
전영현	남	1960.12	부회장	상근	DS부문장	미래사업기획단장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	10
정현호	남	1960.03	부회장	상근	사업지원T/F장	디지털이미징사업부장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
경계현	남	1963.03	사장	상근	미래사업기획단장	DS부문장	서울대(박사)	계열회사 임원	22
김수목	남	1964.05	사장	상근	법무실장	법무실 총무팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	49
김우준	남	1968.05	사장	상근	네트워크사업부장	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김원경	남	1967.08	사장	상근	Global Public Affairs실장	북미총괄 대외협력팀장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	
남석우	남	1966.03	사장	상근	제조&기술담당	글로벌인프라총괄	연세대(박사)	계열회사 임원	
박승희	남	1964.08	사장	상근	Corporate Relations담당	삼성물산, 건설부문 커뮤니케이션 팀장	건국대(석사)	계열회사 임원	22
박용인	남	1964.04	사장	상근	System LSI사업부장	System LSI 전략마케팅실장	연세대(석사)	계열회사 임원	
백수현	남	1963.01	사장	상근	커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
송재혁	남	1967.08	사장	상근	DS부문 CTO	메모리 Flash개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
안중현	남	1963.03	사장	상근	경영지원실 담당임원	SGR, 미래산업연구본부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	6
양걸	남	1962.10	사장	상근	중국전략협력실장	DS부문 중국총괄	서강대(석사)	계열회사 임원	
임대현	남	1966.03	사장	상근	법무실 담당임원	법무실 총무팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
윤석우	남	1970.09	사장	상근	영상디스플레이사업부장	영상디스플레이 담당임원	Polytechnic Univ. of NY(석사)	계열회사 임원	
이영희	여	1964.11	사장	상근	글로벌마케팅실장	무선 마케팅팀장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
전경훈	남	1962.12	사장	상근	DX부문 CTO	네트워크사업부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	
최경식	남	1962.03	사장	상근	북미총괄	무선 전략마케팅실장	한양대(석사)	계열회사 임원	
최시영	남	1964.01	사장	상근	Foundry사업부장	글로벌인프라총괄 메모리제조기술 센터장	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	
한승환	남	1964.07	사장	상근	의료사업일류화추진단장	삼성물산, 리조트부문 대표이사	서울대(학사)	계열회사 임원	22
강동구	남	1976.12	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	

강동훈	남	1970.12	부사장	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
강문수	남	1969.08	부사장	상근	Foundry사업부 담당임원	AVP사업팀장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	
강석채	남	1971.06	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	DS부문 DSA 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
강성철	남	1967.08	부사장	상근	생산기술연구소 담당임원	Samsung Research Robot센터장	서울대(박사)	계열회사 임원	
강신봉	남	1970.01	부사장	상근	글로벌마케팅실 D2C센터장	위대한상상, CEO	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	21
강태우	남	1973.10	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	
계종욱	남	1966.10	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
고대근	남	1965.03	부사장	상근	SEPM법인장	SIEL-P(C)법인장	아주대(학사)	계열회사 임원	
고봉준	남	1972.01	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	Columbia Univ.(박사)	계열회사 임원	55
고승환	남	1962.09	부사장	상근	생활가전 구매팀장	영상디스플레이 구매팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	
고재윤	남	1973.01	부사장	상근	지원팀 담당임원	경영혁신팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
고재필	남	1970.03	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	메모리 인사팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
고형중	남	1970.11	부사장	상근	S.LSI Design Platform개발실장	메모리 Design Platform개발실장	Univ. of Florida(박사)	계열회사 임원	
곽연봉	남	1967.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터장	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
구본영	남	1967.05	부사장	상근	SAS법인장	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
구지흠	남	1968.01	부사장	상근	Foundry 기술개발실장	Foundry 기술개발실 담당임원	North Carolina State Univ.(박사)	계열회사 임원	
권상덕	남	1967.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 담당임원	반도체연구소 Logic TD실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
권태훈	남	1968.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	
김강태	남	1972.10	부사장	상근	Samsung Research 기술전략팀장	Samsung Research SE팀장	중앙대(박사)	계열회사 임원	
김경환	남	1970.06	부사장	상근	법무실 총무팀장	법무실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	59
김경희	여	1969.07	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Yale Univ.(석사)	계열회사 임원	
김기훈	남	1968.05	부사장	상근	지원팀 담당임원	구주총괄 지원팀장	Univ. of Baltimore(석사)	계열회사 임원	
김대주	남	1969.10	부사장	상근	영상디스플레이 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.06	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터장	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	
김동관	남	1969.10	부사장	상근	DS부문 정보보호센터장	삼성SDS 정보보호센터장	한양대(학사)	계열회사 임원	34

김동욱	남	1968.10	부사장	상근	재경팀장	재경팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김동욱	남	1969.06	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	Univ. of California, Irvine(박사)	계열회사 임원	
김두일	남	1971.07	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research Platform팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
김만영	남	1969.07	부사장	상근	SEG법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Boston Univ.(학사)	계열회사 임원	
김명철	남	1968.09	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김민구	남	1964.08	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김병도	남	1967.03	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김보현	남	1973.02	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	메모리 People팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
김상우	남	1971.01	부사장	상근	DS부문 법무지원팀장	법무실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	8
김성욱	남	1968.06	부사장	상근	한국총괄 D2C팀장	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김성윤	남	1966.10	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	IP센터 책임변호사	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
김성근	남	1970.05	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(학사)	계열회사 임원	57
김성한	남	1970.05	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김세윤	남	1973.06	부사장	상근	TSE-S법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김세호	남	1967.10	부사장	상근	SEI법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	동국대(학사)	계열회사 임원	
김수진	여	1969.08	부사장	상근	지속가능경영추진센터장	Global Public Affairs팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(박사)	계열회사 임원	
김연성	남	1966.05	부사장	상근	생활가전 지원팀장	한국총괄 지원팀장	MIT(석사)	계열회사 임원	
김영집	남	1971.03	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김영호	남	1964.12	부사장	상근	수원지원센터장	생활가전 지원팀 담당임원	Tulane Univ.(석사)	계열회사 임원	
김용관	남	1963.12	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	의료기기사업부장	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
김용국	남	1968.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성바이오에피스, 생산본부 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	39
김용수	남	1971.07	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀장	Google, VP	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	10
김용재	남	1972.03	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김용주	남	1970.08	부사장	상근	Foundry 지원팀장	삼성SDI 총대행사사업부 지원팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	34
김우령	남	1970.05	부사장	상근	DSRA-PKG 연구소장	DSRA-AVP 연구소장	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	27

김유석	남	1965.04	부사장	상근	법무실 IP센터장	법무실 IP센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김은중	남	1965.06	부사장	상근	S.LSI Global Operation실 담당임원	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김이수	남	1973.03	부사장	상근	SIEL-P(N)공장장	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	
김인식	남	1967.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성SDS, 전략기획담당 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
김일룡	남	1974.02	부사장	상근	S.LSI Global Operation실 담당임원	System LSI Global Operation실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김정경	남	1973.05	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
김재열	남	1965.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김재준	남	1968.01	부사장	상근	메모리 전략마케팅실장	DS부문 미주총괄 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김재훈	남	1967.01	부사장	상근	SEIB법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김정식	남	1970.08	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
김정현	남	1975.06	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 기획팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
김종현	남	1966.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 People팀장	Foundry 인사팀장	육사(학사)	계열회사 임원	
김주년	남	1969.12	부사장	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
김준석	남	1969.04	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
김종영	남	1973.11	부사장	상근	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	東北大(박사)	계열회사 임원	
김진수	남	1971.10	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	국민대(학사)	계열회사 임원	
김창업	남	1969.08	부사장	상근	SEDA-S판매부문장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
김철기	남	1968.03	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1969.04	부사장	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김평진	남	1973.12	부사장	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	연세대(학사)	계열회사 임원	
김학상	남	1966.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Univ. of Massachusetts, Lowell(박사)	계열회사 임원	
김한석	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
김현도	남	1966.04	부사장	상근	Mobile eXperience 구미지원센터장	생활가전 광주지원센터장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김현우	남	1970.02	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 기술기획팀장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김형로	남	1973.01	부사장	상근	영상디스플레이 People팀장	인사팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	34

김홍경	남	1965.11	부사장	상근	DS부문 경영지원실장	DS부문 경영지원실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김홍식	남	1969.09	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
나기홍	남	1966.03	부사장	상근	People팀장	인사팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
노원일	남	1967.08	부사장	상근	SRA연구소장	네트워크 상품전략팀장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
다니엘오	남	1974.03	부사장	상근	IR팀장	IR팀 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	32
더욱라이언	남	1962.09	부사장	상근	DS부문 DSE총괄	DS부문 구조총괄 담당임원	Limerick Regional Technical Coll.(학사)	계열회사 임원	
데이브다스	남	1975.06	부사장	상근	SEA 담당임원	SEIB법인장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
데이브리	남	1969.07	부사장	상근	Samsung NEXT장	Refactor Capital, Co-founder	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	44
도현호	남	1967.10	부사장	상근	제조&기술담당 설비기술연구소 담당임원	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	31
디페쉬	남	1969.06	부사장	상근	SRI-Bangalore연구소장	SRI-Bangalore 副연구소장	Indian Inst. of Management, Bangalore(석사)	계열회사 임원	
류경동	남	1970.01	부사장	상근	SAIT System Research Center장	SAIT 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	13
린준형	남	1970.07	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구실 담당임원	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	NTUST(박사)	계열회사 임원	21
마크리퍼트	남	1973.02	부사장	상근	북미총괄 대외협력팀장	YouTube, APAC 대외협력총괄	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	31
메노	남	1968.06	부사장	상근	SEF법인장	SEBN법인장	Haarlem Business School(학사)	계열회사 임원	
명호석	남	1967.04	부사장	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
윤성우	남	1971.12	부사장	상근	경영혁신센터장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
윤성훈	남	1974.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	경북대(박사)	계열회사 임원	
윤승도	남	1968.10	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
윤종승	남	1971.08	부사장	상근	생활가전 개발팀장	생산기술연구소장	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
윤준	남	1974.06	부사장	상근	네트워크 개발팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
윤창록	남	1971.01	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 CIS TD팀장	System LSI Sensor사업팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
윤희동	남	1971.07	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	종합기술원 인사팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
민종술	남	1968.03	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
바우만	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEUK법인장	Univ. of Bath(석사)	계열회사 임원	
박건태	남	1969.09	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	감사팀 담당부장	Univ. of Colorado, Boulder(석사)	계열회사 임원	

박문호	남	1965.01	부사장	상근	People팀 담당임원	경영진단팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박상권	남	1971.07	부사장	상근	DS부문 커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	43
박성욱	남	1972.04	부사장	상근	SCS법인장	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
박성준	남	1971.01	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	종합기술원 Material연구센터 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박성호	남	1968.09	부사장	상근	SEVT법인장	SIEL-P(N)공장장	경북대(석사)	계열회사 임원	
박세근	남	1974.01	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	57
박수남	남	1970.10	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실장	Univ. of Minnesota, Minneapolis(박사)	계열회사 임원	
박수철	남	1966.07	부사장	상근	지원팀장	Mobile eXperience 지원팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
박정민	남	1972.03	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀장	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	45
박정호	남	1971.09	부사장	상근	Compliance팀장	Compliance팀 담당임원	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	
박정훈	남	1969.10	부사장	상근	Samsung Research Visual Technology팀장	Samsung Research Media Research팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
박제민	남	1971.12	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실장	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
박종범	남	1969.02	부사장	상근	서남아총괄	SIEL-S 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
박지선	남	1974.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	SRA 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
박진영	여	1971.11	부사장	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	DS부문 구매팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
박찬우	남	1973.05	부사장	상근	한국총괄 B2B통합오피링센터 담당임원	생활가전 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박찬훈	남	1962.04	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	電氣通信大學(박사)	계열회사 임원	
박철우	남	1971.10	부사장	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀장	Mattel, SVP	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
박태상	남	1975.01	부사장	상근	SEVT 담당임원	생산기술연구소 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
박현정	남	1969.12	부사장	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
박형원	남	1966.09	부사장	상근	System LSI Global Operation실장	System LSI 품질팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
반효동	남	1967.06	부사장	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
발라지	남	1969.09	부사장	상근	SSIR연구소장	SSIR VP	Birla Institute of Technology and Science, Pilani(석사)	계열회사 임원	
배광진	남	1968.02	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	금오공대(학사)	계열회사 임원	
배상우	남	1970.10	부사장	상근	메모리 품질실장	메모리 품질보증실 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	

배용철	남	1970.05	부사장	상근	메모리 상품기획실장	메모리 전략마케팅실 담당임원	Harvard Univ.(박사수료)	계열회사 임원	
배일환	남	1970.07	부사장	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
백종수	남	1971.01	부사장	상근	신사업T/F장	지원팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
서보철	남	1972.01	부사장	상근	Mobile eXperience Global운영팀장	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	동국대(학사)	계열회사 임원	
서원주	남	1976.07	부사장	상근	DS부문 IP팀장	DS부문 미주총괄 VP	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	46
서한석	남	1968.02	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEA 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
서행룡	남	1967.09	부사장	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
서형석	남	1968.02	부사장	상근	DS부문 DSC총괄	메모리 전략마케팅실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
성덕용	남	1973.09	부사장	상근	제조&기술담당 설비기술연구소 담당임원	DS부문 CTO 설비기술연구소 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	
성일경	남	1964.01	부사장	상근	구주총괄	영상디스플레이 영상전략마케팅팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
손성원	남	1969.02	부사장	상근	Mobile eXperience 지원팀장	북미총괄 지원팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
손영수	남	1974.02	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 Design Platform개발실장	포항공대(박사)	계열회사 임원	
손태용	남	1972.08	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Micro LED팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
송기환	남	1970.07	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	
송두근	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터장	글로벌 제조&인프라총괄 글로벌환경안전/인프라센터장	아주대(박사)	계열회사 임원	
송명주	여	1970.02	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	TSE-S법인장	서강대(석사)	계열회사 임원	
송명무	남	1973.08	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Intel, Yield Group Manager	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	
송승엽	남	1968.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 S.PKG제조기술센터장	제조&기술담당 AVP제조기술센터장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
송용호	남	1967.04	부사장	상근	메모리 Solution개발실장	메모리 Solution개발실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
송철섭	남	1967.12	부사장	상근	DS부문 DSC 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
송호건	남	1966.01	부사장	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	TSP총괄 Package개발실장	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
신경섭	남	1968.09	부사장	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터장	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
신명훈	남	1965.01	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
신승원	남	1974.09	부사장	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Texas A&M Univ.(박사)	계열회사 임원	45
신승철	남	1973.04	부사장	상근	DS부문 DSSEA총괄	Foundry Corporate Planning실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	

신승혁	남	1968.01	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research IP출원팀장	Polytechnic Univ. of NY(박사)	계열회사 임원	
신영주	남	1969.09	부사장	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
신유근	남	1965.02	부사장	상근	DS부문 CTO 담당임원	반도체연구소 차세대연구실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
신정규	남	1969.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS/인프라기술연구소장	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	Technical Univ. of Munich(박사)	계열회사 임원	13
신종신	남	1973.12	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
신현진	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience People팀장	영상디스플레이 People팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
심상필	남	1965.05	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실장	Foundry 전략마케팅실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
심재현	남	1972.01	부사장	상근	지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
안길준	남	1969.01	부사장	상근	Mobile eXperience 담당임원	무선 개발실 담당임원	George Mason Univ.(박사)	계열회사 임원	
안상호	남	1965.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터장	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
안수진	여	1969.12	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대연구실장	메모리 Flash개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
안유정	여	1974.08	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	Waymo, Head of Design	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	11
안재용	남	1968.08	부사장	상근	DS부문 감사팀 담당임원	DS부문 상생협력센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
안정척	남	1970.12	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
양병덕	남	1971.03	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	
양세영	남	1975.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, Engineering Manager	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
양장규	남	1963.09	부사장	상근	제조&기술담당 설비기술연구소장	DS부문 CTO 설비기술연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
양준호	남	1971.02	부사장	상근	생활가전 디자인팀장	Mobile eXperience CX실 담당임원	세종대(학사)	계열회사 임원	
양혜순	여	1968.02	부사장	상근	생활가전 Global CS팀장	생활가전 상품전략팀장	Michigan State Univ.(박사)	계열회사 임원	
엄재훈	남	1966.06	부사장	상근	상생협력센터장	DS부문 DS대외협력팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
여명구	남	1970.10	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	조직문화개선T/F 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
여태정	남	1970.06	부사장	상근	전장사업팀 담당임원	전장사업팀 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	
여형민	남	1971.06	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성SDS, 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
오문록	남	1974.02	부사장	상근	혁신센터장	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
오재균	남	1972.02	부사장	상근	DS부문 지원팀장	System LSI 지원팀장	Univ. of Iowa(석사)	계열회사 임원	

오정석	남	1970.03	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	TSP총괄 지원팀장	清華大(석사)	계열회사 임원	
오종훈	남	1969.10	부사장	상근	System LSI 지원팀장	메모리 지원팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
오치오	남	1967.01	부사장	상근	한국총괄 B2B팀장	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	건국대(석사)	계열회사 임원	
오태영	남	1974.10	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
오화석	남	1972.02	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
왕봉	남	1962.06	부사장	상근	중국전략협력실 담당임원	SCIC 담당임원	北京郵電大(학사)	계열회사 임원	
우영돈	남	1974.01	부사장	상근	법무실 개인정보보호팀장	법무실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
원성근	남	1968.05	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 펌택사업장 담당임원	충북대(석사)	계열회사 임원	
원순재	남	1972.01	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	
원종현	남	1967.05	부사장	상근	감사팀장	영상디스플레이 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
위훈	남	1970.04	부사장	상근	생활가전 선행개발팀장	생활가전 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
유규태	남	1975.02	부사장	상근	의료기기사업부장	의료기기 전략마케팅팀장	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	22
유미영	여	1968.07	부사장	상근	생활가전 S/W개발팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	포항공대(석사)	계열회사 임원	
유병길	남	1970.09	부사장	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	
유창식	남	1969.12	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	한양대, 교수	서울대(박사)	계열회사 임원	47
육근성	남	1968.08	부사장	상근	한국총괄 지원팀장	한국총괄 지원팀 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	
윤석민	남	1971.02	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	30
윤세승	남	1965.12	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Qualcomm, Senior Director	연세대(학사)	계열회사 임원	29
윤영조	남	1975.02	부사장	상근	Global Public Affairs실 담당임원	IR팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	54
윤인수	남	1974.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
윤장현	남	1968.12	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
윤종덕	남	1969.04	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	
윤주환	남	1970.05	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
윤준오	남	1967.06	부사장	상근	전장사업팀장	기획팀 담당임원	건국대(학사)	계열회사 임원	
윤태양	남	1968.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄, CSO	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터장	고려대(석사)	계열회사 임원	

윤하룡	남	1971.12	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이경우	남	1969.04	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	
이계성	남	1967.11	부사장	상근	법무실 해외법무팀장	구주총괄 대외협력팀장	St. Louis Univ.(석사)	계열회사 임원	
이광렬	남	1969.02	부사장	상근	영상디스플레이 Global CS팀장	Global CS센터 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
이규열	남	1966.05	부사장	상근	TSP총괄	TSP총괄 TP센터장	항공대(학사)	계열회사 임원	
이근호	남	1970.02	부사장	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이금주	여	1971.09	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	중앙대(석사)	계열회사 임원	
이동근	남	1971.08	부사장	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	
이동기	남	1969.05	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	Univ. of California, San Diego(박사)	계열회사 임원	
이동우	남	1967.06	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	메모리 지원팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
이무형	남	1970.02	부사장	상근	생활가전 CX팀장	생활가전 개발팀장	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
이병국	남	1965.11	부사장	상근	Mobile eXperience Global제조센터장	SEVT법인장	부산대(학사)	계열회사 임원	
이병권	남	1972.05	부사장	상근	IR팀 담당임원	기획재정부, 부이사관	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	11
이상도	남	1969.03	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅실 담당임원	생활가전 전략마케팅실 담당임원	City Univ. of New York(석사)	계열회사 임원	
이상우	남	1972.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
이상원	남	1971.07	부사장	상근	서남아총괄 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
이상주	남	1970.09	부사장	상근	구주총괄 대외협력팀장	법무실 담당임원	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
이상훈	남	1973.04	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	Intel, Sr. Principal Engineer	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	26
이석원	남	1970.07	부사장	상근	제조&기술담당 설비기술연구소 담당임원	DS부문 CTO 설비기술연구소 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이석준	남	1965.07	부사장	상근	System LSI 담당임원	System LSI AP개발실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이승구	남	1969.08	부사장	상근	People팀 담당임원	SEG 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
이승엽	남	1968.08	부사장	상근	아프리카총괄	SEIN-S법인장	서울대(학사)	계열회사 임원	
이승재	남	1974.08	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이시영	남	1972.04	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of Sussex(석사)	계열회사 임원	
이양우	남	1972.02	부사장	상근	영상디스플레이 담당임원	KNOWCK, 공동대표	Univ. of Colorado, Boulder(석사)	계열회사 임원	43

이영수	남	1972.01	부사장	상근	생산기술연구소장	SEVT 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이영룡	남	1969.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	18
이영호	남	1967.07	부사장	상근	중국사업혁신팀장	무선 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	
이용익	남	1963.07	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성생명, 자원팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이우섭	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀장	무선 구매팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
이원준	남	1970.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	중동총괄 지원팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
이일환	남	1973.09	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mercedez-Benz, CDO of China	Art Center College Of Design(학사)	계열회사 임원	22
이재범	남	1970.10	부사장	상근	생활가전 기획팀장	영상디스플레이 기획팀장	홍익대(학사)	계열회사 임원	
이재열	남	1970.01	부사장	상근	System LSI LSI사업팀장	System LSI LSI개발실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이경삼	남	1967.06	부사장	상근	SESS법인장	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
이정원	남	1977.04	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	45
이정환	남	1971.05	부사장	상근	DS부문 법무실장	DS부문 법무지원팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	21
이제석	남	1969.01	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	12
이제현	남	1970.04	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이 경영지원실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
이종명	남	1970.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종민	남	1971.09	부사장	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터장	디바이스플랫폼센터 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	
이종열	남	1970.02	부사장	상근	System LSI SOC사업팀장	혁신센터장	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종호	남	1968.01	부사장	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
이주영	남	1966.07	부사장	상근	메모리 담당임원	메모리 DRAM개발실장	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
이주형	남	1972.08	부사장	상근	Samsung Research Global 시센터 담당임원	Samsung Research 시센터 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
이준현	남	1965.05	부사장	상근	Samsung Research Life Solution팀장	Samsung Research 차세대가전연구팀장	Univ. of Cincinnati(박사)	계열회사 임원	
이준화	남	1972.03	부사장	상근	Global EHS실장	생활가전 CX팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이준희	남	1969.03	부사장	상근	네트워크 전략마케팅팀장	네트워크 개발팀장	MIT(박사)	계열회사 임원	
이지별	남	1971.03	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	Meta, Creative Director	Parsons School of Design(학사)	계열회사 임원	26
이진엽	남	1970.02	부사장	상근	DS부문 감사팀장	메모리 Flash개발실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	

이창수	남	1971.07	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
이정용	남	1968.12	부사장	상근	SAVINA-S법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	
이충순	남	1967.09	부사장	상근	CIS총괄	영상디스플레이 영상전략마케팅실 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
이태관	남	1971.12	부사장	상근	법무실 담당임원	삼성물산, 법무팀 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
이학민	남	1972.04	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	네트워크 지원팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	
이한관	남	1971.09	부사장	상근	SRA 담당임원	TSP총괄 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	
이해창	남	1975.10	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	Google, Sensor Team Lead	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	48
이현	남	1969.02	부사장	상근	SEIN-S법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅실 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	
이현	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEF 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
이형우	남	1970.03	부사장	상근	복미총괄 담당임원	Global Public Affairs팀 담당임원	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	
임건	남	1970.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실장	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	55
임병일	남	1970.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성증권, 기업금융1본부장	Univ. of Chicago(석사)	계열회사 임원	34
임석환	남	1974.11	부사장	상근	DSRA-S.LSI 연구소장	System LSI 기반설계실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
임성택	남	1966.06	부사장	상근	한국총괄	중동총괄	연세대(학사)	계열회사 임원	
임성택	남	1970.10	부사장	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 C&M사업팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
임용식	남	1971.01	부사장	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장상익	남	1968.07	부사장	상근	영상디스플레이 구매팀장	영상디스플레이 구매팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
장성환	남	1971.07	부사장	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Interpublic Group, EVP	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	4
장세명	남	1968.01	부사장	상근	기획팀장	기획팀 담당임원	Case Western Reserve Univ.(박사)	계열회사 임원	22
장우승	남	1970.02	부사장	상근	Big Data센터장	무선 차세대플랫폼센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
장재훈	남	1969.07	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실장	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장호영	남	1968.01	부사장	상근	네트워크 구매팀장	네트워크 Global운영팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
장호진	남	1970.09	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
전경빈	남	1966.12	부사장	상근	Global CS센터장	로봇사업팀장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
전상록	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience 전략기획팀장	삼성글로벌리서치, 글로벌전략실 담당임원	Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	22

전신애	여	1973.08	부사장	상근	SAIT Material Research Center장	SAIT Material Research Center 담당Master	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	10
전필규	남	1968.11	부사장	상근	창의개발센터장	삼성경제연구소, 리더십팀장	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(석사)	계열회사 임원	10
정기봉	남	1970.01	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	46
정기태	남	1965.09	부사장	상근	Foundry 담당임원	Foundry CTO	서울대(박사)	계열회사 임원	
정상섭	남	1966.11	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터장	SAS법인장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정성택	남	1976.09	부사장	상근	미래사업기획단 담당임원	신사업T/F장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	26
정용준	남	1969.10	부사장	상근	Foundry 품질팀장	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
정윤	남	1967.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실장	SEA 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
정재연	여	1974.09	부사장	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
정재욱	남	1976.07	부사장	상근	Samsung Research Global 시센터 담당임원	Apple, Sr. Engineering Mgr	Univ. of Waterloo(박사)	계열회사 임원	23
정진국	남	1975.10	부사장	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	
정진민	남	1972.12	부사장	상근	Samsung Research S/W혁신센터장	Samsung Research Platform팀장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정혁준	남	1972.05	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	46
정현준	남	1964.06	부사장	상근	생활가전 Global제조팀장	영상디스플레이 Micro LED팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
정혜순	여	1975.12	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 수석	부산대(학사)	계열회사 임원	
정호진	남	1971.05	부사장	상근	한국총괄 MX팀장	한국총괄 CE영업팀장	Rutgers Univ.(석사)	계열회사 임원	
정훈	남	1969.01	부사장	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
조기열	남	1971.03	부사장	상근	법무실 법무팀장	삼성디스플레이, 법무실장	경찰대(학사)	계열회사 임원	10
조기재	남	1967.01	부사장	상근	메모리 지원팀장	DS부문 지원팀장	Babson College(석사)	계열회사 임원	
조명호	남	1969.05	부사장	상근	영상디스플레이 기획팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
조상연	남	1971.12	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	Univ. of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	
조상호	남	1965.02	부사장	상근	동남아총괄	구주총괄	경희대(학사)	계열회사 임원	
조성대	남	1969.06	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	RPI(박사)	계열회사 임원	
조성혁	남	1970.05	부사장	상근	중동총괄	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
조성훈	남	1970.11	부사장	상근	SEA 담당임원	경영혁신센터 담당임원	건국대(박사)	계열회사 임원	

조시정	남	1969.11	부사장	상근	People팀 담당임원	Mobile eXperience 인사팀장	경희대(학사)	계열회사 임원	
조영준	남	1971.05	부사장	상근	복미총괄 People팀장	네트워크 인사팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
조용	남	1972.08	부사장	상근	법무실 담당임원	삼성SDI, 법무팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	30
조인하	여	1974.02	부사장	상근	SEUK법인장	SENA법인장	서강대(석사)	계열회사 임원	
조필주	남	1971.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 지원팀장	종합기술원 기획지원팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
조학주	남	1969.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
조홍상	남	1966.06	부사장	상근	중남미총괄	SEF법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	
주영수	남	1965.08	부사장	상근	성균관대(파견)	삼성생명서비스, 고객지원실 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	57
주정훈	남	1970.10	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	인사팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
지현기	남	1968.01	부사장	상근	DS부문 상생협력센터장	메모리 기획팀장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
짐엘리엇	남	1970.11	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	미주총괄 VP	California Polytechnic State Univ.(석사)	계열회사 임원	
차경환	남	1972.04	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEAU법인장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
차병석	남	1968.11	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	삼성경제연구소, 연구조정실 담당임원	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(석사)	계열회사 임원	37
채원철	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience Digital Wallet팀장	Mobile eXperience CX실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
최경세	남	1969.04	부사장	상근	TSP총괄 Package개발실장	AVP사업팀 AVP개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최광보	남	1971.03	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	복미총괄 지원팀장	부산대(학사)	계열회사 임원	
최동준	남	1972.05	부사장	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
최성현	남	1970.05	부사장	상근	네트워크 선행개발팀장	Samsung Research 차세대통신연구센터장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	
최순	남	1970.10	부사장	상근	SIEL-S 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
최승범	남	1964.12	부사장	상근	디바이스플랫폼센터장	Samsung Research 기술전략팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
최승식	남	1966.01	부사장	상근	중국총괄	무선 전략마케팅실 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
최승은	여	1969.07	부사장	상근	Mobile eXperience 마케팅팀장	무선 GDC센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
최승훈	남	1970.10	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	삼성생명, 기획팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	22
최완우	남	1965.02	부사장	상근	DS부문 People팀장	메모리 인사팀장	서강대(학사)	계열회사 임원	
최용원	남	1968.05	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라실 비자동화T/F장	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비 개발실장	고려대(석사)	계열회사 임원	

최용훈	남	1969.07	부사장	상근	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
최원준	남	1970.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
최윤준	남	1967.09	부사장	상근	CSS사업팀장	LED사업팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
최익수	남	1967.05	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀장	SESA법인장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
최주호	남	1963.03	부사장	상근	베트남복합단지장	무선 인사팀장	아주대(석사)	계열회사 임원	
최진원	남	1966.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	
최진한	남	1973.05	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비 개발실 담당임원	Univ. of Arizona(박사수료)	계열회사 임원	23
최진혁	남	1967.02	부사장	상근	DSRA-Memory 연구소장	메모리 Solution개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최창규	남	1970.03	부사장	상근	SAIT AI Research Center장	종합기술원 AI&SW연구센터장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
파트릭쇼메	남	1964.05	부사장	상근	Mobile eXperience CX실장	무선 서비스사업실 담당임원	Institut d administration des entreprises(석사)	계열회사 임원	
편정우	남	1970.10	부사장	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
피재걸	남	1964.04	부사장	상근	System LSI 전략마케팅실장	System LSI 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
한상숙	여	1966.07	부사장	상근	Mobile eXperience 서비스Biz팀장	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
한진만	남	1966.10	부사장	상근	DS부문 DSA총괄	메모리 전략마케팅실장	서울대(학사)	계열회사 임원	
허길영	남	1965.08	부사장	상근	DS부문 재경팀장	DS부문 재경팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
허석	남	1973.10	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 기획팀장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
허성희	남	1969.01	부사장	상근	메모리 Flash개발실장	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
현상진	남	1972.02	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대 공정개발실장	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
홍경선	남	1970.08	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
홍기채	남	1969.06	부사장	상근	법무실 담당임원	법무법인 다전, 변호사	한양대(학사)	계열회사 임원	39
홍범석	남	1968.06	부사장	상근	한국총괄 B2B통합오피링센터장	아프리카총괄	중앙대(학사)	계열회사 임원	
홍석준	남	1970.07	부사장	상근	CSS사업팀 담당임원	DS부문 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	16
홍성민	남	1969.06	부사장	상근	Foundry People팀장	글로벌인프라총괄 인사팀장	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	
홍성희	남	1966.02	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	
홍승환	남	1971.06	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	

홍영기	남	1970.03	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	
홍유진	여	1972.05	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당임원	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	
황경순	남	1968.08	부사장	상근	SAIT Air Science Research Center장	UT Austin, 교수	Caltech(박사)	계열회사 임원	16
황기현	남	1967.06	부사장	상근	제조&기술담당 Common Tech센터장	제조담당 제조시너지팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
황상준	남	1972.01	부사장	상근	메모리 DRAM개발실장	메모리 전략마케팅실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
황완구	남	1972.02	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	삼성바이오로직스 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	34
황인철	남	1977.11	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
황태환	남	1968.04	부사장	상근	한국총괄 CET팀장	한국총괄 CE영업팀장	경희대(학사)	계열회사 임원	
황하섭	남	1964.03	부사장	상근	제조&기술담당 평택단지장	제조&기술담당 메모리제조기술센터장	인하대(학사)	계열회사 임원	
황희돈	남	1974.01	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	57
강건혁	남	1978.11	상무	상근	System LSI Design Platform개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	37
강도희	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 품질혁신센터 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	
강동우	남	1971.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 S.PKG제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 AVP제조기술센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	57
강명진	남	1977.02	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	22
강민석	남	1976.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 CX실 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	34
강병욱	남	1967.02	상무	상근	한국총괄 CET팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	57
강보경	여	1976.12	상무	상근	System LSI Design Platform개발실 담당임원	System LSI Design Platform개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	22
강상홍	남	1972.09	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	전장사업팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
강성욱	남	1971.05	상무	상근	지원팀 담당임원	SEUK 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	57
강신광	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	42
강연호	남	1979.11	상무	상근	재경팀 담당임원	관세청, 부이사관	Univ. of York(석사)	계열회사 임원	15
강윤경	여	1968.12	상무	상근	People팀 담당임원	Samsung Research 창의개발센터 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
강은경	여	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	34
강정대	남	1970.09	상무	상근	재경팀 담당임원	상생협력센터 담당부장	한국방송통신대(학사)	계열회사 임원	
강진선	남	1975.09	상무	상근	한국총괄 CET팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	34

강태형	남	1976.05	상무	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	Dell, Director	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	14
강혁	남	1984.10	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	22
강희성	남	1970.08	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술훈터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
고경민	남	1975.03	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
고광현	남	1968.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Intel, Senior Technical Staff	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
고상원	남	1979.11	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	Flex, Sr. Director	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	22
고승범	남	1971.07	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 Design Platform개발실 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	
고알시드	남	1977.12	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Accenture, Mng. Director	Univ. of Sydney(석사)	계열회사 임원	50
고영관	남	1972.06	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	삼성전기 중앙연구소 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
고의종	남	1972.02	상무	상근	Compliance팀 담당임원	법무실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	34
고정욱	남	1976.02	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	57
고주현	남	1974.08	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46
고택균	남	1971.05	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	46
고현목	남	1980.02	상무	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research Global AI센터 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	10
고형석	남	1972.09	상무	상근	People팀 담당임원	SEA 담당임원	Case Western Reserve Univ.(석사)	계열회사 임원	
공병진	남	1971.09	상무	상근	SEM-P법인장	SIEL-P(C)공장장	항공대(학사)	계열회사 임원	46
곽원근	남	1973.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	10
구관본	남	1975.01	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	39
구봉진	여	1971.05	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46
구윤본	남	1970.02	상무	상근	제조&기술담당 담당임원	메모리 제조기술훈터 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
구지천	남	1981.04	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	System LSI 기획팀장	Northwestern Univ.(박사)	계열회사 임원	
권기덕	남	1972.07	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술훈터 담당임원	SCS 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	
권기덕	남	1977.10	상무	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 수석변호사	서울대(학사)	계열회사 임원	46
권기덕	여	1974.10	상무	상근	기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	46
권기록	남	1974.07	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	성균관대(박사)	계열회사 임원	11

권기성	남	1975.01	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실실 수석	인하대(학사)	계열회사 임원	11
권상록	남	1968.08	상무	상근	Samsung Research Life Solution팀 담당임원	Samsung Research 차세대가전연구팀 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
권수범	남	1976.09	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	연세대(석사)	계열회사 임원	57
권영재	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	46
권영훈	남	1972.02	상무	상근	SEA 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	39
권오경	남	1977.08	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46
권육	남	1978.07	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Lazada, CMO	서울대(석사)	계열회사 임원	28
권정현	남	1980.03	상무	상근	Samsung Research Robot센터 담당임원	NVIDIA, Senior S/W Engineering Manager	서울대(박사)	계열회사 임원	20
권춘기	남	1969.04	상무	상근	SEHC법인장	생활가전 Global제조팀 담당임원	포항공대(학사)	계열회사 임원	46
권태훈	남	1971.02	상무	상근	SEA 담당임원	경영혁신센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	46
권혁만	남	1973.06	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	57
권혁우	남	1973.07	상무	상근	DX부문 Global Public Affair실 담당임원	산업통상자원부 과장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	27
권형석	남	1973.02	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
권호범	남	1975.12	상무	상근	Samsung Research Platform팀장	Samsung Research Platform팀 담당임원	New York Univ., Tandon School of Engineering(석사)	계열회사 임원	46
김강수	남	1966.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라QA팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김건우	남	1976.01	상무	상근	SESK 담당임원	SEH-P 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	34
김경륜	남	1983.02	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	34
김경준	남	1969.01	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
김경태	남	1973.12	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	46
김경태	남	1973.07	상무	상근	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 IMC팀 담당부장	성균관대(학사)	계열회사 임원	22
김경택	남	1975.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience CX실 수석	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	10
김광익	남	1974.09	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업팀 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	34
김광훈	남	1975.02	상무	상근	SEDA-P(C)공장장	Mobile eXperience Global제조센터 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	22
김구영	남	1975.03	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	34
김기수	남	1970.02	상무	상근	제조&기술담당 펌웨어팀 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	

김기수	남	1976.05	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술 센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	22
김기연	남	1972.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	22
김기환	남	1975.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	NVIDIA, Principal Research Scientist	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	54
김대신	남	1970.03	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
김대우	남	1970.03	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.08	상무	상근	SME법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당부장	경북대(학사)	계열회사 임원	22
김덕현	남	1975.06	상무	상근	상생협력센터 담당임원	메타블라이트, Co-Founder	고려대(학사)	계열회사 임원	56
김덕호	남	1970.11	상무	상근	생활가전 S/W개발팀 담당임원	SRI-Delhi연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	57
김도기	남	1975.05	상무	상근	DS부문 CTO People팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 People팀장	송실대(학사)	계열회사 임원	22
김동근	남	1976.07	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	34
김동수	남	1975.10	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 인사팀 담당부장	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	34
김동준	남	1973.05	상무	상근	제조&기술담당 담당임원	TSLED법인장	광주과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김래훈	남	1975.07	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	42
김릉	남	1971.12	상무	상근	생활가전 People팀장	People팀 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	46
김명오	남	1972.09	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	46
김무성	남	1975.12	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	34
김문수	남	1977.12	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	SRI-Delhi연구소장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	46
김민우	남	1978.06	상무	상근	TSE-S 담당임원	SESP법인장	한양대(학사)	계열회사 임원	46
김병준	남	1977.03	상무	상근	동남아총괄 지원팀장	사업지원T/F 담당부장	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	10
김병진	남	1975.02	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEAU 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
김병승	남	1976.11	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	메모리 품질실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	11
김보성	남	1974.04	상무	상근	Samsung Research 담당임원	Awair, CDO	Royal Collge of Art(석사)	계열회사 임원	31
김보창	남	1977.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	22
김봉수	남	1971.06	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	46
김상윤	남	1972.01	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SECE법인장	인하대(학사)	계열회사 임원	46

김상현	남	1978.10	상무	상근	SEI 담당임원	SEB법인장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	10
김석영	남	1973.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	11
김석희	남	1971.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	부산대(석사)	계열회사 임원	46
김선기	남	1973.11	상무	상근	혁신센터 담당임원	웹마트랩, Pr.Data Scientist	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	7
김선길	남	1974.11	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 Global CS팀 담당부장	전남대(학사)	계열회사 임원	22
김선정	남	1973.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	National Univ. of Singapore(박사)	계열회사 임원	34
김성권	남	1971.02	상무	상근	디자인경영센터 담당임원	디자인경영센터 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	
김성민	남	1976.03	상무	상근	네트워크 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	34
김성은	남	1968.11	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 기술전략팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	
김세진	여	1973.07	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당부장	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	22
김세훈	남	1975.01	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	중앙대(학사)	계열회사 임원	22
김수연	여	1977.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	Univ. of York(석사)	계열회사 임원	10
김수형	남	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
김수홍	남	1972.11	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
김승연	여	1975.04	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	57
김승일	남	1970.07	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	단국대(학사)	계열회사 임원	
김시우	남	1972.10	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	단국대(석사)	계열회사 임원	46
김신	남	1971.12	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
김연정	남	1975.12	상무	상근	SEV 담당임원	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김영대	남	1968.10	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 제품기술팀장	동국대(석사)	계열회사 임원	
김영무	남	1976.09	상무	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	34
김영아	여	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Adidas, VP	이화여대(학사)	계열회사 임원	2
김영우	남	1972.12	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	삼성글로벌리서치, 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	16
김영일	남	1974.12	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	DS부문 미주총괄 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	22
김영철	남	1972.03	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	34

김영주	남	1973.07	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	34
김영집	남	1979.05	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	22
김용관	남	1976.04	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	Apple, Manager	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	56
김용상	남	1972.08	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	46
김용성	남	1973.09	상무	상근	SAIT Device Research Center장	종합기술원 Material연구센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	57
김용완	남	1970.04	상무	상근	TSP총괄 Global운영팀장	메모리 Global운영팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	57
김용찬	남	1969.03	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
김용한	남	1976.02	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	34
김용훈	남	1972.11	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	46
김우년	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Qualcomm, Principal Engineer	포항공대(박사)	계열회사 임원	
김원국	남	1975.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	경북대(석사)	계열회사 임원	34
김원우	남	1970.03	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEDA-S 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	57
김원희	남	1971.04	상무	상근	SEAU법인장	SEAU 담당임원	Mcgill Univ.(석사)	계열회사 임원	
김유나	여	1979.01	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	SRPOL연구소장	포항공대(박사)	계열회사 임원	34
김유승	남	1978.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	Intuitive, Staff Engineer	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	9
김윤재	남	1973.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	46
김윤희	남	1974.11	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	8
김은경	여	1974.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	단국대(학사)	계열회사 임원	
김은용	남	1979.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	22
김은하	여	1971.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	46
김이태	남	1971.01	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	
김인범	남	1973.05	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	22
김인철	남	1973.12	상무	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	DX부문 경영지원실 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	11
김인형	남	1973.12	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김재관	남	1976.01	상무	상근	SRA 담당임원	지원팀 담당부장	경북대(학사)	계열회사 임원	10

김재성	남	1972.04	상무	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	57
김재윤	남	1970.07	상무	상근	전장사업팀 담당임원	경영혁신센터 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
김재진	남	1969.11	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	46
김재홍	남	1973.03	상무	상근	지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	46
김재환	남	1969.07	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석변호사	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	22
김재훈	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Facebook, S/W Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	36
김정봉	남	1965.07	상무	상근	육상연맹(파견)	SSC 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
김정수	남	1983.09	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	Qualcomm, Principal	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	9
김정현	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	DL E&C, 전무	경희대(석사)	계열회사 임원	23
김정호	남	1972.01	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	기획팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
김종균	남	1966.08	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	정보전략팀 담당부장	경상대(학사)	계열회사 임원	
김종민	남	1968.03	상무	상근	SSC 담당임원	전장사업팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
김종현	남	1972.12	상무	상근	중동총괄 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당부장	세종대(학사)	계열회사 임원	10
김종현	남	1975.11	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	10
김종훈	남	1969.12	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김종희	남	1974.01	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	NXP, Principal	포항공대(박사)	계열회사 임원	11
김주연	남	1974.12	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	22
김준석	남	1972.10	상무	상근	System LSI Project Management팀장	System LSI SOC개발실 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
김준성	남	1975.08	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	22
김준연	남	1973.11	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	삼성디스플레이, 디스플레이연구소 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	6
김준엽	남	1969.10	상무	상근	SERK법인장	SEHC 담당임원	경기대(학사)	계열회사 임원	
김지영	남	1970.04	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
김지용	남	1975.06	상무	상근	SEA 담당임원	SEA 담당부장	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	22
김지윤	여	1975.02	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	
김지훈	남	1971.08	상무	상근	한국총괄 B2B통합오퍼링센터 담당임원	한국총괄 B2B팀 담당임원	서강대(박사수료)	계열회사 임원	34

김진교	남	1973.05	상무	상근	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 담당부장	경찰대(학사)	계열회사 임원	34
김진기	남	1972.01	상무	상근	제조&기술담당 평택단지 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	인하대(학사)	계열회사 임원	34
김진성	남	1971.02	상무	상근	SEVT 담당임원	지원팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	57
김진주	남	1969.05	상무	상근	제조&기술담당 평택단지 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김진호	남	1977.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	22
김찬호	남	1975.06	상무	상근	SEIB 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	46
김창용	남	1973.04	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	SAIT People팀장	고려대(석사)	계열회사 임원	34
김창태	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	금오공대(학사)	계열회사 임원	
김철주	남	1976.07	상무	상근	SRUK연구소장	SRR연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	22
김태경	남	1971.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	Intel, Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	17
김태균	남	1976.02	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석	RPI(박사)	계열회사 임원	34
김태수	남	1985.03	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	Samsung Research Security팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	41
김태영	남	1976.03	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	Kanazawa Univ.(박사)	계열회사 임원	11
김태우	남	1971.05	상무	상근	메모리 기획팀장	메모리 기획팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김태정	남	1972.12	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	충북대(학사)	계열회사 임원	46
김태종	남	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1970.10	상무	상근	제조&기술담당 평택단지 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1973.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	감사팀 담당임원	단국대(학사)	계열회사 임원	46
김한조	남	1973.09	상무	상근	의료기기 지원팀장	SEA 담당부장	Univ. of California, Irvine(석사)	계열회사 임원	10
김향희	여	1972.07	상무	상근	SEROM법인장	SEH-S법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	34
김현	남	1968.07	상무	상근	People팀 담당임원	서남아총괄 대외협력팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
김현근	남	1973.07	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	34
김현기	남	1973.01	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석	광운대(학사)	계열회사 임원	22
김현덕	남	1981.06	상무	상근	혁신센터 담당임원	Meta, Software Engineer	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	21
김현석	남	1976.10	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	34

김현수	남	1970.09	상무	상근	SAIT 미래기술육성센터장	SR 기술전략팀 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
김현중	남	1977.11	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	46
김현중	남	1969.05	상무	상근	한국총괄 e-Commerce팀장	한국총괄 CE영업팀 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
김현철	남	1969.05	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 CIS TD팀 담당임원	반도체연구소 CIS TD팀 수석	Texas A&M Univ.(박사)	계열회사 임원	57
김형섭	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	중앙대(학사)	계열회사 임원	57
김형욱	남	1979.04	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	11
김형재	남	1970.12	상무	상근	SEM-S법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김형준	남	1972.05	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	송실대(석사)	계열회사 임원	34
김호균	남	1968.12	상무	상근	중남미총괄 대외협력팀장	Samsung Research 인사팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김홍민	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	SAIC(석사)	계열회사 임원	
김후성	남	1972.01	상무	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김훈식	남	1981.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, Engineering Manager	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	11
김희승	남	1970.09	상무	상근	System LSI People팀장	DS부문 People팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	57
김희열	남	1975.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	11
나원만	남	1975.06	상무	상근	SEM-P 담당임원	SEM-P 담당부장	영남대(학사)	계열회사 임원	10
나현수	남	1971.06	상무	상근	중국총괄 지원팀장	한국총괄 지원팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	57
남경인	남	1973.03	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SELS법인장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
남덕우	남	1974.11	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당부장	동국대(학사)	계열회사 임원	11
남정만	남	1967.06	상무	상근	SEHC 담당임원	생활가전 Global제조팀 담당임원	전남기계공고(고교)	계열회사 임원	
남태호	남	1969.03	상무	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	한국토지주택공사, 부장	경북대(박사수료)	계열회사 임원	15
노경래	남	1976.12	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEM-S 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
노경윤	남	1972.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	Intel, Director	MIT(박사)	계열회사 임원	37
노미정	여	1971.04	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	57
노수혁	남	1970.04	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	46
노승남	남	1973.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	46

노대현	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
다니엘아 라우조	남	1981.08	상무	상근	Mobile eXperience 전략기획팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	Univ. Of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	22
드미트리	남	1972.07	상무	상근	SERC 담당임원	SERC VP	Moscow Institute of Physics and Technology(석사)	계열회사 임원	46
라병주	남	1972.05	상무	상근	전장사업팀 담당임원	전장사업팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	46
류일곤	남	1968.07	상무	상근	SEVT 담당임원	인사팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
류효경	남	1980.10	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Broadcom, Principal Engineer	Univ. of Michigan(박사)	계열회사 임원	47
마피유	남	1981.10	상무	상근	기획팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	MIT(석사)	계열회사 임원	57
영관주	남	1972.10	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	57
영승일	남	1976.11	상무	상근	지원팀 담당임원	북미총괄 지원팀 담당부장	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	10
모한	남	1973.07	상무	상근	SRI-Bangalore 담당임원	SRI-Bangalore VP	Acharya Nagarjuna Univ.(학사)	계열회사 임원	57
복진호	남	1968.09	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
문석진	남	1974.06	상무	상근	Foundry 지원팀 담당임원	DS부문 지원팀 담당부장	계명대(학사)	계열회사 임원	11
문준기	남	1975.02	상무	상근	SEA 담당임원	SEA 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	10
문진욱	남	1971.12	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	57
문태호	남	1974.11	상무	상근	TSP총괄 품질팀장	AVP사업팀 품질팀장	동아대(학사)	계열회사 임원	11
민병기	남	1963.02	상무	상근	상생협력센터 담당임원	에스원, 커뮤니케이션팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	34
민재호	남	1976.09	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	34
민현진	남	1974.06	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	22
박동욱	남	1974.01	상무	상근	System LSI 기획팀장	DS부문 기획팀 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	46
박두건	남	1981.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	23
박래순	남	1969.05	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	삼성전기, 인사지원그룹장	Peking Univ.(석사)	계열회사 임원	26
박민규	남	1976.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	46
박민철	남	1972.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
박병수	남	1972.12	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B팀 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	22
박홍일	남	1972.02	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI Custom SOC사업팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46

박봉태	남	1974.10	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	SCS 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	57
박상교	남	1972.03	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박상도	남	1973.12	상무	상근	People팀 담당임원	북미총괄 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	57
박상영	남	1976.01	상무	상근	Mobile eXperience People팀 담당임원	Samsung Research People팀 담당부장	아주대(석사)	계열회사 임원	10
박상욱	남	1978.05	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대 공정개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	11
박상훈	남	1978.02	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	34
박상훈	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	법무실 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	
박석민	남	1970.12	상무	상근	생활가전 Global운영팀 담당임원	경영혁신센터 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
박성범	남	1984.10	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	34
박성우	남	1976.04	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	중앙일보, 법조팀장	Univ. Of Chicago(석사)	계열회사 임원	10
박성철	남	1972.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	22
박영민	남	1975.12	상무	상근	SCIC 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	10
박은중	남	1976.05	상무	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당부장	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	10
박장용	남	1979.01	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	서울대(학사)	계열회사 임원	46
박재범	남	1977.08	상무	상근	메모리 People팀장	DS부문 People팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	34
박재성	남	1971.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
박재식	남	1976.08	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	22
박재현	남	1970.07	상무	상근	글로벌마케팅실 담당임원	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	46
박정대	남	1976.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 분석기술팀장	포항공대(박사)	계열회사 임원	
박정미	여	1968.07	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
박정재	남	1974.01	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	57
박정호	남	1974.11	상무	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	57
박제영	남	1969.09	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
박제임스	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당부장	California Polytechnic State Univ.(학사)	계열회사 임원	
박종만	남	1971.11	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	34

박종민	남	1968.08	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	Western Digital, Director	한국과학기술원(학사)	계열회사 임원	9
박종우	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	서울시립대(학사)	계열회사 임원	34
박준수	남	1967.08	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	25
박준영	남	1974.10	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Univ. of Paris 11(석사)	계열회사 임원	46
박준홍	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
박진표	남	1972.11	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	System LSI AP개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
박찬형	남	1973.06	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당부장	City Univ. of New York(석사)	계열회사 임원	22
박창서	남	1980.06	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	43
박창진	남	1967.01	상무	상근	네트워크 Global CS팀장	네트워크 개발팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
박철민	남	1971.01	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	56
박철범	남	1966.03	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
박철웅	남	1973.01	상무	상근	Mobile eXperience 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	34
박충신	남	1973.09	상무	상근	People팀 담당임원	의료기기 People팀장	경북대(석사)	계열회사 임원	46
박태호	남	1969.03	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SEAG법인장	Univ. of Pittsburgh(석사)	계열회사 임원	
박태훈	남	1974.11	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	34
박현근	남	1973.01	상무	상근	Foundry 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	57
박현준	남	1978.01	상무	상근	구주총괄 People팀장	사업지원T/F 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	22
박형민	남	1977.03	상무	상근	SEA 담당임원	SEAD법인장	서울대(학사)	계열회사 임원	46
박형신	여	1977.02	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience CX실 수석	제주대(학사)	계열회사 임원	10
박효우	남	1971.03	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	34
박환홍	남	1973.10	상무	상근	지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	10
박훈철	남	1974.05	상무	상근	SEHC 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	34
반수형	남	1972.06	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	22
반일승	남	1974.11	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	SEJ 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	57
방지훈	남	1973.11	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(석사)	계열회사 임원	

배병희	남	1985.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	생산기술연구소 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	22
배상기	남	1974.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	SAS 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	57
배승준	남	1976.03	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
배윤수	남	1974.12	상무	상근	재경팀 담당임원	기획팀 담당부장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	10
배희선	여	1974.02	상무	상근	SCIC 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	46
백기열	남	1967.07	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	삼성SDS, 품질팀장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	22
백아론	남	1979.10	상무	상근	Samsung Research Life Solution팀 담당임원	Samsung Research 차세대가전연구팀 담당임원	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	34
백피터	남	1971.06	상무	상근	DS부문 IP팀 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Univ. of Minnesota, Minneapolis(석사)	계열회사 임원	57
백혜성	여	1980.02	상무	상근	생활가전 Air Solution Business팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	10
변준호	남	1972.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Southern Illinois Univ.(박사)	계열회사 임원	
부민혁	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience사업부 CX실 담당임원	생활가전 디자인팀장	제주대(학사)	계열회사 임원	
서경현	남	1970.05	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	34
서상권	남	1979.06	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	Apple, Engineer/Manager	Univ. of Michigan(박사)	계열회사 임원	23
서성기	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	건국대(학사)	계열회사 임원	57
서영진	남	1969.05	상무	상근	Global EHS실 담당임원	Global CS센터 담당임원	Insa De Lyon(박사)	계열회사 임원	
서정아	여	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 온라인Biz센터 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
서정혁	남	1972.07	상무	상근	Samsung Research People팀장	네트워크 인사팀장	건국대(학사)	계열회사 임원	34
서정현	남	1974.04	상무	상근	SCS 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	57
서창우	남	1974.06	상무	상근	SEF 담당임원	SEBN 담당부장	Manchester(석사)	계열회사 임원	22
서치영	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	31
서현석	남	1974.06	상무	상근	감사팀 담당임원	감사팀 담당부장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	10
서현정	여	1978.02	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	ERM 코리아, 대표	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	35
선동석	남	1974.04	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46
선종우	남	1974.06	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	11
설지윤	남	1974.12	상무	상근	네트워크 상품전략팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	57

설훈	남	1970.03	상무	상근	SEG 담당임원	SEROM법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	
성낙희	남	1973.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
성백민	남	1971.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 수석	한양공고(고교)	계열회사 임원	34
소재민	남	1983.04	상무	상근	Samsung Research Life Solution팀 담당임원	생산기술연구소 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
손석제	남	1973.08	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	Nike, Director	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	5
손석준	남	1974.07	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	전남대(석사)	계열회사 임원	46
손성민	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	SEV 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	34
손영아	여	1973.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SELA 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	22
손영웅	남	1970.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	57
손용익	남	1984.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	10
손용우	남	1968.09	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	SEDA-P(M) 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
손용훈	남	1973.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	34
손준호	남	1976.08	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	22
손한구	남	1969.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	
손현석	남	1976.03	상무	상근	SEH-P법인장	SEH-P 담당부장	홍익대(학사)	계열회사 임원	22
손호민	남	1969.02	상무	상근	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	57
손호성	남	1968.04	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
송기재	남	1970.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	광운대(박사)	계열회사 임원	46
송명숙	여	1972.11	상무	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
송문경	여	1977.08	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당부장	한동대(학사)	계열회사 임원	10
송방영	남	1974.10	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
송보영	여	1976.10	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	22
송상철	남	1973.09	상무	상근	Mobile eXperience 서비스Biz팀 담당임원	Verizon Media, Chief Architect	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	43
송영근	남	1970.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 AVP제조기술센터 담당임원	건국대(학사)	계열회사 임원	21
송우창	남	1968.01	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	

송원철	남	1976.01	상무	상근	SAMEX 담당임원	자원팀 담당부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	22
송유중	남	1971.10	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대 연구실 담당임원	반도체연구소 차세대TD팀장	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	
송인강	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 기술전략팀 담당부장	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	
송정우	남	1977.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	State Univ. of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	22
송태중	남	1971.04	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
송택상	남	1978.03	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	Rambus, Technical Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	8
송호영	남	1972.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	57
셰인희비	남	1972.05	상무	상근	SEA 담당임원	SEA VP	Fairleigh Dickinson Univ.(석사)	계열회사 임원	
신규범	남	1972.06	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 Global CS팀 담당부장	부산대(학사)	계열회사 임원	46
신대중	남	1971.11	상무	상근	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	SEDA-P(C)공장장	경북대(학사)	계열회사 임원	57
신문선	남	1975.04	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국해양대(학사)	계열회사 임원	22
신민호	남	1970.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	46
신병무	남	1970.08	상무	상근	SEEG-S법인장	SEGR법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	10
신상용	남	1973.05	상무	상근	제조&기술담당 평택단지 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술훈센터 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	22
신승주	남	1972.04	상무	상근	SEASA법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	57
신용우	남	1974.12	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	34
신원화	남	1976.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	성균관대(박사)	계열회사 임원	22
신의창	남	1971.05	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	19
신인철	남	1974.06	상무	상근	TSP총괄 People팀장	DS부문 인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	46
신현석	남	1969.05	상무	상근	신사업T/F 담당임원	Samsung Research Intelligent Machine센터장	서강대(석사)	계열회사 임원	
심승환	남	1974.04	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Apple, Sr. Development Manager	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	16
심우철	남	1982.06	상무	상근	SRPOL연구소장	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
심재혁	남	1978.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술훈센터 담당임원	Dupont Korea, 상무	서강대(학사)	계열회사 임원	24
심호준	남	1977.12	상무	상근	DS부문 상품기획실 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	57
심황윤	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	34

아라이	남	1968.08	상무	상근	DS부문 DSJ총괄	DS부문 일본총괄 VP	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	46
안대현	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 CET팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	46
안성준	남	1975.01	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	System LSI S/W Engineering팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
안승환	남	1970.10	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SEA 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
안신현	남	1972.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 수석	한양대(학사)	계열회사 임원	34
안영모	남	1973.10	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	경북대(학사)	계열회사 임원	10
안용석	남	1974.11	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 DRAM TD실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	22
안재용	남	1977.02	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	감사팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	22
안주원	여	1977.03	상무	상근	생활가전 기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	서강대(학사)	계열회사 임원	22
안준	남	1978.02	상무	상근	네트워크 선형개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	36
안진우	남	1969.11	상무	상근	Compliance팀 담당임원	법무실 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	
안치용	남	1975.12	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 수석	성균관대(학사)	계열회사 임원	22
안희영	여	1976.12	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	22
양시준	남	1974.01	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	46
양익준	남	1969.11	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	아프리카총괄 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
양종훈	남	1974.05	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	22
양준철	남	1972.06	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	57
양진기	남	1971.05	상무	상근	SRA 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
양택진	남	1971.08	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	Samsung Research 기술전략팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	
양희철	남	1975.07	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 UX혁신팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	57
연지현	여	1974.10	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	System LSI 전략마케팅실 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	34
염강수	남	1972.08	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	46
염부호	남	1972.04	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Mobile eXperience 온라인Biz센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	34
염종범	남	1977.06	상무	상근	Mobile eXperience People팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	22
오름	여	1977.02	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	34

오상진	남	1977.11	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	34
오석민	여	1974.07	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	디자인경영센터 담당임원	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	57
오승훈	남	1968.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	SRI-Noida연구소장	Aachen Univ. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
오영기	남	1973.01	상무	상근	인재개발원 담당임원	인재개발원 담당부장	충남대(학사)	계열회사 임원	22
오용찬	남	1972.10	상무	상근	SIEL-S 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	홍익대(학사)	계열회사 임원	22
오정환	남	1973.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	22
오준영	남	1969.02	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	
오정호	남	1971.03	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	SEV 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	46
오혁상	남	1969.06	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	부산대(석사)	계열회사 임원	57
오형석	남	1970.09	상무	상근	TSP총괄 구매팀장	TSP총괄 구매팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
올라프	남	1971.01	상무	상근	SEG 담당임원	SEG VP	Johannes Gutenberg Univ.(석사)	계열회사 임원	34
왕지연	여	1977.09	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Mobile eXperience CX실 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	22
우람찬	남	1978.01	상무	상근	System LSI 기획팀 담당임원	LG전자, 상무	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	5
우준명	남	1980.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	11
우현수	남	1973.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 수석	연세대(학사)	계열회사 임원	11
우형동	남	1970.09	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
원석준	남	1970.02	상무	상근	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	57
원찬식	남	1975.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 수석	서강대(박사)	계열회사 임원	34
유미경	여	1974.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	37
유상민	남	1973.09	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Univ. of Washington(박사)	계열회사 임원	46
유성중	남	1976.03	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	22
유성호	남	1973.02	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	System LSI 지원팀 담당임원	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	34
유송	남	1975.05	상무	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	34
유종민	남	1974.04	상무	상근	People팀 담당임원	SSC 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	57
유한중	남	1973.10	상무	상근	재경팀 담당임원	SEF 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	46

유화열	남	1971.11	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	인하대(석사)	계열회사 임원	57
윤가람	여	1983.08	상무	상근	Samsung Research Visual Technology팀 담당임원	Meta, Manager	Univ. of Arizona(박사)	계열회사 임원	28
윤기영	남	1974.11	상무	상근	SEBN법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	10
윤남호	남	1968.12	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
윤보영	여	1977.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	이화여대(석사)	계열회사 임원	34
윤상용	남	1976.07	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	11
윤석진	남	1968.11	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	44
윤석호	남	1972.07	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	글로벌인프라총괄 LED기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
윤석호	남	1973.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	한국기계연구원, 열에너지솔루션실장	서울대(박사)	계열회사 임원	21
윤성욱	남	1974.06	상무	상근	구주총괄 담당임원	인사팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	34
윤성현	남	1973.05	상무	상근	SIEL-P(C)공장장	SEMA법인장	부산대(학사)	계열회사 임원	10
윤성호	남	1974.01	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원	GE, Staff Engineer	Cambridge Univ.(박사)	계열회사 임원	21
윤성환	남	1972.04	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석	State Univ. of New York, Buffalo(석사)	계열회사 임원	22
윤송호	남	1974.10	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	34
윤승욱	남	1970.01	상무	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
윤여관	남	1972.02	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 책임변호사	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	46
윤원주	남	1978.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	11
윤인철	남	1971.03	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
윤재윤	남	1970.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당Master	고려대(석사)	계열회사 임원	8
윤찬현	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 구매팀 담당부장	영남대(학사)	계열회사 임원	
윤철중	남	1970.07	상무	상근	SELV법인장	SERC 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
윤희용	남	1969.12	상무	상근	SEM-S 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Drexel Univ.(석사)	계열회사 임원	57
은성민	남	1977.01	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	사업지원T/F 담당부장	Wake Forest Univ.(석사)	계열회사 임원	22
이강규	남	1972.09	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	46
이강승	남	1977.07	상무	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	System LSI Global운영팀장	포항공대(박사)	계열회사 임원	57

이강호	남	1977.10	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Global Foundries, Principal Member of Technical Staff	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	10
이경준	남	1976.06	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	46
이경호	남	1975.10	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	34
이계원	남	1968.05	상무	상근	한국총괄 SMB팀장	한국총괄 B2B팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이계훈	남	1980.02	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	34
이관수	남	1969.11	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	SAMEX 담당임원	영남대(학사)	계열회사 임원	
이광열	남	1974.11	상무	상근	아프리카총괄 지원팀장	사업지원T/F 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	34
이광재	남	1974.03	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	10
이귀호	여	1975.05	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당부장	이화여대(학사)	계열회사 임원	57
이규영	남	1968.10	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
이규원	남	1974.03	상무	상근	DS부문 DSJ 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	Waseda Univ.(석사)	계열회사 임원	57
이규철	남	1973.06	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생산기술연구소 수석	서울산업대(학사)	계열회사 임원	10
이근수	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	세종대(학사)	계열회사 임원	
이기욱	남	1970.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	
이기철	남	1972.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	57
이남호	남	1972.02	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	두산, 부문장	성균관대(박사)	계열회사 임원	45
이대성	남	1970.09	상무	상근	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	46
이동진	남	1971.01	상무	상근	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	46
이동하	남	1968.07	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	58
이동현	남	1972.09	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 수석변호사	고려대(학사)	계열회사 임원	
이두희	남	1973.11	상무	상근	SGE법인장	SEMAG법인장	단국대(석사)	계열회사 임원	22
이명재	남	1979.01	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	HEC Paris(석사)	계열회사 임원	10
이명준	남	1976.07	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차세대 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비 개발실 담당임원	Univ. of Arizona(박사)	계열회사 임원	11
이민	남	1978.03	상무	상근	혁신센터 담당임원	Microsoft, Principal Engineer	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	6
이민철	남	1970.04	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	무선 PC사업팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	

이병섭	남	1972.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	인하대(학사)	계열회사 임원	34
이병일	남	1983.07	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	22
이병진	남	1970.09	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 수석변호사	Univ. Of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	46
이병철	남	1972.11	상무	상근	의료기기 People팀장	Mobile eXperience People팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	34
이병한	남	1974.05	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. Of Wisconsin, Madison(학사)	계열회사 임원	22
이병현	남	1974.11	상무	상근	기획팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Manchester Business Sch.(석사)	계열회사 임원	34
이병현	남	1977.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	11
이보나	여	1973.02	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	생활가전 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	34
이보람	여	1973.09	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	World Bank, Senior Consultant	Univ. of Paris 6(박사)	계열회사 임원	5
이상수	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	무선 개발실 수석	아주대(석사)	계열회사 임원	46
이상엽	남	1967.11	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성물산, 상생협력팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	22
이상용	남	1970.02	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	GCT Semiconductor, Senior Director	서울대(박사)	계열회사 임원	
이상욱	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 품질혁신센터 담당임원	금오공대(학사)	계열회사 임원	
이상욱	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
이상직	남	1970.06	상무	상근	SELA법인장	SEM-S법인장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	
이상현	남	1970.09	상무	상근	DSRJ 담당임원	SCS 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
이상호	남	1973.01	상무	상근	SAMCOL법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	22
이상희	남	1974.09	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Mask개발팀장	반도체연구소 Mask개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	34
이석림	남	1974.03	상무	상근	SEAS법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	34
이선웅	남	1976.12	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEH-S법인장	서강대(학사)	계열회사 임원	10
이선화	여	1975.08	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	CX·MDE센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	34
이성원	남	1976.03	상무	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46
이성원	남	1978.10	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	Qualcomm, Sr. Staff Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	25
이성재	남	1974.12	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	IBM, Principal Manager	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	36
이성준	남	1981.10	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	AMD, Director	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(학사)	계열회사 임원	12

이성진	남	1979.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Amazon, Principal Scientist	포항공대(박사)	계열회사 임원	2
이성훈	남	1975.11	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	반도체연구소 Flash TD실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	22
이수용	남	1968.03	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당 Master	한양대(석사)	계열회사 임원	26
이승관	남	1973.10	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	연합뉴스, 기자	고려대(학사)	계열회사 임원	56
이승목	남	1973.09	상무	상근	SAIT People팀장	System LSI People팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
이승민	남	1981.03	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	Meta, Principal Designer	MIT(석사)	계열회사 임원	12
이승준	남	1974.04	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	22
이승철	남	1975.12	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46
이승철	남	1977.11	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	DS부문 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	15
이승호	남	1973.11	상무	상근	SEVT 담당임원	SEIN-P법인장	서울사이버대(학사)	계열회사 임원	46
이승환	남	1971.05	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	LED사업팀 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	34
이승환	남	1980.07	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀 담당임원	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	10
이승훈	남	1976.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	22
이신재	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	
이애영	여	1968.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼 센터 담당임원	포항공대(석사)	계열회사 임원	
이영아	여	1983.03	상무	상근	생활가전 UX팀장	영상디스플레이 UX팀 수석	Carnegie Mellon Univ.(학사)	계열회사 임원	10
이영직	남	1967.08	상무	상근	SEHA법인장	SEH-P법인장	아주대(학사)	계열회사 임원	
이영학	남	1974.09	상무	상근	혁신센터 담당임원	혁신센터 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	22
이우용	남	1975.10	상무	상근	SEDA-P(M) 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당부장	성균관대(학사)	계열회사 임원	22
이원용	남	1978.11	상무	상근	미래사업기획단 담당임원	SAIT 기획지원팀장	MIT(박사)	계열회사 임원	22
이윤경	여	1979.09	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Samsung Research AI센터 수석	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	46
이윤성	남	1971.09	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	46
이윤수	남	1975.11	상무	상근	Samsung Research Data Intelligence팀장	Samsung Research AI센터 수석	Univ. of Maryland(박사)	계열회사 임원	46
이의형	남	1975.09	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술 센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	22
이재영	남	1974.11	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	구주총괄 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	57

이재호	남	1974.08	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 담당부장	서강대(석사)	계열회사 임원	10
이재훈	남	1974.01	상무	상근	SERC 담당임원	SEUC법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	34
이정노	남	1971.02	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
이정숙	여	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 Mobile UX센터 담당임원	Berlin Art Univ.(석사)	계열회사 임원	
이정원	남	1971.07	상무	상근	네트워크 Global제조팀장	네트워크 Global운영팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	46
이정자	여	1969.04	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
이정주	남	1976.07	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	P&G, Sr. Director	고려대(학사)	계열회사 임원	15
이정호	남	1974.11	상무	상근	한국총괄 People팀장	한국총괄 인사팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	34
이종규	남	1970.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	
이종민	남	1973.06	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	57
이종석	남	1973.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, CPU Micro Architect	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	23
이종우	남	1978.04	상무	상근	System LSI Design Platform개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 수석	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	
이종포	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	57
이종필	남	1973.11	상무	상근	Systsem LSI SOC사업팀 담당임원	Systsem LSI SOC사업팀 AP개발실 담당임원	충남대(석사)	계열회사 임원	57
이종필	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(석사)	계열회사 임원	57
이종호	남	1976.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	57
이준	남	1972.04	상무	상근	중동총괄 지원팀장	SEF 담당임원	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	46
이준표	남	1971.06	상무	상근	생활가전 C&M사업팀장	생활가전 C&M사업팀 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	35
이중원	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	34
이지석	남	1978.04	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	LAM Research, Director	Stanford Univ.(박사수료)	계열회사 임원	14
이지수	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
이지영	여	1976.08	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 CX실 수석	제주대(학사)	계열회사 임원	34
이지훈	남	1970.11	상무	상근	SECA법인장	SEA 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	57
이지훈	남	1976.02	상무	상근	구주총괄 지원팀장	SEG 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	46
이진우	남	1979.01	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	34

이진욱	남	1972.01	상무	상근	DS부문 OS대외협력팀 담당임원	DS부문 상생협력센터 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	34
이진원	남	1973.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 Global CS팀 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	57
이창엽	남	1970.04	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	영남대(학사)	계열회사 임원	
이창원	남	1972.03	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	Pennsylvania State Univ.(석사)	계열회사 임원	34
이치훈	남	1969.08	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이태호	남	1974.05	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	원광대(석사)	계열회사 임원	10
이한용	남	1976.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	김앤장, Sr.Foreign Attorney	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	31
이한형	남	1968.09	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
이혁	남	1973.02	상무	상근	기획팀 담당임원	Bloom T/F 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	16
이현동	남	1972.02	상무	상근	SESAR법인장	SELV법인장	영남대(학사)	계열회사 임원	34
이현수	남	1980.12	상무	상근	영상디스플레이 CX팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	10
이현우	남	1974.10	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	46
이현정	여	1977.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	22
이현정	여	1971.11	상무	상근	SCIC 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	34
이호	남	1972.07	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46
이호신	남	1970.12	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
이홍빈	남	1964.04	상무	상근	SSEC법인장	생활가전 Global제조팀 담당임원	명지대(학사)	계열회사 임원	
이화성	남	1970.09	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이훈신	남	1974.09	상무	상근	Global EHS실 담당임원	Global EHS센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	33
이훈철	남	1976.03	상무	상근	네트워크 선형개발팀 담당임원	Ericsson, Sr.Researcher	고려대(박사)	계열회사 임원	1
이희윤	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 글로벌 EHS/인프라센터장	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	부산수산대(학사)	계열회사 임원	
임산	남	1973.03	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	메모리 기획팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	34
임성수	남	1978.11	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	57
임순규	남	1979.07	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이, 대형 지원팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	22
임아영	여	1974.09	상무	상근	네트워크 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	City Univ. of New York(석사)	계열회사 임원	46

임영수	남	1969.06	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	영남대(학사)	계열회사 임원	
임윤모	남	1977.10	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	10
임재우	남	1973.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Design Platform개발실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	46
임전식	남	1969.08	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	전북대(학사)	계열회사 임원	
임지훈	남	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	51
임휘용	남	1965.02	상무	상근	인재개발원 담당임원	네트워크 인사팀장	서강대(학사)	계열회사 임원	
장경모	남	1977.10	상무	상근	SEG 담당임원	구주총괄 지원팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	10
장경훈	남	1970.02	상무	상근	DX부문 CTO 담당임원	Samsung Research Robot센터 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
장세경	남	1974.04	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 품질실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	57
장소연	여	1971.06	상무	상근	한국총괄 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	이화여대(학사)	계열회사 임원	
장수복	여	1977.04	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	부산대(학사)	계열회사 임원	46
장실완	남	1973.02	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(학사)	계열회사 임원	
장용	남	1970.03	상무	상근	네트워크 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장우영	남	1973.02	상무	상근	의료기기 X-ray사업팀장	의료기기 DR사업팀장	서울대(박사수료)	계열회사 임원	46
장욱	남	1973.11	상무	상근	SEJ법인장	SEJ 담당임원	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	22
장윤희	남	1974.09	상무	상근	SIEL-P(N) 담당임원	Mobile eXperience Global제조센터 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	22
장인갑	남	1975.06	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	34
장정렬	남	1977.01	상무	상근	SIEL-S 담당임원	네트워크 개발팀 수석	중앙대(석사)	계열회사 임원	22
장준희	남	1974.01	상무	상근	SEUK 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	46
장지호	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	GCT, VP	서울대(박사)	계열회사 임원	50
장흥민	남	1972.06	상무	상근	Global CS센터 담당임원	동남아총괄 CS팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	22
저메인클라우제	남	1982.08	상무	상근	동남아총괄 지원팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	22
전대호	남	1971.01	상무	상근	제조&기술담당 People팀장	반도체연구소 인사팀장	아주대(석사)	계열회사 임원	46
전범준	남	1976.07	상무	상근	DS부문 CTO 기술기획팀 담당임원	Foundry 지원팀 담당임원	Southern Methodist Univ.(석사)	계열회사 임원	22
전병권	남	1967.02	상무	상근	SAMEX법인장	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	전북대(학사)	계열회사 임원	

전상욱	남	1980.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	22
전성훈	남	1977.01	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	34
전소영	여	1974.05	상무	상근	IR팀 담당임원	SEA 담당임원	Univ. of Texas, Dallas(석사)	계열회사 임원	46
전승수	남	1976.07	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	생활가전 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	46
전승훈	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
전영우	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	HP, Director	York Univ.(석사)	계열회사 임원	7
전지환	남	1977.10	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 전략마케팅실 수석	Univ. Of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	22
전진규	남	1974.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SENA 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	46
전진완	남	1974.03	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	46
전형민	남	1974.03	상무	상근	SEAU 담당임원	SENZ법인장	중앙대(학사)	계열회사 임원	10
전형준	남	1972.10	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 온라인Biz센터 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	25
전희정	여	1977.09	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	Arizona State Univ.(박사)	계열회사 임원	8
정강일	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 CX팀 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	34
정광민	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEPR법인장	부산대(학사)	계열회사 임원	34
정광섭	남	1970.04	상무	상근	재경팀 담당임원	삼성물산, 경영정보팀 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	34
정광희	남	1971.08	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	Tsinghua Univ.(석사)	계열회사 임원	
정기호	남	1973.08	상무	상근	생활가전 Air Solution Business팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한국해양대(학사)	계열회사 임원	34
정다운	남	1980.09	상무	상근	혁신센터 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	57
정덕우	남	1976.12	상무	상근	네트워크 선행개발팀 담당임원	Palo Alto Networks, Sr. Principal	Yale Univ.(박사)	계열회사 임원	7
정문일	남	1971.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	법무법인 지평, 전문위원	숭실대(학사)	계열회사 임원	36
정상일	남	1967.09	상무	상근	제조&기술담당 Sensor제조기술팀장	제조&기술담당 Sensor제조기술팀 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
정석희	남	1975.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	10
정성엽	남	1974.09	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	SBS, 정책사회부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	1
정성원	남	1971.12	상무	상근	SEWA법인장	SCA법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	34
정성원	남	1974.07	상무	상근	메모리 Global운영팀장	메모리 Global운영팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	34

정성훈	남	1976.01	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 수석	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	11
정세환	남	1973.10	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B팀 담당부장	한국해양대(학사)	계열회사 임원	10
정승목	남	1969.05	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	중국전략협력실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
정승일	남	1973.08	상무	상근	SELS법인장	경영혁신센터 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	22
정승진	남	1972.11	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	46
정신영	여	1973.03	상무	상근	Foundry 품질팀 담당임원	Foundry 제품기술실 수석	Univ. of Florida(석사)	계열회사 임원	34
정연일	남	1975.06	상무	상근	TSP총괄 기획팀장	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	22
정영환	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SCIC 담당임원	북단대(석사)	계열회사 임원	22
정용덕	남	1976.09	상무	상근	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46
정원석	남	1971.07	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	57
정원철	남	1973.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	57
정유진	여	1970.06	상무	상근	SENA법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
정유찬	남	1968.09	상무	상근	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
정의철	남	1969.12	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 제품기술실 담당임원	Seattle Pacific Univ.(학사)	계열회사 임원	57
정인호	남	1975.02	상무	상근	TSP총괄 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	57
정인호	남	1970.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	57
정인희	여	1974.09	상무	상근	지속가능경영추진센터 담당임원	LG화학, Expert Advisor	Imperial College(석사)	계열회사 임원	34
정일규	남	1968.05	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
정일홍	남	1970.10	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 재경팀 담당부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	34
정재용	남	1973.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	46
정주영	남	1977.07	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	카카오엔터프라이즈, 부사장	서강대(학사)	계열회사 임원	9
정준수	남	1970.09	상무	상근	SEEG-P법인장	SERK법인장	영남대(학사)	계열회사 임원	34
정지은	여	1974.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
정직한	남	1974.11	상무	상근	Mobile eXperience 서비스Biz팀 담당임원	Mythical Games, VP	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	12
정진희	여	1977.11	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당부장	전남대(학사)	계열회사 임원	10

정춘화	남	1974.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술센터 수석	고려대(학사)	계열회사 임원	11
정한기	남	1976.05	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	22
정혁준	남	1974.09	상무	상근	생활가전 광주지원센터장	생활가전 광주지원센터 담당부장	전남대(학사)	계열회사 임원	34
정홍욱	남	1977.10	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	Hitotsubashi Univ.(석사)	계열회사 임원	10
제이콥	남	1978.11	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	中國科學技術大學(석사)	계열회사 임원	57
제임스웨슬러	남	1972.10	상무	상근	SEA 담당임원	SEA SVP	Ward Melville High School(고교)	계열회사 임원	34
제희원	남	1978.09	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI CP개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	22
조강욱	남	1977.08	상무	상근	북미총괄 지원팀장	동남아총괄 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	22
조근수	남	1976.06	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	10
조근휘	남	1974.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	11
조나단림	남	1976.12	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Microsoft, Sales Director	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	13
조미선	여	1980.04	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	Ericsson, VP	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	21
조성일	남	1973.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
조성제	남	1977.04	상무	상근	People팀 담당임원	People팀 담당부장	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	22
조성훈	남	1976.01	상무	상근	People팀 담당임원	생활가전 People팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	57
조성희	남	1974.08	상무	상근	SRI-Delhi연구소장	영상디스플레이 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	22
조영상	남	1980.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Google, Sr.Staff S/W Engineer	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	1
조영석	남	1976.11	상무	상근	전장사업팀 담당임원	재경팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	22
조영진	남	1979.06	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	22
조용호	남	1970.03	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
조육래	남	1972.03	상무	상근	제조&기술담당 지원팀장	DS부문 재경팀 담당임원	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	46
조유미	여	1971.09	상무	상근	DS부문 글로벌마케팅팀장	메모리 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	46
조유성	남	1971.06	상무	상근	Global EHS실 담당임원	Global EHS센터 담당임원	서울과학기술대(석사)	계열회사 임원	46
조은경	여	1970.08	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	삼성카드, 신용관리담당	성균관대(석사)	계열회사 임원	10
조익현	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	46

조종욱	남	1969.08	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성바이오에피스, 인사팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	34
조지호	남	1972.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	부산대(학사)	계열회사 임원	34
조철민	남	1971.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	57
조철용	남	1975.08	상무	상근	영상디스플레이 디자인팀장	영상디스플레이 디자인팀 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	22
조철형	남	1971.03	상무	상근	SEDA-P(M)공장장	글로벌기술센터 담당임원	충북대(학사)	계열회사 임원	46
조철호	남	1971.07	상무	상근	SETK법인장	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
조현덕	남	1974.05	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당부장	경북대(석사)	계열회사 임원	22
조호근	남	1977.11	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. Of California, LA(석사)	계열회사 임원	22
조훈영	남	1973.08	상무	상근	Samsung Research Global 시센터 담당임원	NC Soft, Lab장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	32
조희권	남	1976.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	SEA 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46
존테일러	남	1968.04	상무	상근	SAS 담당임원	SAS VP	Univ. of New Hampshire(학사)	계열회사 임원	
주재완	남	1968.02	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
주현대	남	1972.12	상무	상근	TSE-P법인장	생활가전 Global제조팀 담당임원	울산대(학사)	계열회사 임원	34
주형빈	남	1973.06	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SESAR법인장	경희대(학사)	계열회사 임원	46
지송하	여	1973.01	상무	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	이화여대(학사)	계열회사 임원	
지혜령	여	1972.04	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
진영두	남	1972.06	상무	상근	생활가전 S/W개발팀 담당임원	Mobile eXperience사업부 개발실 수석	동아대(학사)	계열회사 임원	22
차도현	남	1973.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	57
차이위엔천	남	1968.01	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	TEXAS INSTRUMENTS, Selection Manager	NTUST(석사)	계열회사 임원	24
할리장	남	1973.10	상무	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	SRA SVP	Univ. of Wisconsin, Madison(박사)	계열회사 임원	10
채동혁	남	1973.10	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	세미브레인, 팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	17
천기철	남	1970.09	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	Univ. Of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	46
천상필	남	1969.05	상무	상근	서남아총괄 대외협력팀장	Global Public Affairs실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	57
천홍문	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 수석	단국대(학사)	계열회사 임원	10
최경수	남	1971.12	상무	상근	감사팀 담당임원	상생협력센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	46

최기화	남	1969.03	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀 담당임원	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	
최영진	남	1974.06	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	경영혁신센터 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	10
최민기	남	1977.10	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당부장	Univ. of Wisconsin, Madison(박사)	계열회사 임원	10
최병철	남	1971.06	상무	상근	영상디스플레이 Global운영팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	46
최병희	남	1970.05	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SETK법인장	경북대(학사)	계열회사 임원	46
최상종	남	1973.03	상무	상근	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	46
최상선	남	1975.03	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Big Data센터 수석	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	10
최서림	남	1972.02	상무	상근	DS부문 감사팀 담당임원	설비기술연구소 기획지원팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	34
최선일	남	1971.11	상무	상근	System LSI Design Platform개발실 담당임원	System LSI AP개발실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	34
최성욱	남	1969.02	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	삼성전자공과대학(전문대)	계열회사 임원	
최승림	남	1972.02	상무	상근	CIS총괄 지원팀장	재경팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	34
최연호	남	1975.03	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	10
최영	남	1969.07	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	
최영일	남	1973.08	상무	상근	SAS 담당임원	Foundry 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	46
최영준	남	1967.09	상무	상근	SEACE 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Minnesota, Twin Cities(석사)	계열회사 임원	50
최원경	여	1973.08	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	57
최원서	남	1977.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	10
최원호	남	1981.02	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	Western Digital, Sr. Technologist	Univ. Of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	9
최유라	여	1978.12	상무	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	삼성전기 혁신센터장	IMD(석사)	계열회사 임원	10
최유진	여	1979.06	상무	상근	영상디스플레이 UX팀장	영상디스플레이 UX팀 수석	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	34
최윤석	남	1974.09	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	TSP총괄 Package개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46
최윤성	남	1975.05	상무	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	Qualcomm, Sr. Staff Engineer	Univ. of Florida(박사)	계열회사 임원	5
최인수	남	1973.02	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	메모리 전략마케팅실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	22
최말환	남	1972.11	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Big Data센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	34
최장석	남	1973.06	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	메모리 전략마케팅실 수석	충남대(학사)	계열회사 임원	22

최재혁	남	1974.06	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	46
최정연	남	1974.11	상무	상근	메모리 Design Technology팀장	메모리 Design Platform개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
최정화	남	1973.01	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	22
최종근	남	1978.01	상무	상근	SAIT 기획지원팀장	사업지원T/F 담당부장	MIT(석사)	계열회사 임원	11
최종무	남	1975.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	아주대(석사)	계열회사 임원	46
최종민	남	1976.05	상무	상근	Mobile eXperience Digital Health팀 담당임원	Mobile eXperience Digital Health팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	10
최진필	남	1973.04	상무	상근	SCS 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	57
최정훈	남	1973.08	상무	상근	SIEL-S 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	34
최정훈	남	1972.02	상무	상근	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	생산기술연구소 설비개발실 담당임원	서울시립대(박사)	계열회사 임원	
최철민	남	1973.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
최철환	남	1974.04	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	22
최정호	남	1976.11	상무	상근	법무실 담당임원	광장, 변호사	경북대(학사)	계열회사 임원	21
최항석	남	1969.01	상무	상근	생활가전 Air Solution Business팀장	LG전자, 상무	성균관대(학사)	계열회사 임원	3
최혁승	남	1976.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	22
최현호	남	1979.06	상무	상근	SAIT Material Research Center 담당임원	종합기술원 Material연구센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	46
최호규	남	1968.12	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	CX·MDE센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46
최호석	남	1978.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Morgan Stanley, VP	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	8
최효석	남	1981.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	11
추민기	남	1975.10	상무	상근	SECE법인장	SEUZ법인장	서강대(학사)	계열회사 임원	22
추민수	남	1973.10	상무	상근	SEPCO법인장	SENZ법인장	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	34
카리아타카시	남	1969.02	상무	상근	DS부문 DSRJ 담당임원	TDK, 총괄부장	東北大(박사)	계열회사 임원	23
코너피어스	남	1970.04	상무	상근	SEPOL법인장	SEUK 담당임원	Univ. of Dublin(석사)	계열회사 임원	
하경수	남	1979.04	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
하현재	남	1970.08	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 People팀 담당부장	광운대(학사)	계열회사 임원	22
하현재	남	1984.02	상무	상근	Samsung Research SoC Architecture팀장	Meta, H/W System Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	8

한규희	남	1974.01	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	34
한글라라	여	1976.02	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	22
한상섭	남	1972.04	상무	상근	북미총괄 CS팀장	Global CS센터 담당임원	광운대(석사)	계열회사 임원	34
한상연	남	1969.01	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
한상욱	남	1974.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	22
한석근	남	1978.09	상무	상근	SESK법인장	SERK법인장	경기대(학사)	계열회사 임원	10
한의택	남	1974.02	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SIEL-S 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	57
한장수	남	1970.02	상무	상근	북미총괄 법무지원팀장	무선 지원팀 담당임원	State Univ. of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	
한정남	남	1973.01	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
한중호	남	1976.01	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	SEG 담당임원	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	46
한진규	남	1973.12	상무	상근	Samsung Research 기술표준연구팀장	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	57
한진우	남	1980.07	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	NASA, Senior Scientist	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	29
함선규	남	1970.01	상무	상근	중남미총괄 지원팀장	SRA 담당임원	Washington Univ. in St. Louis(석사)	계열회사 임원	
허욱	남	1972.05	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	Waseda Univ.(학사)	계열회사 임원	22
허일경	남	1978.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS/인프라기술연구소 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 EHS연구소 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	23
허정철	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	10
허준	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	SEA 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	22
허준영	남	1977.02	상무	상근	네트워크 People팀장	구주총괄 인사팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	34
허준희	남	1979.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	39
허지영	남	1970.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
허진욱	남	1971.09	상무	상근	Global CS센터 담당임원	북미총괄 CS팀장	한양대(박사)	계열회사 임원	46
허태영	남	1970.11	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	영상디스플레이 CX팀장	Univ. of California, LA(학사)	계열회사 임원	
허훈	남	1974.08	상무	상근	SECA 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	46
헨릭안손	남	1975.03	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 담당임원	Chalmers Univ.(석사)	계열회사 임원	21
현대은	남	1975.10	상무	상근	영상디스플레이 CX팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	46

현재용	남	1975.09	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	Fusion-io, Fellow	RPI(석사)	계열회사 임원	14
현정혁	남	1977.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	성균관대(학사)	계열회사 임원	22
홍기준	남	1971.05	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
홍순상	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 서비스Biz팀 담당임원	무선 서비스Biz팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	34
홍연석	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	SEIN-P법인장	경북대(석사)	계열회사 임원	34
홍영주	남	1977.08	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	34
홍유석	남	1972.12	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 책임변호사	Univ. of Notre Dame(석사)	계열회사 임원	
홍정호	남	1969.02	상무	상근	SEF 담당임원	의료기기 지원팀장	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	
홍주선	남	1971.10	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	경희대(석사)	계열회사 임원	
홍준식	남	1971.12	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	전북대(석사)	계열회사 임원	46
홍준화	남	1974.05	상무	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	Nike, Sr.Director	Univ. of Chicago(석사)	계열회사 임원	2
홍희일	남	1970.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	57
황근철	남	1973.03	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀장	네트워크 시스템솔루션팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	57
황근하	남	1970.05	상무	상근	영상디스플레이 Global제조팀장	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	
황보용	남	1970.10	상무	상근	기획팀 담당임원	칭의개발센터장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
황성훈	남	1969.07	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	
황영삼	남	1977.10	상무	상근	동남아총괄 People팀장	People팀 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	22
황용호	남	1975.10	상무	상근	Samsung Research Security&Privacy팀장	Samsung Research Security팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	57
황일권	남	1973.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	22
황호승	남	1967.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	46

※ 미등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 보통주(의결권 있는 주식)97,985,730주(이재용 회장 97,414,196주 등),

우선주(의결권 없는 주식) 195,016주(이재용 회장 137,757주 등)이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의

'임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참조하십시오.

※ 최대주주의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 재직기간은 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년 이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 기재를 생략하였습니다.

라.미등기임원의 변동

작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변동된 미등기임원은 다음과 같습니다.

구분(사유)	성명	성별	출생연월	직위	담당업무	최대주주와의 관계
임원선임	이혜경	여	1978.01	상무	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	계열회사 임원

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

2. 임원의 보수 등

임원의 보수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

당사는 2024년 3분기말 현재 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 해외종속법인의 유연한 자금조달을 위하여 통합채무보증을 제공하고 있습니다

(단위 : 천US\$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.08.19	715,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	210,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.09.30	329,000	329,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.12.17	2025.06.13	62,000	64,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2023.12.17	2025.06.13	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.12.16	96,000	96,000	8,065	△8,065	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	917,000	947,000	320,893	186,472	507,365	47.0%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.12.16	70,000	70,000	-	-	-	
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	114,000	114,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.05.31	835,508	832,731	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	125,000	125,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	537,000	537,000	-	-	-	
SECA	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	60,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2023.11.01	2025.09.05	888,400	856,400	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	15,600	15,600	-	-	-	
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	404,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2023.12.17	2025.06.13	270,000	270,000	-	-	-	
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	30,000	30,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	110,000	110,000	-	1,427	1,427	0.0%
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	20,000	20,000	-	-	-	
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	10,000	10,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증 시작일	보증 종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
합 계							9,070,657	9,063,960	839,935	176,502	1,016,438	

※ 별도 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 당사는 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 산정된 채무보증 수수료를

수취하고 있습니다. 당사는 2023년 중 US\$2,141천의 수수료를 청구하였으며, 2024년 중 수취하였습니다.

당사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우 유동성 위험에 대응하고 있습니다. 권역 내 Cash Pooling 참여법인들은 Pooling 모법인(SEA, SEEH, SAPL, SCIC 등)으로부터 상시 자금조달이 가능한 바, 별도 본사 지급보증을 통한 차입의 필요성은 낮으나 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 Pooling 모법인이 활용할 수 있는 차입한도를 별도 배정하고 있습니다. 또한 현지 규제 등으로 Cash Pooling이 불가능한 지역에 대해서는 통합채무보증을 통해 법인별로 보증한도를 설정하고 유동성 위험에 효율적으로 대응하고 있습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 2024년 3분기 중 법인의 생산설비 증설 등 목적으로 자산을 Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS) 등의 계열회사에 매각하였으며, 생산 효율화 등을 위해 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	처분손익
SESS	계열회사	자산매각/매입	2024.09.15	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	20,119	4,827
SCS	계열회사	자산매각/매입	2024.08.14	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	11,220	7,566
SEVT	계열회사	자산매각/매입	2024.06.28	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	4,213	26
SII	계열회사	자산매각	2024.02.15	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	1,753	60
TSLED	계열회사	자산매각	2024.09.23	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	845	266
SEHC	계열회사	자산매각	2024.08.07	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	272	△8
SSEC	계열회사	자산매각	2024.04.14	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	250	2
SEDA	계열회사	자산매각	2024.04.23	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	149	-
SEV	계열회사	자산매입	2024.01.17	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	132	-
삼성바이오로직스(주)	계열회사	자산매각	2024.02.28	차량운반구	자산 효율화	122	△14

※ 별도 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 거래일자는 최근 거래일자 기준입니다.

※ 거래금액은 시장 및 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정되었으며, 거래 다음달 15일 · 30일 이내 현금 지급조건 등통상적인 조건으로 거래되었습니다.

※ 상기 자산양수도 거래는 이사회 결의 대상이 아닙니다.

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 거래금액이 1억원 미만인 경우에는 기재를 생략하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래

2024년 3분기 중 계열회사인 Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) 등과 매출, 매입 등의 영업거래를 하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
SSI	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.09	반도체 매출입 등	28,421,708
SEA	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.09	스마트폰 및 가전제품 매출입 등	23,316,849
SSS	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.09	반도체 매출입 등	22,382,749
SEVT	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.09	스마트폰 매출입 등	19,862,666
SEV	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.09	스마트폰 매출입 등	12,730,709
SCS	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.09	반도체 매출입 등	9,062,586

※ 별도 기준입니다.

※ 공시대상은 최근사업연도 매출액의 5% 이상 기준입니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건등

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등을 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

당사(삼성전자(주), 삼성디스플레이(주) 등)는 분할된 삼성디스플레이(주) 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

그 밖의 우발부채 및 약정사항에 대해서는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

나. 채무보증내역

(단위 : 천US\$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.08.19	715,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	210,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.09.30	329,000	329,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.12.17	2025.06.13	62,000	64,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2023.12.17	2025.06.13	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.12.16	96,000	96,000	8,065	△8,065	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	917,000	947,000	320,893	186,472	507,365	47.0%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.12.16	70,000	70,000	-	-	-	
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	114,000	114,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.05.31	835,508	832,731	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	125,000	125,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	537,000	537,000	-	-	-	
SECA	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	60,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2023.11.01	2025.09.05	888,400	856,400	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	15,600	15,600	-	-	-	
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2023.11.09	2025.06.13	404,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2023.12.17	2025.06.13	270,000	270,000	-	-	-	
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	30,000	30,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	110,000	110,000	-	1,427	1,427	0.0%
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	20,000	20,000	-	-	-	
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.12.17	2024.12.16	10,000	10,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증 시작일	보증 종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	2,000	2,000	-	-	-	-
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	100,000	100,000	-	-	-	-
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	25,000	25,000	-	-	-	-
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	-
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	15,000	15,000	-	-	-	-
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024.06.14	2025.06.13	30,000	30,000	-	-	-	-
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2021.11.22	2026.02.19	601,149	597,229	510,977	△3,332	507,645	8.1%
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022.04.26	채무소멸시	340,000	340,000	-	-	-	-
합 계							9,070,657	9,063,960	839,935	176,502	1,016,438	

- ※ 연결 기준입니다. SDN 건은 삼성디스플레이㈜, SAS 건은 SEA가 각각 채무보증인입니다. [△는 부(-)의 값임]
- ※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.
또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.
- ※ 당사는 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 산정된 채무보증 수수료를
수취하고 있습니다. 당사는 2023년 중 US\$2,141천의 수수료를 청구하였으며, 2024년 중 수취하였습니다.
한편, 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2023년 중 US\$3,066천의 수수료를 청구하였으며, 2024년 중 수취하였습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

제재 등과 관련된 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

연결대상 종속회사 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

2. 계열회사 현황(상세)

계열회사 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

3. 타법인출자 현황(상세)

타법인출자 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

4. 연구개발실적(상세)

☞ 본문 위치로 이동

부문		연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	영상 디스플레이	Neo QLED 8K (~2024.03.)	<ul style="list-style-type: none"> □ Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV (65 · 75 · 85") <ul style="list-style-type: none"> - QN900 (65 · 75 · 85") / QN800 (65 · 75 · 85") / QN700 (55 · 65 · 75") - 세밀한 Mini LED의 향상된 명암비로 더욱 실재를 보는 듯한 QLED 8K 화질 - Neural Quantum Processor 8K 적용하여 입체감과 현실감 있는 시청 경험 제공 - OTS(Object Tracking Sound) 기능으로 공간을 감싸는 입체감 있는 음질 경험 제공
		Neo QLED 4K (~2024.03.)	<ul style="list-style-type: none"> □ Mini LED 기반 4개 시리즈, 7개 사이즈 (43 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85 · 98") □ Mini LED 적용을 통한 Slim 구현 및 Bezel-less/Metal를 통한 디자인 프리미엄 Look <ul style="list-style-type: none"> - Quantum Nano-Layer Multi-Cell 구조를 적용하여 Slim하면서도 높은 광 효율과 광 Profile 조절이 가능한 New LED - 장르별 선호 화질 선택 시, AI 활용하여 장르별 맞춤형 화질 변환 - 편리한 사용성 제공하는 New Home을 통해 빠른 진입점 및 추천경험 제공
		OLED TV (~2024.03.)	<ul style="list-style-type: none"> □ Quantum Dot 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (55 · 65 · 77") <ul style="list-style-type: none"> - S95 (55 · 65 · 77") : 144Hz VRR 적용된 QD-OLED Display와 OLED Glare Free 적용된 True Reality 화질과 Ultra Slim Flat 폼팩터에 Top Speaker가 내장된 Infinity One Design에 Object Tracking Sound 및 ATMOS 까지 모두 적용된 진정한 TV 가치를 제공하는 OLED TV - S90 (55 · 65 · 77") : Neo QLED 외, 삼성 OLED 라인업 강화하여 Premium TV 시장 내 포지셔닝 확대를 위해 144Hz VRR 적용된 OLED Display의 화질과 Laser Slim Design에 OTS Lite 및 ATMOS 적용으로 부족함 없는 입체 사운드 경험을 제공하는 OLED TV □ White OLED 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (42 · 48 · 55 · 65 · 77 · 83") <ul style="list-style-type: none"> - S90 (42 · 48 · 55 · 65 · 77 · 83") : 상동 - S85 (55 · 65 · 77 · 83") : OLED 판매 확대 및 손익 개선 중심의 신규 라인업으로 기획된 White OLED Display와 최후부까지 곡선으로 날렵하게 이어지는 Contour Design에 OTS Lite 및 ATMOS 적용으로 부족함 없는 입체 사운드 경험을 제공하는 OLED TV
		QLED TV (~2024.03.)	<ul style="list-style-type: none"> □ Flat QLED 4K TV (32 · 43 · 50 · 55 · 60 · 65 · 70 · 75 · 82 · 85 · 98") <ul style="list-style-type: none"> - 4K 최고의 화질(AI/밝기/시야각) 및 음질(OTS)을 통한 시청 경험을 극대화한 Flagship QLED - 최고의 명암비, 시야각 Free, Life-like 컬러와 최적의 밝기로 몰입감을 극대화 - 음성인식 및 AI 기술 기반으로 외부 환경 및 사용자 Context를 인지하여 최적의 시청 경험 제공 - 고가의 전문 장비 없이 모바일로 손쉽게 TV 화질을 Calibration - Game Bar를 통한 캐주얼 게이머들을 위한 게임 경험 확대
		UHD TV (~2024.03.)	<ul style="list-style-type: none"> □ Flat UHD TV (43 · 50 · 55 · 58 · 60 · 65 · 70 · 75 · 82 · 85 · 98") <ul style="list-style-type: none"> - Slim한 Bezel-less 디자인과 실제 자연색에 가까운 Color를 제공하는 UHD 스마트 TV - Dynamic Crystal Color 및 Dual LED를 통해 원본 콘텐츠의 화질을 그대로 표현하는 UHD 화질 - Multi-media Screen 경험 제공, 풍부한 콘텐츠, Smart Home의 경험을 통해 완성된 Smart 경험 제공 - Game Hub, IoT Hub, Chat Together, Voice Ready, Daily+, SmartThings Mobile Plugin 기능을 추가를 통한 Smart 경험 강화
		Lifestyle TV (~2024.04.)	<ul style="list-style-type: none"> □ The Sero (43") <ul style="list-style-type: none"> - Modern & Simple 한 세로형 Screen에 판상형 Speaker가 부착된 360도 Design - 다양한 거주공간 어디에도 쉽게 거치 가능, 이동 가능한 Floor 스탠드 제공 - 기울어진 폼팩터에도 외광/실내 조명 반사 없는 화질로 기존 제품의 VoC 대폭 개선 □ The Frame (32 · 43 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85") <ul style="list-style-type: none"> - Real 액자 디자인 및 액자 설치 경험 완성 - 다양한 영화, 사진 등 감상 가능, 인테리어와 조화로운 Lifestyle 디자인 채용

		<ul style="list-style-type: none"> - 초대형 Life Style 제품 Needs에 따른 85" 추가도입 - 외광/실내 조명 반사 없이 항상 종이와 같은 질감을 표현하는 화질로 Real Frame 경험 완성 <input type="checkbox"/> The Serif (43 · 50 · 55 · 65") - 'I' 형태 Serif Font 디자인으로 확실한 차별화 및 인테리어 감성 극대화 - 대형 사이즈 제품 포지션 확대를 위한 65" 추가도입 - 외광/실내 조명 반사 없이 항상 매트한 질감을 표현하는 화질로 가구와 같은 디자인 완성 - White 외 Dark계열 신규컬러(Ivy Green) 옵션 제공 <input type="checkbox"/> The Terrace (55 · 65 · 75") - 옥외에서 휴식과 Entertainment를 동시에 즐기려는 Lifestyle 대응을 위한 차별화된 제품 <input type="checkbox"/> The Premiere (100~130") - 초단초점 · 레이저 · 고화질 폼팩터에 업계 최고 Smart UX/OTT 경험 제공 - Blended 디자인으로 벽 근처에 쉽게 놓고 원하는 공간에 적합한 사이즈로 투영 - 당사 TV의 완성된 콘텐츠 경험과 차별화된 화질 · 음질을 제공하는 프로젝트 <input type="checkbox"/> The Freestyle (30~100") / Freestyle Rev (30~100") - 언제 어디서나 다양한 콘텐츠를 쉽게 감상할 수 있는 Movable Smart Screen - 다양한 공간에 쉽게 놓이며 각도/거리에 상관없이 최적 시청 경험 제공(Auto Focus/Auto Keystone) - 기본 Cradle로 다양한 공간에 거치 사용성이 추가되고 소켓을 통해 신규 설치 확장도 가능
	Micro-LED TV (~2023.12.)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Micro-LED Screen (76 · 89 · 101 · 114", TFT 기반) - 프리미엄 고객 및 유통의 Needs를 만족 시켜 주는 차세대 Flagship 모델 - TFT Glass기반 12.7" 모듈(Pitch 0.51) Micro-LED Screen 완품형 출시 - MicroLED Processor : AI scaling + HDR enhancing 기반 선명한 입체 화질 구현
	Sound Bar (~2022.03.)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sound Bar Q990B - 업계 최초, TV에서 사운드바로 무선 ATMOS 전송(Wireless ATMOS) - TV와 Soundbar의 모든 채널을 활용하여 극장과 같은 최상의 Cinema True ATMOS 제공 - 사운드바 자체 공간 보정 기술 탑재
	모니터 (~2023.09.)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 스마트 모니터 M80B (32") - 초슬림, Flat Back, Warm White 컬러 적용 Lifestyle 디자인 - Magnetic 방식의 전용 카메라 In-box 영상 커뮤니케이션 - 스마트 경험 강화(VOD 시청/모바일 연결/PC-less기능/IoT/Communication/Game) <input type="checkbox"/> 게이밍 모니터 G85NB (32") - 세계 최초 UHD 240Hz 1ms(GTG) 최고 게이밍 성능 모니터 (1000R Curved) - 새로운 수준 화질 경험을 제공하는 Odyssey Neo (Mini LED, Quantum HDR2000) <input type="checkbox"/> 세계 최초 1000R 대형 게임 스크린 G97NB (55") - 1000R, 16:9, 55" Big Curved Screen으로 근접 환경에서도 시야각 제약 없는 최대 사이즈 화면으로 최고의 몰입감 제공 - 세로로 회전하고 자유로운 각도 조정으로 우주선 조종석에 앉은 것 같은 새로운 몰입 경험 제공 - 4K 165Hz 입출력 및 반응속도 1ms까지 지원 가능한 게임 전용 패널 <input type="checkbox"/> QD-OLED 게이밍 모니터 (G85SB 34") - True RGB 자발광 Display와 Quantum Dot 기술의 조합으로 다양한 컬러를 정교하게 표현 - 0.1ms 최고 응답속도, 175Hz 주사율로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능 - Gaming Hub 적용으로 Cloud Game, 콘솔 등 All-In-One Game Discovery Platform 도입 <input type="checkbox"/> 5K 초고해상도 모니터 (S90PC 27") - 4K 대비 50% 이상 더 많은 픽셀로 더 많은 정보를 담는 5K(5120X2880) 해상도 - 모니터 후드 없이도 빛 반사를 줄여 화면 왜곡을 없애고 눈 보호하는 Matte Display - MAC/Windows 모두 만족하는 Thunderbolt 4 및 miniDP 제공 - 나의 작업/ 일상/ 공간에 맞춰 활용하는 '스마트스크린' <input type="checkbox"/> DUHD Flagship Gaming 모니터 (G95NC 57")

		<ul style="list-style-type: none"> - 신규 57" 초대형 폼팩터 및 초고화질 Dual UHD(7680X2160)을 통한 '극한의 몰입감' 제공 - 240Hz 주사율, 1ms 최고 응답속도로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능
	<p>사이니지 (~2023.06.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> LCD 기반의 B2B Smart Signage (LFD, Video Wall, Outdoor 등) (13 · 24 · 32 · 43 · 49 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85 · 98") <input type="checkbox"/> LED 소자를 활용한 Indoor / Outdoor 사이니지 <input type="checkbox"/> 부가 장치 일체형 All-in-one Kiosk (24") <ul style="list-style-type: none"> - Tizen 결제모듈/주문 앱 개발 위한 결제 플랫폼, 향균 코팅
생활가전	<p>냉장고 (~2024.08.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 구주 177cm 1Door 빌트인 냉장고 신규 진입 <ul style="list-style-type: none"> - 빌트인 패키지 라인업 확대 - 신규격 기준 에너지 최고등급 구현 - 간냉식 용량 우위 확보 - 식품 신선보관(고습 냉장) 및 변온기능(냉동→냉장) 차별화 <input type="checkbox"/> 북미 48" 냉장고 빌트인 시장 교체 및 신규 수요 대응 <ul style="list-style-type: none"> - 빌트인 27.4cf 대용량 구현 - Ice & Water Solution 차별화(Auto Fill Water, Dual Auto Ice Maker) - Soft Closing 도어 적용으로 감성품질 고급화 <input type="checkbox"/> 한국향 초격차 에너지 모델 도입(초절전 1등급, 1등급-22%달성) <ul style="list-style-type: none"> - 세계 최고 효율 압축기 적용 (W1, EER 9.3) - Set 열부하 저감(VIP Coverage 증대) - 기계실 방열 증대(Comp 측 Side Cool 추가) <input type="checkbox"/> Global Wide BMF 냉장고 <ul style="list-style-type: none"> - 고효율 에너지 등급 및 AI Energy mode 적용, 에너지 비용 절감 - SpaceMax 적용으로 내용적 확대로 수납 편의성 - SmartThings 기반 시간대별 고내 조영 자동 조절 등 Smart 서비스 제공 <input type="checkbox"/> 중국 가옥 맞춤형 냉장고(W83cm) <ul style="list-style-type: none"> - 좌우 제로갭 설치로 주방 공간에 딱 맞게 빌트인처럼 매끈하게 설치 가능 - AI에너지 모드 적용으로 실사용 에너지 절감(중국에너지 1등급) - 최적 온도와 습도에서 전문적으로 식재료 특화 보관 제공(건습/보습 Box) - Wide Open 자동 도어 열림 기능 적용 <input type="checkbox"/> Peltier 적용 냉장고 <ul style="list-style-type: none"> - Peltier 적용 및 폐열 활용을 통한 최고 효율 및 에너지 등급 달성 - 2개 냉각방식(Comp+Peltier)의 장점을 결합하여 소비자 Value 창출 <ul style="list-style-type: none"> · 1등급 -30% 에너지 달성 (기존 1등급 -22%) · Peltier 냉각 시스템 Compact화로 내용적 확보(기존 875L → 900L) <input type="checkbox"/> 구주 Built-In BMF 냉장고 <ul style="list-style-type: none"> - 구주향 빌트인 BMF 대용량(380리터 ↑) 최고 에너지 등급 달성 - AI Energy 적용, 동급비 10%이상 실사용 에너지 절감 - Full 간냉 및 [냉동→냉장 전환] 기능 제공 <input type="checkbox"/> 한국 4Door 김치냉장고 도입 (소분/숙성 기능 장착) <ul style="list-style-type: none"> - 식재료 소분 저장/저온 숙성 가능한 별도 공간 제공 <ul style="list-style-type: none"> · 김치숙성, 육류해동, 반죽발효등 다양한 모드로 활용성 강화 - 개정 에너지 규격 기준 1등급 고효율 모델 도입 <input type="checkbox"/> 한국 오토 오픈 4Door 김치냉장고 도입 <ul style="list-style-type: none"> - Auto Open Door 적용으로 사용 편의성 강화 - 냄새 저감 김치통 적용으로 다양한 식재료 보관 가능 - 숙성, 해동, 발효 가능한 맞춤형숙성실 제공
	세탁기	<input type="checkbox"/> 그랑데 AI 24kg 세탁기

		<p>(~2024.02.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 24kg, Flat Design (Glass Type) - 핏케어 코스 적용(열룩, 냄새, 알러젠 제거) - Auto open door 적용(세탁 종료 후 자동으로 문 열림) □ BESPOKE 그랑데시 원바디 Top-Fit - 한국향 BESPOKE 그랑데시 일체형 Washer - 세탁기(21kg)와 건조기(17kg) 일체형 원바디 디자인 - 심플한 플랫폼 디자인 □ 세탁건조기 BESPOKE AI 콤보 - ONE 솔루션 : 세탁물 이동없이 편리하게 하나로 세탁건조 - AI 홈 : 터치화면 및 음성인식으로 간편하게 세탁건조 - AI 맞춤코스 : 세탁물에 맞는 최적의 코스로 작동
		<p>에어컨 (~2024.07.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ 구주 EHS 신형 플랫폼 적용 및 라인업 강화로 매출 확대 - 저소음 규제 대응 : 독일을 중심으로 구주 국가별 소음 규제 확대 대응 - 저온 성능 강화 : -25℃외기에서 정격 난방 성능 100% 구현 - 고온 토출수 : Heat Pump 단일 사이클 최고 70℃ 토출수 구현 - 디자인 차별화 : 주거 환경에 조화를 이루는 Dark 색상 계열의 1FAN 실외기 □ BESPOKE 무풍에어컨 원도우핏 - 방안에서도 직바람 없이 시원한 무풍 냉방 - 진동과 소음을 줄여 숙면을 도와주는 32 dB 저소음 모드 - 상황에 맞춰 선택하는 고효율 에너지 맞춤 절전 - 더 강력한 냉방 성능과 더 커진 팬으로 골고루 시원하게 대용량 강력 냉방 - 빈틈없이 쉽고 안전하게 간편 안심 설치킷 □ Infinite Line 1Way BESPOKE 무풍 시스템에어컨 - 자연스럽게 공간의 무드를 만들어내는 은은한 간접조명 엣지 라이팅 - 고효율 에너지 맞춤절전 와이드 무풍 - 공기질부터 내부 관리까지 케어 8단계 - 상황에 맞춰 선택해 에너지를 절감하는 AI 절약모드 □ 구주 EHS 신 냉매(R290) 신규 플랫폼 - 2027년 냉매 규제에 따른 신 냉매(R290) 솔루션 대응 - 보일러 시장 대체를 위한 고온 토출수 구현 (Max 출수 75℃) - 저소음 구현 (최저 35dB(A)) □ 구주 EHS 하이드로 유닛(탱크 일체형 및 벽걸이형) 실내기 개발 - 통합 Energy 관리 솔루션/고객 사용경험 및 편의성 향상(CX-MDE 기반 에너지 절전) - AI Energy 및 업계 최고 급탕효율 성능으로 경쟁사 비 연간 소비 전력량 15% 절감 - Slim Fit 설계로 구주내 증가하고 있는 공동 주택(아파트 등) 수요 선점 대응 □ 시스템 에어컨 주력 상품인 DVM S의 혁신 고효율 신규 플랫폼 도입 - 캐나다내 Top 에너지 효율 달성(경쟁사 제품비 IEER 효율 경쟁력 리더쉽 확보) - 캐나다내 최대 용량 달성(단일 Set 최대 20Ton, D社 단일 Set 최대 14Ton) - 캐나다내 최대 난방 운전 온도 범위 <ul style="list-style-type: none"> · 당사 -30~24℃ ,D사 -25~16℃, X사 -30~16℃
		<p>청소기 (~2024.03.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ BESPOKE 제트 AI 청소기(최고 흡입력 280W) - 흡입력 및 원조 POD(청정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거

			<ul style="list-style-type: none"> - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 무게로 무겁게 편리하게 청소 <input type="checkbox"/> 한국형 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 <ul style="list-style-type: none"> - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션
		렌지후드 (2022.02.)	<input type="checkbox"/> 자가 후드 프리미엄 라인업 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 제품과의 성능 차별화 <ul style="list-style-type: none"> · 트리플 센서를 탑재하여 상시배기 시스템으로 최적의 풍량 운전 · 업계 최고 흡입력 780CMH 구현, 업계 최저 소음 (29dB, Quiet Mark 인증) - 전기레인지와 연동 및 스테인리스 필터에 이지 클린 코팅 적용으로 사용편의성 개선 - 소비자의 다양한 니즈 반영한 디자인(BESPOKE 컬러) - Easy Install 및 설치 프로세스 도입으로 B2C 시장 진입
		인버터 제습기 (2022.05.)	<input type="checkbox"/> 에너지 소비효율 1등급 저소음 인버터 제습기 <ul style="list-style-type: none"> - 와이드 블레이드로 빠르고 강력하게 대용량 제습 - 욕실부터 드레스룸까지 공간을 쾌적하게 스마트 공간 케어 - 스윙 블레이드로 섬세한 의류도 골고루 와이드 의류 건조 - 어디에도 잘 어울리는 심플한 디자인과 컴팩트 사이즈 - 장시간 사용해도 조용한 저소음 모드
		식기세척기 (2022.06.)	<input type="checkbox"/> 구주/한국 시장 경쟁력있는 자체 기술 플랫폼 <ul style="list-style-type: none"> - 구주 시장 Tall Tub 대응 - 최고 수준 에너지/물/소음 사양 경쟁력 확보 - 한국 세제자동투입, Simple UX 등 차별화를 통한 프리미엄 강화 - Z-wash, Smart, Flexible Basket 사양 차별화
		가스오븐 (~2023.08.)	<input type="checkbox"/> 북미 Dacor 48" Pro-Range <ul style="list-style-type: none"> - 48" all Gas Pro range 도입, 외관 Transitional(Chef) look 디자인 적용 - Air Fry, Air Sous-Vide 등 Healthier cooking POD 적용 - 7" Pop-up display 적용 <input type="checkbox"/> 북미 Dacor 48" Pro-Range (Dual Fuel) <ul style="list-style-type: none"> - 48" Dual Fuel Pro range 도입, 외관 Transitional(Chef) look 디자인 적용 - Dual Fuel 연료 형태로 Oven(전기) + Cooktop(가스) - Cooktop부 6 Burners + Griddle 사양 적용 - Small oven 12" (신규 플랫폼), Big oven 36" (기존 플랫폼) 조합 - Steam Assist 기능 제공
	MX	Galaxy 폴더블 (~2024.07.)	<input type="checkbox"/> Galaxy Z Fold4 (2022.08.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 67.1mm x 155.1mm x 14.2~15.8mm (펼쳤을 때) 130.1mm x 155.1mm x 6.3mm - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8+ Gen 1, Android 12.0, One UI 4.1.1 - Nightography 사진/비디오, 고해상도(50M/8K), 고배율줌(30X)로 카메라 사용 경험 완성도 제고 - Taskbar제공으로 쉽고 빨라진 멀티 태스킹 - 다양한 진입점으로 편리하게 생성하는 멀티 윈도우 - 이미지에서 텍스트를 인식하여 AI 기반 Action 추천 기능
			<input type="checkbox"/> Galaxy Z Flip4 (2022.08.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 1.9" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 71.9mm x 84.9mm x 15.9~17.1mm (펼쳤을 때) 71.9mm x 165.2mm x 6.9 mm

		<ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8+ Gen 1, Android 12.0, One UI 4.1.1 - 25W 충전 지원 및 3700mAh 배터리 제공 - 다양한 각으로 사진/영상 촬영에 최적화된 플렉스 캠 지원 - 플렉스 모드에서 쉽고 빠른 앱 전환 및 조작 - 커버 스크린 기능 확대 (간편 답장, 삼성 월렛 플랫폼, 퀵세팅 확대 등)
		<input type="checkbox"/> Galaxy Z Fold5 (2023.08.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 67.1mm x 154.9mm x 13.4mm (펼쳤을 때) 129.9mm x 154.9mm x 6.1mm - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 신규 힌지 적용을 통한 Slim Closed Gap 디자인 구현 : Dumbbell 방식(물방울형) Flex Hinge 적용 - 무게 절감과 두께 축소를 통한 단말 휴대성 및 그림감 향상 - 대화면 최적화를 통한 사용자 경험 개선 <ul style="list-style-type: none"> · 양손 활용 동작 : 한 손으로 앱/컨텐츠를 선택, 다른 손으로 원하는 동작 실행 · Taskbar 최적화 : 최근 앱 표시 확대(2→4개), Navigation 영역 자동 확장 · 멀티윈도우 전환 강화 : 홈화면에서 팝업 윈도우를 손쉽게 멀티윈도우로 전환 · Game 최적화 : 주요 Game에 대한 최적 해상도 사전 확보 - 내구성 강화 : Display내 충격 흡수층 강화 및 세트 힌지부 구조 변경 - 슬림하고 가벼운 S-Pen과 Case : S-Pen 및 Case 형상 변경으로 두께 및 무게 절감
		<input type="checkbox"/> Galaxy Z Flip5 (2023.08.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 3.4" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 71.9mm x 85.1mm x 15.1 mm (펼쳤을 때) 71.9mm x 165.1mm x 6.9 mm - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 설계 최적화를 통한 커버스크린 확대(1.9" →3.4") - 신규 힌지 적용을 통한 Slim Closed Gap 및 두께 축소를 그림감 개선 - 대형 커버스크린 활용한 차별화된 사용자 경험 핵심 기능 제공 및 사용성 강화 <ul style="list-style-type: none"> · 주요 위젯13종(Music, Alarm 등), 주요 앱(삼성Wallet, 메시지 답장), Fast Scroll 기능 제공 · Quick Setting 6종 →9종 확대(Mobile Data, Screen Recording, Modes 3종) - 대화면 커버스크린을 활용한 다양한 촬영 효과 및 기능 제공 - 내구성 강화 : Display내 충격 흡수층 강화 및 세트 힌지부 구조 변경
		<input type="checkbox"/> Galaxy Z Fold6 (2024.07.) <ul style="list-style-type: none"> - 얇고 가벼운 무게로 뛰어난 휴대성 제공을 통한 제품 경쟁력 강화 - 한단계 더 진화된 Galaxy AI를 통해 차별화된 사용자 경험 제공 - 인치(Main/Sub) : 7.6" QXGA+(2160 x 1856) / 6.3" HD+ (968 x 2376) - 사이즈(W x H x D) : Open 132.6 x 153.5 x 5.6 mm, Close 68.1 x 153.5 x 12.1 mm, 239g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Gen 3, Android 14, One UI 6.1.1 - 폴더를 톱픽터와 Galaxy AI 기능 탑재를 통한 Galaxy Intelligence 경험 혁신 <ul style="list-style-type: none"> · 서클 투 서치, 실시간 통역, 노트/채팅 어시스트 등 · 듀얼 스크린 활용한 '대화 번역 모드' 등 - 향상된 카메라/갤러리 경험 제공 <ul style="list-style-type: none"> · 포토/그리기 어시스트, 날씨 및 시간 배경 화면 등 - 무게 14g 감소, 두께(Close) 1.3mm 감소, Cover Display 0.1" 증가
		<input type="checkbox"/> Galaxy Z Flip6 (2024.07.) <ul style="list-style-type: none"> - 내구성 향상을 통한 제품 경쟁력 강화 - 한단계 더 진화된 Galaxy AI를 통해 차별화된 사용자 경험 제공 - 인치(Main/Sub) : 6.7" FHD+ (2640 x 1080) / 3.4" (720 x 748)

		<ul style="list-style-type: none"> - 사이즈(W x H x D) : Open 71.9 x 165.1 x 6.9 mm, Close 71.9 x 85.1 x 14.9 mm, 187g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Gen 3, Android 14, One UI 6.1.1 - 폴더블 폼팩터와 Galaxy AI 기능 탑재를 통한 Galaxy Intelligence 경험 혁신 <ul style="list-style-type: none"> · 서클 투 서치, 실시간 통역, 포토/노트/채팅 어시스트 등 · 듀얼 스크린 활용한 '대화 번역 모드', 플렉스윈도우에서의 '답장 추천' 기능 지원 등 - 고화소 카메라(Wide 50MP) 적용 및 향상된 Flex 카메라 경험 제공 <ul style="list-style-type: none"> · 저조도/원거리 선명한 디테일 제공 · AI를 통한 Flex Zoom 기능 지원으로 편리한 핸드프리 촬영 - Display Folding부 내구성 강화 <ul style="list-style-type: none"> · 화면 내구성 강화 및 폴딩부 굴곡 개선 	
		<p>□ Galaxy S22 · S22+ · S22 Ultra (2022.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Design: Enhance Galaxy Design attractiveness with geometric bold design and integrity on quality - 인치 : S22 6.1", S22+ 6.6", S22 Ultra 6.8" - 사이즈(W x H x D) : S22 70.6 x 146.0 x 7.6 mm, S22+ 75.8 x 157.4 x 7.6 mm, S22 Ultra 77.9 x 163.3 x 8.9 mm - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 1 /Exynos2200, Android 12.0, One UI 4.1 - 카메라 동영상 촬영 및 저조도 성능 강화 <ul style="list-style-type: none"> · 동영상 : HDR, OIS+AI Stabilizer 성능 개선으로 풍부한 컬러 지원 및 흔들림/지터링 최소화 · 저조도 성능강화 : Big Pixel 센서 및 On-device AI 알고리즘 적용 - S Pen 내장을 통한 Ultra/Note 통합 * Latency 최적화 : 5.6ms(S21 Ultra) → 2.8ms(S22 Ultra) - Display 야외 시인성 개선 * Peak 휘도: 1,500nit(S21 Ultra) → 1,750nit(S22 Ultra) - All day 사용 가능한 배터리와 초고속 45W 충전 속도 (S22 Ultra/S22+) - 내구성 강화 : 10% 개선된 Amor AL, Victus+ Glass 적용 - Galaxy Foundation 경험 완성도 제고 <ul style="list-style-type: none"> · One UI 4.1: 감성적 Interaction 경험과 사용자 개인 경험 고도화 · Galaxy Eco : End-to-End 완성도 제고 및 체감 편의 경험 강화 	
	<p>Galaxy S (~2024.01.)</p>	<p>□ Galaxy S23 · S23+ · S23 Ultra (2023.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Design: Ultimate Premium Experience designed for today and beyond <ul style="list-style-type: none"> * Unrivaled Camera, Ultimate Gaming Eco-conscious Design - 인치 : S23 6.1", S23+ 6.6", S23 Ultra 6.8" - 사이즈(W x H x D) : S23 70.9 x 146.3 x 7.6 mm, S23+ 76.2 x 157.8 x 7.6 mm, 195g S23 Ultra 78.1 x 163.4 x 8.9 mm, 233g - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 강화된 시 기반 저조도 및 동영상 경험 완성도 제고 <ul style="list-style-type: none"> · AI Scene 분석 기반 컬러 솔루션 개선으로 야간에도 정확한 인물 색감/톤 표현 가능 · OIS 보정각 확대로 동영상 손떨림 보정 강화 (S22 Ultra 1.5° → S23 Ultra 3°) - 고화소의 섬세한 디테일 구현 및 고해상도 사진 촬영 경험 제공 <ul style="list-style-type: none"> · S23 Ultra, 200MP 초고화소 센서 적용 · 조도 구간별 픽셀 크기 자동 조정으로 최적 화질 제공 - 발열, 낙하 내구성 등 기본 성능 개선 <ul style="list-style-type: none"> · 소모전류 개선 및 발열 구조 획기적 개선 등 발열 성능 향상을 통한 부드러운 게이밍 경험 제공 · 단품 강도 21% 개선된 Victus 2 Glass 적용으로 낙하 내구성 강화 - S23 Ultra, 내장된 S-Pen으로 더욱 완벽한 Productivity 경험 제공 <ul style="list-style-type: none"> · 이미지 / 동영상에서 텍스트를 인식하여 AI 기반 맞춤 Action 제안 - 멀티기기 연동 사용 경험 강화 (폰-PC) <ul style="list-style-type: none"> · 폰에서 브라우징 하던 웹페이지를 PC에서 이어서 사용 가능 	

			<ul style="list-style-type: none"> - 컬러부터 소재까지 전반에 걸친 친환경 소재 적용으로 친환경 스토리 구성 · 패키징 박스 100% 재생용지 사용 · 재활용 메탈접합 PBT레진 적용(10%), 재활용 메탈 소재 적용(28%) 사이드키 등 · 전/후면 글라스 재생유리 적용(22%), 메탈 가공시 천연영료 사용, 재활용 PET 필름 사용 등 - Privacy와 Security 강화 · 보안 상태 시각화 / 이미지 공유시 민감 정보 알림 / 제품 수리시 개인 정보 접근 제한 <hr/> <p>□ Galaxy S24 · S24+ · S24 Ultra (2024.01.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Galaxy AI 기능 탑재를 통한 Galaxy Intelligence 경험 혁신 · 서클 투 서치, 실시간 통역, 포토/노트/채팅 어시스트 등 신규 AI 기능 제공 - 인치 : S24 6.2", S24+ 6.7", S24 Ultra 6.8" - 사이즈(W x H x D) : S24 70.6 x 147.0 x 7.6 mm 167g, S24+ 75.9 x 158.5 x 7.7 mm, 196g S24 Ultra 79.0 x 162.3 x 8.6 mm, 232g - Platform(H/W, S/W) : Snapdragon 8 Gen 3/Exynos 2400, Android 14, One UI 6.1 - Slimmer and even bezels 적용으로 몰입감 있는 디스플레이 경험 강화 - One-mass 디자인을 통한 조형의 일체감 완성 - 향상된 AI ProVisual Engine 탑재로 카메라 촬영 및 갤러리 감상/편집 강화 · 스페이스 줌, 나이트그래피로 선명한 고품질 사진 촬영 · Instant Slow-mo, Edit Suggestion 기능 제공 - 디스플레이 야외 시인성 개선 * Peak 밝기: 1,750nit → 2,600nit - S24 Ultra, 메탈 프레임 티타늄 소재 적용을 통한 내구성 강화 및 고급감 극대화 - S24 Ultra, 고화소 망원 카메라 적용 * 10MP (S23 Ultra) → 50MP (S24 Ultra) <hr/> <p>Galaxy 탭 (~2023.08)</p> <p>□ Galaxy Tab S8 · S8+ · S8 Ultra (2022.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : Tab S8 11" WQXGA (2560 x 1600) Tab S8+ 12.4" WQXGA+ (2800 x 1752) Tab S8 Ultra 14.6" WQXGA+ (2960 x 1848) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Tab S8 165.3mm x 253.8mm x 6.3mm, 503g Tab S8+ 185.0mm x 285.0mm x 5.7mm, 567g Tab S8 Ultra 208.6mm x 326.4mm x 5.5mm, 726g - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 1, Android 12, One UI 4.1 - Memory : 8GB+128GB / 8GB+256GB / 12GB+256GB / 16G+512G, microSD up to 1TB - 화상 통화 경험 향상 [Tab S8 Ultra] Dual 전면 카메라(12M 80도, 12M 120도) 및 Auto Framing 기능 제공 [Tab S8+ / Tab S8] 12M 120도 전면 카메라 및 Auto Framing 기능 제공 - AP 방열 설계 강화를 통한 AP Sustain 성능 개선(전작비 GPU 70%, CPU 25%↑), 게임 성능 향상 - S Pen Latency 개선 (5.6ms → 2.65ms) 및 Prediction Algorithm 최적화 Writing & Drawing 시 Real Pen과 같이 끊김 없고 정밀한 필기 경험 제공, 밀착감 개선 - 3 MIC Noise Cancellation 성능 강화 (3종 잡음 제거 모드)로 화상 회의 오디오 경험 향상 - 태블릿 최초로 WiFi 6E 기능을 탑재하여 Device 간 대용량 데이터 전송 시간 개선 - D2D 15W 충전 기능 탑재하여 전작 대비 Phone Power Share 충전 시간 절반으로 단축 <hr/> <p>□ Galaxy Tab S9 · S9+ · S9 Ultra (2023.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : Tab S9 11"WQXGA (2560 x 1600) Tab S9+ 12.4"WQXGA+ (2800 x 1752) Tab S9 Ultra 14.6"WQXGA+ (2960 x 1848) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Tab S9 165.8 x 254.3 x 5.9 mm, 498g Tab S9+ 185.4 x 285.4 x 5.7 mm, 581g Tab S9 Ultra 208.6 x 326.4 x 5.5 mm, 732g - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> - 풍부한 색상과 환경에 적응하는 대화면 경험 제공 · Tab S9 시리즈 전 모델 선명하면서도 편안한 Dynamic AMOLED 2X 기술 채용 · 햇빛 아래에서도 선명한 화면을 보여주는 Vision Booster 기술 도입 - 어디서나 걱정 없이 사용 가능하도록 이동성 및 신뢰성 확보 · 최상의 방수/방진 인증 등급 IP68 획득 · 충격과 낙하에서 기기를 안전하게 보호하는 Armor Aluminum · 양방향 충전 적용 S-Pen 및 Ruggedized 액세서리 도입으로 사용성 Eco 확대 · Tab FE 모델군과 키보드 및 액세서리 공용화로 호환성 강화 · Vapor Chamber를 이용한 양방향 방열 신규 구조 도입 장시간 사용에도 불편함 없이 사용 - 다양한 분야에 걸친 풍성한 Android App Eco 확보 · 필기, 문서, 브라우징 등 생산성 강화 주요 안드로이드 앱 강화 : 삼성노트, 굿노트 등 · 그림, 사진 및 영상 편집 사용성 개선을 위한 주요 앱 확보 : 루마퓨전, 클립스튜디오 등 - 외관 대형 플라스틱 부위 및 강화 유리 재활용으로 제품 전반에 걸친 친환경 소재 적용 · S-PEN 부착 부위 대형 재활용 플라스틱 신규 적용 · 디스플레이 강화 유리 신규 재활용 도입 (10%, 고릴라 글래스5) · 패키징 박스 100% 재생 용지 및 재활용 Armor Aluminum 적용(20%), 재활용 플라스틱 내장 자재 사용 등
		Galaxy A (~2024.09.)	<input type="checkbox"/> Galaxy A13 5G (2022.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.5" HD+ (1600 x 720) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.5mm x 164.5mm x 8.8mm, 195g - 6.5" HD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A12 6.5" HD+ 60Hz) - LTE 사용자 Migration 및 5G 시장 확산을 위한 초저가 5G 모델 - Entry 시장 대응을 위한 AP 성능 강화 (P35 → D700) - 50MP 카메라 적용으로 전작(A12 16MP)비 고화소 사진 촬영 가능 <input type="checkbox"/> Galaxy A23 (2022.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ (2408 x 1080) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.9mm x 165.4mm x 8.4mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : SDM680, Android 12, One UI 4.1 - 6.6" FHD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A22 6.4" HD+ 90Hz) - 고화소 50MP OIS 카메라 적용으로 어두운 곳에서 흔들림 없는 선명한 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용 및 25W 초고속 충전 지원 <input type="checkbox"/> Galaxy A13 LTE (2022.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ (2408 x 1080) 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.4mm x 165.1mm x 8.8mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : Exynos850, Android 12, One UI Core 4.1 - 6.6" FHD+ 디스플레이 적용하여 전작(A12 6.5" HD+)비 향상된 대화면 경험 제공 - 50MP 카메라 적용하여 전작(A12 48MP)비 고화소 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 고용량 배터리 및 AI Power mode 적용하여 1회 충전으로 2 Days 사용 가능 <input type="checkbox"/> Galaxy A73 5G (2022.04.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.7" FHD+ Super AMOLED+ (1080 x 2400) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.1mm x 163.7mm x 7.6mm, 181g - Platform(H/W, S/W) : SDM778G, Android 12, One UI 4.1 - 108MP 고해상도 화질 및 OIS 지원으로 선명하면서도 어두운 곳에서 흔들림 없는 사진 촬영 가능 - 120Hz 고주사율과 sAMOLED display 적용으로 부드럽고 선명한 화면 경험 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 초고속 충전 지원 - Gorilla Glass 5 및 IP67등급 적용으로 강력한 내구성 제공 - One UI 4.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공

			<p>□ Galaxy A53 5G (2022.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.5" FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 74.8mm x 159.6mm x 8.1mm, 189g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1280, Android 12, One UI 4.1 - 8.1t 슬림 디자인 및 5,000mAh 대용량 배터리 적용 (전작比 0.3t↓, 500mAh↑) - 120Hz 고주사율과 빠른 반응속도의 sAMOLED 조합이 제공하는 부드럽고 선명한 화면 경험 - Gorilla Glass 5 적용으로 Glass 내구성 향상 - One UI 4.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공 <p>□ Galaxy A33 5G (2022.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.4" FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 74.0mm x 159.7mm x 8.1mm, 186g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1280, Android 12, One UI 4.1 - 6.4" FHD+ 디스플레이, 90Hz 지원으로 향상된 화면 경험 제공 (전작 A32-5G HD+ TFT 60Hz) - 48MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 - Gorilla Glass 5 적용, IP67 등급의 방수&방진 지원으로 내구성 향상 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 초고속 충전 지원 <p>□ Galaxy A23 5G (2022.09.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ TFT LCD (1080 x 2408) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.9mm x 165.4mm x 8.4mm, 197g - Platform(H/W, S/W) : SDM695, Android 12, One UI 4.1 - SDM695 적용하여 전작(A22-5G D700) 대비 AP 성능 강화 - 50MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 (NA 권역 OIS 미지원) - 6.6" FHD+ 적용하여 전작(A22-5G 6.6" FHD+ 90Hz) 대비 향상된 대화면 경험 제공 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 고속충전 지원 <p>□ Galaxy A14 5G (2023.01.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ TFT LCD (2408 x 1080) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.0 x 167.7 x 9.1mm, 201g - Platform(H/W, S/W) : D700/Exynos1330, Android 13, One UI core 5.0 - 전작 (A13-5G) 대비 고사양 Front camera 적용으로 고화소 사진촬영 가능 (5MP → 13MP) - 6.6" FHD+ 대화면 디스플레이 적용으로 전작(A13-5G 6.5" HD+) 대비 향상된 화면 경험 제공 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용 <p>□ Galaxy A54 5G (2023.03.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.4" FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.7 x 158.2 x 8.2mm, 202g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1380, Android 13, One UI 5.1 - AP 화질 개선 기능, 조도별 튜닝 세분화 및 1000nit 적용을 통한 시인성 향상 - 120Hz 최적의 주사율 제공을 통한 성능 및 배터리 효율 극대화 - Linear 모터의 정교한 진동 조절을 통한 풍부한 Haptic 경험 제공 - Balanced Design 및 Premium CMF 강화 (6.4", 19.5:9 적용) - One UI 5.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공 <p>□ Galaxy A34 5G (2023.03.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.1 x 161.3 x 8.2mm, 199g - Platform(H/W, S/W) : D1080, Android 13, One UI 5.1 - 6.6" FHD+, 1,000nit 휘도, 120Hz 주사율 지원으로 향상된 화면 경험 제공 - 48MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 - Linear Motor 탑재하여 플래그십 수준의 햅틱 경험 제공
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>□ Galaxy A14 (2023.03.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ TFT LCD (2408 x 1080) 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.0 x 167.7 x 9.1mm, 201g - Platform(H/W, S/W) : Exynos850/G80, Android 13, One UI core 5.1 - 전작 (A13) 대비 고사양 Front camera 적용으로 향상된 Selfie 경험 제공 (8MP → 13MP) - 5,000mAh 대용량 배터리 적용 <p>□ Galaxy A24 (2023.05.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.5" FHD+ sAMOLED U-Cut (1080 x 2340) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 77.6mm x 162.1mm x 8.3mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : G99, Android 13, One UI core 5.1 - 전작(A23) 대비 고사양 Front camera 적용으로 향상된 Selfie 경험 제공 (8MP →13MP) - 신규VDIS 적용으로 OIS와 함께 진보된 흔들림 없는 비디오 제공 - 전작(A23) 대비 야외 시인성 향상, 넓어진 색대역 등으로 밝고 편리한 화면 경험 제공 <p>□ Galaxy A05s (2023.10.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.7" FHD+ TFT LCD U-cut (1080 x 2400) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 77.8mm x 168.0mm x 8.8mm, 194g - Platform(H/W, S/W) : SDM680, Android 13, One UI core 5.1 - LTE Entry 시장 물량 및 M/S 견인 - 전작 A04S 비 고성능 AP 탑재 (Exynos850 8nm → SDM680 6nm), 고사양 Front Camera 적용 (5MP → 13MP) - Global 5,000mAh 대용량 배터리 적용 및 급속25W 충전 지원 (15W → 25W) <p>□ Galaxy A05 (2023.10.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.7" HD+ TFT LCD U-cut (720 x 1600) 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.2mm x 168.8mm x 8.8mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : G85, Android 13, One UI Core 5.1 - 6.7" 대화면과 50MP 고화소 카메라 지원으로 향상된 멀티미디어 경험 제공 - 고성능 AP 탑재하여 고객의 제품 사용성 향상 (전작비 CPU 33%↑, GPU 150%) - 25W 고속으로 30분 충전하여 장시간 사용할 수 있는 배터리 <p>□ Galaxy A25 5G (2024.01.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.5" FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 120Hz - 사이즈(W x H x D) : 76.5 x 161.0 x 8.3 mm, 197g - Platform(H/W, S/W): Exynos 1280, Android 14, One UI 6.0 - 6.5" FHD+, 120Hz 주사율을 지원하여 향상된 화면 경험 제공 - 50MP OIS 광각 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용 <p>□ Galaxy A15 (2024.01.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.5" FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 90Hz - 사이즈(W x H x D) : 76.8 x 160.1 x 8.4 mm, 200g - Platform(H/W, S/W): [5G] D6100+ / [LTE] G99, Android 14, One UI 6.0 - 전작(A14) 대비 디스플레이 업그레이드를 통한 화질 향상 (LCD → Super AMOLED) - 25W 고속 충전 가능한 5,000mAh 대용량 배터리 탑재 - Knox Vault 지원으로 보안 및 사생활 보호 강화 <p>□ Galaxy A55 5G (2024.03.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 120Hz - 사이즈(W x H x D) : 77.4 x 161.1 x 8.2 mm, 213g - Platform(H/W, S/W): Exynos 1480, Android 14.0, One UI 6.1 - 강화된 카메라 센서 및 AP로 더 완벽해진 Nightography와 비디오 촬영 경험 제공
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> - Metal + Glass 적용, Young & Energetic한 CMF 구현으로 디자인 경쟁력 강화 - 6.6" FHD+ 대화면 디스플레이 적용으로 향상된 화면 경험 제공 (전작 A54-5g 6.4") <p><input type="checkbox"/> Galaxy A35 5G (2024.03.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 120Hz - 사이즈(W x H x D) : 78.0 x 161.7 x 8.2 mm, 209g - Platform(H/W, S/W): Exynos 1380, Android 14.0, One UI 6.1 - HID(Hole In Display), Back Glass 적용하여 디자인 차별화 - Knox Vault로 보안을 강화하고, OS UP 4회 및 Security MR 5회 지원하여 품질 보증 확대 <p><input type="checkbox"/> Galaxy A06 (2024.09.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - A05 후속 최저가 LTE 모델로 Entry Seg 물량 확대 - 인치 : 6.7" HD+ TFT LCD (1600 x 720) 60Hz - 사이즈(W x H x D) : 77.3 x 167.3 x 8.0 mm, 189g - Platform(H/W, S/W): G85, Android 14, One UI 6.1 - 대화면 Slim 디자인 (두께 8.00mm) 적용 - 측면 지문 지원 및 Samsung Knox Vault 보안솔루션 탑재로 데이터 보안 강화
		Galaxy북 (~2024.09.)	<p><input type="checkbox"/> Galaxy Book2 Pro 360 (2022.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 15.6" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% <li style="padding-left: 40px;">13.3" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 354.85 x 227.97 x 11.9mm, 1.41kg <li style="padding-left: 40px;">13.3" 302.5 x 202 x 11.5 mm, 1.04kg - Platform, OS : Intel® Core™ Processor (12세대), Windows 11 - sAMOLED : Default 370nit/HDR 500nit, Color volume 120% - S Pen & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing 지원) - SSD : Gen4 SSD, Expendable SSD (M.2 2230) - WiFi 6E 지원 - Battery : 15.6" 68Wh (21hrs), 13.3" 63Wh (21hrs) - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control 등 · QR Sign-in : 폰에 사용중인 계정과 연동된 QR 인식으로 Galaxy북에 로그인 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원 <p><input type="checkbox"/> Galaxy Book2 Pro (2022.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 15.6" FHD AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% <li style="padding-left: 40px;">13.3" FHD AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 355.4 x 225.8 x 11.7mm, 1.11kg <li style="padding-left: 40px;">13.3" 304.4 x 199.8 x 11.2mm, 0.87kg - Platform, OS : Intel® Core™ Processor (12세대), Windows 11 - AMOLED : Default 400nit/HDR 500nit, Color volume 120% - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing 지원) - SSD : Gen4 SSD, Expendable SSD (15.6" Only, M.2 2280) - WiFi 6E, 5G Sub6 (15.6" Only) 지원 - Battery : 15.6" 68Wh (21hrs), 13.3" 63Wh (21hrs) - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control 등 · QR Sign-in : 폰에 사용중인 계정과 연동된 QR 인식으로 Galaxy북에 로그인 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원 <p><input type="checkbox"/> Galaxy Book2 Go 5G (2022.12.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 14" IPS (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) : 323.9mm x 224.8mm x 15.5mm

			<ul style="list-style-type: none"> - Platform : Snapdragon 7C+ Gen 3, Window 11 - 7C+ Gen3 적용 Mass WoA 제품 개발 (Snapdragon 7C Gen 2 대비 CPU 63%↑, GPU 102%↑) - Display 화질개선 (TN →IPS) - WiFi 6E, 5G Sub6 지원 - 보급형 ENDC/eSIM지원 5G 모델 도입 - 45W 충전 지원 - MIL-STD-810H 8개 항목 보증 • Shock, High/Low Temperature, Thermal Shock, Dust, Vibration, Low pressure, Humidity <hr/> <p>□ Galaxy Book2 Pro 360(2023) (2022.12.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 13.3" FHD AMOLED (16:9), Touch Screen, Color Volume(DCI-P3) 100%, S Pen - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 13.3" 302.5 x 202.0 x 11.5mm, 1.04kg - Platform, OS : Snapdragon 8cx Gen 3, Windows 11 Home - AMOLED : 13.3" FHD Super AMOLED (16:9), Color Volume(DCI-P3) 100%, up to 370nit, S Pen - Speakers : Stereo 2 x 4W (Smart AMP), AKG, Dolby Atmos - SSD : eUFS on board, 256GB - WiFi 6E (802.11ax) - Battery : 63Wh (Video Play 35hrs↑) - Galaxy ecosystem : Smart Switch, Samsung Account, Samsung Apps, Keyboard & Touch Pad Sharing between Galaxy devices - Security : 지문 인식, Secured Core PC (Level 3, H/W & F/W Protection) - AI : Noise Reduction, Video Call with Neural Engine <hr/> <p>□ Galaxy Book3 Ultra (2023.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16.0" OLED 120Hz, 370nit/500nit, 16:10 (2880 x 1800, 3K) - 사이즈(W x D x H) : 355.4 x 250.5 x 16.5mm, 1.79kg. - Intel® Core™ Processor (13세대), Win 11, LPDDR5, NVIDIA® GeForce RTX™ 4050/4070, 76W Battery, FHD MIPI Camera, A/C/D AI, B Glass, TA 100W - 13세대 Intel® Core™ H-프로세서와 차세대 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 시리즈 그래픽 적용 - WQXGA+를 적용한 3K 고해상도 디스플레이, 컬러 볼륨 120% - 39% 더 넓어진 터치 패드 (Galaxy 북2 Pro 33.7 cm / 39.6cm 대비) - 100W 고속 충전, 30분 충전 시 55% 충전 가능 - Quad Speaker : AKG와 Dolby Atmos 적용 - Galaxy Ecosystem 적용 • Multi Control : 키보드와 마우스를 스마트폰, 탭에서도 사용할 수 있고, 기기 간 파일을 옮기거나, 문서/이미지의 복사, 붙여넣기도 가능 • Second Screen : Galaxy Tab을 듀얼 모니터처럼 활용, PC 화면 확장 또는 복제 가능 • Quick Share : 폰/태블릿 등 Galaxy 기기 간 무선 파일 공유 <hr/> <p>□ Galaxy Book3 Pro 360 (2023.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16.0" WQXGA+ AMOLED (16:10) 2880 x 1800, Touch Screen, DCI-P3 120%, S Pen - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16.0" 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.66kg - Platform, OS : Intel® Core™ Processor (13세대), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - S Pen & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Quad SPK(AKG/Dolby, Max_5Wx2, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic - SSD : Gen4 SSD - WiFi 6E 지원
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> - Battery : 76Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
		<input type="checkbox"/> Galaxy Book3 Pro (2023.02.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16" WQXGA+ AMOLED (16:10), up to 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% 14" WQXGA+ AMOLED (16:10), up to 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16" 355.4 x 250.4 x 12.5mm, 1.56kg 14" 312.3 x 223.8 x 11.3mm, 1.17kg - Platform, OS : Intel® Core™ Processor (13세대), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880 x 1800), 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Quad SPK(AKG/Dolby, Max_5Wx2, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic - SSD : Gen4 SSD, Expendable SSD (M.2 2280) - WiFi 6E 지원 - Battery : 16" 76Wh, 14" 63Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy Book3 360 (2023.02.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 15.6" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), DCI-P3 120% 13.3" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), DCI-P3 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 355.4 x 228.0 x 13.7mm, 1.49kg 13.3" 304.4 x 202.0 x 12.9 mm, 1.16kg - Platform, OS : Intel® Core™ Processor (13세대), Windows 11 - sAMOLED: 1080p FHD, 500nit(HDR), 60Hz, DCI-P3 120% - S Pen & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Stereo SPK(Dolby, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic - SSD : Gen4 Dramless SSD, Expendable SSD (15.6") - WiFi 6E 지원 - Battery : 15.6" 68Wh, 13.3" 61.1Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy Book4 Ultra (2024.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16" WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective - 사이즈(W x D x H) & 무게 : 355.4 x 250.4 x 16.5mm, 1.86kg - Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR) - 그래픽 : NVIDIA® GeForce RTX™ 4050/4070 - AKG 쿼드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera - Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD - Bluetooth v5.3, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2 - Battery : 76Wh(Typical) 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy Book4 Pro 360 (2024.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16" WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective, S펜 지원 - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.66kg - Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR), S펜 	

		<ul style="list-style-type: none"> - 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics - AKG 퀴드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera - Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD - Bluetooth v5.3, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2 - Battery : 76Wh(Typical)
		<input type="checkbox"/> Galaxy Book4 Pro (2024.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective 14"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16"355.4 x 250.4 x 12.5mm, 1.56kg 14"312.3 x 223.8 x 11.6mm, 1.23kg - Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR) - 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics - AKG 퀴드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera - Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD - Bluetooth v5.3, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2 - Battery : 16"76Wh, 14"63Wh (Typical)
		<input type="checkbox"/> Galaxy Book4 Edge (2024.06.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective 14"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16"355.4 x 250.4 x 12.3mm, 1.55kg 14"312.3 x 223.8 x 10.9mm, 1.16kg - Platform, OS : Qualcomm Snapdragon X Elite (12 core), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K (2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 400nit (HDR) - 그래픽 : Qualcomm Adreno - 퀴드 스피커 (16"우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2 / 14"우퍼 Max 4W x 2, 트위터 2.7W x 2), Dolby Atmos, 2M Camera - Memory, SSD : 16"16GB, eUFS 512GB, 1TB / 14"16GB, eUFS 512GB - Bluetooth v5.3, WiFi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be - Battery : 16"60.6Wh, 14"55.9Wh - Next Gen AI PC 시장 선도를 위한 AI 기능 탑재
		<input type="checkbox"/> Galaxy Book5 Pro 360 (2024.09.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective, 스펀 지원 - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.69kg - Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR), 스펀 - 그래픽 : Intel® Arc™ Graphics - 퀴드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 3.3W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M Camera - Memory, SSD : LPDDR5X, NVMe SSD - Bluetooth v5.4, WiFi 7, 802.11 be 2x2 - Battery : 76Wh(Typical)
	Galaxy 워치 (~2024.07.)	<input type="checkbox"/> Galaxy Watch5 & Galaxy Watch5 Pro (2022.08.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : Watch5 Pro (46mm) : 34.6mm AMOLED (450 x 450) 330PPI Watch5 (44mm) : 34.6mm AMOLED (450 x 450) 330PPI Watch5 (40mm) : 30.4mm AMOLED (396 x 396) 330PPI - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Watch5 Pro (46mm) : 45.4 x 45.4 x 10.5 mm, 46.5g Watch5 (44mm) : 44.4 x 43.3 x 9.8 mm, 33.5g

			<p style="text-align: center;">Watch5 (40mm) : 40.4 x 39.3 x 9.8 mm, 28.7g</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W) : Exynos W920, Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 3.5) - 사파이어 크리스탈 디스플레이 적용한 시그니처 원형 디자인 - 진화된 바이오엑티브 센서 탑재로 더 강력해진 통합 건강 관리 기능 <ul style="list-style-type: none"> · 체성분, 심박, 혈압, 심전도 정확도 개선 및 수면 관리 기능 강화 - Wear OS 기반의 'One UI Watch 4.5' 탑재하여 다양한 구글 모바일 서비스와 앱 활용 - 프리미엄 소재 티타늄 바디, 향상된 GPS 성능으로 아웃도어 스포츠에 최적화 (Watch5 Pro) <ul style="list-style-type: none"> · 기능 향상과 내구성 제고하여 하이킹/사이클링과 같은 아웃도어 스포츠 활용도 제고 · 마그네틱 D-버클 스포츠 밴드 제공하여 내구성, 편의성 및 스타일리시한 모습 연출 · 경로운동(Route Workout) 및 GPX(GPS Exchange Format) 파일 이용한 운동경로 저장 및 공유 · 트랙백(Track back) 기능 통해 지나왔던 길찾기 제공 · 큰 용량 배터리(590mAh) 적용으로 장시간 아웃도어 활동 가능 <p>□ Galaxy Watch6 / Galaxy Watch6 Classic (2023.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : Watch6 Classic (47mm) : 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) <div style="margin-left: 40px;">Watch6 Classic (43mm) : 33.3mm Super AMOLED (432 x 432)</div> <div style="margin-left: 40px;">Watch6 (44mm) : 37.3mm Super AMOLED (480 x 480)</div> <div style="margin-left: 40px;">Watch6 (40mm) : 33.3mm Super AMOLED (432 x 432)</div> - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Watch6 Classic (47mm) : 46.5 x 46.5 x 10.9 mm, 59.0g <div style="margin-left: 40px;">Watch6 Classic (43mm) : 42.5 x 42.5 x 10.9 mm, 52.0g</div> <div style="margin-left: 40px;">Watch6 (44mm) : 44.4 x 42.8 x 9.0 mm, 33.3g</div> <div style="margin-left: 40px;">Watch6 (40mm) : 40.4 x 38.8 x 9.0 mm, 28.7g</div> - Platform(H/W, S/W) : Exynos W930, Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4) - 시인성 향상을 구현한 디자인과 성능 <ul style="list-style-type: none"> · 전작 대비 베젤 축소 및 약 20% 넓어진 대화면 구현 · 고해상도 Super AMOLED 디스플레이 탑재 및 최대 2,000니트 밝기 지원 - 강화된 수면 관리 경험 제공 <ul style="list-style-type: none"> · 수면 점수를 구성하는 요인을 항목별 심층 분석 및 종합하여 수면 점수 제공 · 향상된 맞춤형 수면 코칭 프로그램 제공 - 보다 개인화된 피트니스 관리 기능 등 신기능 추가 <ul style="list-style-type: none"> · 심폐 역량에 따라 5가지 심박수 구간 측정으로 사용자에 개인화된 운동 가이드 제공 · 트랙 달리기 기능으로 레인 지정 등 트랙 운동 기록 · 불규칙 심장 리듬 알림 기능 적용 - One-Click 밴드 적용으로 보다 쉽고 편리하게 워치 스트랩 교체 - 배터리 용량 확대로 실사용 성능 강화 <ul style="list-style-type: none"> · 47/44mm 425mAh, 43/40mm 300mAh 적용 <p>□ Galaxy Watch7 / Galaxy Watch Ultra (2024.07.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : Watch7 (44mm) 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) <div style="margin-left: 40px;">Watch7 (40mm) 33.3mm Super AMOLED (432 x 432)</div> <div style="margin-left: 40px;">Watch Ultra (47mm) 37.3mm Super AMOLED (480 x 480)</div> - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Watch7 (44mm) 44.4 x 44.4 x 9.7 mm, 33.8g <div style="margin-left: 40px;">Watch7 (40mm) 40.4 x 40.4 x 9.7 mm, 28.8g</div> <div style="margin-left: 40px;">Watch Ultra (47mm) 47.1 x 47.4 x 12.1 mm, 60.5g</div> - Platform(H/W, S/W): Exynos W1000(5Core,3nm), Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 5) - 강력한 하드웨어로 높은 사용성 제공 <ul style="list-style-type: none"> · 3나노 프로세서 탑재하여 빠른 CPU 속도와 소모 전류 효율 개선 · 이중 주파수 GPS 시스템 탑재하여 복잡한 환경에서의 GPS 정확도 개선 - 강화된 건강 모니터링 제공
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> · 최종당화산물 지표(AGEs Index) 측정 제공 · 수면 무호흡 감지 및 개선된 수면 AI 알고리즘 적용하여 정확한 수면 측정 지원 - 극대화된 성능을 통해 차원 높은 아웃도어 피트니스 경험 제공 (Ultra only) · 시그니처 원형 디자인에 새로운 쿠션 디자인 가미 · 다이내믹 러그 시스템 적용으로 쉬운 체결과 완벽한 착용감 제공 · 10ATM 방수 지원 등 극한 환경에서 다양한 피트니스 활동 측정 · 긴 배터리 수명 제공 : 절전모드 100시간, 운동 중 절전모드 48시간 사용 가능 - 배터리 : 47mm 590mAh, 44mm 425mAh, 40mm 300mAh 적용
	Galaxy 버즈 (~2024.07.)	<input type="checkbox"/> Galaxy Buds 2 Pro (2022.08.) <ul style="list-style-type: none"> - 24bit 고품질 Hi-Fi 사운드와 편안한 착용감을 제공하는 커널 타입 Premium TWS - 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 21.6mm x 19.9mm x 18.7mm (Cradle) 50.2mm x 50.1mm x 27.7mm - Platform(H/W, S/W) : BES2700YP 1Chip 솔루션, RTOS · 당사 Buds 최초 24bit/48kHz Hi-Fi 기술 적용하여 원본 음질 손실을 최소화한 고품질 사운드 경험에 High-SNR MIC, 소음 제거 솔루션과 대화 감지 기술을 적용한 Intelligence ANC · 멀티 채널 오디오와 향상된 헤드 트래킹 기술을 통해 현장감 있는 360 Audio 청취 경험 강화 · 개선된 VPU와 개인화 Beamforming 기술을 통해 또렷하고 향상된 통화 음질 제공 - 인체공학적 디자인을 통해 편안하고 안정감 있는 착용감 제공 · 전작 대비 15% 작아진 기기 사이즈와 개선된 통기홀 구조를 적용하여 착용감 개선 - Galaxy Device 간 쉬운 연결을 통한 사용 경험 강화 · 오토 스위치 기능 제공을 폰, 태블릿, 위치에서 TV로 확장하고 쉽고 빠르게 기기 전환 <input type="checkbox"/> Galaxy Buds3 Pro / Buds3 (2024.07.) <ul style="list-style-type: none"> - 신규 Stem 디자인을 통한 착용성 개선 · 차별화된 Futuristic Blade 디자인으로 선명성 확보 - 오디오 기기 특성을 반영한 시를 통해 개인 맞춤형 사운드 경험 제공 · 주변 환경에 따른 소음 최적화 및 착용 상태에 따른 실시간 사운드 최적화 - 통역 듣기 모드 지원을 통한 자유로운 소통 경험 제공 - 사이즈(H x W x D) : Buds3 Pro 18.1 x 19.8 x 33.2 mm, 5.4g Buds3 18.1 x 20.4 x 31.9 mm, 4.7g Cradle 48.7 x 58.9 x 24.4 mm, 46.5g - Platform(H/W, S/W) : BES2800(6nm)/BES2700(14nm), RTOS - 오디오 음질 개선 · 24bit/96kHz UHQ 지원 *Buds2 Pro(24bit/48kHz Hi-Fi) · Buds3 Pro 분리형 2 Way Speaker 적용 · Adaptive EQ 지원 *Buds2 Pro(Fixed EQ) - 설계 최적화를 통한 통화 품질 개선 · Complex DNN/VPU 솔루션 적용으로 음성 명료도 강화 · Super Wide Band 통화 지원으로 음성 대역폭 강화 - Cradle 버튼 Pairing 적용으로 직관적인 동작 경험 제공 - Intelligence 기능 경험 강화 · Buds3 Pro Siren/Voice Detect 및 Adaptive Noise Control 지원 - 배터리 : Buds3 Pro 53mAh, Buds3 48mAh, Cradle 515mAh
	Galaxy 링 (2024.07.)	<input type="checkbox"/> Galaxy 링 (2024.07.) <ul style="list-style-type: none"> - 일상 중 항시 착용 가능한 디자인으로 Galaxy Health 경험 확장 - 사이즈 : 9종 (5호 ~ 13호) - 크기 & 무게 : (Ring) 7.0(W) x 2.6 mm(D), 2.3g(5호) ~ 3.0g(13호)

			<p>(Cradle) 48.9(W) x 48.9(H) x 24.5 mm(D), 61.3g</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W) : nRF5340, Zephyr RTOS - 24/7 상시 착용에 용이한 디자인 및 배터리 사용시간 <ul style="list-style-type: none"> · 슬림하고 가벼운 디자인으로 편안한 착용감 · 한번 충전하면 최대 7일 사용으로 건강 정보 지속 측정 가능 * 5호 18mAh ~ 13호 23.5mAh - 티타늄 소재 및 10ATM, IP68 방수 적용으로 내구성 강화 - 개인 맞춤형 건강 관리 기능 제공 <ul style="list-style-type: none"> · 개인의 컨디션 관리를 위한 지표 및 개인화된 인사이트 메시지 제공 · 고도화된 수면 분석 및 코칭 지원 · 고/저심박수 알림, 자동 운동 감지 등 일상 활동에 대한 모니터링 - Galaxy 사용자 차별화된 사용 경험 제공 <ul style="list-style-type: none"> · 단말과 연계된 Easy Pairing, 제스처 컨트롤, 링 위치 찾기 지원 · 위치와 동시 착용 시 사용시간 개선 등 최적의 사용성 제공
		<p>RAN S/W Package (~2024.06.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> vRAN* SW Package (2023.11.) <ul style="list-style-type: none"> * vRAN(virtualized RAN):가상화 기지국 - 당사 vRAN SW Package에 1차 4세대 CPU 연동 개발로 업계 최초 vRAN 상용망 적용 · 당사는 3세대 CPU를 활용한 vRAN 대규모 상용을 既완료한데 이어, 4세대 CPU를 적용한 vRAN으로 상용망에서 data call 성공 <input type="checkbox"/> 5G vRAN SW PKG (2024.06.) <ul style="list-style-type: none"> - RedCap Energy-saving 기능 시험 완료(5G IoT 디바이스의 전력 소모를 줄이는 기능 시험) · 업계 최초로 vRAN 기반 5G RedCap Energy-saving 기술 시험 완료 · 당사는 vRAN RedCap 기술 검증(美 vRAN 상용망 등)을 이어오고 있으며, 향후 tRAN, vRAN 모두 상용 기능 제공할 계획 * RedCap(Reduced Capability) : 5G 저전력 사물 인터넷(IoT) 기술
	<p>네트워크</p>	<p>기지국 (~2024.08.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 국내 3.5GHz NR 32T32R TDD MMU (2022.02.) <ul style="list-style-type: none"> - 당사 최초 Mechanical PSA(Phase Shift Antenna) 적용 * 안테나 기울기(Tilt 0~12°)를 MMU 내부에서 Motor로 자동 제어 <input type="checkbox"/> 고성능 RFIC + DFE 통합 Chip 개발 (2022.04) <ul style="list-style-type: none"> * RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit): 무선통신에 적합한 고주파 집적 회로 * DFE(Digital Front End): 통신을 위한 Digital 신호처리의 마지막 단계 <input type="checkbox"/> Dish향 FDD RU 2종(Dual Band/Tri Band RU) (2022.09) <ul style="list-style-type: none"> - ORAN 표준을 준수하고 여러 주파수 대역을 동시에 지원하는 5G FDD RU 제품 개발 * RU 지원 주파수 : n71(600MHz), n29(700MHz), n66(AWS: 1.7GHz/2.1GHz), n70(AWS: 1.7GHz/1.9GHz) <input type="checkbox"/> Gen.3 Dual Band NR 2T2R AU (2022.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 세계 최초 Dual Band(28GHz+39GHz) AU 개발 - 기존 2세대 AU 대비 동일 사이즈에 출력 2배 향상, 용량 2배 확대로 제품 성능 개선 <input type="checkbox"/> 국내 3.5GHz NR 64T64R MMU (2022.11.) <ul style="list-style-type: none"> - 국내向 최초 상용 64T64R Massive MIMO MMU 개발 - 기존 국내向 32T32R MMU(구형) 대비 Antenna Element 2배 증가, 출력 2.7배 증가 <input type="checkbox"/> 3.5GHz CBRS NR Strand Smallcell (2023.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 당사 최초 상용 Strand Smallcell(전선 설치형 소형 기지국) 개발 - Digital Unit, Radio Unit, 안테나 기능을 하나의 form factor로 제공하는 기지국 - 당사가 자체 개발한 최신 2세대 5G 모뎀칩(5G Modem SoC) 탑재하여, 전선 위 설치 가능하도록 소형화 <input type="checkbox"/> 북미向 C-band NR 64T64R MMU (2023.05.) <ul style="list-style-type: none"> - 1세대 대비 고출력화, 소형화, 경량화, 저전력화 개발

			<ul style="list-style-type: none"> □ 캐나다 n77(3.4~3.8GHz) NR 64T64R 신규 MMU (2024.08.) <ul style="list-style-type: none"> - 새로운 구조의 New PAM(Power Amplifier Module : 전력 증폭기 모듈) 적용한 고효율의 New MMU 플랫폼 제품 개발 - 기존 제품대비 Wideband 지원(고효율)으로 고효율, 저전력을 요구하는 글로벌 시장 진입이 가능해져 5G 시장 확대에 기여 * Wideband 지원: 넓은 주파수 대역 사용으로 많은 양의 데이터 동시 전송으로 전송속도가 빠름
DS 부문	메모리	모바일용 DRAM (2023.09. ~2024.07.)	<ul style="list-style-type: none"> □ 업계 최초 LPCAMM 개발 (2023.09.) <ul style="list-style-type: none"> - LPDDR 기반 모듈 개발로 PC·노트북 등 차세대 모듈 시장 선도 - SO-DIMM 대비 성능 50%↑ 전력 효율 70%↑ 탑재 면적 최대 60% 이상↓ 가능 및 교체·업그레이드 용이하여 제조 유연성 및 사용자 편의성 증대 - 주요 고객사와 차세대 시스템에서 검증 예정, 2024년 상용화 추진 및 차세대 PC·노트북부터 데이터센터 등으로 응용처 확대 기대 □ 미디어택과 업계 최고 속도 LPDDR5X 동작 검증 성공 (2024.07.) <ul style="list-style-type: none"> - 미디어택 최신 플래그십 모바일AP '디멘시티'에 검증 완료로 고성능 제품 상용화 선도 - 온디바이스 AI 시대에 저전력·고성능 LPDDR D램 역할 증대 - 모바일 분야 넘어 AI 가속기, 서버, HPC, 오토모티브 등 응용처 적극 확대
		서버용 DRAM (2022.12. ~2023.09.)	<ul style="list-style-type: none"> □ 업계 최선단 12나노급 D램 개발 (2022.12.) <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최초로 '12나노급 16Gb DDR5 D램' 개발, 차세대 컴퓨팅 서비스에 최적화된 '고성능·저전력' 특성 확보 - 기존 대비 소비전력 약 23% 감소, 생산성 약 20% 향상 - 2023년 양산 돌입으로 고객의 차세대 시스템에 최적의 메모리 솔루션 제공, 데이터센터, 인공지능, 차세대 컴퓨팅 등 응용처 확산 기대 □ 업계 최선단 12나노급 D램 양산 (2023.05.) <ul style="list-style-type: none"> - 14나노 D램 대비 생산성 향상 및 저전력 특성 개선으로 생산성 약 20% 향상, 소비전력 약 23% 감소로 차세대 컴퓨팅 최적화 - 고유전율 신소재 적용 커패시터 등 최신 기술 적용 최선단 공정 완성 - 대용량 컴퓨팅 시장 수요에 맞는 고성능, 고용량 D램 솔루션 제공 및 12나노급 D램 라인업 확대해, 다양한 응용처에 공급 예정 □ 현존 최대 용량 32Gb DDR5 D램 개발 (2023.09.) <ul style="list-style-type: none"> - 1983년 64Kb D램 개발 40년만에 용량 50만배 확대 - TSV 공정 적용 없이 128GB 모듈 제작 가능 및 12나노급 16Gb 기반 동일 용량의 모듈 대비 소비 전력 10% 개선 - AI에 최적화된 고용량 D램 솔루션 제공, 1TB 모듈 구현 가능 - 연내 양산 예정으로AI, 차세대 컴퓨팅 등 다양한 응용처 공급 예정
		그래픽 DRAM (2022.07. ~2023.07.)	<ul style="list-style-type: none"> □ 업계 최고 속도 GDDR6 D램 개발 (2022.07.) <ul style="list-style-type: none"> - 3세대 10나노급(12) 공정 적용으로 업계 최초 24Gbps 구현 - 기존 제품 대비 성능 30% 이상 높여 초당 최대 1.1TB 데이터 처리, 1.1V 동작전압 지원, 전력 효율 20% 높여 다양한 고객 요구 충족 - 국제 반도체 표준화 기구 JEDEC의 표준규격 준수해 호환성 확보 - 차세대 그래픽카드, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 응용처 확대 □ 첨단 패키징 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 (2022.11.) <ul style="list-style-type: none"> - GDDR6W는 새로운 메모리 칩 다이(die)의 개발 없이 적층, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package)

		<p>기술을 통해 구현된 제품</p> <ul style="list-style-type: none"> - GDDR6와 동일한 크기의 패키지로 성능(대역폭) 2배와 용량 2배를 구현 <p>□ 업계 최초 GDDR7 D램 개발 (2023.07.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D램 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% 향상 - 패키지 신소재 적용 · 회로 설계 최적화로 고속 동작시 발열 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로 <p>차세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 응용처 확대</p>	
	<p>HBM (2022.10. ~2024.02.)</p>	<p>□ HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 시용 가속기 구현 (2022.10.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 감소 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통합된 소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 <p>□ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 (2023.10.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며, 열전도를 극대화해 열 특성을 또한 개선 - 현재 HBM3 8단, 12단 제품을 양산 중이며, 차세대 제품인 HBM3E도 고객들에게 샘플을 전달 중 <p>□ 업계 최초 36GB HBM3E 12H D램 개발 (2024.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12단 적층으로 업계 최대 용량 36GB 구현, - Advanced TC NCF 기술로 HBM3 8단과 동일한 높이로 12단 적층 구현 및 성능과 용량 모두 50% 이상 향상 - 업계 최소 7마이크로미터 칩간 간격으로 수직 집적도 개선 및 다양한 사이즈의 범프를 적용 - 고객사에 샘플 제공 시작, 상반기 양산 예정 	
	<p>NAND (2022.11. ~2024.09.)</p>	<p>□ '8세대 V낸드' 양산 (2022.11.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 세계 최고 용량의 '1Tb(테라비트) 8세대 V낸드' 양산 - 웨이퍼당 비트 집적도 대폭 향상, 업계 최고 수준 비트 밀도 확보 - 차세대 인터페이스 적용, 2.4Gbps 전송 속도 구현으로 기존대비 성능 1.2배 향상 - 차세대 서버시장 고용량화 주도, 고신뢰성을 요구하는 전장 시장까지 사업 영역 확대 <p>□ 업계 최초 '9세대 V낸드' 양산 (2024.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최초 '1Tb TLC 9세대 V낸드' 양산 - 더블 스택(Double Stack) 구조로 구현 가능한 최고 단수 V낸드 - 업계 최소 크기 두께, 차세대 인터페이스 적용 등으로 기술 리더십 증명 - 최첨단 기술로 셀 면적은 줄이면서 간섭 현상은 줄여 이전 세대 대비 비트 밀도 1.5배 증가 <p>□ 업계 최초 'QLC 9세대 V낸드' 양산 (2024.09.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9세대 V낸드 QLC, TLC 모두 업계 최초 출시로 고용량 QLC · 고성능 TLC 통해 차세대 낸드플래시 시장 경쟁력 강화 - '채널 홀 에칭' 기술로 더블 스택 구조 등 혁신 기술 집약을 통해 업계 최고 단수 제품 구현 - 브랜드 제품 시작으로 모바일 UFS, PC · 서버 SSD 등 응용처 확대 	
	<p>eStorage (2022.05.)</p>	<p>□ 업계 최고 성능 UFS 4.0 개발 (2022.05.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - UFS 3.1 제품 대비 읽기/쓰기 속도 약 2배로 개선 - 동일한 데이터 처리시, 전력효율 약 46% 향상되어 장시간 사용 가능 - 최신 보안 기술을 적용하여 고객들의 중요 데이터를 읽고 저장하는 성능 개선 	

		<ul style="list-style-type: none"> - 스마트폰, Automotive 및 VR/AR 등 컨슈머 기기로의 확대 예상
서버용 SSD (2022.07.)	<ul style="list-style-type: none"> □ 연산기능 강화한 '2세대 스마트SSD' 개발 (2022.07.) - 연산 성능 2배 향상, 처리시간 50% 이상, 에너지 70%, CPU 사용 97% - SSD 내에서 데이터 처리, 시스템 성능과 에너지 효율 동시에 향상 - 데이터베이스, 비디오 트랜스코딩 등 다양한 시장 요구에 적극 대응 - 컴퓨터이셔널 스토리지 표준화 주도, 차세대 스토리지 제품 개발 확대 	
Client SSD (2023.01.)	<ul style="list-style-type: none"> □ 5나노 기반 컨트롤러 탑재한 PC용 고성능 SSD 'PM9C1a' 양산 (2023.01.) - 5나노 기반 신규 컨트롤러와 7세대 V낸드 탑재로 성능 향상 - 기존 대비 속도 최대 1.8배, 전력 효율 최대 70% 가량 향상 - DICE 표준 신규 적용 등 보안솔루션 강화로 디바이스 인증, 증명 기술 지원 	
브랜드 SSD (2022.04. ~2024.09.)	<ul style="list-style-type: none"> □ 성능과 내구성 모두 갖춘 전문가용 포터블 SSD 'T7 실드(Shield)' 출시 (2022.04) - 방수, 방진, 최대 3미터 낙하 보호 설계 - 고화질 영상 녹화, 편집 등의 성능 저하 없이 안정적으로 데이터 전송 □ 게이밍에 최적화된 고성능 SSD '990 PRO' 공개 (2022.08) - 최신 V낸드 기술과 독자 컨트롤러로 업계 최고 수준 성능 구현 - 전작보다 속도 최대 55%, 전력 효율 최대 50% 향상 - 고성능 그래픽 게임, 4K/8K 고화질 비디오 등 초고속 데이터 처리 작업이 요구되는 환경에 최고 성능 제공 □ 고성능 SSD '990 PRO' 4TB 출시 (2023.09) - 최첨단 '8세대 V낸드' 적용 및 업계 최고 수준 성능 구현으로 PCIe 4.0 기반 소비자용 SSD 중 가장 빠른 임의 읽기 속도 제공 - 고성능 게임, 3D/4K그래픽 작업 등 초고속 데이터 처리 작업 필요한 환경에 최적화 - 단면 설계, 열 분산 시트/히트싱크 장착으로 호환성, 방열 성능 강화 □ 초고속 포터블 SSD 'T9' 출시 (2023.10.) - 최신 데이터 전송 인터페이스 'USB 3.2 Gen2x2' 지원으로 전세대 대비 연속읽기/쓰기 성능 약 2배 향상 - 대용량 파일 전송 시 발생하는 성능 저하, 발열 현상 개선을 위해 표면 소재 개선 및 S/W 최적화 □ 업계 최대 8TB 용량 포터블 SSD 신제품 'T5 EVO' 출시 (2023.11.) - USB3.2 Gen1 기반 최대 460MB/s 연속 읽기·쓰기 성능 제공 - 컴팩트한 크기와 무게와 메탈링 적용하여 휴대성 강화 - 과열 방지 기술과 하드웨어 데이터 암호화 기술을 적용 □ 성능과 범용성 모두 갖춘 소비자용 SSD '990 EVO' 출시 (2024.01.) - '970 EVO Plus' 대비 읽기·쓰기 속도 최대 43% 향상 - 5나노 신규 컨트롤러 탑재로 전력 효율 최대 70% 개선 - 차세대 인터페이스 PCIe 5.0 x2 지원 - 호스트 메모리 버퍼(HMB) 기술 적용으로 가격 경쟁력 강화 □ PCIe 4.0 기반의 고성능 소비자용 SSD '990 EVO Plus' 출시 (2024.09.) - 8세대 V낸드·5나노 컨트롤러 탑재로 전작 대비 읽기·쓰기 속도 45%, 50% 향상 및 전력 효율 70% 이상 개선 - 고용량 4TB 제품 포함 3가지 용량으로 출시로 소비자 선택지 확대 - 노트북·PC 메인보드에 장착해 성능·용량 간편하게 업그레이드 가능 - 니켈 코팅된 컨트롤러와 열 분산 라벨로 과열 방지, 제품 안정성 강화 	
CXL (2022.05. ~2024.06.)	<ul style="list-style-type: none"> □ 업계 최초 고용량 512GB CXL D램 개발 (2022.05.) - CXL D램 용량 4배 향상, 서버 한 대당 수십 테라바이트 이상 확장 가능 - CXL 전용 컨트롤러 탑재, 데이터 지연 시간 1/5로 감소 □ 고용량 AI 모델을 위한 CXL 기반의 PNM 솔루션 개발 (2022.10.) - PNM(Processing-near-Memory)은 연산기능을 메모리 옆에 위치시켜 CPU-메모리간 발생하는 	

		<p>병목현상을 줄이고 시스템 성능 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> - 높은 메모리 대역폭을 요구하는 추천 시스템이나 인-메모리 데이터베이스 등의 응용에서 약 2배 이상 성능이 향상 <p>□ 업계 최초 'CXL 2.0 D램' 개발 (2023.05.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - D램 모듈의 한계 극복, 대역폭과 용량 확장 가능 - CXL D램 영역을 분할 사용하는 '메모리 풀링' 지원으로 서버 운영비용 절감 - 데이터센터, 서버, 칩셋 기업과 지속 협력해 CXL 생태계 확장 및 차세대 컴퓨팅 시장 수요 적기 대응 <p>시장 선도</p> <p>□ 업계 최초 '레드햇 인증 CXL 인프라' 구축 (2024.06.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 삼성전자 내부 연구시설인 SMRC에 레드햇 인증 CXL 인프라 구축하여 제품부터 소프트웨어까지 모든 서버 구성 요소 자체 검증 가능 - 업계 최초 CMM-D 레드햇 인증 등 신속한 제품 개발 진행, 고객 맞춤 솔루션 제공 - 美 '레드햇 서밋 2024'에서 CXL 기반 서버 성능 향상 기술 시연
	<p>브랜드 Card (2022.05. ~2024.08.)</p>	<p>□ 성능과 내구성을 강화한 메모리카드 'PRO Endurance' 출시 (2022.05.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서버급 고품질 낸드 채용, 16년 연속 녹화 가능한 내구성 - CCTV, 블랙박스 등 고해상도(4K, 풀HD) 영상 녹화장치에 최적화 - 극한 환경에서도 안정적 녹화 성능을 유지, 6-proof 보호 적용 - 클래스 10, UHS 클래스 U3, 비디오 스피드 클래스 V30 속도 지원, 풀HD·4K 고해상도 영상 연속 촬영 <p>□ 속도와 안정성 강화한 메모리카드 'PRO Ultimate' 출시 (2023.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - UHS-I 규격 최고 수준의 200MB/s 읽기 속도, 130MB/s 쓰기 속도 지원, 기존 대비 전력 효율 37% 향상 및 방수·낙하·마모·엑스레이·온도 등 극한의 외부 환경에서도 데이터 보호 - 전문 포토그래퍼, 크리에이터 및 드론, 액션캠, DSLR 카메라 등 고해상도 콘텐츠 작업에 최적의 SD카드/마이크로SD카드 제공 <p>□ 업계 최초 SD 익스프레스 마이크로SD 카드 개발 (2024.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 마이크로SD 카드 최고 연속 읽기 성능인 초당 800 메가바이트(800MB/s)와 256GB의 고용량을 제공 - SSD에 탑재했던 DTG(Dynamic Thermal Guard) 기술을 최초 적용해 소형 폼팩터에서 발생하는 발열 문제를 효과적으로 해결 <p>□ 최신 V낸드 기반 고용량 1TB UHS-I 마이크로 SD카드 양산 (2024.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8세대 V낸드로 마이크로 SD카드에 테라바이트급 고용량 구현 - 방수, 낙하마모 등 극한 외부환경에서도 데이터를 안전하게 보호 <p>□ 고용량 1TB 마이크로SD 카드 2종 출시 (2024.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최고 용량 1Tb TLC 8세대 V낸드 적용하여 테라바이트급 고용량 구현 - 최대 용량 1TB로 고성능·고용량 솔루션에 대한 요구 충족 - 28나노 컨트롤러 탑재로 전력 효율 개선, 배터리 소모량 감소
	<p>Automotive (2023.07. ~2024.09.)</p>	<p>□ 초저전력 차량용 UFS 3.1 양산 (2023.07.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최저 소비 전력을 가진 차량용 인포테인먼트(IVI) UFS 3.1 양산으로 전기차, 자율주행차 등에 최적화 - 전 세대 제품 대비 33% 낮은 소비 전력, 256GB 기준 최대 읽기 속도 2,000MB/s, 최대 쓰기 속도 700MB/s 제공 - 고객의 다양한 요구 충족을 위한 128GB/256GB/512GB 라인업 구축으로 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)용 UFS 3.1 제품과 함께 전장 스토리지 제품 라인업 강화 <p>□ 2025년 전장 메모리 시장 1위 달성을 위한 차량용 핵심 솔루션 공개 (2023.10.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 스토리지 가상화를 통해 하나의 SSD를 분할해 여러 개의 SoC가 사용할 수 있는 'Detachable AutoSSD(탈부착 가능한 차량용 SSD)' 공개, 최대 6,500MB/s의 연속 읽기 속도를 지원

			<p>하며</p> <ul style="list-style-type: none"> 4TB 용량 제공 - 차량용 고대역폭 GDDR7 및 패키지 크기를 줄인 LPDDR5X 등도 선보임 <p>□ 퀄컴 차량용 솔루션에 'LPDDR4X' 공급 (2024.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 삼성전자-퀄컴, 차량용 반도체 분야에서 첫 협력 시작하여 스냅드래곤 디지털 새시에 공급 및 프리미엄 차량용 인포테인먼트 지원 - 영하 40℃~영상 105℃까지 극한 환경에서도 안정적 성능 보장 - 글로벌 완성차 및 자동차 부품 업체 등 고객사에 장기 공급 계획 <p>□ 업계 최초 8세대 V낸드 기반 차량용 SSD 개발 (2024.09.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 256GB SSD 샘플 고객 제공 및 차량 내 AI 기능 지원 최적화 - 8세대 V낸드?5나노 기반 컨트롤러 탑재로 업계 최고 속도 구현 - 고성능 SLC 모드 지원으로 고용량 파일 빠르게 접근 가능 - 내년 초 2TB 제품 출시로 차량용 고용량 SSD 고객 수요 대응
	System LSI	<p>이미지센서 (2022.01. ~2024.06.)</p>	<p>□ 업계 최소 픽셀 크기의 2억화소 이미지센서 공개(HP3, 0.56um/200Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 HP1(0.64um)보다 12% 작아진 픽셀 크기로 카메라 모듈 면적 최대 20% 감소 - '슈퍼 QPD' 기술로 2억개 픽셀 모두 자동 초점 가능 구현 - '테트라 스퀘어드 픽셀' 기술 활용, 저조도 환경에서도 선명한 화질 - AI기반의 화질처리 솔루션 구현으로 2억화소 화질 해상도 개선 및 5천만 화소 센서 중 활용도 향상 <p>□ 초고화소 기술 집약된 2억화소 이미지센서 출시(HP2, 0.6um/200Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최초 '듀얼 버티컬 트랜스퍼 게이트' 적용, 색 표현력 및 화질 개선 - '테트라 스퀘어드 픽셀' 기술 활용, 저조도 환경에서도 선명한 화질 - '듀얼 슬로프 게인' 적용, 업계 최초 5천만화소에서 센서 자체로 HDR 구현 - '슈퍼 QPD' 적용, 전 화소 이용 위상차 자동 초점 지원 <p>□ 업계 최고 성능 자율주행 이미지센서 출시(1H1, 2.1um/8.3Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전장 120dB HDR, LFM(LED Flicker Mitigation) 및 Motion-Artifact Free 동시 구현 - 인접 픽셀 간섭 방지 DTI(Deep Trench Isolation) 적용, 저조도 SNR 강화 <p>□ '아이소셀 비전 63D' iTOF(indirect Time of Flight) 센서 공개(63D, 3.5um/0.3Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 빛의 파장을 감지해 사물의 3차원 입체 정보를 측정 - 업계 최초 원칩 iTOF 센서 적용, 전작(33D) 대비 시스템 전력 소모량 40% 감소 - 면광원 및 점광원 모드 동시 지원하여 최대 측정거리 10미터까지 확장 <p>□ '아이소셀 비전 931' 글로벌 셔터(Global Shutter) 센서 공개(931, 2.2um/0.4Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사람 눈처럼 모든 픽셀 동시에 빛에 노출해 촬영하여 신속성 및 정확성 증가 - 사용자의 눈동자, 얼굴 표정, 손동작 같은 미세한 움직임 인식 가능 <p>□ 업계 최초 망원용 2억화소 모바일 이미지 센서 공개(HP9, 0.56um/200Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 독자 개발 신규 소재 적용 마이크로 렌즈 적용, 저조도 감도 대폭 향상 - 3배 망원 모듈 탑재시 최대 12배 zoom까지 선명한 화질 구현 <p>□ 새로운 픽셀 기술의 집약체로 듀얼 픽셀 '아이소셀 GNJ' 출시(GNJ, 1.0um/50Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - '센서 자체 줌' 기능 탑재로 잔상, 모아레 현상 없는 선명한 해상력 구현 - 픽셀 간 격벽 물질 변경으로 픽셀 간섭 현상 최소화해 빛 투과율 향상 <p>□ 모든 화각에서 일관된 카메라 경험 선사, '아이소셀 JN5' 출시(JN5, 0.64um/50Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 얇은 옵티컬 포맷 적용하여 광각, 초광각부터 전면, 망원용까지 채용 가능
		<p>엑시노스 (2022.01. ~2024.07.)</p>	<p>□ 프리미엄 모바일 AP '엑시노스 2200' 출시</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMD와 공동 개발한 차세대 GPU '엑스클립스(Xclipse)' 탑재, 게임 성능 및 전력 효율 극대화 - 업계 최초 모바일 기기에서 하드웨어 기반 '광선 추적(Ray Tracing)' 기술 구현 - ARM 최신 CPU 아키텍처 'Armv9' 기반 코어 적용하여 성능 및 보안 강화 - NPU 연산 성능 이전 대비 두 배 이상 향상, 머신러닝 성능 대폭 향상

			<p>□ 5G 기반 위성통신용 모뎀 국제 표준기술 확보(NTN: Non Terrestrial Network)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 이동통신 표준화 기술협력기구(3GPP)의 최신 표준(릴리즈-17) 반영 - 저궤도 위성 위치 예측, 주파수 오류 최소화 기술 적용 - 간단한 문자 메시지 외 영상 등 대용량 데이터 양방향 송수신 가능 <p>□ UWB기반 근거리 무선통신용 반도체 '엑시노스 커넥트 U100' 공개</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수 센티미터 이내, 5도 이하 정밀 측위 가능 - 저전력 원칙으로 모바일, 전장, 각종 IoT 기기에 최적화 - 해킹 방지 STS(Scrambled Timestamp Sequence) 기능 및 보안 HW 암호화 엔진 적용 - UWB 표준 단체 'FiRa 컨소시엄' 국제 공인 인증 <p>□ 삼성전자-AMD, 차세대 그래픽 설계자산 파트너십 확대</p> <ul style="list-style-type: none"> - 스마트폰 외 다양한 기기에서 콘솔 게임 수준의 게이밍 경험 제공 - 차세대 그래픽 솔루션 연구개발 생태계 확장 <p>□ 삼성전자, 현대자동차와 차량용 인포테인먼트 분야 첫 협력</p> <ul style="list-style-type: none"> - 프리미엄 인포테인먼트용 '엑시노스 오토 V920', 현대자동차에 공급 - 전작(V910) 대비 대폭 향상된 성능으로 운전자에게 최적의 모빌리티 경험 선사 - 차량용 시스템 안전기준인 '에이실-B' 지원 통해 높은 안정성 제공 <p>□ 최첨단 모바일 AP '엑시노스 2400' 공개</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최고 수준의 레이 트레이싱 성능, 전작 대비 2.1배 성능 향상 - 향상된 AI성능으로 인터넷 연결없이 온디바이스 생성형 AI 기능 제공 - 비직상 네트워크(NTN : Non-Terrestrial Network) 기술, 엑시노스 최초 탑재 <p>□ 삼성전자, 최신 기술 적용 모바일 AP '엑시노스 1480' 공개</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최신 4나노 공정 적용, 전작 대비 22% 개선된 전력 효율성 - 강력한 AI성능 기반으로 콘텐츠 인식 이미지 프로세싱 기능 탑재 - AMD RDNA 기반 엑스클립스 530 GPU 탑재로 전 세대 대비 그래픽 성능 향상 <p>□ 삼성전자, 최신 기술 적용 웨어러블 SOC '엑시노스 W1000' 공개</p> <ul style="list-style-type: none"> - 웨어러블 최초 3나노 공정 적용 및 Big 코어 탑재, 전작(엑시노스 W930) 대비 싱글코어 3.4배, 멀티코어 3.7배 성능 개선 - 최신 패키지(FO-PLP:Fan-Out Panel Level Packaging, SiP: System in Packaging, ePoP: embedded Package on Package) 적용으로 시스템 실장 공간 확보 극대화
		LSI (2022.01.)	<p>□ 생체인증카드용 원칩 지문인증 IC 출시(S3B512C)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 하드웨어 보안칩(SE, Secure Element), 지문 센서, 보안 프로세서 기능을 하나의 IC로 통합 - 보안 국제 공통 평가 기준(CC, Common Criteria)의 EAL6+ 등급 획득, 글로벌 온라인 카드 결제 기술표준(EMVCo) 인증 및 마스터카드의 생체 인식 평가 통과로 보안성 입증
	Foundry	세계 최초 GAA 기술 적용 3나노 공정 (2022.06.)	<p>□ 세계 최초 Gate-All-Around(GAA) 트랜지스터 기술 적용한 3나노 공정 양산</p> <ul style="list-style-type: none"> - 나노시트 활용한 독자적 GAA 기술 'MBCFET' 적용해 전력효율 및 성능 극대화 - 3나노 1세대 공정은 5나노 대비 전력 45%↓, 성능 23%↑, 면적 16%↓ <p>□ GAA는 핀펫의 기술적 한계를 극복하여 공정 미세화 지속을 가능케 하는 기술</p> <ul style="list-style-type: none"> - 채널의 모든 면을 게이트가 감싸 전류제어 특성 향상, 동작전압 및 전력소모 감소 - 채널을 수직 적층한 구조로 단위 면적당 채널폭 및 전류량이 증가하며 성능 향상 - 채널 폭을 조절할 수 있어 설계 자유도 향상 <p>□ 에코시스템 파트너들과 검증된 3나노 설계 인프라 및 서비스 제공 중</p> <p>□ 고성능·저전력HPC용 시스템 반도체, 모바일SOC 등에 적용 확대 계획</p>
SDC	디스플레이 패널	55/65" QD-Display (2022.01.)	<p>□ 세계 최초 TV형 QD-Display (55" UHD, 65" UHD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - BT2020 90% 업계 최고의 넓고 선명한 색 표현 - 전방위 균일하게 빛을 발하는 QD 특성으로 어느 각도에서도 최고의 휘도와 색감 구현 - 뛰어난 HDR 성능, 깊고 디테일한 Black 표현

		34" QD-Display (2022.03.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 모니터형 QD-Display (34" QHD) - 175Hz, 0.1ms, 1800r, HDR True Black, G-Sync 지원으로 최고의 게이밍 경험 제공 - 뛰어난 색, 시야각, 명암비 특성 및 유해 블루라이트를 최소화
		Galaxy Z Fold4용 폴더블 OLED개발 (2022.08.)	<input type="checkbox"/> 전작비 추가적인 개선 진행 - 카메라 성능을 유지하면서 Under Panel Camera 영역 시인성 크게 개선, 대화면 경험 강조 - 투과율이 개선된 에코스퀘어 플러스(Eco2 OLED Plus)로 에너지 효율 증가 - FRP(Fiber Reinforced Plastics)-Digitizer 일체형을 통한 원가 및 무게 저감
		Galaxy북3 프로용 14/16" OLED개발 (2023.02.)	<input type="checkbox"/> 세계최대 Size (16") OCTA 기술 최초 상품화 - 기존 스마트폰에 적용했던 Touch 일체형 기술인 OCTA 기술을 중형 노트북용 OLED로 확대적용 - 신규재료 및 공정기술 개발로 패널 Dead Space 최소화 - 48~120Hz 가변주사율 노트북 OLED 최초 적용으로 소비전력 감소
		HP Elitebook용 16" OLED개발 (2023.04.)	<input type="checkbox"/> OLED 유기재료 성능개선으로 저소비전력, 장수명 달성 - 16" WQ+ (2,880 x 1,800, 16:10) - 48~120Hz, VRR (Variable Refresh Rate) 적용하여 AMD Freesync Premium Pro 인증, 최적 Game환경제공
		Google Pixel 8pro용 OLED개발 (2023.10.)	<input type="checkbox"/> 고효율, 장수명 OLED 신규재료 적용으로 고휘도 (HBM 1,600nits, Peak 2,400nits), 저소비전력 구현 - 6.7" WQXGA+ (1,344 x 2,992) - 1~120Hz, VRR (Variable Refresh Rate) 및 Dead Space 최소화 기술 적용
		Galaxy S24 AMOLED개발 (2024.01.)	<input type="checkbox"/> Galaxy S24 (6.16"FHD+, 6.66"WQ+, 6.79WQ+) - 고해상도 저소비전력 기술과 패널 Dead Space 최소화 기술 적용 - 고해상도에서 고휘도 및 저전력, Slim Bezel구현. 화질 특성 및 사용자 체감성능 향상
		31.5"UHD, 27"QHD QD-OLED개발 (2024.01.)	<input type="checkbox"/> 31.5"(140ppi), 27"(360Hz) QD-OLED 모니터개발 - 초정밀 잉크젯 프린팅 기술 및 당사 고유 AI 기반 구동 알고리즘 기술로 고해상도(140ppi), 고주사율(360Hz) 자발광 제품 개발
		BMW Mini 13.4" 185ppi개발 (2024.06.)	<input type="checkbox"/> 13.4", 차량 Center Information Display용 Round OLED Display (1,752 x 1,660) - Automotive向 Round Shape 최초 적용 - 新 보상회로 및 패널구조 개발로, 비정형 Display의 영역별 균일특성 확보 - 대면적 비정형 OCTA 기술 개발
		Surface Pro 10 개발 (2024.05.)	<input type="checkbox"/> 13" WQ+ (2,880x1,920, 3:2) - 30Hz 저주파 구동 노트북 OLED 최초 적용 (30~120Hz 가변주사율)으로 저소비전력 구현
		Galaxy Z Fold6용플 더블 OLED개발 (2024.07.)	<input type="checkbox"/> 7.61" (2,160x1,856) 폴더블용 Display - 광효율 및 시인성 개선 新패널 구조/재료 적용으로 저소비전력 구현, 화질 개선 - 폴더블 내구성 향상 구조/재료 적용
		Google Pixel 9proXL용 OLED개발 (2024.09.)	<input type="checkbox"/> 7.65" 고화질/저전력 스마트폰용 Display · 1,344 x 2,992, Peak 휘도 3,000nit - 저소비전력 패널 구조와 고효율 신규 유기재료 적용으로 밝기와 수명, 화질 개선 및 소비전력 10% 감소

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계